金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职

责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

引 言

为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在发行人保证提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签名、印章是真实的，并已履行该等签名和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经相关机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得相关机构确认的，对相关内容进行核查和验证后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

在本法律意见书和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本法律意见书和《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告及境外法律意见的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书和《律师工作报告》仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会和证券交易所的审核要求引用本法律意见书或《律师工作报告》的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
公司/发行人/晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
晶合有限	指	发行人前身合肥晶合集成电路有限公司
日本晶合	指	晶合日本株式会社，发行人全资子公司
北京晶芯成	指	晶芯成（北京）科技有限公司，发行人全资子公司
南京晶驱	指	南京晶驱集成电路有限公司，发行人全资子公司
上海晶合	指	合肥晶合集成电路股份有限公司上海分公司，发行人分公司
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
力晶科技	指	力晶科技股份有限公司
美的创新	指	美的创新投资有限公司
中安智芯	指	合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
惠友豪创	指	深圳市惠友豪创投资合伙企业（有限合伙）
合肥存鑫	指	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司
杭州承富	指	杭州承富投资管理合伙企业（有限合伙）
泸州隆信	指	泸州隆信投资合伙企业（有限合伙）
宁波华淳	指	宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
中小企业基金	指	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
安华创新	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司
合肥晶煅	指	合肥晶煅企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶遂	指	合肥晶遂企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶炯	指	合肥晶炯企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶咖	指	合肥晶咖企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶珏	指	合肥晶珏企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶梢	指	合肥晶梢企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶柔	指	合肥晶柔企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶恳	指	合肥晶恳企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持

		股平台
合肥晶本	指	合肥晶本企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶洛	指	合肥晶洛企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶辽	指	合肥晶辽企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶确	指	合肥晶确企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶铁	指	合肥晶铁企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶妥	指	合肥晶妥企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶雄	指	合肥晶雄企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人员工持股平台
合肥晶策	指	合肥晶策企业管理有限公司，为发行人员工持股平台的管理机构
保荐机构/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
合肥市市监局	指	合肥市市场监督管理局
合肥市工商局	指	原合肥市工商行政管理局，现已整合为合肥市市监局
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
《合资合同》	指	根据上下文意所需，指当时有效的《关于合肥晶合集成电路有限公司之合资合同》
《发起人协议》	指	合肥建投、合肥芯屏、力晶科技、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶煅、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶恳、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄于 2020 年 11 月 5 日共同签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指当时有效的《中外合资经营企业合肥晶合集成电路有限公司章程》、《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》
《发行人章	指	发行人为本次发行上市而修订的公司章程，经发行人于 2021

程》		年 2 月 9 日召开的第一届董事会第三次会议及于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，自发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之日起生效实施
《股东大会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》
《关联交易实施细则》	指	发行人于 2020 年 11 月 20 日召开的创立大会审议通过的《合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《编报规则第 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部令第 41 号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部公告[2010]33 号）
《私募基金登记备案办法》	指	中国证券投资基金业协会于 2014 年 1 月 17 日发布并于 2014 年 2 月 7 日实施的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（中基协发[2014]1 号）
《私募基金管理办法》	指	中国证监会于 2014 年 8 月 21 日发布并实施的《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第 105 号）
台湾理律	指	理律法律事务所新竹事务所
台湾杰宇	指	杰宇法律事务所
日本律师	指	King & Wood Mallesons Law Offices (Foreign Law Joint Enterprise)
《律师工作报告》	指	《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》
《台湾理律法律意见书》	指	台湾理律于 2021 年 4 月 20 日出具的关于晶合集成的法律意见书
《台湾杰宇法	指	台湾杰宇于 2021 年 1 月 22 日出具的关于力晶科技的法律意见

律意见书》		书
《日本法律意见书》	指	日本律师于 2021 年 3 月 12 日出具的关于日本晶合的法律意见书
《审计报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《审计报告》（[2021]230Z0089），包括后附的经审计的发行人的财务报表及其附注
《内控报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（[2021]230Z0141）
《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》	指	容诚为本次发行上市于 2021 年 2 月 9 日出具的《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（[2021]230Z0143）
《招股说明书（申报稿）》	指	《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
报告期/最近三年	指	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
中国台湾	指	中华人民共和国台湾地区
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）
元	指	人民币元

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正文

一、本次发行上市的批准和授权

（一）本次发行上市的批准

根据发行人提供的第一届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会的会议通知、会议议案及会议决议并经本所律师核查，发行人于 2021 年 2 月 9 日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案；发行人于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

经本所律师核查，发行人第一届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本所认为，发行人本次发行上市已获得公司 2020 年年度股东大会的批准，该次股东大会的召开程序、决议内容合法有效。

（二）本次发行上市的授权

发行人 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，授权董事会及其授权人士（董事长蔡国智先生、董事会秘书朱才伟先生）全权办理本次发行上市有关具体事宜。

经本所律师核查，发行人股东大会已授权董事会办理本次发行上市事宜，上述授权范围、程序合法有效。

综上，本所认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权；发行人本次发行尚待上交所科创板股票上市委员会审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人发行上市的主体资格

发行人系由晶合有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，自2015年5月19日晶合有限成立之日起计算，发行人持续经营时间已超过3年。

发行人现持有合肥市市监局于2020年11月25日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q），注册资本：人民币 1,504,601,368 元；住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号；法定代表人：蔡国智；公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）；成立日期：2015年5月19日；营业期限：长期；经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人依法有效存续

根据本所律师登录国家企业信用信息公示系统进行查询与检索，发行人自设立至今依法有效存续，不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的需要终止的情形。

（三）发行人的组织机构

发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并建立了独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会工作制度，聘请了高级管理人员，设置了若干职能部门。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条之规定，发行人具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

（一）本次发行上市符合《证券法》的相关条件

1、发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据《审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、根据《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及发行人书面说明，并经本所律师登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn）、中国检察网（http://www.12309.gov.cn）等网站查询，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本法律意见书“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《审计报告》《内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《审计报告》；根据《内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《内控报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）如本法律意见书“五、发行人的独立性”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）如本法律意见书“八、发行人的业务”所述，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本法律意见书“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本法律意见书“六、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本法律意见书“十、发行人的主要财产”“十一、发行人的重大债权债务”及“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本法律意见书“八、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（2）如本法律意见书“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

（3）如本法律意见书“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》及其在中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果并访谈发行人董事、监事和高级管理人员，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（三）本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（申报稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（申报稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元，符合《上市规则》第2.1.2条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第2.1.1条第（四）项的规定。

综上，本所认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

四、发行人的设立

（一）发行人设立的程序、方式

发行人系由晶合有限整体变更设立的股份有限公司，其整体变更为股份有限公司时履行了以下程序：

2020年10月19日，容诚出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994号），经审计，截至2020年9月30日，晶合有限账面净资产值为7,353,140,545.50元。

2020年10月21日，中水致远出具《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020502号）。根据该报告，截至2020年9月30日，晶合有限的净资产评估值为918,198.75万元。2020年11月9日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

2020年10月21日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，公司全体股东作为发起人以公司按截至2019年9月30日经容诚审计的账面净资产值7,353,140,545.50元为基础，按1:0.20462的比例折合1,504,601,368股，公司的注册资本变更为1,504,601,368元，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

2020年11月5日，晶合有限全体股东签署《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》。

2020年11月20日，晶合有限召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备情况的报告的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹备费用的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》

等议案，选举产生第一届董事会董事、第一届监事会监事，并授权公司董事会办理工商注册登记及相关事宜。

2020 年 11 月 20 日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]第 230Z0263 号），对晶合有限整体变更为股份有限公司的情况予以审验。

2020 年 11 月 25 日，合肥市市监局向晶合集成换发《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。根据合肥市人民政府办公厅发布的《加快推进“三证合一”登记制度改革工作方案》相关规定，发行人取得由工商行政管理部门核发的营业执照后，无需另行申领税务登记证书。

综上，本所认为，发行人设立的程序、方式等符合有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。

（二）发行人的设立资格和条件

经本所律师核查，发行人具备《公司法》第七十六条、第七十八条规定的股份有限公司设立的资格和条件，具体如下：

1、发起人共有 30 名，符合法定人数，且半数以上在中国境内有住所；

2、发起人缴纳的注册资本为 1,504,601,368 元，符合《公司章程》规定的全体发起人认购的股本总额；

3、发起人将其在晶合有限的权益所对应的净资产投入发行人，并折算为各发起人所持有的发行人的股份，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变，股份发行、筹办事项符合法律规定；

4、发起人共同签署《公司章程》；

5、发行人有公司名称，并且设立了股东大会、董事会、监事会、总经理等股份有限公司应当具备的组织机构；

6、发行人注册于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，具有公司住所。

综上，本所认为，发行人设立的资格、条件等符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人设立过程中签订的改制重组合同

经本所律师核查，发行人不存在国有企业、集体企业改制而来的或历史上存在挂靠集体组织经营的情形。2020 年 11 月 5 日，晶合有限全体股东签署《发起人协议》，约定了改制方案，股份公司的名称、住所，公司的经营宗旨和经营范围，公司设立的方式、组织形式，公司注册资本、股份总额、发起人认购股份的数额、形式及期限，发起人的权利和义务，费用承担等重要事项。

本所认为，《发起人协议》的签署符合有关法律、法规和规范性文件规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（四）发行人设立过程中的审计、资产评估及验资事项

1、发行人设立过程中的审计事项

根据容诚于 2020 年 10 月 19 日出具的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3994 号），截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限账面净资产值为 7,353,140,545.50 元。

2、发行人设立过程中的资产评估事项

根据中水致远于 2020 年 10 月 21 日出具的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的《合肥晶合集成电路有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 020502 号），截至 2020 年 9 月 30 日，晶合有限的净资产评估值为 918,198.75 万元。2020 年 11 月 9 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《国有资产评估项目备案表》。

3、发行人设立过程中的验资事项

根据容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），晶合集成登记的注册资本为人民币 1,504,601,368 元，由晶合有限全体股东以其拥有的晶合有限截至 2020 年 9 月 30 日止的净资产缴纳 7,353,140,545.50 元，并按照 1:0.20462 比例折合股本 1,504,601,368 元，整体变更后的股本与整体变更前的注册资本保持一致，资本公积和未分配利润在整体变更前后保持不变。

综上，本所认为，发行人设立过程中有关审计、资产评估、验资等已履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）发行人创立大会的程序及所议事项

根据发行人提供的创立大会会议通知、议案及决议并经本所律师核查，发行人于 2020 年 11 月 20 日召开创立大会，审议通过《关于合肥晶合集成电路股份有限公司筹办情况的报告的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司章程>的议案》《关于选举合肥晶合集成电路股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举合肥晶合集成电路股份有限公司第一届监事会成员的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事薪酬的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于制定并实施<合肥晶合集成电路股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于设置董事会专门委员会的议案》《关于授权办理合肥晶合集成电路股份有限公司设立相关事宜的议案》。

经核查，本所认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（六）改制中是否存在侵害债权人合法权益情形

2020 年 10 月 21 日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，整体变更后的注册资本为 1,504,601,368 元，未高于晶合有限经审计的净资产额 7,353,140,545.50 元，同时，公司的一切资产及债权、债务，由依法变更后的股份公司

继承，不存在通过自身资产的调整或者企业间资产转移等行为侵害债权人合法利益的情形。

经查询中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等，截至本法律意见书出具日，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

综上，本所认为，发行人改制中不存在侵害债权人合法权益的情形，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

五、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料和发行人书面说明，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人依法经营，发行人独立开展业务并对外签署合同，其业务独立于发行人控股股东及其控制的其他企业。如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”所述，截至本法律意见书出具日，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或显失公平的关联交易。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的业务独立。

（二）发行人的资产独立、完整

根据容诚出具的《审计报告》《验资报告》、发行人提供的工商档案文件、相关资产权属证明等文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人不存在部分资产来自于上市公司的情形；发行人设立及历次增资时的出资均已经会计师事务所验资，发行人的注册资本已足额缴纳。如本法律意见书“十、发行人的主要财产”所述，发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；发行人主要生产经营厂房系向控股股东下属子公司合肥蓝科投资有限公司租赁，相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市

人民政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一，发行人能够长期使用上述厂房、土地，不会对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的资产独立、完整。

（三）发行人的人员独立

根据发行人高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》和发行人书面说明，经本所律师核查，报告期内，发行人存在合肥建投、力晶科技向发行人委派高级管理人员的情形，具体包括：合肥建投曾向发行人委派销售副总监周义亮（曾兼任采购副总监），采购副总监王继武，总会计师朱才伟，审计师、敬业管理委员会委员长、行政副总朱晓娟，审计师、敬业管理委员会委员长杨幼玲；力晶科技曾向发行人委派副总会计师邱垂源、李伽谕，行政副总经理刘荫，审计师陈美华、潘炯升。截至本法律意见书出具日，公司高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

截至本法律意见书出具日，发行人的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的人员独立。

（四）发行人的机构独立

根据《内控报告》《公司章程》等公司内部治理文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人已按照《公司法》及《公司章程》的规定，设立股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等机构，聘请高级管理人员，发行人按照自身经营管理的需要设置了相关职能部门，已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的机构独立。

（五）发行人的财务独立

根据《内控报告》、发行人财务会计制度和发行人书面说明，经本所律师通过对发行人财务负责人访谈等方式进行核查，发行人设立了独立的财务部门，已建立独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策；发行人具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人的财务独立。

（六）发行人具有面向市场自主经营的能力

根据《内控报告》、发行人说明以及本所律师对发行人经营场所的实地调查结果，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务；发行人拥有业务经营所需的资质许可，独立从事经营范围内的业务，其业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系；发行人具有健全的内部组织结构，独立地面向市场进行经营活动。

本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人拥有业务经营所需的资质许可，独立从事经营范围内的业务，其业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人的业务独立、人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整，具有面向市场自主经营的能力。

六、发起人和股东

（一）发起人的资格

根据发行人提供的工商档案资料，并经本所律师核查，发行人整体变更为股份有限公司的发起人共 30 名，分别为合肥建投、合肥芯屏、力晶科技、美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成、合肥晶煅、合肥晶遂、合肥晶炯、合肥晶咖、合肥晶珏、合肥晶梢、合肥晶柔、合肥晶恳、合肥晶本、合肥晶洛、合肥晶辽、合肥

晶确、合肥晶铁、合肥晶妥、合肥晶雄，该等发起人分别以其持有的晶合有限股权所对应的净资产作为对发行人的出资。

各发起人的具体情况详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。经本所律师核查，本所认为，各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。

（二）发起人的人数、住所、出资比例

根据发行人《公司章程》《发起人协议》及容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司（筹）验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号）并经本所律师核查，发行人股份公司设立时，发起人共计 30 名。各发起人的住所情况详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

综上，本所认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人的现有股东

经本所律师核查，自发行人设立至本法律意见书出具日，发行人的股份结构未发生变化，发行人的现有股东即发行人的发起人。

（四）发行人现有股东之间的关联关系

根据发行人股东提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人现有股东之间存在的关联关系情况如下：

合肥建投直接持有合肥芯屏 47.44%的合伙份额，并通过持有合肥芯屏普通合伙人合肥建投资本管理有限公司 70.83%的股权控制合肥芯屏。发行人 15 个员工持股平台的普通合伙人均为合肥晶策，系发行人员工持股平台的管理机构。

除上述情况外，发行人股东之间不存在关联关系。

（五）发行人的控股股东及实际控制人

1、发行人的控股股东及实际控制人的认定

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，合肥建投直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份；发行人董事会中，6 名董事由合肥建投提名，合肥建投系发行人的控股股东。合肥市国资委持有合肥建投 100%的股权，系发行人的实际控制人。经核查，发行人控股股东、实际控制人不存在设立在国际避税区且持股层次复杂的情形。

2、发行人实际控制人近两年未发生变更

经本所律师核查，报告期内，合肥建投支配发行人 50%以上的股权，委派或提名发行人半数以上董事，合肥建投实际支配的表决权足以对发行人董事会、股东大会的决议产生重大影响；合肥建投的唯一股东为合肥市国资委。本所认为，发行人最近两年实际控制人未发生变更。

（六）发起人的出资

1、根据《发起人协议》《公司章程》及容诚于 2020 年 11 月 20 日出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司（筹）验资报告》（容诚验字[2020]230Z0263 号），并经本所律师核查，发行人系由其前身晶合有限以其经审计净资产值折股整体变更而来，各发起人均以其所持晶合有限股权所对应的净资产作为对发行人的出资。各发起人投入发行人的资产产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

2、经本所律师核查，发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，发行人不存在将全资附属企业或其他企业先注销再折价入股或以在其他企业中的权益折价入股的情形。

3、经本所律师核查，发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人以其对晶合有限出资形成的权益所对应的净资产折为其所拥有的发行人的股份，晶合有限的资产、业务和债权、债务全部由发行人承继，相应的资产或权利的权属证书所有人名称已变更为发行人或正在办理变更为发行人的手续。

（七）员工持股计划

1、员工持股计划的人员构成

发行人 15 个员工持股平台的人员构成详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

本所认为，发行人员工持股计划的人员构成符合公司《员工持股管理办法》的规定。

2、减持承诺

根据公司《员工持股管理办法》，员工持股平台不在公司首次公开发行股票时转让股份，并自公司上市之日起锁定 36 个月。

发行人 15 个员工持股平台作为发行人股东，分别出具了《关于股份锁定的承诺函》，就所持发行人股份的锁定期承诺如下：自晶合集成本次发行上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份，也不由晶合集成回购本公司/本企业在本次发行上市前直接或间接持有的晶合集成股份。

本所认为，发行人员工持股平台上述锁定承诺符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所的相关规定。

3、员工持股平台的具体安排及规范运行情况

2020 年 9 月 10 日，晶合有限董事会通过《员工持股管理办法》，对于员工加入及退出员工持股平台进行了明确规定，具体如下：

（1）员工加入持股平台的相关规定

根据公司《员工持股管理办法》，除非另有规定，在经批准的员工持股计划实施方案范围内，公司相关员工达到公司考核标准后，经员工持股平台管理人书面同意，可以取得员工持股平台的股权/出资份额。如直系亲属多人在公司的，只能一人持股。员工持股计划实行以岗定股，相关员工不得存在以下情形：最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；最近 36 个月内存在损害公司利益的情形的；存在《公司法》第 148 条规定的行为，违反其对公司、子公司或任职关联企业的忠实义务的；为各级党委、政府及其部门、机构任命的国有

企业领导人员；为公司外部董事、监事（含职工代表监事）；法律法规规定不得参与员工持股计划的。

（2）员工退出持股平台的相关规定

根据公司《员工持股管理办法》，除非另有规定，并经员工持股平台管理人事先书面同意，于禁售期届满前员工不得向第三人（包括员工持股平台的其他员工）转让其在员工持股平台中的全部或部分股权/财产份额。员工违反本办法擅自转让的，该转让行为无效并应当赔偿由此给员工持股平台造成的损失。

根据公司《员工持股管理办法》，于禁售期届满前，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人（或其指定的符合条件的人士；下同）转让其持有的员工持股平台全部股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

于禁售期届满后，员工因任何原因（包括但不限于解除或终止劳动合同关系、退休、丧失民事行为能力、死亡等）自公司或其子公司或关联企业离职的，则该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应当向员工持股平台管理人转让其持有的、尚未完全解除出售限制的全部员工持股平台股权/财产份额，但另有约定或员工持股平台管理人书面同意的除外。员工（或其继承人、法定代理人或监护人）按照规定向员工持股平台管理人转让其股权/财产份额的，转让价格由交易双方协商确定，员工持股平台向该等员工支付转让价款时将扣减相应的税费。

除另有约定或员工持股平台管理人书面同意的外，无论员工因任何原因离职，该员工（或其继承人、法定代理人或监护人）应于其提出离职之日起 15 个自然日内（以下简称出售期限）向员工持股平台管理人发出指示，按规定出售/减持其持有的员工持股平台股权/财产份额。出售期限届满后，员工未向员工持股平台管理人发出出售/减持指示的，员工持股平台管理人有权自主决定出售/减持上述员工持有的股权/财产份额，

且无须对此承担法律责任。离职员工持有的未经解除出售限制的股权/财产份额，依照前述规定办理。

员工持股平台的合伙人如存在与发行人解除或终止劳动合同关系的情形，经员工持股平台管理人事先同意后，向员工持股平台管理人及其指定的符合条件的人士转让。

（3）员工持股平台的规范运行情况

根据发行人书面说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人 15 个员工持股平台中的有限合伙人均为发行人在职员工，符合《员工持股管理办法》的相关规定，具体情况详见《律师工作报告》“六、发起人和股东”之“（一）发起人的资格”。

4、是否履行登记备案程序

发行人的员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，除投资发行人外，未开展其他经营活动。本所认为，发行人的员工持股平台不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需按照规定履行私募投资基金备案程序。

七、发行人的股本及其演变

（一）发行人设立时的股本结构

发行人设立时的具体情况详见《律师工作报告》“四、发行人的设立”。经本所律师核查，本所律师认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效。

（二）发行人及其前身的历次股权变动情况

发行人及其前身的历次股权变动情况详见《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。

经本所律师核查，本所认为，发行人历史上不存在工会、职工持股会持股或者自然人股东人数较多等情形，发行人历次股权变动均合法、有效。

（三）国有股东标识管理

2021 年 3 月 19 日，合肥市国资委出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（合国资产权[2021]27 号）。根据该批复，合肥市国资委同意将合肥建投所持发行人的股份界定为国有法人股，其证券账户应标识为“SS”。

（四）发行人股份质押情况

根据发行人及其全体股东出具的书面确认并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），截至本法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

八、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人现持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），发行人的经营范围为“集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

发行人境内子公司的经营范围详见本法律意见书“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件、发行人书面确认并经核查，本所认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据发行人说明、《审计报告》并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发

行人境外子公司的具体情况详见本法律意见书“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）主营业务变更情况

根据《审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，发行人最近两年内主营业务未发生变更。

（四）主要业务资质、许可或备案

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人拥有的主要经营资质证书情况如下：

资质名称	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
辐射安全许可证	皖环辐证[A0390]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2020 年 6 月 5 日至 2022 年 5 月 21 日
排污许可证	91340100343821433Q001W	合肥市生态环境局	2019 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
对外贸易经营者备案登记表.	02360936	-	-
海关进出口货物收发货人备案	3401660005	庐州海关	2020 年 7 月 8 日至长期

（五）发行人的主营业务

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人书面确认，截至本法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。

（六）发行人的持续经营能力

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》《企业信用报告》以及发行人的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

（七）发行人合作研发的相关情况

发行人目前 CIS 技术平台分别与合肥海图微电子有限公司、思特威（上海）电子科技有限公司进行合作开发，PMIC 技术平台与杰华特微电子（杭州）有限公司进行合作开发。报告期内，发行人 CIS、PMIC 工艺平台对营业收入贡献较小。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人的主要关联方如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥建投的具体情况，详见本法律意见书“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业

截至本法律意见书出具日，除发行人及其控股子公司以外，发行人控股股东直接或间接控制的其他主要企业如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥芯屏	2016 年 1 月 18 日	合肥市包河区武汉路 229 号	投资管理、资产管理；投资咨询。
2	合肥蓝科投资有限公司（以下简称合肥蓝科）	2008 年 11 月 5 日	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。
3	合肥燃气集团有限公司（以下简称合肥燃气）	1995 年 11 月 13 日	合肥市蜀山区合作化南路 466 号	燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。
4	合肥供水集团有限公司（以下简称合肥供水）	1994 年 7 月 21 日	安徽省合肥市屯溪路 70 号	自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
5	合肥蜀山百大购物中心有限公司（以下简称百大购物）	2012 年 6 月 27 日	安徽省合肥市蜀山区望江西路 218 号	预包装食品批发兼零售（在许可证有效期内经营）；保健食品销售（李宝赢堂牌参茸酒）（在许可证有效期内经营）；日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电、化工产品（除危险品）、文体用品、办公用品、金银珠宝玉器、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺品、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、儿童用品销售；卷烟零售；合肥通卡代收代付（在协议范围内经营）；物业服务；企业管理咨询；房屋租赁。
6	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称百大合家福）	2000 年 6 月 15 日	安徽省合肥市沿河路 118 号	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销售（除国家限制项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目；特殊医学用途配方食品销售；网络表演；为本超市销售产品提供配送服务。
7	合肥市建设投资有限公司	1992 年 4 月 15 日	合肥市滨湖新区武汉路 229 号	项目投资、股权投资、资产重组及并购（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁。
8	合肥市交通投资控股有限公司	2004 年 2 月 11 日	安徽省合肥市梅山路 77 号	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务；城乡交通基础设施及相关产业的投资与运营；营运授权范围内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务；实业投资；旅游项目的投资开发。
9	合肥城建投资控股有限公司	2001 年 12 月 6 日	合肥市滨湖区武汉路 229 号	城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易，房屋租赁。
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	1996 年 7 月 29 日	安徽省合肥市长江中路 150 号	预包装食品、酒、乳制品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输，土产品、纺织品、服装、工艺美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务，黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。
11	合肥丰乐种业股份有限公司	1997 年 4 月 16 日	合肥市蜀山区创业大道 4 号	农作物种子、种苗生产、销售；大米、芝麻、棉花生产、销售；肥料销售；农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售；粮食作物、油料作物种植、储藏、运输、销售；农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；农业高新技术开发及成果转让；农业技术咨询、技术服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。
12	合肥科融高科技产业投资有限公司	2009 年 11 月 10 日	安徽省合肥市滨湖新区武汉路 229 号	高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理。
13	合肥市轨道交通集团有限公司	2009 年 6 月 2 日	安徽省合肥市阜阳路 17 号	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售；轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告。
14	合肥金太阳能源科技股份有限公司	2010 年 12 月 30 日	安徽省合肥市高新区黄山路 630 号	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。
15	合肥文旅博览集团有限公司	2002 年 4 月 30 日	安徽省合肥市政务文化新区习友路 988 号	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产经营管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。
16	合肥市水务环境建设投资有限公司	2000 年 8 月 8 日	安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼	水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。
17	合肥通航控股有限公司	2015 年 10 月 19 日	合肥市包河区徽州大道 1 号骆岗机场	机场运营、资产管理、设备维修、物业管理、企业管理、投资咨询、企业策划、航空投资、计算机系统集成、数据处理。
18	合肥建投资本管理有限公司	2016 年 1 月 11 日	合肥市包河区武汉路 229 号	投资管理、资产管理。
19	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	2013 年 1 月 9 日	安徽省合肥市包河区包河大道 398 号建投综合办公区 A 座 8-9 楼	农业、文化旅游产业项目投资及运营管理；农村基础设施建设及人居环境建设；乡村旅游开发；特色小镇开发及田园综合体开发；农产品生产种植与销售；城市基础设施建设；土地整治；土地储备业务。
20	安徽环巢湖生态发展有限公司	2004 年 10 月 18 日	安徽省巢湖市巢庐路（原东庵林场）	生态产业投资与建设，休闲旅游产业、文化旅游产业的投资与运营，旅游景区的开发、建设、运营，旅行社、旅游交通服务，文化演艺与婚庆、展览服务，旅游商品开发与销售，酒店管理，物业管理，会议、培训服务，旅游策划与管理咨询，文化体育运动的组织与服务。
21	合肥市电动汽车充电设施投资运营	2015 年 2 月 15 日	合肥市蜀山区合作化南路 466 号燃气大厦 22-24	电动汽车充、换电设施的投资运营、建设及网络规划、设计；电动汽车充、换电服务；售电业务；电

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	有限公司		层	动汽车采购、销售；销售汽车配件；电动汽车租赁；计算机信息系统及互联网技术开发和服务；发布国内广告；充、换电设施及零部件的销售、维修服务；停车场运营管理。
22	合肥市综合管廊投资运营有限公司	2016 年 12 月 23 日	合肥市包河区武汉路 229 号建投大厦	城市地下综合管廊或管沟等的投资、建设及运营管理工作；地下空间开发及运营；资产管理及物业管理。
23	合肥融科项目投资有限公司	2010 年 11 月 11 日	合肥市新站区大禹路与东方大道交口西北角合肥综合保税区进口商品展示中心大楼 12-14 层	项目投资。
24	合肥市引江济淮投资有限公司	2017 年 8 月 30 日	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路 118 号	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。
25	合肥市建庐建设投资有限公司	2017 年 12 月 21 日	合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 15 层	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。
26	安徽中安智通科技股份有限公司	2015 年 12 月 16 日	合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号	城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售；城市交通项目投资；交通设施和器材的研发、设计、制作、安装及维护维修；机械式立体停车设备、智能车位引导等自动化控制系统及系统集成的研发设计、生产制造销售、技术服务；停车场相关设计施工、技术服务、管理服务；软件开发；广告发布、传媒灯箱、信息咨询服务；住房及商用房租赁；物业管理。
27	合肥市住房租赁发展股份有限公司	2020 年 5 月 18 日	安徽省合肥市蜀山区长江西路 460 号合房租赁办公区	住房租赁，商业房产运营，房地产开发、咨询、代理、经纪，房屋建筑工程施工，室内外装饰工程设计施工，酒店管理，物业管理，停车场（库）运营，户外广告、道路绿

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				化及工程施工咨询，家具及家用电器用品出租服务，计算机和网络技术服务，互联网信息服务。

此外，过去 12 个月内发行人控股股东直接或间接控制的其他企业亦为发行人的关联方。

3、发行人的控股子公司

截至本法律意见书出具日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司，在中国境外拥有 1 家控股子公司。上述公司的具体情况，详见本法律意见书“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人现任董事、监事、高级管理人员以及过去 12 个月内曾经担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方，上述人员的具体情况，详见本法律意见书“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

截至本法律意见书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	智慧记忆科技股份有限公司	蔡国智担任董事、郑素芬担任董事
2	Xsense Technology Corporation	蔡国智担任董事
3	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、黄颢担任董事兼副总经理
4	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
5	合肥建投资本管理有限公司	黄颢担任董事
6	合肥德轩投资管理有限公司	黄颢担任董事
7	合肥京东方显示技术有限公司	黄颢担任董事长
8	合肥市信实产业投资基金（有限合伙）	黄颢担任执行事务合伙人委派代表
9	合肥奕斯伟封测控股有限公司	黄颢担任董事
10	合肥颀中封测技术有限公司	黄颢担任董事
11	合肥维信诺科技有限公司	黄颢担任董事
12	蔚来控股有限公司	黄颢担任董事
13	启迪新基建产业（合肥）集团有限公司	黄颢担任董事
14	合肥德电新能源汽车股份有限公司	黄颢担任董事
15	合肥神州数码信创控股有限公司	黄颢担任董事
16	智丰科技股份有限公司	郑素芬担任总经理
17	新相科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
18	顺立投资股份有限公司	郑素芬担任董事
19	瑞相科技股份有限公司	郑素芬担任董事
20	晶相光电股份有限公司	郑素芬担任董事
21	力相光学股份有限公司	郑素芬担任董事
22	宏丽数位创意股份有限公司	郑素芬担任董事
23	智合精准医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
24	智成电子股份有限公司（以下简称智成电子）	郑素芬担任董事
25	景睿科技股份有限公司	郑素芬担任董事
26	集邦科技股份有限公司	郑素芬担任董事
27	智仁科技开发股份有限公司	郑素芬担任董事
28	智高医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
29	英达投资股份有限公司	胡竞英担任董事长且控制
30	疯狂秀股份有限公司	胡竞英担任董事
31	中兴农林开发股份有限公司	胡竞英担任董事
32	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	胡竞英担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
33	合润生活国际有限公司	胡竞英担任董事

此外，过去 12 个月内发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至本法律意见书出具日，除合肥建投以外，直接持有发行人 5%以上股份的股东为合肥芯屏、力晶科技、美的创新。

美的集团股份有限公司直接持有美的创新 70%的股权，并通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司间接持有美的创新 30%的股权，亦系发行人的关联方。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织

截至本法律意见书出具日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织包括：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	力信投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
2	世仁投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
3	富硕投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
4	Sprout International Limited	力晶科技直接或间接控制
5	智典国际股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
6	世成科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
7	智仁科技开发股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
8	智慧记忆体科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
9	Deutron Japan Corp.	力晶科技直接或间接控制
10	智翔投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
11	智成电子	力晶科技直接或间接控制

序号	关联方名称	关联关系说明
12	力相光学股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
13	广东美云智数科技有限公司	美的创新直接或间接控制
14	深圳数智场景定位科技有限公司	美的创新直接或间接控制
15	上海美仁半导体有限公司	美的创新直接或间接控制

此外，过去 12 个月内直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

（1）直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2020 年 12 月 31 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	合肥建投董事
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	黄颢	合肥建投董事兼副总经理
5	倪敬东	合肥建投董事
6	吴子能	合肥建投董事
7	杨雪蕾	合肥建投董事
8	黄跃明	合肥建投监事
9	杨国庆	合肥建投监事
10	范红金	合肥建投监事
11	田胜彬	合肥建投监事
12	朱庆	合肥建投监事
13	罗文萍	合肥建投高级管理人员

过去 12 个月内曾经担任合肥建投董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方。

（2）前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织

前述关联自然人中，陆勤航、黄灏亦系发行人董事。除陆勤航、黄灏外，其他关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥维信诺科技有限公司	李宏卓担任董事长
2	合肥建投资本管理有限公司	李宏卓担任董事长，陈小蓓、罗文萍担任董事
3	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
4	合肥芯屏	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
5	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
6	合肥市乡村振兴产业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
7	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
8	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
9	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事
11	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事
12	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
13	合肥市水务环境建设投资有限公司	吴子能担任董事长
14	合肥市铭城建设发展有限公司	吴子能担任董事长
15	合肥市环巢湖建设发展有限公司	吴子能担任董事长
16	合肥泽众城市智能科技有限公司	吴子能担任副董事长
17	安徽庐铜铁路有限公司	吴子能担任副董事长
18	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	吴子能担任副董事长
19	合肥新桥国际机场有限公司	吴子能担任副董事长
20	合肥龙和投资咨询有限公司	黄跃明担任董事兼总经理

序号	关联方名称	关联关系说明
21	合肥科融高科技产业投资有限公司	黄跃明担任执行董事兼总经理
22	合肥二号线轨道交通有限公司	田胜彬担任董事
23	合肥市建庐建设投资有限公司	杨雪蕾担任董事长，田胜彬担任董事
24	合肥建翔投资有限公司	田胜彬担任董事
25	合肥市建设投资有限公司	罗文萍担任执行董事兼总经理
26	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	杨雪蕾担任执行董事

除此之外，前述关联自然人过去 12 个月内曾经担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

（二）关联交易

根据《审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人报告期内关联交易的情况如下：

1、 向关联方采购商品及接受服务

报告期内，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
合肥建投	咨询服务	199.69	0.12%	672.40	0.63%	696.23	0.85%
合肥燃气	采购燃气	368.42	0.22%	303.58	0.28%	286.98	0.35%
合肥供水	采购厂区用水	308.09	0.19%	293.89	0.27%	516.43	0.63%
百大购物	采购商品	2.70	0.00%	-	-	-	-
百大合家福	采购商品	2.28	0.00%	-	-	-	-
力晶科技	采购商品及服务	160.17	0.10%	2,236.81	2.09%	1,890.24	2.32%
智成电子	采购服务	372.62	0.23%	152.95	0.14%	177.18	0.22%
关联采购合计		**1,413.97**	**0.86%**	**3,659.62**	**3.42%**	**3,567.06**	**4.37%**

2、 向关联方销售商品及提供服务

报告期内，发行人未向关联方销售商品及提供服务。

3、 关联租赁

报告期内，发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。根据发行人与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人作为承租方向合肥蓝科租入土地、厂房及配套厂务设施的具体情况如下：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合肥蓝科	土地	263.24	263.24	263.24
合肥蓝科	厂房及配套厂务设施	6,235.21	3,117.61	-

4、 关联担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
合肥建投	华泰资产管理有限公司（以下简称华泰资产）	1,300,000,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		300,000,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		420,000,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		900,000,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		80,000,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行股份有限公司合肥分行	809,397,599.99	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行股份有限公司合肥分行	668,360,017.01	借款发放日	2028/1/7	否	是
	中国银行股份有限公司合肥北城支行	492,833,531.73	借款发放日	2028/1/15	否	是

2017 年 12 月 14 日，合肥建投与中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称中国银行北城支行）签署了《最高额保证合同》，约定合肥建投为公司与中国银行北城支行签署的《授信额度协议》项下 70,000 万元授信提供连带责任保证担保，保证期间为《授信额度协议》生效之日至主债权期限届满之日起两年。

2017 年 12 月 28 日，合肥建投与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称平安银行合肥分行）签署了《最高额保证担保合同》，合肥建投为公司与平安银行合肥分行签署的《综合授信额度合同》项下 110,000 万元的债务提供最高额连带责任保证担保，担保期限至主合同项下债务完全清偿。

2017 年 12 月 29 日，合肥建投与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称兴业银行合肥分行）签署了《最高额保证合同》，合肥建投为公司与兴业银行合肥分行在保证额度有效期内最高本金限额 70,000 万元的债务提供连带责任保证担保，保证额度有效期自 2017 年 12 月 29 日至 2028 年 1 月 5 日止。

2018 年 8 月 20 日，合肥建投与华泰资产签署了《华泰－合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划保证担保合同》，合肥建投为公司与华泰资产签署的《华泰-合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划投资合同》项下本金 300,000 万元的债务提供连带责任保证担保，担保期间自同生效之日起至全部债务期限届满之日起两年。

根据公司与合肥建投签订的反担保合同及补充协议，公司就合肥建投为公司上述借款的担保以部分机器设备及原物料提供反担保。

5、 关联方资金拆借

报告期内，发行人作为借款人向关联方进行资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
合肥建投	75,500.00	2018/5/9	2018/10/18	4.35%
合肥建投	5,000.00	2018/5/2	2018/10/18	4.35%

2018 年 4 月 28 日，发行人与合肥建投、中国银行合肥北城支行签订人民币委托贷款合同，合同约定借款金额为 80,500.00 万元，借款期限为 6 个月，借款利率为 4.35%，按季结息。截至 2018 年 10 月 18 日，发行人和关联方的上述资金拆借情况已清理完毕。报告期内未再发生发行人与关联方资金拆借的情形。

6、 关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额分别为 1,002.60 万元、1,022.05 万元和 1,417.96 万元。

7、 关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	13.83	-	11.10	-	3.12	-
其他应收款	詹奕鹏	2.02	-	-	-	-	-
其他应收款	简瑞荣	0.18	-	-	-	-	-
其他应收款	朱才伟	-	-	7.30	-	1.20	-
其他应收	黎湘鄂	-	-	-	-	5.58	-

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
款							
其他应收款	谢明霖	-	-	0.90	-	-	-
其他应收款	合肥燃气	40.00	-	94.00	-	94.00	-
其他非流动资产	力晶科技	-	-	-	-	1,330.39	-

（2）应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应付款	周义亮	0.07	0.22	-
其他应付款	王燕	-	0.02	-
其他应付款	李泇谕	0.34	-	-
其他应付款	朱才伟	0.05	-	-
其他应付款	简瑞荣	-	-	0.80
其他应付款	合肥蓝科	712.94	444.12	338.05
应付账款	合肥蓝科	704.13	444.20	235.96
应付账款	力晶科技	7.44	-	1,376.54
应付账款	合肥燃气	27.18	5.02	5.93
应付账款	智成電子	189.74	92.01	75.05
长期应付款	合肥蓝科	180,182.88	183,938.79	187,056.39

注：其他应付个人款项主要为员工报销款；合肥蓝科长期应付款系发行人向合肥蓝科融资租赁厂房及配套厂务设备形成。

8、 其他关联交易事项

（1）《委托经营管理合约》的签订与解除情况

2015 年 10 月 19 日，晶合有限与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成 12 英寸晶圆制造厂项目。2020 年 1 月 2 日，公司与力晶科技签订了《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意自 2019 年 12 月 25 日起即终止《委托经营管理合约》。

（2）专利所有权的转让情况

2017 年 3 月，力晶科技使用 58 项专利技术使用权等专有技术向晶合有限增资。2020 年 9 月 3 日，力晶科技与晶合有限签署《专利转让协议》，约定将上述 58 项专利中尚在有效期内的 44 项专利的所有权无偿转让给晶合有限。截至本法律意见书出具日，前述 44 项专利的所有权已转让至晶合有限，相关专利具体情况详见本法律意见“七、发行人的股本及其演变”之“（二）发行人及其前身的历次股权变动情况”。

（三）关联交易的决策程序

1、报告期内关联交易所履行的决策程序

发行人于 2021 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第三次会议以及于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司 2018 年度至 2020 年度期间关联交易的议案》《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计>的议案》，对发行人在报告期内关联交易以及报告期后预计持续发生的日常关联交易的公允性进行了确认，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已就发行人报告期内关联交易出具了独立意见：“（1）上述关联交易事项审议程序和表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）合肥蓝科投资有限公司系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则确认为政府补助，计入递延收益，该等关联交易符合公司和全体股东的利益；（4）除此之外，公司其他与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。”

发行人于 2021 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第四次会议以及于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司与合肥建投签订反担保相关协议的议案》《关于公司与合肥蓝科签订<晶合二厂厂务及配套项目租赁合同>及<晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议>的议案》，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已就上述报告期外新增关联交易出具了独立意见：“（1）上述关联交易事项审议程序和

表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决；（2）上述关联交易事项均是为了满足公司日常正常业务开展的需要而进行，该等关联交易是必要、合理的；（3）公司与关联方的交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易事项经双方充分商业谈判达成相关条款，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。”

综上所述，发行人与关联方之间关联交易合同的签订和决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》及发行人内部规章制度的规定。本所认为，发行人与关联方进行上述关联交易已经公司董事会、股东大会审议或确认，独立董事就此事宜发表了相关意见，上述关联交易已经采取必要措施对其他股东的利益进行保护，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、发行人《公司章程》等对于关联交易决策程序的规定

发行人在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及上市后生效的《发行人章程》中，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序。

发行人除在上述制度中规定了关联交易决策程序的内容以外，还专门制定了《关联交易实施细则》。该制度就关联人的界定、关联交易的范围、关联人报备、关联交易披露及决策程序、关联交易定价、关联人及关联交易应当披露的内容、日常关联交易披露和决策程序的特别规定、关联交易披露和决策程序的豁免等内容进行了具体规定。

综上所述，本所认为，发行人已在其《公司章程》及其他内部规章制度中明确了关联交易的公允决策程序。

（四）减少和规范关联交易的措施

为规范及减少公司与关联方之间未来可能发生的关联交易，发行人控股股东及其他持股 5%以上的股东出具承诺如下：

1、发行人控股股东合肥建投就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

（3）本公司保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本公司及本公司直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

2、发行人控股股东的一致行动人合肥芯屏就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于与晶合集成经营活动相关的且无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件中关于关联交易的相关要求，履行晶合集成公司章程中关联交易决策程序，按照公平合理的原则确定关联交易价格，并依法履行信息披露义务。

（3）本企业保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、晶合集成的公司章程及相关制度行使相应权利，承担相应义务，不会利用控股股东一致行动人的地位谋求晶合集成及其控股子公司在业务经营等方面给予本企业及本企业直接或间接控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不通过关联交易损害晶合集成及其无关联关系股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给晶合集成造成的实际损失。”

3、其他持股 5%以上的股东出具的承诺

其他单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东力晶科技、美的创新就规范并减少关联交易事宜出具承诺如下：

“（1）本公司及本公司直接或间接控制的公司将尽量减少与晶合集成及其控股子公司的关联交易。

（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的公司将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

（3）保证将依照有关法律、法规、规范性文件、晶合集成章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移晶合集成及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害晶合集成除本公司之外的其他股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给公司造成的全部损失。”

（五）同业竞争

1、发行人控股股东及其控制的其他企业

发行人控股股东及其控制的其他企业的基本情况详见本法律意见书“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”以及本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（一）关联方”。

截至本法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

（六）避免同业竞争的承诺或措施

为了避免未来可能发生的同业竞争情况，合肥建投及合肥芯屏已分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

1、本企业目前一直公允地对待本企业直接或间接控制的其他企业，将来也不会利用控股股东（及其一致行动人）的地位谋求不正当利益或作出不利于晶合集成而有利于其他下属企业的任何决定，不会损害晶合集成及其他股东的合法权益。因违反本承诺函的任何条款而导致晶合集成及其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支，本企业将予以赔偿。

2、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，目前不存在、将来也不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与晶合集成及其控股子公司所从事的主营业务相同或相似业务的情形。

3、如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业从事了与晶合集成业务相同或相似的业务，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给晶合集成或其控股子公司，晶合集成享有优先受让上述资产或股权的权利。若晶合集成因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本企业，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。

4、如果本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将来可能存在任何与晶合集成业务产生竞争的业务机会，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将通知晶合集成并尽力促使该业务机会首先提供给晶合集成或其控股子公司，晶合集成或其控股子公司享有优先获取上述业务的权利。若晶合集成或其控股子公司因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业直接或间接控制的其他企业应确保不会导致与晶合集成产生同业竞争。

5、本企业及本企业直接或间接控制的其他企业不向晶合集成业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与晶合集成业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

6、本企业保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保晶合集成按照上市公司的规范独立自主经营，保证晶合集成的资产、业务、财务、人员、机构独立。

7、上述承诺于本企业作为晶合集成的控股股东（及其一致行动人）期间内持续有效。

（七）发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有或使用的主要财产情况如下：

（一）土地使用权及房屋所有权

1、自有物业

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 3 处，面积合计约 215,654.47 平方米。上述租赁房产及土地使用权的具体情况，详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

（二）在建工程

根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人在建工程的账面余额为 139,070.50 万元。

（三）知识产权

1、商标

根据发行人提供的《商标注册证》等相关文件、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家工商行政管理总局商标局查册结果并查询中国商标网（http://sbj.cnipa.gov.cn），并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 93 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 17 项，在中国境外注册的商标 76 项。该等商标的具体情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

2、专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查册结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（http://pss-system.cnipa.gov.cn），并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 54 项已授权专利，在中国境外共拥有 44 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

3、互联网域名

截至 2020 年 12 月 31 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（http://beian.miit.gov.cn），发行人及其子公司合法拥有 1 项注册域名。该等域名的具体情况如下：

序号	注册域名	注册所有权人	注册日期	到期日期
1	nexchip.com.cn	晶合集成	2015 年 9 月 16 日	2023 年 9 月 16 日

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（三）知识产权”。

（四）主要生产经营设备

根据《审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至 2020 年 12 月 31 日，机器设备的账面价值为 608,864.61 万元、电子设备及其他的账面价值为 3,347.06 万元、运输工具的账面价值为 0.21 万元。

（五）发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司及 1 家分支机构，在中国境外拥有 1 家控股子公司。具体情况详见《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、发行人说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，除本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”之“4、关联担保情况”所述发行人向合肥建投提供的反担保外，发行人及其子公司拥有的主要财产所有权或使用权不存在担保或其他权利受到限制的情况。

十一、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司签署的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同包括销售合同、采购合同、借款合同以及入区协议、一厂厂房租赁协议、90nm 项目技术协议、二厂厂务设施租赁及收购意向协议、合作框架协议以及授权使用 IP 相关协议，具体情况详见《律师工作报告》“十一、发行人的重大债权债务”。

（二）上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三）根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）根据《审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”及“十一、发行人的重大债权债务”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（五）报告期内，发行人金额较大的应收款、应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人的增资扩股及减资

发行人自设立以来历次增资扩股及减资情况详见《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”。经本所律师核查，发行人的历次增资扩股及减资符合当时中国法律、法规和规范性文件的规定，已经履行了必要的中国法律手续。

（二）发行人重大资产收购/出售

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人报告期内无重大资产收购或出售。

（三）发行人拟进行的重大资产出售/收购

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

十三、发行人公司章程的制定与修改

《公司章程》系晶合有限整体变更为发行人时制定的公司章程，经 2020 年 11 月 20 日召开的发行人创立大会审议通过，《公司章程》已报合肥市市监局备案。发行人及其前身晶合有限最近三年对公司章程的修订详见《律师工作报告》“十三、发行人公司章程的制定与修改”。

经本所律师核查，发行人公司章程的制定及最近三年的历次修订已经履行了必要的法定程序，其内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

为本次发行上市之目的，发行人已按照《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定了《发行人章程》，《发行人章程》已获发行人 2020 年年度股东大会审议通过，自发行人完成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起生效。经本所律师核查，《发行人章程》的内容符合《公司法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人已设置股东大会、董事会、监事会，选举了公司董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；董事会由独立董事和非独立董事组成，独立董事人数占全体董事人数不少于三分之一；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

经本所律师核查，发行人根据《公司法》并参照《上市公司股东大会规则》等规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度。

本所认为，该等议事规则及公司治理制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开情况

1、股东大会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人共召开了 2 次股东大会会议，其主要情况如下：

序号	股东大会会议名称	会议日期
1	创立大会	2020 年 11 月 20 日
2	2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 16 日

2、董事会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人共召开了 4 次董事会会议，其主要情况如下：

序号	董事会会议名称	会议日期
1	第一届董事会第一次会议	2020 年 11 月 20 日
2	第一届董事会第二次会议	2020 年 12 月 25 日
3	第一届董事会第三次会议	2021 年 2 月 9 日
4	第一届董事会第四次会议	2021 年 3 月 5 日

3、监事会会议

自发行人整体变更为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人共召开了 2 次监事会会议，其主要情况如下：

序号	监事会会议名称	会议日期
1	第一届监事会第一次会议	2020 年 11 月 20 日
2	第一届监事会第二次会议	2021 年 2 月 9 日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所认为，发行人上述历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）发行人股东大会、董事会历次授权或重大决策

根据发行人提供的股东大会、董事会会议决议、会议记录等文件资料，并经本所律师核查，本所认为，发行人股东大会、董事会做出历次授权或重大决策行为，均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及公司其他现行有效的内部规章制度所规定的股东大会或董事会的职权范围，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化的具体情况，详见《律师工作报告》“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。

经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员的任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。发行人董事、高级管理人员的上述变化符合法律法规及当时有效的公司章程的有关规定，并已履行必要的法律程序。发行人董事、高级管理人员、核心技术人员最近两年内没有发生重大不利变化，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。除陈绍亨、BEICHAO ZHANG （张北超）尚待取得独立董事资格证书并完成上交所科创板独立董事视频课程学习外，发行人的独立董事任职资格、职权范围符合法律、法规、规范性文件、中国证监会的有关规定及《发行人章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定。

十六、发行人的税务

（一）税务登记及税种、税率

根据《审计报告》《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种及税率情况，详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务”。

本所认为，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

发行人及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠的具体情况，详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务”。

本所认为，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司享受的税收优惠合法、合规，不存在税收优惠到期的情形。

（三）政府补贴

根据《审计报告》、发行人说明并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度获得的与资产相关的政府补助分别为 33,318,547.22 元、47,527,511.10 元及 62,053,047.60 元；与收益相关的政府补助为 18,760,685.60 元、29,542,567.16 元及 30,007,536.30 元。

本所认为，发行人及其境内控股子公司在报告期内享受的主要政府补贴合法、合规。

（四）税务合规证明

2021 年 2 月 3 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经征管系统查询，该纳税人自 2018 年 1 月 1 日以来，按时申报缴纳各项税费款，未发现欠缴税费款，未发现有税收违法行为不良记录及因违反税收相关法律法规和规范性文件规定受到行政处罚。”

2021 年 2 月 3 日，国家税务总局南京市栖霞区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“该公司自 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 1 月 31 日经税务征管系统查询能够按时申报纳税，未发现其有偷税漏税情况及违规情况。”

2021 年 1 月 6 日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚。”

2021 年 2 月 25 日，国家税务总局上海市浦东新区税务局向上海晶合出具《税务证明》，“在 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，能按税法的规定按期办理纳税申报，暂未发现有欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法规的情形。”

（五）税务处罚

报告期内，发行人及其境内子公司不存在税务处罚。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

根据发行人说明及其提供的文件，截至本法律意见书出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及环保相关事项。发行人环保实施情况详见《律师工作报告》“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”之“（一）环境保护”。

经核查，发行人主要环保设施运行正常，环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染总体上相匹配；发行人生产经营符合国家和地方产业政策和环保规定，符合相关主管部门的要求；发行人已建项目履行了环评手续，报告期内未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。本所认为，发行人的经营情况总体符合国家和地方环保要求。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及产品质量和技术监督标准相关事项。根据发行人书面说明，并经本所律师登录安徽省市场监督管理局网站（http://amr.ah.gov.cn）、合肥市市场监督管理局网站（http://amr.hefei.gov.cn）查询，发行人及其子公司最近三年没有因违反国家、地方有关质量、技术监督方面的规定而被质量技术监督管理部门处罚的情形。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，截至本法律意见书出具日，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项。发行人安全生产合规情况如下：

2021 年 1 月 15 日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自 2018 年 1 月 1 日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十八、发行人的劳动及社会保障

（一）劳动及社会保险

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的社保缴纳凭证及其说明，报告期内，发行人及其境内子公司为员工缴纳社会保险的具体情况，详见《律师工作报告》“十八、发行人的劳动及社会保障”。

报告期内，发行人及其境内子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为：1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；2）在境内任职的中国台湾籍员工按照台湾地区法规缴纳了劳健保；3）在境内任职的外籍员工未缴纳社会保险。

2021 年 1 月 7 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 7 未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

（二）住房公积金缴纳情况

报告期内，发行人及其境内子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：1）存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；2）在境内任职的中国台湾籍、外籍员工未缴纳住房公积金。

2021 年 1 月 8 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自 2016 年 7 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

（三）劳务派遣及劳务外包

1、劳务派遣

报告期内，发行人及其子公司不存在劳务派遣用工。

2、劳务外包

报告期内，发行人劳务外包主要为保安、保洁、物业、搬运等生产经营中辅助性工作，各年度劳务外包费用占发行人管理费用的比例较低，发行人不存在将主要生产经营活动交由劳务外包公司实施的情况。

十九、发行人募集资金的运用

2021 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，公司拟公开发行不超过 501,533,789 股人民币普通股（行使超额配售选择权前），实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：亿元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	发行人	12 英寸晶圆制造二厂项目	165	120

发行人“12 英寸晶圆制造二厂项目”的实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，位于发行人厂区范围内，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁，合肥蓝科已取得相关房屋的不动产权证，具体情况如《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”所述。

发行人“12 英寸晶圆制造二厂项目”已向相关部门申请备案，备案完成后可向环保主管部门申请办理环评相关审批手续。

本所认为，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、行政法规和规章的规定。

二十、发行人业务发展目标

（一）发行人业务发展目标与主营业务的一致性

根据《招股说明书（申报稿）》及发行人出具的书面说明，发行人的发展战略为：

在当前的国内行业上下游仍高度依赖进口的背景下，发行人将抓住 5G、AI、物联网等市场机遇，提升晶圆制造环节的本土企业市场影响力，实现国内显示驱动芯片、微处理器、CMOS 图像传感器等集成电路产品的自主可控供应，进一步提高集成电路行业的国产化水平。

未来，公司将不断依托核心优势、提升专业技术水平，整合行业及客户资源，发挥管理团队和技术团队能动性，进一步向兼顾晶圆代工产品和设计服务能力的综合性晶圆制造企业发展，逐步形成显示驱动、图像传感、微控制器、电源管理四大集成电路特色工艺应用产品线，矢志成为全球第一的面板驱动晶圆代工厂，矢志成为中国卓越的集成电路专业制造公司。

本所认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致。

（二）发行人业务发展目标的合法性

经本所律师核查，本所认为，发行人在《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）、中国检察网（http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）、中国检察网（http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，截至 2020 年 12

月 31 日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）等网站，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

（一）发行人及其控股股东等责任主体相关承诺的合法性

根据发行人及其控股股东等责任主体签署的相关承诺函并经本所律师核查，发行人及其控股股东等责任主体就本次发行上市涉及的相关事宜作出的主要承诺如下：

序号	承诺事项	承诺方
1	关于所持股份锁定期	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		持有发行人不足5%股份的股东
		持有发行人股份的董事、高级管理人员，以及核心技术人员
2	关于持股意向及减持意向	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
3	关于上市后三年内稳定公司股价措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		董事（不含独立董事）及高级管理人员
4	股份回购和股份购回的措施和承诺	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
5	对欺诈发行上市的股份购回承	发行人

序号	承诺事项	承诺方
	诺	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
6	关于摊薄即期回报填补措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、高级管理人员
7	关于依法承担赔偿或赔偿责任	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
8	关于避免同业竞争	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、监事、高级管理人员
9	关于规范并减少关联交易	发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		全体董事、监事、高级管理人员
10	关于未履行承诺事项的约束措施	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
		全体董事、监事、高级管理人员，以及核心技术人员
11	关于避免资金占用和违规担保	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
12	关于诉讼/仲裁事项及行政处罚事项	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		持有发行人5%以上股份的股东力晶科技、美的创新
13	关于缴纳社保及公积金	发行人
14	关于不存在违规情形的承诺函	全体董事、监事、高级管理人员
15	关于申请文件真实、准确、完整	发行人
		全体董事、监事、高级管理人员
16	关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	发行人
		发行人控股股东合肥建投、合肥芯屏
		全体董事、监事、高级管理人员
17	股东信息披露专项承诺	发行人
18	力晶科技出具的其他承诺	持有发行人5%以上股份的股东力晶科技

经本所律师核查，本次发行上市涉及的相关责任主体作出的主要承诺文件已经相关责任主体或其授权代表签署，相关承诺合法合规。

（二）发行人及其控股股东等责任主体未履行相关承诺的约束措施的合法性

经本所律师核查，上述对于未履行相关承诺的约束措施已经发行人及其控股股东等相关责任主体签署，内容合法、合规，符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》对相关责任主体作出公开承诺事项应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求。

同时，发行人已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了摊薄即期回报的填补措施。发行人及其董事、高级管理人员、控股股东已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保发行人填补回报措施的切实履行作出了承诺。发行人第一届董事会第三次会议已将摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及上述相关承诺主体的承诺等事项形成议案，由发行人2020年年度股东大会审议通过。

二十三、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所律师已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》，并特别审阅了其中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容。本所认为，《招股说明书（申报稿）》引用本法律意见书和《律师工作报告》相关内容与本法律意见书和《律师工作报告》无矛盾之处。本所对《招股说明书（申报稿）》中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用本法律意见书和《律师工作报告》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十四、关于本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所认为，发行人符合《证券法》《公司法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的各项条件，不存在重大违法违规行为。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引

用本法律意见书和《律师工作报告》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人本次发行尚待获得上交所审核同意并报经中国证监会注册，本次发行完成后，经上交所审核同意，发行人股票可于上交所科创板上市交易。

（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

苏 峥

刘东亚

单位负责人：

王 玲

二〇二一年四月二十日

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（一）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2021 年 4 月 26 日出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

鉴于上交所于 2021 年 6 月 6 日下发《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公

开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2021]308 号）（以下简称“《问询函》”），本所现根据《问询函》的要求，就其中所涉及的法律问题进行核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》不可分割的组成部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法律意见的引言、前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

在本补充法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、验资报告及境外法律意见等某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会及上交所有关规定的要求，出具本补充法律意见书如下：

目录

一、《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定 70

二、《问询函》第 2 题：关于以专利技术使用权出资 86

三、《问询函》第 3 题：关于特殊权利条款 107

四、《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务 109

五、《问询函》第 8 题：关于客户集中度 115

六、《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性 117

七、《问询函》第 12.1 题：委托经营管理 141

八、《问询函》第 12.2 题：委派管理人员 165

九、《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施 178

十、《问询函》第 12.4 题：订单互补支持 189

十一、《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况 191

十二、《问询函》第 12.6 题 193

十三、《问询函》第 13 题：关于关联交易 194

十四、《问询函》第 14 题：关于存在累计未弥补亏损 199

十五、《问询函》第 22 题：关于信息披露豁免 203

十六、《问询函》第 24 题：关于募投项目 204

十七、《问询函》第 25 题：关于股东核查情况 205

一、《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定

根据申报材料：（1）发行人控股股东为合肥建投，直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份，系发行人的控股股东。发行人实际控制人为合肥市国资委，直接持有合肥建投 100%的股权。（2）2015 年 10 月，公司与第二大股东力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理。根据保荐工作报告，2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。（3）目前，公司董事长蔡国智的提名人为力晶科技。

请发行人披露合肥建投能够控制合肥芯屏的原因。

请发行人说明：（1）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用；（2）委托经营管理合约终止前后公司实际控制人认定情况；（3）力晶科技是否将发行人并入合并报表；（4）结合公司报告期内股东（大）会、董事会表决情况，董监高及重要岗位的提名任免，重大事项决策机制，委托经营管理及执行情况，2019 年 12 月以前合肥建投占董事会席位未达 2/3 等，说明报告期内实际控制人认定情况，充分论证发行人最近两年实际控制人是否发生变更。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）请发行人披露合肥建投能够控制合肥芯屏的原因

1、合肥建投资本管理有限公司对合肥芯屏具有控制力

根据合肥芯屏持有的《营业执照》、现行有效的合伙协议，截至本补充法律意见书出具日，合肥芯屏的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投资本管理有限公司（以下简称建投资本）	普通合伙人	1,000.00	0.04
2	合肥建投	有限合伙人	1,159,000.00	47.44
3	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,033,125.00	42.29
4	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	250,000.00	10.23
合计		**-**	**2,443,125.00**	**100.00**

根据合肥芯屏的合伙协议，普通合伙人建投资本为执行事务合伙人，有限合伙人不执行合伙事务；合肥芯屏设立投资决策委员会，5 名委员均由执行事务合伙人委派，投资决策委员会负责合伙企业投资项目决策。建投资本作为合肥芯屏的执行事务合伙人对外代表合伙企业、执行合伙事务，并通过委派投资决策委员会委员能够控制合肥芯屏投资项目决策。因此，建投资本对合肥芯屏具有控制力。

2、合肥建投对建投资本具有控制力

根据建投资本持有的《营业执照》、现行有效的《公司章程》，截至本补充法律意见书出具日，建投资本的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥建投	7,083.00	70.83
2	合肥德轩投资管理有限公司	2,917.00	29.17
合计		**10,000.00**	**100.00**

根据建投资本的《公司章程》，股东会是公司的最高权力机构，股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、修改章程、解散或者变更公司形式等重大事项作出决议必须经全体股东通过，其他事项必须经代表 1/2 以上表决权的股东通过；建投资本设董事会，由 5 名董事组成，董事人选由股东推荐，其中合肥建投推荐 4 名，合肥德轩投资管理有限公司推荐 1 名，董事会对相关事项作出决议，必须经全体董事 2/3 以上同意通过。合肥建投持有建投资本 70.83%的股权，是建投资本的控股股东，

且合肥建投推荐的董事占建投资本全体董事的 2/3 以上。因此，合肥建投对建投资本具有控制力。

综上所述，合肥建投通过建投资本能够控制合肥芯屏。

（二）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用

1、公司设立背景及定位

随着电子信息产业的高速发展，我国已成为全球最大的集成电路市场，但集成电路高端制造技术欠缺、晶圆制造产能仍有较大缺口，特别是门槛较高的 12 英寸集成电路制造能力仍较为薄弱，导致集成电路产品对外依赖度较高。2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升到国家战略层面，纲要指出：“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”，要求“加速发展集成电路制造业。以生产线建设带动关键装备和材料配套发展”。

作为国家级科技创新型试点城市，合肥市政府制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏器合”的产业发展战略，其中，“芯”指芯片产业，“屏”指新型显示产业，“器”指装备制造和机器人等产业，“合”指人工智能和制造业融合为代表的新兴产业等。2015 年，合肥市的新型显示产业已形成规模，京东方 6 代线、8.5 代线已投产，10.5 代线项目即将开工建设，但芯片产业仍处于起步初期。合肥市拟引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，利用合肥市新型显示产业的协同效应，以显示驱动芯片为切入点，通过面板显示等终端应用带动芯片产业发展，建设自主可控的芯片制造能力。

为落实国家集成电路产业发展战略和合肥市集成电路产业发展规划，2015 年 4 月，合肥市政府与力晶科技签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》（以下简称“《合作框架协议》”），与力晶科技合作 12 英寸晶圆制造基地项目并由合肥建投设立晶合有限作为项目公司。发行人主营业务为 12 英寸晶圆代工业务，是芯片制造的关键环节之一。发行人设立初期所代工产品的主要应用领域为面板显示驱动芯片领域，配套服务于新型显示产业。

2、合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用

（1）合肥市国资委与合肥建投的基本情况及定位

合肥市国资委系合肥市政府直属特设机构，受合肥市政府委托，代表合肥市政府履行出资人职责，对全市国有（集体）企业、授权的事业单位进行国有资产监督管理，主要职责包括：履行出资人职责，监督市属政府委托授权单位的国有资产；承担监督所监管单位国有资产的保值增值的责任；参与指导监管单位的投资、融资工作；通过法定程序对所监管单位负责人进行任免；代表市政府向所监管单位派出监事会；对监管范围内的国有资产进行预算管理等。根据《合肥市属国有企业投资管理办法》《合肥市市属国有企业功能界定与分类方案》《市国资委以管资本为主推进职能转变方案》等文件的规定，合肥市国资委对企业投资实行分类、分级监管，市属国有企业对其实际控制子公司进行类别界定；将延伸到子企业的管理事项，原则上归位于重点监管企业，将部分审批权限下放给企业集团，层层落实责任，确保国有资产保值增值。

合肥建投是经合肥市人民政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司，属于合肥市国资委重点监管企业。合肥建投的主要业务板块包括战略性新兴产业投资、工程建设、城市运营服务、乡村振兴和现代农业、商业百货、文旅博览等。在战略性新兴产业投资方面，合肥建投发挥国有资本投资运营公司的平台功能，推动京东方、维信诺、蔚来汽车、彩虹股份等项目在合肥落户投产。

（2）合肥市国资委及合肥建投在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用

根据发行人提供的工商档案文件、发行人报告期内历次董事会、股东大会会议文件、发行人履行国资汇报、备案或审批程序的相关文件、《审计报告》以及发行人出具的说明等资料并本所律师核查，《委托经营管理合约》终止前，合肥市国资委、合肥建投在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用主要如下：

①合肥建投通过委派董事在董事会层面审议公司重大事项决策

《委托经营管理合约》终止前，公司最高权力机构为董事会。根据晶合有限当时

适用的公司章程，董事会行使的职权包括：决定合资公司的经营方针和投资计划；决定董事、监事报酬；审议批准合资公司年度财务预算方案、决算方案；审议批准合资公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对合资公司增加或减少注册资本作出决议；对合资公司进行股权、债券融资作出决议；决定董事会委员会的设置和组成，推选董事长；决定合资公司总经理的任免和报酬事项，并根据总经理的提名任命高级管理人员；决定聘请或解聘为合资公司审计的会计师事务所；对合资公司合并、分立、解散、清算或变更组织形式作出决议；修改合资公司章程及其他职权。

董事会作为晶合有限股改前的最高决策机构，决定晶合有限的年度经营总结及次年经营规划、签订重大合同、聘任高级管理人员、增加注册资本等一切重大事项。公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。

因此，《委托经营管理合约》终止前，合肥建投通过委派董事在董事会层面审议公司重大事项决策。

②合肥建投通过委派高管对发行人日常经营进行监督和管理

公司日常经营计划由高级管理人员负责制定及执行。自 2016 年至股改前，公司部分高级管理人员由合肥建投委派并经公司董事会聘任，合肥建投委派高级管理人员的具体情况如下：

委派高管职务	委派期间	主要职责
总会计师	2016 年 3 月至 2020 年 3 月	总体负责公司财务方面各项工作，合肥建投通过委派总会计师对公司整体财务状况进行监督和管理
采购副总监	2016 年 4 月至 2020 年 4 月	参与公司采购流程、决策，合肥建投通过委派采购副总监对公司采购情况进行监督和管理
销售副总监	2016 年 4 月至 2020 年 3 月	参与公司销售流程、决策，合肥建投通过委派销售副总监对公司销售情况进行监督和管理
行政副总经理	2019 年 10 月至 2020 年 3 月	总体负责公司人事与总务等行政工作，合肥建投通过委派行政副总经理

		对公司行政事务进行监督和管理
审计师	2019 年 1 月至 2020 年 4 月	总体负责公司内部审计工作，合肥建投通过委派审计师对公司内部控制进行监督
敬业促进委员会委员长	2017 年 8 月至 2020 年 11 月	规范公司员工行为、鼓励敬业服务，合肥建投通过委派敬业促进委员会委员长对公司员工行为及敬业情况进行了解

《委托经营管理合约》终止前，合肥建投曾向公司委派总会计师、采购副总监、销售副总监、行政副总经理、审计师、敬业促进委员会委员长等高级管理人员，涉及公司财务、采购、业务、行政等主要日常经营环节，通过委派高管对公司日常经营进行监督和管理。

③合肥市国资委、合肥建投按照国有控股企业对公司进行管理

发行人设立至今，合肥市国资委和合肥建投始终按照国有控股企业对公司进行管理，具体情况如下：

（A）公司设立及产权变动

公司设立、历次股权变动、股改均按照《企业国有资产交易监督管理办法》等规定，履行了国有及国有控股企业相关的审批、资产评估及备案等程序。2021 年 4 月，合肥市国资委出具《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》，确认“晶合集成的设立、历次股权变动、股改等事项均履行了审批程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形”。

（B）关键岗位人员任命

2016 年 2 月，力晶科技入股后，公司成立了董事会。公司董事长、总经理人选由合肥建投履行内部审核流程后，再由公司董事会进行聘任。

（C）投资设立子公司、分公司

公司设立日本子公司、上海分公司，均按照《合肥市属国有企业投资管理暂行办

法》中对于国有控股企业的相关规定，履行了国资审批程序，经合肥建投请示合肥市国资委批准同意后实施。

（D）确定重大采购招投标模式

公司在确定机台、设备等重大采购的采购方式时，均按照《中华人民共和国招投标法实施条例》《合肥市 2016 年公共资源集中交易目录》《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市 2016 年市级政府集中采购目录及限额标准的通知》中对于国有控股企业相关项目的规定，履行了国资审批程序，经合肥建投、合肥市公共资源交易监督管理局、合肥市政府审批后实施。

④合肥市国资委、合肥建投对发行人生产经营的支持

（A）向公司出租土地、厂房及配套设施

根据合肥市政府与力晶科技签署的《合作框架协议》，合肥市政府负责提供土地与厂房建设资金，并以租赁方式供发行人使用该等土地及厂房，租赁期限为全产能量产后 20 年，租期届满后若项目营运顺利，再以相同条件续租 10 年。合肥蓝科系合肥建投的全资子公司，依据前述《合作框架协议》投资建设了相关厂房、无尘室、厂务设施及配套设施，并租赁给公司。该等厂房系按照半导体行业生产标准进行定制化设计和建设，较难在市场租赁或购置第三方同类厂房，对发行人生产经营具有重要作用。

（B）在公司业务拓展方面提供支持

发行人直接客户为芯片设计公司，发行人所代工产品需在下游终端产品公司验证通过后才能进行量产。为加快发行人与客户建立合作，推动合肥市新型平板显示产业与集成电路产业协同发展，合肥建投积极协调京东方等终端产品公司，为发行人产品验证、业务拓展方面提供了支持。

（C）为公司提供借款及担保支持

晶圆代工行业属于资本密集型行业，产能扩充和持续研发都需要大量的资金投入。合肥建投作为控股股东，在公司资金紧张或有融资需求时提供支持。2018 年 4 月，合肥建投通过中国银行合肥北城支行向公司提供 80,500.00 万元委托贷款，支持公司经

营发展；2018 年 10 月，公司增资扩股后向合肥建投归还了上述委托贷款。此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司长期借款（含一年内到期的长期借款）均由合肥建投提供担保。除合肥建投外，力晶科技或其他股东均未向公司提供借款或担保等财务方面的支持。

综上所述，本所认为，委托经营管理合约终止前，合肥市国资委通过合肥建投在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥了重要作用。

（三）委托经营管理合约终止前后公司实际控制人认定情况

《委托经营管理合约》终止前后，公司实际控制人均为合肥市国资委，具体认定情况如下：

1、在公司最高权力机构中占主导地位

公司股改前，最高权力机构为董事会，合肥市国资委通过合肥建投、合肥芯屏（以下合称“合肥国资方”）控制公司 50%以上的股权，委派的董事数量占公司董事会成员半数以上，且合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位。自 2016 年 3 月公司设立董事会至股改前，公司共计召开 33 次董事会，历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票，仅发生 1 次力晶科技部分委派董事在董事会审议中弃权事宜，未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

公司股改后，最高权力机构为股东大会，合肥国资方控制公司 50%以上的股份，提名的董事数量占公司董事会成员半数以上。

因此，《委托经营管理合约》终止前后，根据《上市规则》《上市公司收购管理办法》中关于实际控制人认定的相关标准，公司实际控制人均为合肥市国资委。

2、委派高级管理人员监督、管理公司日常经营

自 2016 年 3 月至 2020 年合肥建投向发行人委派高级管理人员，在财务、采购、业务、行政等主要日常经营环节进行监督和管理，详见本补充法律意见书第 1 题之“（二）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用”以及第 12.2 题之“（一）委托经营管理合约终止

前后合肥建投和力晶科技委派管理人员的具体情况及其主要考虑”的相关回复。

3、按照国有控股企业对公司进行管理

合肥市国资委、合肥建投对公司设立及产权变动、关键岗位人员任命、投资设立子公司及分公司、重大采购招投标等事项，均按照国有及国有控股企业相关规定进行管理，并履行了相关国资审批程序，详见本补充法律意见书第 1 题之“（二）委托经营管理合约终止前，合肥市国资委在发行人生产经营、重大事项决策和日常经营管理等方面发挥的作用”的相关回复。《委托经营管理合约》终止前后，合肥市国资委、合肥建投均按照国有及国有控股企业对公司进行管理，公司重要决策均在国资监管下进行。

4、提供公司生产经营所需土地、厂房

公司生产经营所使用的土地、厂房均租赁自合肥建投的全资子公司合肥蓝科，详见本补充法律意见书第 12.3 题之“向控股股东子公司租赁厂房及设施”的相关回复。《委托经营管理合约》终止前后，发行人均向合肥国资方租赁土地、厂房及配套设施等重要资产，对于公司生产经营具有重大影响。

5、公司未将经营管理权交予力晶科技

《委托经营管理合约》签订后，力晶科技仅履行了部分条款，公司未将经营管理权交予力晶科技。《委托经营管理合约》未对发行人日常经营及重大事项决策机制造成实质影响，发行人实际控制人认定情况未因此发生变化。详见本补充法律意见书第 12.1 题之“（一）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定”的相关回复。

6、主要股东对公司实际控制人认定予以确认

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》，在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认。

根据合肥建投出具的确认函，自晶合集成成立以来，合肥建投一直系晶合集成的直接或间接控股股东，且不存在与力晶科技共同控制晶合集成的情形。

根据力晶科技出具的确认函，力晶科技充分认可合肥建投方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国资委作为晶合集成实际控制人的地位。力晶科技自入股以来未以任何形式谋求晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

综上所述，本所认为，《委托经营管理合约》终止前后，发行人的实际控制人均为合肥市国资委。

（四）力晶科技是否将发行人并入合并报表

根据力晶科技公开披露的 2016 年至 2020 年期间的年度报告，自 2016 年 2 月力晶科技入股公司至今，力晶科技均未将公司纳入合并报表范围，仅作为参股投资企业列示。

（五）结合公司报告期内股东（大）会、董事会表决情况，董监高及重要岗位的提名任免，重大事项决策机制，委托经营管理及执行情况，2019 年 12 月以前合肥建投占董事会席位未达 2/3 等，说明报告期内实际控制人认定情况，充分论证发行人最近两年实际控制人是否发生变更

1、报告期内股东大会表决情况

报告期初至股改前，公司最高权力机构为董事会；自 2020 年 11 月，公司整体变更为股份有限公司后，公司最高权力机构为股东大会，合肥国资方控制公司 50%以上的股份。

报告期内，发行人共召开 1 次股东大会，经全体股东同意，审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2、报告期内董事会表决情况

报告期内，合肥国资方委派的董事数量占公司董事会成员半数以上，且合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位。公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上

进行表决。报告期内，公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

3、董监高及重要岗位的提名任免情况

（1）董事的提名任免情况

报告期初至股改前，公司董事由双方股东委派并经公司董事会任命。股份公司成立后，公司董事由股东提名，股东大会选举产生。报告期内，合肥国资方委派或提名的董事数量均占多数。公司董事席位分布情况如下：

股东名称	2018 年 1 月至 2019 年 12 月	2019 年 12 月至 2020 年 11 月	2020 年 11 月至 2020 年 12 月
合肥国资方	委派 5 名董事	委派 6 名董事	提名 4 名非独立董事、2 名独立董事
力晶科技	委派 4 名董事	委派 3 名董事	提名 2 名非独立董事、1 名独立董事

（2）监事的提名任免情况

报告期初至股改前，公司不设监事会，由双方股东各委派一名监事。股份公司成立后，公司设监事会，股东代表监事由股东提名，股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表选举产生。报告期内，公司监事席位分布情况如下：

股东名称	2018 年 1 月至 2020 年 11 月	2020 年 11 月至 2020 年 12 月
合肥国资方	委派 1 名监事	提名 1 名监事
力晶科技	委派 1 名监事	提名 1 名监事
其他	-	职工代表大会选举产生 1 名监事

（3）高级管理人员的提名任免情况

报告期初至股改前，公司部分高级管理人员岗位一直系董事会直接聘任、由公司员工任职，部分高级管理人员岗位最初由双方股东委派，逐步转化为董事会直接聘任、由公司员工任职。股份公司成立后，公司高级管理人员均由公司员工任职，由董事长、总经理提名，由董事会聘任。

报告期内，发行人的日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工。报告期内。公司高级管理人员的具体变化情况如下：

序号	职能	职位	2018.1	2018.3	2018.5	2018.12	2019.3	2019.5	2019.10	2019.12	2020.3	2020.4	2020.6	2020.11	2020.12
1	/	总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
2	营运	副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
3		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	公司员工
4	销售	总监/副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	公司员工	未设置	未设置	未设置
5		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
6		副总监	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	未设置	未设置	未设置	未设置
7	采购	总监/副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置
8		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工
9		副总监	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	未设置	未设置	未设置	未设置
10	研发	副总经理	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
11		协理	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工	未设置	未设置	未设置	未设置
12	财务	总会计师/副总经理	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
13		副总会计师/协理	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	力晶科技	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
14	内审	审计师	力晶科技	力晶科技	力晶科技	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	未设置	未设置	未设置	未设置
15	敬业监督	敬业促进委员会委员长	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	合肥建投	不再为高级管理人员	
16	行政	副总经理	力晶科技	力晶科技	未设置	未设置	未设置	未设置	合肥建投	合肥建投	合肥建投	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工
17	证券	董事会秘书	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	未设置	公司员工	公司员工	公司员工	公司员工

4、重大事项决策机制

报告期初至股改前，公司最高权力机构为董事会，根据当时有效的《中外合资经营企业法》及其实施条例，合营企业章程的修改、合营企业的中止、解散、合并、分立以及注册资本的增加、减少等重大事项需要出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议。自 2020 年 11 月，发行人整体变更为股份有限公司后，发行人最高权力机构为股东大会。

报告期内，公司最高权力机构对重大事项的决策机制如下：

期间	决议类型	审议内容
2018 年 1 月至 2020 年 11 月股改前	一般事项	除下述一致批准事项和特殊表决事项以外，其它一般事项根据在符合法定人数的董事会会议上以出席会议董事的简单多数票决定。
	一致批准事项	有关下列事项的董事会决议应由出席会议董事（本人或其书面委托的代理人）在按规定程序召开的董事会会议上一致投赞成票方可通过： (a) 合资公司公司《章程》的修改； (b) 合资公司的中止、解散； (c) 合资公司注册资本的增加、减少； (d) 合资公司的合并、分立； (e) 推选董事长和 CEO 的人事任免； (f) 合资公司公司《章程》《投资参股协议》《技术移转协议》中载明的其它事项。
	特殊表决事项	有关下列事项的董事会决议应有至少包括出席会议 2/3 的董事投赞成票方可通过： (a) 重大的经营事项：制定或改变合资公司中长期发展规划、经营方针、年度或季度经营计划、投资计划和方案；改变合资公司主营业务或合资公司公司名称；经营计划之外处置合资公司重要业务、资产或其控制权；设立分公司、子公司、对外投资；购置高档汽车或者房地产；选择 IPO 承销商和上市交易所；IPO 的估值、条款和条件。 (b) 重大的财务事项：合资公司季度和年度预算、决算；对财务制度或会计政策作出变更；聘请或变更会计师事务所；预算之外的借贷行为；预算之外的重大财务开支；宣布或支

期间	决议类型	审议内容
		付股息、分配利润；减资或回购股份。 (c) 重大的人事事项：总会计师、COO、CTO、副总经理及采购副总监、销售副总监以上高级管理人员的职数设立、人事任免及其薪酬待遇管理。 (d) 其它重大事项：任何对外担保；任何关联交易；证券、期货或金融衍生产品投资；对第三方作出无限制的或超过一定金额的责任承诺。
2020 年 11 月股改后至 2020 年 12 月	普通决议	普通决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项
	特别决议	特别决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）公司现金分红政策的调整或者变更； （七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

公司成立初期，为控制公司经营决策风险，重大事项由绝对多数董事通过有利于公司稳健运营，因此当时有效的《公司章程》约定，公司部分重大事项需全体董事或 2/3 以上董事投赞成票方能通过。2018 年 1 月至 2019 年 12 月期间，合肥国资方委派董事占公司董事会席位未达 2/3，该等董事会席位设置系合肥国资方出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，而经友好协商确定。

合肥国资方及其委派董事对公司的战略方针、经营决策及重大经营管理等事项拥有重大影响。公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，报告期内公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

根据力晶科技出具的确认函，力晶科技充分认可合肥建投方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国资委作为晶合集成实际控制人的地位。力晶科技自入股以来未以任何形式谋求晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

5、委托经营管理及执行情况

签订《委托经营管理合约》主要目的系在发行人经营、发展状况不及预期时，合肥国资方能约束力晶科技向公司投入更多精力和支持。《委托经营管理合约》签订后，公司未实际将经营管理权交予力晶科技，仅部分条款实际履行，详见本补充法律意见书第 12.1 题之“（一）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定”的相关回复。《委托经营管理合约》未对发行人日常经营及重大事项决策机制造成实质影响，发行人实际控制人认定情况未因此发生变化。

6、说明报告期内实际控制人认定情况，充分论证发行人最近两年实际控制人是否发生变更

结合前述分析，考虑到：

（1）报告期内，合肥建投为发行人控股股东，合肥国资方控制公司 50%以上的

股份。合肥国资方委派的董事数量占公司董事会成员半数以上。

（2）公司成立初期，为控制公司经营决策风险，重大事项由绝对多数董事通过有利于公司稳健运营，因此当时有效的《公司章程》约定，公司部分重大事项需全体董事或 2/3 以上董事投赞成票方能通过。2018 年 1 月至 2019 年 12 月期间，合肥国资方委派董事占公司董事会席位未达 2/3，该等董事会席位设置系合肥国资方出于招商引资需要及保护小股东利益考虑而经友好协商确定。报告期内，合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形

（3）报告期内，发行人的日常经营运作以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工。

（4）《委托经营管理合约》签订后，公司未实际将经营管理权交予力晶科技，《委托经营管理合约》未对发行人日常经营及重大事项决策机制造成实质影响，发行人实际控制人认定情况未因此发生变化。

（5）根据力晶科技出具的确认函，力晶科技充分认可合肥建投方的控股股东地位，认可并尊重合肥市国资委作为晶合集成实际控制人的地位。力晶科技自入股以来未以任何形式谋求晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

综上所述，报告期内，发行人的实际控制人均为合肥市国资委，发行人最近两年实际控制人未发生变更。

二、《问询函》第 2 题：关于以专利技术使用权出资

根据保荐工作报告：2017 年 3 月，经台湾经济部投资审议委员会批准，力晶科技以 58 项专利技术使用权作价人民币 20 亿元向晶合集成增资。

请发行人说明：（1）专利技术使用权出资的背景及具体情况，是否存在期限即将届满的专利，相关专利技术使用权作价 20 亿元的评估定价依据，是否存在利益输送，增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用；（2）力晶科技以专利技术使用权作价出资是否符合当时法律法规的规定，出资方式及内容是否与外资审批机构的批复相符；（3）受让技术在使用、后续研发等方面是否受到我国台湾地区政策等方面的限制

或存在相关风险；（4）上述专利技术在发行人的生产经营中的实际使用情况及技术发展过程中所起的作用；（5）相关专利对应的收入和专利的账面价值，报告期内发生减值的情况。

请保荐机构和发行人律师对上述事项（1）至（4）进行核查并发表明确意见，请保荐机构和申报会计师对上述事项（5）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）专利技术使用权出资的背景及具体情况，是否存在期限即将届满的专利，相关专利技术使用权作价 20 亿元的评估定价依据，是否存在利益输送，增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用

1、专利技术使用权出资的背景及具体情况

（1）专利技术使用权出资的背景

发行人设立初期所代工产品的主要应用领域为面板显示驱动芯片领域，配套服务于新型显示产业。考虑到晶合集成初期的产品定位，以及需充分运用力晶科技成熟的技术优势和 12 英寸晶圆厂运营经验，帮助晶合集成以最快的速度掌握整套 DDIC 制程技术并实现产品量产的需求，合肥市政府要求力晶科技投入 150nm 大尺寸驱动 IC、110nm 小尺寸驱动 IC、90nm 小尺寸驱动 IC 相关的三项 DDIC 制程技术（以下简称“三项制程技术”）。拟投入的三项制程技术包含专利技术、技术文件及数据，以及运用该等技术过程中形成的技术经验等内容，其中：技术文件及数据、技术经验较为难以量化且涉及商业秘密，而专利技术由于已进入公开领域并受到保护，其范围与边界较为清晰，因此双方协商以专利技术作为技术出资的载体。除专利技术外，其他制程平台所需技术文件及数据、技术经验等也由力晶科技导入晶合集成，帮助晶合集成最终实现量产。由于当时力晶科技自身仍在使用前述三项制程技术生产相关产品，无法将相关专利技术的所有权转让给晶合集成，经过合肥市政府与力晶科技多轮谈判，力晶科技同意以前述三项制程技术中涉及的专利技术使用权对晶合集成进行出资。

（2）专利技术使用权出资的具体情况

2015 年 4 月，合肥市政府与力晶科技签署《合作框架协议》，约定双方共同合作

实施合肥新站综合开发试验区 12 英寸晶圆制造基地项目，力晶科技为晶合集成提供完整的驱动 IC 芯片代工制程技术，技术出资作价 20 亿元。2015 年 10 月，合肥建投、发行人与力晶科技签署《技术移转协议》，约定了力晶科技三项制程技术移转的步骤及实施细节，包括技术整备、技术移转团队建置与人才培育、进行技术授权与导入、移转技术之技术试验载体产品、移转技术验证完成与时程，及技术验证完成之后续事项等。

力晶科技用于出资的 58 项专利使用权具体情况如下：

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
1	光学光刻方法	中国	发明专利	ZL03155531.4	2003/8/28	2023/8/27
2	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	中国	发明专利	ZL200510065580.3	2005/4/18	2025/4/17
3	导线的制造方法	中国	发明专利	ZL200510065608.3	2005/4/18	2025/4/17
4	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	中国	发明专利	ZL200510129767.5	2005/12/5	2025/12/4
5	半导体元件及其制造方法	中国	发明专利	ZL200610005891.5	2006/1/19	2026/1/18
6	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	中国	发明专利	ZL200710161775.7	2007/9/26	2027/9/25
7	监控光刻工艺的方法与监控标记	中国	发明专利	ZL200810093317.9	2008/4/18	2028/4/17
8	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	中国台湾	发明专利	I313889	2003/7/21	2023/7/20
9	制作通孔的方法	中国台湾	发明专利	I240988	2004/1/7	2024/1/6

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
10	浅沟渠隔离结构的制造方法	中国台湾	发明专利	I234228	2004/5/12	2024/5/11
11	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	中国台湾	发明专利	I254409	2005/2/16	2025/2/15
12	导线的制造方法	中国台湾	发明专利	I254365	2005/1/27	2025/1/26
13	自行对准接触窗开口的制作方法	中国台湾	发明专利	I301997	2005/6/17	2025/6/16
14	半导体元件及其制造方法	中国台湾	发明专利	I267190	2005/8/29	2025/8/28
15	隔离结构的制造方法	中国台湾	发明专利	I300968	2006/6/28	2026/6/27
16	光罩复验方法与系统	中国台湾	发明专利	I305004	2006/7/17	2026/7/16
17	管制规格界限之制定方法	中国台湾	发明专利	I305838	2006/9/29	2026/9/28
18	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	中国台湾	发明专利	I301982	2006/9/28	2026/9/27
19	半导体元件的制造方法	中国台湾	发明专利	I464831	2012/6/27	2032/6/26
20	接触窗的形成方法	中国台湾	发明专利	I473206	2012/7/3	2032/7/2
21	Semiconductor device having reduced interconnect-line parasitic capacitance	美国	发明专利	US 6,531,776 B2	2001/8/29	2021/8/28
22	Method for forming stepped contact hole for	美国	发明专利	US 6,444,574 B1	2001/9/6	2021/9/5

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	semiconductor devices					
23	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	美国	发明专利	US 6,583,055 B1	2002/1/25	2022/1/24
24	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	美国	发明专利	US 6,670,254 B1	2002/10/1	2022/9/30
25	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	美国	发明专利	US 6,828,633 B2	2003/2/26	2023/2/25
26	Silicon-on-insulator device structure	美国	发明专利	US 7,019,582 B2	2004/9/29	2024/9/28
27	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	美国	发明专利	US 6,807,454 B2	2003/3/17	2023/3/16
28	Method for producing a gate	美国	发明专利	US 6,699,755 B1	2003/3/24	2023/4/29
29	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	美国	发明专利	US 7,461,472 B2	2003/6/16	2025/12/11
30	Method of improving a	美国	发明	US 7,008,733 B2	2003/9/25	2024/5/31

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle		专利			
31	Re-performable spin-on process	美国	发明专利	US 6,881,590 B2	2003/8/25	2023/8/24
32	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	美国	发明专利	US 6,995,086 B2	2004/6/28	2024/8/4
33	Method for forming a titanium nitride layer	美国	发明专利	US 7,030,015 B2	2004/9/16	2023/4/3
34	Method of manufacturing semiconductor device	美国	发明专利	US 7,056,787 B2	2005/1/12	2025/1/11
35	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	美国	发明专利	US 7,098,124 B2	2005/5/31	2025/5/30
36	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	美国	发明专利	US 7,550,372 B2	2005/8/29	2026/12/19
37	Semiconductor device having self-aligned contact	美国	发明专利	US 7,612,433 B2	2005/9/21	2027/1/30
38	Method for forming buried doped region	美国	发明专利	US 7,465,632 B2	2005/10/28	2027/1/31
39	Method of fabricating	美国	发明	US 7,268,055 B2	2005/11/7	2025/12/14

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	semiconductor device		专利			
40	Method for manufacturing gate dielectric layer	美国	发明专利	US 7,273,787 B2	2005/11/18	2026/4/3
41	Method of manufacturing self-aligend contact openings	美国	发明专利	US 7,429,527 B2	2007/9/11	2025/12/14
42	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	美国	发明专利	US 7,803,692 B2	2009/9/18	2025/9/20
43	Method for forming contact window	美国	发明专利	US 8,722,538 B2	2012/9/12	2032/9/11
44	Method for manufacturing semiconductor device	美国	发明专利	US 8,822,303 B2	2012/9/15	2032/9/20
45	PROCESS FOR FORMING SHALLOW TRENCH ISOLATION	美国	发明专利	5747377	1996/9/6	2016/9/5
46	SELF-BIASED VOLTAGE-REGULATED CURRENT SOURCE	美国	发明专利	5801580	1996/11/26	2016/11/25
47	LOW-CURRENT SOURCE CIRCUIT	美国	发明专利	5805010	1996/12/3	2016/12/2
48	Low mask count cmos process with inverse-t gate ldd	美国	发明专利	5854101	1997/4/4	2017/4/3

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	structure					
49	Method of fabricating a short-channel mos device	美国	发明专利	5773348	1997/5/21	2017/5/20
50	Method of fabricating a mos device having a gate-side air-gap structure	美国	发明专利	5736446	1997/5/21	2017/5/20
51	Method of fabricating a mos device with a localized punchthrough stopper	美国	发明专利	5963811	1997/8/5	2017/8/4
52	METHOD TO FORM METAL-TO-METAL ANTIFUSE FOR FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY APPLICATIONS USING LIQUID PHASE DEPOSITION (LPD)	美国	发明专利	5937281	1997/8/5	2017/8/4
53	Sub-range flash analog-to-digital converter	美国	发明专利	5973632	1998/3/3	2018/3/2
54	Method of Fabricating lightly-doped drain transistor having inverse-t gate structure	美国	发明专利	6130135	1998/5/18	2018/5/17
55	Method for fabricating trench-	美国	发明专利	6069057	1998/5/18	2018/5/17

序号	专利名称	国家/地区	专利类型	专利号	申请日	到期日
	isolation structure					
56	Circuit for Removing Bubble Errors Occurring in Thermal Codes	美国	发明专利	5995028	1998/2/12	2018/2/11
57	分距快闪式类比数位转换器	中国台湾	发明专利	409464	1998/7/2	2018/7/1
58	移除热码内气泡错误电路	中国台湾	发明专利	421924	1998/7/2	2018/7/1

2、是否存在期限即将届满的专利

合肥市政府与力晶科技于 2015 年初即协商确定以驱动 IC 制程技术向公司出资，并于 2015 年 4 月签署《合作框架协议》。根据《合作框架协议》，公司、合肥建投与力晶科技于 2015 年 10 月签订《技术移转协议》，各方已确认力晶科技用以出资的专利技术范围。上述协议签订时，力晶科技用以出资的 58 项专利不存在期限届满的情况，有 3 项专利即将在 2016 年内届满。截至评估基准日 2016 年 10 月 31 日，力晶科技用以出资的专利中有 1 项专利期限届满，有 2 项专利有效期即将在当年届满。

由于力晶科技用以出资的专利技术是《技术移转协议》约定下三项制程技术所需要使用的专利，相关专利在双方协商谈判的过程中均视为一个技术包进行整体考虑，截至资产评估基准日，个别专利存在期限届满或即将届满的情形，不会实质影响相关专利对发行人的作用及价值。

3、相关专利技术使用权作价 20 亿元的评估定价依据，是否存在利益输送

力晶科技用于出资的 58 项专利使用权，是《技术移转协议》项下三项制程技术所需要使用的专利技术，相关专利在应用于三项制程技术的过程中整体产生价值。另外，根据《技术移转协议》的约定，除前述 58 项专利外，三项制程技术所需的其他技术文件及数据、技术经验等，也由力晶科技同步移转，与前述 58 项专利形成整体制程技术包，共同对发行人生产经营发挥作用。

合肥建投与力晶科技就力晶科技用于出资的 58 项专利技术使用权委托安徽华洲资

产评估有限公司进行评估，评估方法为收益法，即通过估测资产未来预期收益的现值来判断其价值，具体通过销售收入提成率（或收益分成率）将资产贡献的收入从全部收入中“分离”出来，并将其折现得到评估值。该等通过出资方式获取的专利使用权广泛应用于发行人生产制造过程的各个环节及工艺流程，共同对生产产品发挥作用，故在评估时预测发行人整体收入及相关专利技术对发行人收入的整体贡献，并推算相关专利技术的价值。具体评估过程包括：（1）经济寿命分析；（2）未来销售收入预测；（3）确定无形资产提成率；（4）确定专利销售收入提成额；（5）根据对比公司估计折现率；（6）计算评估价值。

2016 年 12 月 28 日，安徽华洲资产评估有限公司就力晶科技拟以无形资产出资项目出具《资产评估报告书》（华洲评报字（2016）第 056 号），根据收益法评估结果，截至评估基准日 2016 年 10 月 31 日，力晶科技拟出资 58 项专利技术使用权的评估价值为 204,950.05 万元。2017 年 3 月 10 日，合肥市国资委就上述资产评估项目基本情况及资产评估结果出具了《接受非国有资产评估项目备案表》。

由于安徽华洲资产评估有限公司不具备证券期货相关业务评估资格，晶合集成聘请具备证券期货相关业务资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）对上述专利技术使用权出资进行评估复核。2020 年 1 月 20 日，同致信德出具了《关于对华州评报字（2016）第 056 号<力晶科技股份有限公司拟以无形资产出资项目>资产评估报告的复核报告》（同致信德评核字（2020）第 050001 号），经复核，安徽华洲资产评估有限公司出具的原评估报告书所涉及评估基准日的选择适当，评估所依据的法律、法规和政策基本齐全，评估报告的格式、内容全面、正确、基本符合规范要求，评估方法的选用恰当，评估结论合理。原评估目的和评估范围表述不准确。根据力晶科技、公司、合肥建投签订的《技术移转协议》，力晶科技转移的是晶圆芯片代工所需的 58 项专利技术使用权（普通许可）及专有技术使用权，而原评估报告中评估目的和评估范围描述的仅仅是 58 项专利技术使用权，表述不准确。

经与同致信德确认，调整评估范围表述的原因为：截至原评估基准日 2016 年 10 月 31 日，58 项专利技术使用权中存在部分专利的有效期限已经届满的情形，因此将有效期限届满的专利技术使用权认定为专有技术使用权，评估范围调整为 58 项专利技术使用权及专有技术使用权。

4、增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用

根据 2015 年 10 月晶合集成与力晶科技、合肥建投签订的《技术移转协议》，力晶科技用以出资的转移技术授权发行人使用，该等授权为不可转让、不可再授权、全球性、非专属性的授权，该等转移技术的知识产权归力晶科技所有。因此，力晶科技在增资后能继续使用或授予其他方使用该等转移技术。

根据力晶科技出具的书面确认，力晶科技用以出资的 58 项专利在出资时点仍在实际使用。2019 年 5 月，力晶科技与其下属企业力积电进行业务重组，力晶科技将其全部晶圆代工业务及相关资产转让至力积电，力晶科技成为控股型企业，转让的资产包中即包含上述 58 项专利中尚在有效期内的专利。根据力积电与发行人共同签署的确认函，本次转让不影响力晶科技与晶合集成此前签订的《技术移转协议》，晶合集成可以根据前述协议依法继续使用相关专利技术。2020 年初，为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产的权利完整性，合肥国资方与力晶科技进行了谈判，要求其将技术出资涉及的相关专利所有权转让给发行人。为此，力积电对当时其使用的技术情况进行了梳理，确认其自 2020 年 3 月起已不再使用力晶科技用于出资的相关专利技术。2020 年 3 月，力晶科技与力积电签署协议，力积电将前述在有效期内的专利所有权转让予力晶科技。

2020 年 9 月，力晶科技与发行人签署《专利转让协议》，约定将尚在有效期内的 44 项专利所有权无偿转让给晶合集成，转让完成之日起，晶合集成对前述专利享有完整的所有相关权利，力晶科技保证不向任何第三方许可上述专利，且协议签署前任何针对前述专利的许可（如有）已全部解除。2020 年 10 月，双方就前述 44 项专利办理了所有权变更登记手续。

根据力晶科技出具的书面确认，力晶科技与晶合集成签署《专利转让协议》后，力晶科技、力积电未使用也未许可他人使用《专利转让协议》项下的相关专利。

（二）力晶科技以专利技术使用权作价出资是否符合当时法律法规的规定，出资方式及内容是否与外资审批机构的批复相符

1、力晶科技以专利技术使用权作价出资是否符合当时法律法规的规定

力晶科技于 2017 年 3 月以专利技术使用权向发行人作价出资，根据当时有效的《中外合资经营企业法实施条例（2014 修订）》第二十二条规定，合营者可以用专有技术作价出资。以专有技术作为出资的，其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定，或者聘请合营各方同意的第三者评定。根据当时有效的《中华人民共和国公司法（2013 修正）》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。因此除法律、行政法规规定不得出资的财产，“可以用货币估价”并“可以依法转让”的非货币财产可以作价出资。专利技术使用权不属于《公司注册资本登记管理规定》第五条列举的“劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等”不得作价出资的财产，不违反当时法律法规的规定。此外，根据当时有效的《中华人民共和国专利法》（2008 年修订），被许可人实施专利应向专利权人支付专利使用费。根据当时有效的《合同法》，“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。”综上，专利使用权可以依法转让并用货币估价，且不属于当时法律法规规定不得作价出资的财产。

此外，双方已就专利技术使用权出资履行了资产评估、工商登记等手续。

根据合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《证明》，发行人无因违反市场监管类法律法规而受到该局行政处罚的记录。因此，发行人未因力晶科技以专利技术使用权出资受到市场监督管理部门的行政处罚。

综上，本所认为，力晶科技以 58 项专利技术使用权作价出资符合当时有效的《中外合资经营企业法实施条例（2014 修订）》《中外合资经营企业法实施条例》《中华人民共和国公司法（2013 修正）》《公司注册资本登记管理规定》等法律、法规的相关规定。

2、出资方式及内容是否与外资审批机构的批复相符

自 2016 年 2 月力晶科技投资参股晶合有限后，晶合有限变更为中外合资经营企业，属于外商投资企业。2017 年 3 月力晶科技以专利技术使用权作价出资时，根据当时有效的《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》第六条规定，外商投资企业投资

者基本信息变更，包括认缴出资额、出资方式、出资期限、资金来源地、投资者类型变更等，应由外商投资企业指定的代表或委托的代理人在变更事项发生后 30 日内通过综合管理系统在线填报和提交《外商投资企业变更备案申报表》及相关文件，办理变更备案手续。根据上述规定，外商投资企业的出资额及出资方式发生变更的，不需要事先取得审批，应在线报送设立备案信息或办理变更备案手续。

就力晶科技本次出资，发行人已完成了外商投资企业相关备案手续。

综上，力晶科技以专利技术使用权出资事宜无需经外资审批机构批复，发行人已依法办理外资备案手续。

（三）受让技术在使用、后续研发等方面是否受到我国台湾地区政策等方面的限制或存在相关风险

1、力晶科技以专利使用权出资时已经过中国台湾投审委核准

（1）以专利使用权出资需要经过中国台湾投审会核准的相关规定

力晶科技以专利使用权出资时有效的《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》（以下简称“《许可办法》”）第七条规定：“台湾地区人民、法人、团体或其他机构依本办法规定在大陆地区从事投资或技术合作者，应先备具申请书件向投审会申请许可”。力晶科技以专利使用权出资属于《许可办法》所规定的“在大陆地区从事投资”，需要经中国台湾投审会核准。

（2）力晶科技以专利使用权出资时已经过中国台湾投审会核准

根据台湾投审委于 2017 年 3 月 29 日出具的经审二字第 10600015560 号函，依据《许可办法》及《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》的规定，核准力晶科技以专门技术（晶圆代工制程相关技术）作价人民币 20 亿元，用于对晶合集成进行技术出资。

根据《台湾法律意见书》，力晶科技依《投资参股协议》《技术移转协议》执行技术移转的行为，事先已经中国台湾投审会核准。因此，力晶科技已履行完毕中国台湾地区相关审批程序。晶合集成使用、后续研发力晶科技用以出资的专利技术不会受

到中国台湾地区政策等方面的限制，亦不存在相关风险。

2、力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时无需台湾投审委核准

经核查，2020 年 9 月 3 日，为进一步完善力晶科技无形资产出资的资产权利完整性，力晶科技与晶合集成签订了《专利转让协议》，力晶科技将上述 58 项专利中尚在有效期内的 44 项专利的所有权无偿转让给晶合集成。2020 年 10 月，双方完成专利所有权的转让。

根据力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时有效的《许可办法》第七条规定：“台湾地区人民、法人、团体或其他机构依本办法规定在大陆地区从事投资或技术合作者，应先备具申请书件向投审会申请许可。”《许可办法》第五条对“技术合作”进行了解释：“本办法所称在大陆地区从事技术合作，系指台湾地区人民、法人、团体或其他机构，提供专门技术、专利权、商标专用权或著作财产权与大陆地区人民、法人、团体或其他机构之合作”。根据台湾法律意见书，“技术合作指专门技术、专利权等之授权，不包含专门技术、专利权等之转让”。

因此，力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时，专利权转让不属于《许可办法》所规定的“在大陆地区从事技术合作”或“在大陆地区从事投资”的情形，无需中国台湾投审会核准。

综上，力晶科技以专利技术使用权出资已取得中国台湾投审会核准，力晶科技将相关专利所有权转让给发行人时不需要取得中国台湾投审会核准。发行人已取得相关专利技术的所有权，受让技术在发行人使用、后续研发等方面不会受到中国台湾地区政策等方面的限制，亦不存在相关风险。

（四）上述专利技术在发行人的生产经营中的实际使用情况及技术发展过程中所起的作用

根据发行人提供的专利证书等相关资料，发行人从力晶科技处受让取得的 58 项专利发行人生产经营中使用情况具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
1	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	用于增加曝光制程精准度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
2	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
3	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	用于提升铜导线制程精准度	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
4	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	用于减少焊垫面积	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
5	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	用于缩小导线间距	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
6	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
7	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	用于提高光刻准确度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
8	发明专利	Semiconductor device having reduced interconnect-line parasitic capacitance	US 6,531,776 B2	用于达到有效电容面积	150nm、110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
9	发明专利	Method for forming stepped contact hole for semiconductor devices	US 6,444,574 B1	用于有效控制接触面	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
10	发明	Method of forming stepped	US 6,583,055 B1	用于有效控制浅沟槽深度位	110nm、90nm 制程 Driver

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
	专利	contact trench for semiconductor devices		置	IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic 、 PMIC
11	发明专利	Method for automatically controlling defect -specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	用于改善良率	Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、PMIC
12	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	用于使电性稳定	90nm 制程 Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic、PMIC
13	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	用于 SOI 器件改善浮体效应	150nm 、 110nm 、 90nm 制程 Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic 、 PMIC
14	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	用于 SOI 器件改善浮体效应	150nm 、 110nm 、 90nm 制程 Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic 、 PMIC
15	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm 、 90nm 制程 Driver IC 、 MCU 、 CIS 、 Logic 、 PMIC
16	发明	Half-tone phase shift mask and patterning	US 7,461,472 B2	用于增加曝光	Driver IC 、 MCU 、 CIS 、

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
	专利	method using thereof		制程容忍度	Logic、PMIC
17	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	用于增加曝光制程容忍度	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
18	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	用于通过重复旋转涂布工艺生成介电层来改善半导体器件良率	150nm 、110nm 、90nm，制程 Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic 、PMIC 产品
19	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	用于增加通孔接触率	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
20	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	用于提高氮化钛膜品质	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
21	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm 制程 Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic 、PMIC
22	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	用于形成多个自对准接触孔	150nm 、110nm、90nm 制程 Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic 、PMIC
23	发明	Semiconductor device having	US 7,612,433 B2	用于减少光刻	Driver IC 、

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
	专利	self-aligned contact		层数，节省光罩	MCU、CIS、Logic、PMIC
24	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
25	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	用于提升铜导线制程精准度提升	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
26	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	55nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
27	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
28	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	用于有效控制闸极面积	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
29	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
30	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
31	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	用于改善数据的非易失性安全存储传输延迟问题	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
32	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	用于增加曝光制程容忍度	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
33	发明专利	制作通孔的方法	I240988	用于提高抗反射层移除率增加通孔接触率	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
34	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	用于减少光刻层数，节省光罩	110nm、90nm制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
35	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
36	发明专利	导线的制造方法	I254365	用于提升铜导线制程精准度	55nm制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
37	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
38	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	用于减少焊垫面积	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
39	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
40	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	用于降低光罩异常风险	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
41	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	用于提高产品品质	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
42	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	半导体组件故障检测的方法，用于分析产品良率不佳的主要原因	110nm 制程 Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
43	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	用于减少光刻层数，节省光罩	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
44	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	增加半导体堆叠结构之间的气隙比，改善传输延迟	110nm 制程 Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
45	发明专利	PROCESS FOR FORMING SHALLOW TRENCH ISOLATION	5747377	用于减少鸟嘴效应、热氧化应力和沟槽缺陷	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
46	发明专利	SELF-BIASED VOLTAGE-REGULATED CURRENT SOURCE	5801580	用于稳定电流源输出电流	110nm、90nm 制程 Driver IC
47	发明专利	LOW-CURRENT SOURCE CIRCUIT	5805010	用于产生具有最小空闲状态的恒定电流和参考电压	110nm、90nm 制程 Driver IC
48	发明专利	Low mask count cmos process with inverse-t gate ldd structure	5854101	用于减少光掩模数并最小化闩锁和沟道热载流子效应	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
49	发明专利	Method of fabricating a short-channel mos device	5773348	用于降低当前光刻工艺的限制	Driver IC 、MCU 、CIS 、Logic、PMIC
50	发明专利	Method of fabricating a mos device having a	5736446	用于改善 MOS 器件的栅极延	Driver IC 、MCU 、CIS 、

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
		gate-side air-gap structure		迟时间和功耗	Logic、PMIC
51	发明专利	Method of fabricating a mos device with a localized punchthrough stopper	5963811	用于防止由减小的沟道长度引起的穿通现象	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
52	发明专利	METHOD TO FORM METAL-TO-METAL ANTIFUSE FOR FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY APPLICATIONS USING LIQUID PHASE DEPOSITION (LPD)	5937281	用于改善反熔丝结构性能	Driver IC
53	发明专利	Sub-range flash analog-to-digital converter	5973632	用于校正闪存数位转换器中粗分比较和细分比较之间的不匹配	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
54	发明专利	Method of Fabricating lightly-doped drain transistor having inverse-t gate structure	6130135	用于减小漏极附近的电场并防止热载流子退化以提高器件可靠性	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
55	发明专利	Method for fabricating trench-isolation structure	6069057	用于减小硅局部氧化隔离（LOCOS）中的鸟嘴效应和机械应力	Driver IC、MCU、CIS、Logic、PMIC
56	发明专利	Circuit for Removing Bubble Errors	5995028	用于消除热码中出现的气泡	110nm 制程 Driver IC、MCU、CIS、

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利技术作用	专利技术使用情况
		Occurring in Thermal Codes		错误	Logic、PMIC
57	发明专利	分距快闪式类比数位转换器	409464	用于通过热码校正方式校正粗分比较和细分比较间的失配	110nm 制程 Driver IC 、MCU 、 CIS 、Logic、PMIC
58	发明专利	移除热码内气泡错误电路	421924	用于消除热码中出现的气泡错误	110nm 制程 Driver IC 、MCU 、 CIS 、Logic、PMIC

上述专利相关技术主要用于发行人成立初期，为快速完成产线搭建、开展生产经营、承接客户需求，减少发行人自行重复研发上述技术所需的时间及费用，在生产经营中实际使用了前述相关专利技术，对于发行人生产经营及技术发展起到了推进作用。

三、《问询函》第 3 题：关于特殊权利条款

根据保荐工作报告，合肥建投同力晶科技签订的《投资参股协议》，约定了增资选择权、后续增资、股份处置限制条件等条款，但未具体说明相关条款内容。双方已签署补充协议，约定自该协议签署之日起，该条款终止，且对双方不再有约束力，无论何种情况下亦不再恢复。

请发行人说明：（1）上述该等特殊约定条款的签署背景及主要内容，相关条款的履行情况，与委托经营管理的关系以及对公司治理的影响；（2）相关条款终止是否存在纠纷或潜在纠纷，是否影响控制权稳定。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）上述该等特殊约定条款的签署背景及主要内容，相关条款的履行情况，与

委托经营管理的关系以及对公司治理的影响

1、上述该等特殊约定条款的签署背景及主要内容

根据合肥建投与力晶科技签订的《投资参股协议》，及力晶科技、合肥建投的说明，《投资参股协议》中特殊约定条款的主要内容及签署背景如下：

条款名称	具体内容	签署背景
增资选择权	晶合集成获利起 5 年内，乙方（力晶科技）享有对晶合集成现金增资 12 亿元的选择权。 上述现金增资，若在晶合集成 IPO 前，则以晶合集成当期评估净值增资；若在晶合集成 IPO 之后，则依据中国上市公司定向增发相关规定执行。为引入战略合作厂商、鼓励员工或其它营运需要，经双方协商一致，乙方可以其本人或指定的第三方执行前述的增资选择权。	签署本条款系合肥市政府招商引资的条件之一，主要目的在于激励力晶科技在投资后能积极履行股东义务，促进力晶科技关注、参与公司经营，有利于公司发展。如履行相关增资选择权，在晶合集成实现获利后，力晶科技可以享受更多分红及股权增值等收益。另外，根据双方约定的投资规模，在晶合集成实现获利后，即使力晶科技增资 12 亿元，其持股比例仍不会超过合肥国资方控制的股权比例，该等条款并非出于力晶科技谋求公司控制权而设置。
后续增资	晶合集成资本额达到 83.1 亿元后，若拟再增加资本额（乙方因本协议第二条第六项依增资选择权入股者，不在此限）晶合集成须取得其已发行普通股 2/3 以上股份同意后方得进行增资。	签署本条款系力晶科技为维护自身小股东权益而提出，避免引入其他投资方造成力晶科技的持股比例被进一步稀释，或引入与力晶科技晶圆代工业务的直接竞争者，以促进双方合作稳定，并相互提供保障。
股份处置条件	于晶合集成 IPO 前，除甲方（合肥建投）向其组建的基金及其关联方转让持股及乙方向其关联方转让持股外，非经甲方特洽股东全体及乙方书面同意，所有股东不得转让持股，若任一股东因不可抗力事由而需处置持股，其它股东依其持股比例可以相同条件享有优先承购权。若甲方各特洽股东因不可抗力事由需处置持股，而乙方未执行优先承购权，甲方各特洽股东售股对象不	

	得为乙方晶圆代工的直接竞争者。	

2、相关条款的履行情况

根据发行人提供的工商档案资料、合肥建投与力晶科技签订的《投资参股协议》及其补充协议以及力晶科技、合肥建投出具的确认函，上述增资选择权、后续增资、股份处置条件等特殊约定条款均未实际履行。2021 年 3 月，合肥建投与力晶科技签订《投资参股协议之补充协议》，上述特殊约定条款均已终止。

3、与委托经营管理的关系以及对公司治理的影响

上述特殊约定条款系出于保护力晶科技小股东权益、稳固双方合作关系等目的而签订，与委托经营管理不存在关系；上述增资选择权、后续增资、股份处置条件等特殊约定条款均未实际履行，对公司治理不存在不利影响。

（二）相关条款终止是否存在纠纷或潜在纠纷，是否影响控制权稳定

鉴于相关条款均未实际履行，合肥建投与力晶科技经协商一致后签署《投资参股协议之补充协议》，终止上述特殊约定条款。2021 年 6 月，合肥建投、力晶科技分别出具确认函，确认双方签订《投资参股协议之补充协议》系双方真实意思表示，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

综上，相关条款终止不存在纠纷或潜在纠纷，不影响发行人控制权稳定。

四、 《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务

根据保荐工作报告，力晶科技及其关联企业力积电从事晶圆代工业务，与发行人主营业务属于同一类型业务。在定位方面，双方均定位于晶圆代工领域；主要产品方面，发行人晶圆代工服务主要为制程为 90nm-150nm 的 12 英寸晶圆代工，力晶科技及力积电晶圆代工服务主要为制程为 65nm 及以上的 12 英寸、8 英寸晶圆代工；工艺平台方面，发行人主要工艺平台为 DDIC 晶圆代工，力晶科技及力积电主要工艺平台为 DDIC、PMIC、分离式元件、Flash、影像感测 IC、记忆体整合芯片。同时，发行

人与力晶科技及力积电主要客户、供应商存在重叠的情形。

请发行人：（1）具体说明公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务及技术方面的差异情况；（2）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况；（3）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因，是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）具体说明公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务及技术方面的差异情况

1、公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务方面的差异情况

报告期内，力晶科技及其关联企业中，从事晶圆代工业务的主体包括力晶科技和力积电。根据力晶科技公开披露的年报、审计报告等公开资料，力晶科技逐步淡出标准型内存产品的生产和销售，于 2013 年转型成为晶圆代工企业。力晶科技由 DRAM 制造企业转型至晶圆代工企业后， 2019 年 5 月将位于中国台湾的 3 座 12 英寸晶圆厂相关净资产、业务分割让与力积电，由力积电主导其晶圆代工服务的生产与销售。至此，力晶科技不再拥有晶圆代工产能，不再从事晶圆代工业务。

根据力积电公开披露的年报、审计报告等公开资料，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人与力积电均从事晶圆代工业务，发行人从事 12 英寸半导体晶圆代工，力积电从事 12 英寸及 8 英寸半导体晶圆代工；在制程节点方面，发行人以 150nm、110nm、90nm 半导体晶圆代工为主，力积电可以提供 350nm 至 25nm 制程节点的半导体晶圆代工服务；在工艺平台方面，报告期内，发行人以显示驱动芯片晶圆代工为主，力积电以记忆体产品晶圆代工、逻辑及特殊应用产品（例如：显示驱动芯片、电源管理芯片等）晶圆代工为主。

2、公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工技术方面的差异情况

根据发行人出具的说明，发行人在力晶科技技术出资取得的相关专利、及与力晶科技签订技术转让协议导入 90nm 衍生技术及 90nm M+技术平台的基础上，针对不同的客户需求和工艺平台进行了独立自主的研发，对产品结构、工艺流程进行了自主设计，拓展了新的工艺平台，增强了发行人的技术实力和技术独立性，扩大了发行人晶圆代工服务的产品结构，提升了产品质量，更加契合客户的产品需求，降低了发行人的生产成本，提高了产品性价比，有效增强了发行人晶圆代工服务的市场竞争力。

经过多年发展，发行人的晶圆代工技术在制程节点、代工晶圆尺寸、金属制程、技术路线、产品特性等方面已与力晶科技和力积电存在一定差异。

（二）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况

根据力晶科技和力积电公开披露的年报、审计报告等公开资料，报告期内，力晶科技和力积电晶圆代工业务的收入规模及毛利情况如下：

1、2018 年

2018 年度，力晶科技与力积电均具备晶圆代工产能，其收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技[1]	力积电
营业收入	**42,276,344**	**7,637,449**
其中：晶圆代工	41,607,352	7,637,436
包装元件	216,922	-
其他	452,070	13
营业成本	29,196,532	5,637,731
毛利	**13,079,812**	**1,999,718**
毛利率[2]	30.94%	26.18%

注 1：力晶科技数据为个体数据，不合并力积电

注 2：力晶科技、力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近。，数据出自力晶科技、力积电的年报和审计报告。

2、2019 年

2019 年 5 月 1 日，力晶科技将旗下三座 12 英寸晶圆厂及相关营业、净资产移转给力积电。收购完成后，力晶科技不再拥有晶圆代工产能，力积电拥有三座 12 英寸晶圆代工厂、两座 8 英寸晶圆代工厂，其收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技	力积电 [1]
营业收入	-	**35,897,121**
其中：晶圆代工	-	35,514,287
包装元件	-	382,834
营业成本	-	32,896,453
毛利	-	**3,000,668**
毛利率 [2]	-	8.36%

注 1：力积电数据以收购后之营运规模为基础，2019 年三座 12 英寸晶圆厂转至力积电前产生的收入与利润计入力积电。

注 2：力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近，数据出自力晶科技、力积电的年报和审计报告。

3、2020 年

2020 年，力积电具备晶圆代工产能，力晶科技不具备晶圆代工产能，其收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技	力积电
营业收入	-	**45,684,615**
其中：晶圆代工	-	45,552,596
包装元件	-	132,019
营业成本	-	34,692,204
毛利	-	**10,992,411**
毛利率*	-	24.06%

注：力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近，数据出自力晶科技、力积电的年报和审计报告。

（三）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因，是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

1、发行人与力晶科技及力积电的主要客户重叠情况和原因

（1）具体情况

报告期内，发行人前五大客户占发行人营业收入的比重分别为 99.74%、94.70%和 89.80%，该等客户占力晶科技及力积电营业收入比重分别为 15.61%、14.22%和14.63%，2020 年度，其客户重要性在力晶科技及力积电较低。

（2）客户重叠的原因

根据公开资料，近年来全球晶圆代工产能紧缺，上游芯片设计企业在全球范围内寻求稳定、可靠的晶圆代工产能。根据第三方咨询机构 Omdia 的统计，2020 年大尺寸显示驱动芯片市场份额排名前 8 的企业的市占率为 92.3%，市场集中度较高；排在前八名的企业中，芯片设计（Fabless）企业共有六名，包括：联咏科技（24.1%）、奇景光电（14.2%）、Silicon Works（14.2%）、瑞鼎科技（9.1%）、天钰科技（8.7%）、集创北方（3.2%），市占率合计达 73.5%。

一方面，该等芯片设计企业对晶圆代工需求较高，单一晶圆代工企业无法满足其生产需求，在全球范围内寻找稳定可靠的晶圆代工产能；另一方面，不同晶圆代工企业可以提供不同制程和工艺平台的代工服务，芯片设计企业需要根据设计需求，向不同晶圆代工企业下单，同时，芯片设计企业在多个晶圆代工企业下单，也可以达到分散风险的作用。

因此，上述芯片设计企业同时向力晶科技/力积电和发行人采购晶圆代工服务符合行业特征，发行人与力晶科技/力积电客户重叠具备合理性。

2、发行人与力晶科技及力积电的主要供应商重叠情况和原因

（1）具体情况

根据发行人取得的报告期内力晶科技及力积电采购占比达 90%以上的原材料供应商明细表（采购占比由大到小排序，合计占比达 90%以上），报告期内，从供应商数

量来看，发行人与力晶科技及力积电的主要供应商存在重叠较高的情形，发行人在报告期内向重叠原材料供应商采购的金额分别为 2.37 亿元、2.94 亿元和 5.40 亿元，占发行人向原材料供应商采购总额的比重分别为 83.30%、88.99%和 85.34%。

（2）供应商重叠的原因

①半导体原材料行业市场集中度较高

半导体行业原材料对纯度、材料稳定性等有较高要求，属于高端化学品、高端材料领域，行业领先的供应商在产品质量、供货稳定性、售后服务等方面具有优势，受到晶圆代工厂的青睐；除向发行人和力晶科技及力积电供货外，该等供应商亦向其他晶圆代工厂供货。

发行人与力晶科技及力积电的供应商存在重叠符合行业集中度特征。

②经营初期发行人主要向由力晶科技技术转让所取得《合格供应商名单》中载明的供应商采购

根据发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》，发行人自力晶科技处取得了相关技术文件，其中的《合格供应商名单》载明了晶圆代工各生产环节所需主要原材料的主要供应商名称。在发行人生产经营初期，为确保技转成功、品质稳定，发行人结合过往行业经验及生产经营的实际需要，主要向《合格供应商名单》中载明的供应商进行采购。因此，发行人与力晶科技及力积电的供应商存在重叠具备合理性。

报告期内，发行人的供应商均由发行人独立开发、谈判、维护。发行人的主要原材料和设备采购均由发行人独立决策、独立执行。力晶科技及力积电不参与发行人采购的任何环节。

3、是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

根据发行人出具的说明，发行人与力晶科技在技术方面存在差异，双方提供的晶圆代工服务存在差异，不具备完全的互相替代性；发行人的前五大客户和供应商均为行业知名企业，与发行人、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在配合发行人进行利益输送的情形；同时，全球晶圆代工市场规模较大，发行人与力晶科技及力积电均具有较大的发展空间，同一客户在多个晶圆代工厂同时下单、

同一供应商同时向多个晶圆代工企业供货等情形具备合理性。

力晶科技已于 2021 年 3 月 23 日签署关于独立性与同业竞争的《承诺函》，并承诺：

“2018 年 1 月至今，本公司及本公司下属企业与晶合集成存在部分客户、供应商重叠，该等重叠的客户、供应商均系双方独立开发、谈判、维护，不存在非公平竞争、通过重叠客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。”

综上所述，报告期内，发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠具备合理性，不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争和利益输送，亦不存在对发行人利益造成重大损害的情形及风险。

五、 《问询函》第 8 题：关于客户集中度

招股说明书披露：报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为 21,708.56 万元、50,563.95 万元、135,804.49 万元，占营业收入的比例分别为 99.74%、94.70%、89.80%，客户集中度较高，2020 年向第一大客户联咏科技股份有限公司销售收入占比 51%。合肥捷达微成立于 2017 年，2018 年与发行人开始合作，2019 年向发行人采购 2,439.84 万元；集创北方于 2020 年 9 月以货币出资 10,000.00 万元认缴 880.14 万元新增注册资本，持有发行人股份 0.58%，同时报告期各期均为发行人前五大客户之一。重大合同部分的销售合同主要披露了产能预留合同、订单等。

请发行人按照《问答（二）》第 12 条的要求进行相关信息披露。

请发行人说明：（1）报告期主要客户的获取方式、订单的下达方式及相关沟通记录，参与的销售人员情况及是否与力晶科技存在关系，获取客户的方式与销售费用的关系，列表说明协议签订方、签订时间、约定内容等协议相关的具体内容、委托经营管理前后协议签订的具体变化；是否与主要客户签订框架合同，如是，请说明销售合同披露的准确性，并提供相关合同；（2）联咏科技向发行人大额采购的原因，是否构成对联咏科技的重大依赖；采购量占联咏科技同类产品出货量的比例，联咏科技与力晶科技、发行人、实际控制人和董监高之间是否存在关联关系和潜在利益安排，联咏科技与力晶科技的合作历史，在发行人之前向力晶科技的采购情况；（3）前五大客户

向发行人采购的产品类型、数量和单价，单价与同行业同类别产品价格的比较情况，发行人产能、产量、销量、客户采购量及存货的匹配关系；（4）合肥捷达微成立不久即向发行人大额采购的原因，合肥捷达微和集创北方向发行人采购后的使用情况或向下游客户的销售情况，回款情况，与发行人、实际控制人和董监高是否存在关联关系或其他利益安排；集创北方入股价格的公允性，是否需要股份支付。

请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见，请保荐机构、发行人律师和申报会计师说明对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查方式和核查结论。

回复：

对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查方式和核查结论

（一）对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查方式

针对发行人的客户来源与力晶科技之间关联关系，发行人律师采取了以下核查方式：

1、对公司管理层和销售人员进行访谈，了解公司销售业务的主要模式、交易流程、客户获取方式等；

2、通过企查查等工商信息查询系统查询主要客户工商信息，核实主要客户与力晶科技是否存在关联关系及其他利益安排；

3、取得力晶科技出具的关于发行人主要客户来源情况的确认函；

4、实地走访/视频访谈主要客户，就客户与发行人的合作情况、初次接洽情况、与力晶科技的关联关系以及历史合作情况等进行询问并形成书面访谈记录，获取客户确认的与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系确认函的承诺函。

（二）对发行人的客户来源与力晶科技之间关联的核查结论

发行人在 2017 年自力晶科技技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与奇景光电、奕力科技涉及技术移转的相关技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证；在力晶科技与发行人确认了技术转让平台的适用

性和产品可靠性后，发行人与奇景光电、奕力科技进行独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等工作。

除上述情况外，发行人其余主要客户均为发行人自主联系、独立开发，双方通过邮件、电话等沟通确认需求，正式订单主要通过邮件等方式进行下达。与主要客户对接的主要销售人员刘忠育、李俊嘉、缪凤玲均为发行人员工，与发行人签署独立劳动关系合同，与力晶科技不存在关联关系。

六、《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性

根据申报材料：（1）招股说明书对核心技术情况披露较为简单。公司取得力晶科技相关技术后，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了现有技术平台。（2）核心技术人员多为中国台湾籍且具有力晶科技任职背景，部分曾有中芯国际、联华电子等工作经历。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，发行人发明专利数量 2018 年为 0 项，2019 年为 2 项，2020 年为 71 项。（4）2015 年 10 月，《技术移转协议》约定力晶科技提供驱动 IC 代工所需之制程技术予公司，用以出资的转移技术作价 20 亿元。（5）2020 年 9 月，力晶科技将用于出资的 58 项专利技术使用权中尚在有效期的 44 项无偿转让给晶合有限。（6）2018 年 4 月、2021 年 4 月，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》及《补充协议》，约定力晶科技向公司移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，公司需合计支付 500 万美元。

请发行人详细披露核心技术的形成过程，力晶科技在发行人技术发展过程中的作用，现有技术平台和技术先进性的具体表征。

请发行人说明：（1）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响；（2）2018 年、2019 年发行人发明专利数量较少的原因；（3）2020 年新增多项发明专利的原因，除力晶科技转让的 44 项发明专利外，其他发明专利的形成过程及研发人员情况，与力晶科技的技术及人员间的关系，新增自有专利在发行人生产经营中的作用；受让专利部分注册地位于美国的原因；（4）用以转移出资的技术与 90nm M+相关协议约定的技术之间的关系，支付费用获取 90nm M+驱动 IC 制程技术的必要性，非一次性支付的原因，若不购买上述技术公司能否独

立开展 90nm 晶圆代工研发及生产；（5）力晶科技转让给发行人的相关技术与自身（包括力积电）技术的差异；（6）结合发行人部分高管及核心技术人员曾在力晶科技任职、力晶科技向发行人转让技术、委托经营管理等情况，说明发行人自我研发能力体现在何处，是否对力晶科技构成研发和技术体系依赖，是否具备独立研发能力。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。请发行人律师说明对核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷事项的核查情况及核查结论。

回复：

（一）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响

在取得力晶科技转让的相关技术后，为更好地满足客户需求，提升自身的市场竞争力，发行人针对市场需求，由发行人自身的研发团队采取了一系列技术研发措施，对工艺结构和工艺流程进行了自主设计和创新升级，形成了发行人的核心技术平台，并将部分技术成果申请并获得了专利。

2015 年，力晶科技依据技术转让协议，将驱动芯片代工相关的 90 纳米、110 纳米、150 纳米工艺制程的基础技术文件及规格文件提供给发行人。2018 年，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》，导入 90nm M+技术平台。该等技术虽然可以用于部分产品的生产，但该等产品与客户需求存在差距，倘若不进行技术升级，则无法满足客户更高规格、更高效能的晶圆代工服务需求，产品应用种类亦存在局限性，无法满足公司进一步市场开拓的需要，难以进一步提高市场竞争力、丰富产品结构、提高收入规模。

通过自主设计工艺结构、改造工艺流程等持续的创新优化和技术研发，发行人积累了丰富的技术成果与研发经验，在 150nm、110nm、90nm 制程节点形成了 LCD 显示驱动、LED 显示驱动、CIS、E-tag、MCU 等领域的核心技术平台，增强了发行人的技术实力和技术独立性，扩大了发行人晶圆代工服务的范围和质量，更加契合客户的产品需求，有效提高了发行人晶圆代工服务的市场竞争力，为发行人在晶圆代工领域开拓市场、提高收入规模、丰富产品结构提供了有效的支撑。

报告期内，2018 年至 2020 年，发行人晶圆代工业务收入分别为 21,765.95 万元、53,336.01 万元和 151,186.11 万元，实现了稳健增长。

（二）2018 年、2019 年发行人发明专利数量较少的原因

根据发行人报告期内专利申请明细、《专利管理办法》等内部制度以及发行人出具的说明，发行人在设立初期，主要精力投入在调试机台及产能建设中。在人员配备上，主要以制程工程师、设备工程师为主。在实现产品量产后，公司立即加大对专利申请和保护工作的投入。

公司于 2018 年 1 月成立专利委员会，组织专利评审会，在内部推行正式的专利申请奖励制度，并开始相关技术的专利申请流程。2018 年 3 月公司成立研发副总经理室，下设设计服务处、模型器件处、先进整合处、光学模型处。研发副总经理室主要职责包括开发先进技术平台，提供集成电路 IP 设计、测试及管理。研发副总经理室成立后，公司研发人员逐步完善。

根据公司提供的员工花名册，截至 2018 年 2 月末，公司研发人员共计 30 位；截至 2018 年 12 月 31 日，公司研发人员增加至 119 名；截至 2019 年 12 月 31 日公司研发人员共计 207 名。此外，根据国家知识产权局出具的证明，公司 2018 年申请境内发明专利 13 项，境外发明专利 6 项；2019 年申请境内发明专利 29 项，境外发明专利 10 项。中国、美国及其他国家或地区的专利申请一般在提交日起至少 18 个月后才予以公布。因此，发行人 2018 年不存在获得授权的发明专利，2019 年发行人获得授权的发明专利为 2 项。

本所认为，公司在 2018 年及 2019 年获得授权的专利较少存在合理原因，与公司业务发展阶段相匹配。

（三）2020 年新增多项发明专利的原因，除力晶科技转让的 44 项发明专利外，其他发明专利的形成过程及研发人员情况，与力晶科技的技术及人员间的关系，新增自有专利在发行人生产经营中的作用；受让专利部分注册地位于美国的原因

1、2020 年新增多项发明专利的原因

根据发行人报告期内专利申请明细、发行人已取得的专利证书、报告期内研发人员名单以及发行人出具的说明，随着发行人代工产品数量上升、业务规模不断扩大，

发行人核心技术的保护需求增加。与此同时，发行人研发团队不断扩充，相关技术研发投入持续加大。根据中国（南京）知识产权保护中心及中国（北京）知识产权保护中心网站，经知识产权保护中心预审合格的专利申请，可进入国家知识产权局快速审查通道，将大幅缩短专利申请的审查周期。2020 年发行人先后在北京、南京成立子公司，以通过当地知识产权保护中心的预审服务申请及进入快速审查通道，加快取得授权发明专利速度

经核查，2020 年发行人新增境内授权发明专利 20 项，境外授权发明专利 5 项，新增专利的具体情况如下：

类型	数量
境内新增授权发明专利	20
其中：	
2020 年申请的发明专利	14
2019 年申请的发明专利	5
2018 年申请的发明专利	1
境外新增授权发明专利	5
其中：	
2019 年申请的发明专利	3
2018 年申请的发明专利	2

2、除力晶科技转让的 44 项发明专利外，其他发明专利的形成过程及研发人员情况，与力晶科技的技术及人员间的关系，新增自有专利在发行人生产经营中的作用

截至 2020 年 12 月 31 日，除力晶科技转让的 44 项发明专利外，发行人拥有自行申请的发明专利共计 27 项，该等发明专利的形成过程、专利作用及研发人员情况具体如下：

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
1	中国	MOS 场效应晶体管及其制造方法	2018/10/23	ZL201811237197.5	陈耿川	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**随着集成电路中元件特征尺寸的逐渐减小，由于尖角效应，栅极覆盖的沟道区边界附近的栅介质层变薄，并且沟道和栅极之间的电场增强，导致栅极覆盖沟道区边界处的泄露电流增大，并影响器件的性能和可靠性。 **采取的措施：**发行人技术人员通过增加栅极覆盖的沟道边界处的阈值电压解决上述问题。 **实现的效果：**增加栅极覆盖的沟道区边界的阈值电压，改进器件的可靠性，降低工艺复杂程度，利于生产。
2	中国	沟槽隔离结构的形成方法	2019/1/18	ZL201910048694.9	张玉贵；吴佳特	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在采用高密度等离子体工艺改善绝缘材料层对沟槽的填充性能时会导致衬底表面上相应的沉积有较大厚度的绝缘材料层，从而使衬底表面不平坦，导致化学机械研磨后的表面更容易产生凹陷，使得研磨后的表面平坦度降低，此将会对后续的工艺造成不利影响。 **采取的措施：**发行人技术人员通过形成含氧绝缘层并进一步注入硼离子，改进工艺流程解决上述问题。

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						实现的效果：增加了沟槽隔离结构的隔离性能，避免出现由化学机械研磨工艺所产生的表面凹陷的问题，提高了良率。
3	中国	一种存储器及其制造方法	2019/2/1	ZL201910104747.4	许春龙；李庆民；杨宗凯	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**目前业界现有的可擦除可编程只读存储器（EPROM）一般都是先进行存储区浮栅（Floating Gate）及介电层（ONO:Oxide-SiN-Oxide）、存储区控制闸及逻辑区闸极的制作，再进行后段接触孔和金属互连的制作，闸极材料一般为多晶硅。现行的工艺必须先进行浮栅、控制闸与逻辑闸的制作，并最终通过接触孔将控制闸接出，工艺步骤比较复杂。 **采取的措施：**发行人技术人员在上述工艺基础上，将 EPROM 控制闸的制作工艺与接触孔同时制作，降低层间介质（ILD）的厚度。 **实现的效果：**降低工艺的复杂程度，降低成本。
4	中国	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	2019/7/8	ZL201910611966.1	黄志贤；刘小东；方建智；刘镇豪	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在 110nm 以及 150nm 逻辑产品中发现，由于氧化层掉落源极与漏极使金属硅化物无法顺利形成，造成金属硅化物形成存在缺陷，进而影响良率。

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						采取的措施：发行人技术人员改变预处理方法避免氧化层掉落，进而顺利形成金属硅化物。 **实现的效果：**增加 110nm 以及 150nm 逻辑产品稳定度，减少不良产品出现。
5	中国	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	2019/12/11	ZL201911268173.0	许春龙；李庆民；杨宗凯	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**集成电路制造技术对于器件（Device）与器件之间的隔离，多使用浅沟槽隔离(STI: Shallow Trench Isolation)的方法。器件按操作电压可分为低压（LV: Low Voltage）器件（约 0.8V~2.5V）和高压(HV: High Voltage)器件（约大于 3.3V），低压与高压器件所需浅沟槽隔离的深度不同(低压区约小于 2,000A，高压区约大于 3,000A)。现有的制造工艺主要是使用两枚不同的光罩（Mask）分别对低压及高压区进行光刻及蚀刻的过程来实现制作不同深度浅沟槽隔离的目的。 **采取的措施：**发行人技术人员利用低压与高压区域沟槽宽度不同及硼磷硅玻璃加热融化流动的特性，将融化后流入沟槽的硼磷硅玻璃作为高图形密度区的沟槽阻挡层，再蚀刻低图形密度区域的沟槽，达到两种不同的沟槽深度的效果。 **实现的效果：**只使用一枚光罩即可制作两种不同深度的浅沟槽隔离，简化了现行工艺并可以降低制造

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						成本。
6	中国	扩散型场效应晶体管的形成方法	2020/1/15	ZL202010043997.4	王梦慧；李庆民；祝进专	发行人技术人员自行研发。 **面临的问题：**在现有 110nm 平台横向扩散金属氧化物半导体（LDMOS）结构中，发现器件击穿电压比较低，导通电阻比较大。 **采取的措施：**发行人技术人员在现有 LDMOS 结构基础上，提出一种新型 LDMOS 结构，包括形成在漂移区中的沟槽隔离结构等。 **实现的效果：**对器件的耐压性能的双重优化。
7	中国	半导体器件及其制造方法	2020/2/18	ZL202010099798.5	翁文杰；王恒	发行人技术人员自行研发。 **面临的问题：**在孔洞成型要针对沟槽刻蚀时，必须要填入抗刻蚀物质；填入的过程中多余的部份必须要透过不同机台清除，导致产品制造时间长。 **采取的措施：**在填入抗刻蚀物质的机台新增 OKA73，直接在填入的机台将多余的物质清除。 **实现的效果：**缩短制造的时间。
8	中国	半导体元件的制造方法	2019/2/1	ZL201910103609.4	田矢真敏；中野纪夫；熊	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在集成电路中混合搭载多种半导体元件进行制造，可变电容元件会与例如场效应晶体管

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
					谷裕弘	（FET）等混合在一起制造，在此工艺流程中，有时部分杂质会被注入到可变电容元件，存在使可变电容元件的电容特性劣化的可能性的问题。 **采取的措施：**发行人技术人员通过将极性与 FET 的阱相同的杂质注入衬底的表面，形成一层掩模对可变电容元件进行保护，抑制可变电容元件的 C-V 特性的劣化的问题。 **实现的效果：**降低成本，防止可变电容元件的电容特性的劣化。
9	中国	一种半导体结构及其制造方法	2020/9/28	ZL202011039422.1	罗雪婷；林士程；吴建宏	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**55nm 制程生产工艺中，由于抗反射涂层（Barc）填充不平坦，从而使光刻胶胶厚不均匀，导致线宽变化及驻波效应。 **采取的措施：**发行人技术人员通过创新沟槽填充材料使沟槽平坦化解决上述问题。 **实现的效果：**减少驻波效应产生，提供更高的刻蚀选择性。
10	中国	测试结构及其测试方法	2020/10/16	ZL202011106814.5	周山；王丽雅；俞佩佩	发行人技术人员自行研发。 **面临的问题：**半导体集成电路的钝化层(Passivation)内存在的膜内应力对外部环境温度变化较敏感，可能造成钝化层破裂，在芯片使用过程

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						中会产生裂缝导致芯片故障。 **采取的措施：**设计一种钝化层质量评估的测试结构，在代工厂内即可以进行相关测试，实现对钝化层质量的评估。 **实现的效果：**降低钝化层破裂风险，提高良率。
11	中国	一种金属互连结构的形成方法	2020/9/30	ZL202011054620.5	张国伟；许宗能；王建智	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**铜制程工艺在开发过程中，由于为金属通孔（TV）陡直，这样沉积的薄膜的垂直厚度高，蚀刻时造成残留，在钝化层刻蚀（PV Etch）容易造成部分氧化硅（SiO2）和氮化硅（SiN）残留在上层金属通孔（TV）形成的开口中，造成封测（Bumping）良率损失。 **采取的措施：**发行人技术人员通过改良 TV 结构，并改进工艺流程解决上述问题。 **实现的效果：**提升铜制程代工产品良率。
12	中国	晶圆裂片方法及其应用	2020/9/8	ZL202010931740.2	陈曦	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在半导体工艺的开发和失效分析中，采用金刚石笔手工在晶圆上划出一定深度的划痕，然后利用晶圆特性使其沿着划痕裂开，从而获得所需要的横断面，受限于手工的操作限制，难以达到

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						微米级的精准度。 **采取的措施：**发行人技术人员通过利用漏斗式激光标记解决上述问题，简化裂片工序以缩短裂片时间的同时，并使得裂片的精度达到微米级。 **实现的效果：**能够对晶圆进行快速有效的失效分析。
13	中国	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	2020/9/9	ZL202010938526.X	温育杰；李文庆；吴小贤；王曼真；陈晓红	发行人技术人员自主研发 **面临的问题：**在逻辑平台制程开发过程中，发现现行检验方法应用在离子注入机台时，由于感度低而无法检测机台的差异，无法反应产品状况。 **采取的措施：**在原有的离子注入基础上再加入一道反向掺杂，增加两组半导体设备的电阻差异。 **实现的效果：**提高检测感度，解决机台差异问题。
14	中国	一种光阻层阻挡能力的检测方法及检测系统	2020/9/9	ZL202010937768.7	温育杰；程挚；李昌达；方晓宇；郭宜婷	发行人技术人员自主研发 **面临的问题：**现有技术中判断光阻层的阻挡能力会因表面结构缺陷导致判定困难，且击穿离子数量/离子能量太低时无法感测。 **采取的措施：**建立不同的检测机制，改变表面结构特性，使热导率检测感度提升。

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
						实现的效果：简化测试过程，快速测量光阻层阻挡离子注入的能力。
15	中国	一种浅沟槽结构制备方法	2020/9/24	ZL202011012959.9	林子荏；杨智强；林政纬；林祐丞	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在 55nm 逻辑平台工艺开发过程中，在浅沟槽制程中，在利用氢氟酸蚀刻氧化硅时，浅沟槽中的硅都会有一定程度的损伤，所以必须在氢氟酸中添加抑制剂避免浅沟槽中的硅受到损伤。 **采取的措施：**发行人技术人员利用干蚀刻方式使用对硅有高选择比的蚀刻方式做氧化硅蚀刻。 **实现的效果：**避免上述损伤，节省成本。
16	中国	一种半导体结构的制备方法	2020/9/9	ZL202010937769.1	林祐丞；杨智强；林子荏；林政纬	发行人技术人员自行研发。 **面临的问题：**在 Flash Memory 平台开发过程中，发现控制栅极蚀刻后若氧化物-氮化物-氧化物结构的包围层（ONO fense）太高易藏有多晶硅残留造成短路影响良率。 **采取的措施：**发行人技术人员在这道工艺进行蚀刻时采用特殊策略在最小的副作用下将 ONO fense 消除。 **实现的效果：**提升良率。

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
17	中国	一种半导体结构的制备方法	2020/9/25	ZL202011021798.X	卢俊玮；贾涛；范广超	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**现有蚀刻工艺会导致盖帽层圆弧化及金属硬掩模刻蚀侧壁受损，导致金属互连线的导通性能受到影响。 **采取的措施：**发行人技术人员通过在刻蚀过程中在金属硬掩模侧壁上形成一层保护膜，用于解决盖帽层圆弧化及金属硬掩模层侧壁受损的问题。 **实现的效果：**利用此技术保障金属互连线的导通，有效提高公司产品的良率和稳定性。
18	中国	电容器及其制备方法	2020/9/28	ZL202011037143.1	陈明睿；任雪琪；汪文婷；姚子凤；刘苑	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**目前半导体制程单层电容值很小，需要多层才能够扩大电容值，但这将会导致器件尺寸的增加。 **采取的措施：**发行人技术人员将同一基底的两个 MOS 电容串联，扩大电容值。 **实现的效果：**提高电容器的单位电容值，减小电容器尺寸。
19	中国	一种静电放电防护线路	2020/10/15	ZL202011099926.2	陈明睿；许嘉哲；曾权飞；	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**做静电释放测试时，发现内部电路与

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
					田姿璘	平台距离太近，导致内部电路被静电损伤。 **采取的措施：**发行人技术人员通过改变静电防护模块内部的接线方式，使放电路径变长，达到减小被静电损伤的危害。 **实现的效果：**延长了静电释放路径，保护内部电路不受损伤。
20	中国	半导体器件的制备方法	2020/10/14	ZL202011093528.X	阳清；崔助凤；金起準	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**高压平台开发中器件存在漏电问题。 **采取的措施：**发行人技术人员通过增加退火，减轻栅极预掺杂导致颗粒化效应，同时提升 N 型和 P 型硅栅极的蚀刻均一性解决该问题。 **实现的效果：**解决高压平台开发中器件漏电大性能不佳及 SRAM 软失效问题，提升器件可靠性及 SRAM 良率，加快平台开发进程
21	美国	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD	2018/11/25	US10,636,801 B2	陈耿川	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**现有的隧道介电层的材料不是完全的绝缘体，当隧道介电层的厚度较小时，容易引起漏电流，电荷存储在浮栅泄漏到擦除栅中并被擦除，引起数据不良的问题。 **采取的措施：**将浮栅的顶部设计为尖锐的尖端，可

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		THEREOF				以增加擦除栅和浮栅之间的隧穿电介质层的厚度，从而避免了泄漏电流，并且使分离栅非易失性存储器具有更好的数据保留。 **实现的效果：**使分离栅非易失性存储器具有更好的数据保存效果。
22	美国	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	2018/8/31	US10,490,647 B1	张玉贵；方建智；彭康钧；林群证	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在金属硅化物层中容易出现金属硅化物的团聚，将导致衬底内的许多针孔缺陷，并增加了金属硅化物层表面的粗糙程度。 **采取的措施：**在金属硅化物层形成中提供缓冲层，利用该缓冲层减小金属原子从金属层到基板中的扩散速度和深度。 **实现的效果：**防止在衬底中发生的针孔缺陷，改善金属硅化物层的表面粗糙度。
23	美国	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION	2018/11/25	US10,726,894 B2	陈耿川	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**目前的能隙间隧穿机制令 P 通道非易失性存储器的编程电流较低(<1 uA)，由于空穴迁移率低于电子迁移率，所以 P 沟道非易失性存储器具有单元读取电流低的缺点。

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		METHOD				**采取的措施：**采用双层导电层(如多晶硅)结构，对非易失性存储单元和阵列进行编程时引起碰撞电离，并且产生相对较高的 N 沟道电流。 **实现的效果：**减少所需的电子数量，降低编程电流。
24	美国	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	2018/10/18	US 10,490,441 B1	蒲甜松；李庆民；陈信全	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**在绝缘衬底上通过硅技术实现隔离一般需要对衬底进行离子注入工艺来形成隔离，或者通过硅片键合来形成隔离，其方法相对工艺比较复杂，成本较高，且生产周期相对较长。 **采取的措施：**发行人技术人员在形成第一凹槽后，在第一凹槽内形成第二凹槽，再在第二凹槽的侧壁形成保护层，之后对第一凹槽的侧壁进行氧化时，保护层起到保护作用，从而只在第一凹槽未被保护层覆盖的侧壁上形成氧化层，之后去除保护层，填充隔离材料，最终形成多个完全绝缘的硅岛。 **实现的效果：**不需要额外的离子注入、键合等工艺实现特定区域硅岛的形成，降低工艺的复杂程度，降低成本。
25	美国	NON-VOLATILE MEMORY AND	2019/2/18	US 10,854,758 B2	陈耿川	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**目前非易失性存储器的存储单元尺寸

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME				大，擦除效率低，擦除电压要求高且数据保持力差。 **采取的措施：**发行人技术人员通过在浮栅结构上设置第一尖锐部与第二尖锐部，且浮栅结构的一侧面与浮栅结构的一部分顶面所构成的拐角未被控制栅结构遮盖，拐角连接于第一尖锐部与第二尖锐部的一端之间，擦除栅结构的隧穿介电层包覆第一尖锐部、第二尖锐部及拐角的尖端部分，由此解决上述面临的问题。 **实现的效果：**提高了擦除效率，降低了擦除电压以及提高了数据保持力。
26	日本	ラッチ回路	2019/5/21	特许第 6761074 号	Hidemitsu Kojima	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**目前的锁存电路占用面积比较大。 **采取的措施：**发行人技术人员通过设计第一 PMOS 晶体管及第一 NMOS 晶体管、第二 PMOS 晶体管及第二 NMOS 晶体管的阈值电压，使其分别相差在预定值以上，以适当地构成锁存电路。 **实现的效果：**有效的减少了锁存电路的占用面积。
27	日本	SRAM、半導体集積回路及び LCD	2019/6/19	特许第 6801053 号	Hidemitsu Kojima	发行人技术人员自主研发。 **面临的问题：**SRAM 以并联方式输出数据时，数据线的面积较大。另一方面，在对 SRAM 的高速性

序号	专利地	专利名称	申请日	专利号	发明人	专利形成过程及作用
		ドライバ				要求较低的设备中，基于并联输出的高速性有时会有性能过剩的情况，数据线也因并联输出而需要较多的面积。 **采取的措施：**发行人技术人员通过将 SRAM 划分为多个存储单元及输入、输出电路，并且多个输入、输出电路串联，以解决数据线并联占用较多面积的问题。 **实现的效果：**减少输入、输出所需要的数据线的数量，进而减少了数据线的占用面积。

根据晶合集成提供的上述发明人的劳动合同，晶合集成新增专利均为自主研发，发明人均与晶合集成签署劳动合同，为晶合集成的员工。其在发行人任职期间形成的技术成果均为执行发行人指派的工作任务，并利用了发行人提供的物质技术条件完成，属于本人在发行人的职务发明，与力晶科技的技术及人员间无任何关系。

3、受让专利部分注册地位于美国的原因

根据专利转让协议以及发行人出具的说明，发行人受让的力晶科技部分专利主要应用于生产显示驱动芯片产品。专利权具有地域性，部分目标客户所生产的终端产品市场涉及美国，为了促进市场拓展和产品推广，同时保证相关专利在美国获得保护，故受让的力晶科技部分专利注册地位于美国，有利于对公司技术的保护。此外，在美国、日本或中国台湾等国家或地区申请专利符合集成电路行业惯例，发行人在美国等重点国家拥有专利权将减少其晶圆代工业务相关的专利风险。

（四）用以转移出资的技术与 90nm M+相关协议约定的技术之间的关系，支付费用获取 90nm M+驱动 IC 制程技术的必要性，非一次性支付的原因，若不购买上述技术公司能否独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产

1、用以转移出资的技术与 90nm M+相关协议约定的技术之间的关系，支付费用获取 90nm M+驱动 IC 制程技术的必要性

根据《90nm 项目技术协议》及发行人出具的说明，2018 年初，根据联咏科技需求，公司拟着手生产 90nm 触控与显示驱动整合芯片平台。但公司当时持有的受让于力晶科技技术转让的 90M 平台无法满足联咏科技的产品需求。

因此，为适应市场变化，完成产品更新换代，公司需要在当时拥有的 90M 技术平台上进行技术升级改造。2018 年 4 月 10 日，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》，约定力晶科技向发行人移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，发行人向力晶科技合计支付 500 万美元。

在通过取得 90nm M+相关技术平台后，经发行人技术团队与客户沟通比较，90nm M+相关技术相比发行人自力晶科技技术转移的 90 M 技术，在应用模型、设计元件等方面接近客户的技术标准，但仍不能满足客户的产品设计开发的要求，随后公司由核心技术人员李庆民带领研发团队对 90nm M+技术平台进行开发改进，同时公司取得了新增第三方 IP 公司力旺电子的 IP 授权，形成了公司核心技术平台 90nm 触控

与显示驱动整合芯片平台并实现量产，以满足联咏科技的技术要求。

2、非一次性支付的原因

根据发行人与力晶科技签署《90nm 项目技术协议》中相关条款，非一次性支付为双方协商与技术文件分批次约定交付时间所致，为正常商业安排，具有合理性。

3、若不购买上述技术公司能否独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产

若不购买上述技术，晶合亦可独立开展 90nm 晶圆代工研发及生产，但开发时间将至少延后 9 至 12 个月（其中包括工艺设计及开发 6 个月，SPICE 模型提取 3-6 个月），且研发费用预估将增加 600 万美元以上。

（五）力晶科技转让给发行人的相关技术与自身（包括力积电）技术的差异

根据《技术移转协议》《技术转移协议确认函》及发行人出具的说明，晶合集成与力晶科技于 2015 年 10 月 19 日签订了技术移转协议，此次技转均为力晶科技主流技术节点，包括三项制程技术（即 0.15um 大尺寸驱动 IC 及 90nm/0.11um 小尺寸驱动 IC 制程技术），包含专利技术、技术文件及数据以及运用该等技术过程中形成的技术经验等内容。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于 2018 年 3 月 31 日已完成技转。整体来看，截至双方完成技术转移之日，力晶科技转让给发行人的相关技术与其自身（包括力积电）技术均为当时的 90nm-150nm 主流技术平台，整体无显著差异。

经过三年多发展，考虑到集成电路行业的快速发展进步、不同客户领域的产品需求等方面均有所差异，对设备成本、质量、可靠性、性能等方面的要求各不相同，力晶科技转让给公司的技术在研发、生产和服务方面的成功经验不再完全适用，公司逐步依靠自身研发能力形成 110nm-55nm 的多种工艺平台产品并获得了客户认可。关于目前发行人与力晶科技的技术差异，具体情况详见本补充法律意见书第 4 题之“（一）具体说明公司与力晶科技及其关联企业在晶圆代工业务及技术方面的差异情况”的相关回复。

（六）结合发行人部分高管及核心技术人员曾在力晶科技任职、力晶科技向发行人转让技术、委托经营管理等情况，说明发行人自我研发能力体现在何处，是否对力晶科技构成研发和技术体系依赖，是否具备独立研发能力

根据力晶科技出具的《确认函》及发行人出具的说明，在发行人 10 名高级管理人员和核心技术人员中，有 4 名曾在力晶科技任职。自 2016 年 10 月至今，上述 4 人均在发行人处任职并与公司签署劳动合同，不再在力晶科技及其下属企业担任任何职务。同时，上述 4 人与公司签署了保密及竞业禁止协议，约定员工在工作过程中研发的或利用发行人生产工具制造的任何性质的知识产权均属于员工的职务成果，该等职务成果归属于发行人所有。

《委托经营管理合约》签订后，公司研发部门主要管理岗位包括研发副总、副处长、代副处长。公司研发部门成立于 2018 年 3 月，研发部门人员、研发团队均系公司员工，相关员工利用公司自有资源独立进行研发工作并将自主研发的成果申请专利，累积申请数十项专利，获得 10 项专利授权，力晶科技人员未参与公司技术研发。

报告期内，公司建立生产、销售、采购、财务、行政、企划、研发、内审等各部门，相关部门在董事会、管理层的领导下负责各自职责事项，根据公司经营需要制定经营计划，由公司董事会最终决策；公司自主研发主营业务相关技术，独立开发客户及开拓市场，在实际经营过程中独立承担经营责任和风险；公司在技术、人员、经营、管理等各方面均不存在对力晶科技依赖。

发行人所在晶圆代工行业主要依靠自身的工艺平台技术和客户设计图纸进行匹配，发行人在力晶科技技转的基础上已持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，后续的技术发展不需要依赖力晶科技的进一步授权或技术转让，对力晶科技不构成研发和技术体系上的依赖。

公司研发投入及研发人员占比较高，具有较强自主研发能力，公司自设立以来始终重视晶圆代工技术创新与工艺研发，公司通过持续对研发人才的招聘和培养，组建了由境内外资深专家组成的研发核心团队，其拥有在行业内多年的技术研发经验。

发行人的研发团队均为自有员工，不属于力晶科技员工或委派人员，在发行人任职期间形成的技术成果均为独立、自主地执行发行人指派的工作任务，对力晶科技不构成研发和技术体系上的依赖。

《委托经营管理合约》期间，力晶科技人员未参与公司技术研发，发行人自主研发主营业务相关技术，独立开发客户及开拓市场，在实际经营过程中独立承担经营责

任和风险；公司在技术、人员、经营、管理等各方面均不存在对力晶科技依赖。发行人的自我研发能力体现在机制、团队、专利和客户等方面，不依赖于力晶科技的研发和技术体系，在自主研发能力方面具备独立性。

（七）核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、核心技术人员入职发行人的时间及入职前任职情况

根据晶合集成提供的核心技术人员的劳动合同、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》、《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》及核心技术人员出具的声明，经本所律师核查，核心技术人员入职发行人的时间及入职前任职情况如下：

姓名	入职发行人时间	入职前任职情况			
		任职期间	入职前任职单位	职务	离职时间
蔡辉嘉	2016 年 4 月	1992 年至 1995 年 5 月	华隆微电子股份有限公司	工程师	1995 年 5 月
		1995 年 6 月至 2016 年 6 月	力晶科技	历任工程师、课长、代副理、经理、部经理、副处长、副厂长、厂长、协理	2016 年 6 月
詹奕鹏	2019 年 4 月	1997 年 7 月至 2001 年 8 月	联华电子股份有限公司	主任工程师	2001 年 8 月
		2001 年 8 月至 2018 年 5 月	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	资深技术总监	2018 年 5 月
		2018 年 5 月至 2019 年 4 月	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	顾问	2019 年 4 月

姓名	入职发行人时间	入职前任职情况			
		任职期间	入职前任职单位	职务	离职时间
邱显寰	2016 年 6 月	1996 年 6 月至 2007 年 6 月	力晶科技	历任工程师、黄光工程部副理、黄光工程部经理	2007 年 6 月
		2007 年 6 月至 2013 年 8 月	瑞晶电子股份有限公司	历任黄光工程部经理、制程模组工程一处处长	2013 年 8 月
		2013 年 8 月至 2015 年 9 月	台湾美光记忆体股份有限公司	历任制程模组工程处处长、新技术处处长	2015 年 9 月
		2015 年 9 月至 2016 年 6 月	力晶科技	技术处长	2016 年 6 月
张伟墐	2016 年 6 月	1995 年 9 月至 2013 年 7 月	力晶科技	制造部课长	2013 年 7 月
		2013 年 8 月至 2013 年 12 月	台湾美光记忆体股份有限公司	制造部经理	2013 年 12 月
		2013 年 11 月至 2016 年 6 月	力晶科技	制造部经理	2016 年 6 月
李庆民	2016 年 10 月	1982 年 8 月至 1983 年 3 月	工业技术研究院（光电所）	工程师	1983 年 3 月
		1983 年 3 月至 1984 年 3 月	华邦电子股份有限公司	制程整合工程师	1984 年 3 月
		1984 年 3 月至 1986 年 10 月	台湾茂矽电子股份有限公司	元件开发工程师	1986 年 10 月

姓名	入职发行人时间	入职前任职情况			
		任职期间	入职前任职单位	职务	离职时间
		1986 年 10 月至 1987 年 11 月	联瑞电子股份有限公司	副理	1987 年 11 月
		1987 年 10 月至 1989 年 4 月	联华电子有限公司	技术开发副理	1989 年 4 月
		1989 年 4 月至 1989 年 12 月	合泰电子股份有限公司	整合经理	1989 年 12 月
		1989 年 12 月至 2012 年 2 月	联华电子有限公司	历任整合经理、资深经理	2012 年 2 月
		2012 年 2 月至 2016 年 10 月	力晶科技	开发处经理、开发部经理	2016 年 10 月

2、核心技术人员不存在违反竞业禁止、保密协议的情形

根据台湾法律意见书、力晶科技及发行人核心技术人员出具的书面确认、相关离职证明，发行人核心技术人员不存在违反竞业禁止、保密协议的情形。

3、未使用原单位技术成果，与原单位不存在纠纷或潜在纠纷

根据发行人核心技术人员的书面确认，其在发行人任职期间形成的技术成果均为执行发行人指派的工作任务，并利用了发行人提供的物质技术条件完成，属于本人在发行人的职务发明。在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务与在发行人承担的工作任务无关，不存在使用原任职单位技术成果的情形。

根据核心技术人员的书面确认并经检索中国裁判文书网等相关网站，核心技术人员与原任职单位之间不存在纠纷或潜在纠纷。

综上，本所认为，公司核心技术人员不存在违反原任职单位竞业禁止、保密协议

的情形，亦不存在使用原任职单位技术成果，核心技术人员与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

七、《问询函》第 12.1 题：委托经营管理

根据申报材料：2015 年 10 月，公司与力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理，以协助公司执行于合肥新站区建成 12 英寸晶圆制造厂项目。2020 年 1 月 2 日，公司与力晶科技签订终止协议，双方同意自 2019 年 12 月 25 日起即终止《委托经营管理合约》。根据合约约定，力晶科技应将公司视为其工厂之延伸，全力支持公司经营管理，使公司迅速获利、扩充产能并且达到 IPO 的目标。但申报材料中未充分说明《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、公司治理、人员结构、技术等方面的变动及影响。

请发行人说明：（1）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定；（2）合约自 2019 年 12 月 25 日起终止但于 2020 年 1 月 2 日签订终止协议的原因，终止合约是否附带相应条件及期限；（3）各方当事人对于委托经营管理解除是否存在纠纷或潜在纠纷；（4）详细说明《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、客户、供应商、技术、日常经营管理等方面的变动及影响，并梳理完善招股说明书相关信息披露情况；（5）报告期内力晶科技如何全力支持公司经营管理，使公司在业务、技术、财务等方面达到 IPO 申报条件。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）《委托经营管理合约》签署的背景、主要内容、委托经营管理范围及具体方式，相关条款的具体执行情况，除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理事项的约定

1、《委托经营管理合约》签署的背景

（1）设立晶合集成的目的系建设合肥市国资方自主可控的芯片制造能力

2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升到国家战略层面，纲要指出：“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”，要求“加速发展集成电路制造业。以生产线建设带动关键装备和材料配套发展”。

作为国家级科技创新型试点城市，合肥市政府制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏器合”的产业发展战略。 2015 年，合肥市的新型显示产业已形成规模，京东方 6 代线、8.5 代线已投产，10.5 代线项目即将开工建设，但芯片产业仍处于起步初期。合肥市拟引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，利用合肥市新型显示产业的协同效应，以显示驱动芯片为切入点，通过面板显示等终端应用带动芯片产业发展。

投资设立发行人的初衷系落实国家集成电路产业发展战略，由合肥国资方主导建设国有控股的芯片制造企业，力晶科技作为合作方协助公司建立独立的运营能力，而非将公司作为力晶科技下属子厂进行管理。

（2）签订《委托经营管理合约》的目的系促进合作及控制投资风险

根据《合作框架协议》及《投资参股协议》，合肥市政府与力晶科技合作 12 英寸晶圆制造基地项目，并选定合肥建投为国资方投资平台，设立晶合集成作为项目公司。力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆制造企业营运方面有较为成熟的经验，且中国台湾地区在晶圆制造行业较为领先，而当时中国大陆拥有晶圆制造行业建厂及营运经验的企业、人才较为稀缺，合肥市国资方亦首次投资晶圆制造项目，对于晶圆制造企业的发展及营运无任何经验。因此，为了使晶合集成项目建成后能够尽快投产、建立独立的营运能力，降低公司的营运风险，合肥国资方拟借助力晶科技的成功经验，并结合行业特点以及中国大陆地区的实际情况，帮助公司完善晶圆制造行业各项制度的落地，建立独立的营运团队，加快公司整体发展，落实合肥市政府与力晶科技签订的《合作框架协议》的要求及精神。2015 年 10 月 19 日，力晶科技与公司签订《委托经营管理合约》，主要目的系促进双方合作以及配合技术导入，帮助公司尽快建立独立的营运能力；同时，如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够

约束力晶科技向公司投入更多精力与支持，降低投资风险。

（3）公司建设进程顺利，双方根据公司发展需求仅履行了《委托经营管理合约》中的部分条款

《委托经营管理合约》签订于双方建立合作意向初期，尽管《委托经营管理合约》的合同名称包含“委托经营”，但签订《委托经营管理合约》的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力，协议中并未约定委托经营的期限、委托经营的费用以及相关违约责任等在常规委托经营模式下的约定事项。在实际履行过程中，公司自身经营团队建立的进展顺利，部分为了预防经营、发展状况不及预期而设定的条款已无履行必要，双方仅根据公司发展的需求履行了《委托经营管理合约》中的部分条款，公司与力晶科技之间相互独立，力晶科技未将公司视为在大陆的子厂，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

2、《委托经营管理合约》的主要内容、委托经营管理范围及具体方式

《委托经营管理合约》的具体条款如下，其中第一条第一款及第二款对委托管理范围和方式进行了约定：

对应条款	主要内容
第一条第一款 委托经营管理范围	乙方审计师、副总会计师及其他经营管理团队由甲方指派。乙方财务实行总会计师与副总会计师会签及核决制度，采购、销售业务实行总监与副总监会签制度。乙方日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托甲方管理。
第一条第二款 经营管理模式	甲方将透过移转与授权技术、移转经营经验与经营管理系统、业务支持互补、移转或派驻经营团队、训练当地之干部与人才等方式，达成乙方付托之经营管理任务。甲方除遴选适当人员至乙方各组织，以兼职、派驻或全职身份按相关组织核决权限执行业务外，乙方董事会下应设立经营管理委员会，由甲方之高管及合肥建投委派至乙方，依第一条第一款所列之全部人员担任委员会成员，具体协助董事会指导并督促乙方所有经理人与经营团队。
第二条第一款 技术移转	甲方应按照技术移转协议，于乙方建置完成可进行驱动 IC 代工业务之相关技术，确保乙方能够完全掌握该技术，并可在无须另行依赖其他技术的前提下，完整地生产出本项目所涉全部合格产品。
第二条第二款 经营经验导入与经营管理系	（一）甲方应将现行于甲方实行，具备效率与竞争力之经营管理经验导入乙方，由乙方人员建置吸收并且在乙方推行，成为乙方的企业文化或 SOP。

统建立	（二）甲方应将现行于甲方量产，具备竞争力之量产全部参数导入乙方机台，并训练乙方生产与技术人员，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。 （三）甲方应将现行于甲方运作，具备竞争力之全部经营管理系统，包含但不限于生产管理软件、派工作业、自动化控制生产系统、会计系统、人事系统、签核流程等，导入乙方之计算机系统内，并训练乙方管理人员进行操作与问题解决能力，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。
第二条第三款 业务能力建立与订单互补支持	（一）针对技术授权之制程技术及代工业务，甲方应协助建立乙方之业务能力，让乙方业务人员运用大陆之优势，开拓并争取业务订单，以达成国产化之目标。 （二）当甲方之业务量需求超过甲方产能，且乙方之产能仍可支持时，甲方应移转订单到乙方进行生产。当乙方之业务量超过乙方产能，且甲方产能仍可支持时，乙方应移转订单到甲方。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利。
第二条第四款 派驻或经营团队建立	除技术移转协议规范之技术团队外，甲方应派驻并建立乙方所需之经营管理团队，以执行经营管理职务，类型与相关规定如下： （一）兼职人员：兼职人员系指具备甲方员工身分，但必须于乙方挂职以执行乙方业务之人员。此类人员之薪资由甲方负担，在移转技术验证完成之前，若因执行乙方业务时产生之差旅费及各项费用，由乙方支付。乙方可经过乙方董事会核准，支付该兼职人员薪资补贴。 （二）派驻人员：派驻人员系指由乙方雇佣并约定一定期间期满后即结束与乙方聘雇关系之相关人员。派驻人员派驻期间之薪资由乙方负担，派驻期间之相关保险与退休，亦由乙方按照法令予以支付，甲方及乙方可给予相对优惠条件于派驻人员，吸引人员愿意派驻。 （三）全职人员：全职人员系指由乙方雇用且正式任职乙方之人员。乙方于法令许可条件下，可以优惠条件吸引甲方相关团队（包含技术人员）成为乙方之全职人员。
第二条 第五款 训练全职或当地之经营人才与员工	甲方应从各方面促使乙方尽速建立全职或当地之经营人才及员工，以达成经营效率目标。
第三条 第一款	甲乙双方同意并了解，甲方与乙方皆为独立之公司，各自执行业务皆须满足各自之法令、公司内稽内控或审计制度、会计制度、组织签核权限等，不能因为人员重复而有混淆。相关精神与原则甲方与乙方须落实倡导，让相关人员得以遵守。

第三条 第二款	乙方所需之各项系统与设备，包含软硬件或劳务服务，若由乙方专用且须支付费用向第三方购买时，由乙方发包采购付款并列为乙方资产。
第三条 第三款	乙方所需有形资产（软硬件系统或设备），若需向甲方购买，则乙方可经过董事会核准后向甲方采购，并列为乙方资产。若乙方所需为甲方之无形资产，甲方应于移转技术验证完成之前无偿移转该无形资产予乙方。
第三条 第四款	本项委托经营乙方除因特别需求并经董事会批准之外，无需向甲方支付本协议约定外的其他任何费用。
第四条 委托经营管理目标	甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸，全力支持乙方之经营管理，使乙方迅速获利、扩充产能并且达成 IPO 之目标。甲方在约定时间内完成以下委托经营管理目标： 一、争取乙方于建厂完成后 12 个月内开始获利，并保持持续盈利能力。 二、争取乙方于建厂完成后第 13 至 24 个月期间净利润不低于 3 亿元，第 25-36 个月期间净利润不低于 4 亿元，第 27 至 48 个月期间净利润不低于 5 亿元，委托经营期内乙方税前内部收益率不低于 10%。 三、争取于建厂完成后的 5 个会计年度内达成乙方于中国大陆资本市场 IPO 需满足的除委托经营事项外的其他基本条件，同时乙方应立即启动中国大陆资本市场 IPO 申报程序。 四、甲方承诺为乙方聘雇的大陆员工提供必要培训，并保证建厂完成后 5 年内乙方具备独立经营能力，包括但不限于： 资产完整。乙方应具有开展生产经营所必备的完整资产，包括使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，乙方拥有健全的技术研发、应用能力。 人员独立。乙方高级管理人员、经营团队、技术团队等均独立于甲方，为其自行聘雇的全职人员。乙方的劳动、人事及工资管理均完全独立。 财务独立。乙方设置独立的财务部门，具有独立的财务核算体系、健全的财务会计管理制度，能够独立核算，独立进行财务决策，已发独立纳税。 机构独立。乙方的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，甲方及其职能部门与乙方及其职能部门之间不存在上下级关系。 业务独立。乙方应独立于甲方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具备独立的产、供、销系统，甲、乙双方之间无法

	避免的关联交易必须遵循市场公正、公平的原则。乙方委托甲方进行产品销售或原材料采购的金额，占其主营业务收入或外购原材料总额的比例均不应超过 30%。 上述目标中的第一、二、三项系由甲方依据自身经验与市场现况拟定，实际执行仍须双方进行分析及调研后讨论定案。甲方将努力争取完成上述目标，若因市场变化、营运策略、与产品组合之异动有所增减，得而由双方议定后更改。
第五条 解除委托经营管理合约	本合约有效期自签约生效日起至乙方满足于中国大陆资本市场 IPO 所需除委托经营事项外的其他基本条件之日止。本合约有效期截止后，乙方应立即启动中国大陆资本市场 IPO 申报程序。双方保证在取得其主管机关、董事会及其他法定必要的许可、核准及审批后方签署本合约。甲方应善尽善良管理人责任，依据委托经营管理合约执行管理义务，若单独因甲方未尽委托经营管理职责或有其他违反法律情事致使公司严重亏损，如经乙方要求甲方仍未补正者，乙方可要求终止委托经营管理合约，并追究甲方法律责任。
第六条 保密责任	任一方因履行本合约而知悉或持有他方之机密信息或对于本合约之内容，除依法令而应揭露外，应负保密责任，并非经揭露方书面同意，任一方不得泄露、告知或交付予任何第三人。任一方并应担保其员工或第三方亦遵守此一条款，若任一方或其员工或第三方违反此一条款时，该方应与违反之行为人负连带损害赔偿责任。本条款于本合约终止或解除后仍有效存在。
第七条 通知	本合约所称各项请求、通知或双方相互之间请求、通知，应以书面为之，并以挂号函件或快递亲签方式送达下列地址： 甲方：力晶科技股份有限公司 地址：台湾新竹市科学工业园区力行一路 12 号 乙方：合肥晶合集成电路有限公司 地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内 上述地址如有变更，变更之一方应即通知他方，否则不得以其变更对抗他方。
第八条 违约责任	甲乙任何一方如有不履行或违法本合约规定之任一承诺、保证或约定事项之情事时，经他方提出异议而未于适当期限内改善或补正者，即视为违约。 除本合约另有规定外，未违约之一方得径自通知解除或终止本合约书，或（并）对违约之他方请求因违约而产生之损害赔偿。

第九条 准据法	本合约以中华人民共和国法律为准据法。
第十条 仲裁	双方倘因本合约事宜发生争议，同意提交上海国际经济贸易仲裁委员会，依据该会之仲裁规则进行仲裁。双方同意对争议之内容及仲裁之提起、进行、内容、程序、结果，对外应严守秘密。
第十一条 转让	非经他方事前书面同意，本合约任一方当事人不得转让其于本合约之权利或义务之全部或一部予任何第三人，或设定负担或为其他任何处分。
第十二条 本合约份数	本合约正本一式二份，甲方、乙方各执一份存查。

2015 年 10 月，公司与力晶科技签署《委托经营管理合约》的同时，合肥建投与力晶科技签署了《投资参股协议》，其中亦对落实力晶科技导入晶圆代工厂建设经营，协助公司建立经营管理团队，以及双方向公司委派高级管理人员共同对公司生产经营实施监督进行了约定，并在后续签订的《公司章程》《合资合同》中予以沿用。具体条款如下：

文件名称及签订主体	签订时间	具体内容	终止情况
《投资参股协议》，其中：甲方为合肥建投、乙方为力晶科技	2015 年 10 月	第五条第二款 团队组成 甲乙双方同意，由乙方指派经营团队管理与主导晶合集成所有营运，包含但不限于建厂、技术导入、量产、公司经营等事项。 由甲方指派总会计师、财务部门负责人，由乙方指派审计师、副总会计师。此外，甲方指派采购副总监、销售副总监各 1 位，其余经营团队及经理人皆由乙方指派。 乙方应指派专属团队，常驻于合资公司协助营运，乙方指派其员工派驻执行相关业务时，合资公司可制定相关补贴标准，经董事会核准后，对特定员工给予补贴。未来常驻团队将逐步转为合资公司全职员工，由其直接聘录（相关规定细节亦由《委托经营管理合约》约定）。 叁方指派高管或经理人时必须依照合资公司之	2021 年 3 月，双方签订《投资参股协议之补充协议》，相关条款均已终止。

		公司制度，依叁方在本合约中针对董事会及管理团队之约定，通过相关程序并取得相关核准后才可就任。	
《公司章程》，由合肥芯屏、合肥建投、力晶科技共同签署	2016 年 1 月 20 日	第 33 条 合资公司的管理机构由以下高级管理人员组成：一名总经理、若干名副总经理，总会计师、审计师、副总会计师、采购副总监及销售副总监各一名，合资合同规定的其他高级管理人员以及视合资公司的经营需要由董事会不时任命的其他高级管理人员	2020 年 11 月，公司改制为股份有限公司，全体股东签署了新的《公司章程》，前述条款均已终止
《合资合同》，其中：甲方为合肥芯屏，乙方为力晶科技，丙方为合肥建投	2016 年 1 月 20 日	8.1 组建 甲乙丙叁方同意，由乙方指派经营团队管理与主导合资公司所有营运，包含但不限于建厂、技术导入、量产、公司经营等事项。 合资公司的管理机构由以下高级管理人员组成：一名总经理、若干名副总经理、并由甲方及丙方共同指派总会计师、财务部门负责人，由乙方指派审计师、副总会计师。此外，甲方及丙方共同指派采购副总监、销售副总监各 1 位，其余经营管理团队及经理人皆由乙方指派。 乙方应指派专属团队，常驻于合资公司协助营运，乙方指派其员工派驻执行相关业务时，合资公司可制定相关补贴标准，经董事会核准后，对特定员工给予补贴。未来常驻团队将逐步转为合资公司全职员工，由其直接聘录（相关规定细节亦由《委托经营管理合约》约定）。 叁方指派高管或经理人时必须依照合资公司之公司制度，依叁方在本合约中针对董事会及管理团队之约定，通过相关程序并取得相关核准后才可就任。	2020 年 11 月，公司改制为股份有限公司前，各方签署《关于合肥晶合集成电路有限公司之<合资合同>之终止协议》，《合资合同》已终止

3、相关条款的具体执行情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议记录、经营管理委员会会议记录、部分发行人日常经营性会议的会议记录、发行人员工花名册及部分员工合同、发行人组织机构图及审批权限表、力晶科技及合肥建投向发行人委派人员的名单、自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单、力晶科技出具的《确认函》以及发行人出具的说明等资料，并经本所律师访谈发行人主要客户、供应商，相关条款的具体执行情况如下：

（1）第一条第一款“委托经营管理范围”的具体执行情况

本条款主要目的系约定委托经营管理范围，明确双方权利义务。力晶科技通过委派高管人员，对公司生产经营实施监督，防止控股股东滥用控股地位；同时导入力晶科技在晶圆代工厂方面已较为成熟的各项制度，控制公司经营风险。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** 乙方审计师、副总会计师由甲方指派	实际履行
	具体执行情况： 合肥建投通过委派总会计师对下级控股企业的财务方面进行监督与管理，力晶科技为保障其作为小股东对公司财务状况的知情权以及共同对公司的运营情况进行监督，要求向公司委派审计师、副总会计师。该等约定在《投资参股协议》以及后续签订的《合资合同》、《公司章程》中亦有体现。股东双方委派高管参与管控、监督合资企业运营为国有企业与外资企业合资时的通常约定，非为委托经营特别约定事项。 ①《委托经营管理合约》签订后，公司内审部门主要管理岗位包括审计师、副审计师。《委托经营管理合约》签订后初期，公司的审计师由力晶科技委派，未设置副审计师；自 2019 年 1 月起，改由合肥建投委派审计师、力晶科技委派副审计师。上述委派安排系双方股东依据《投资参股协议》的约定，共同对公司的运营情况进行监督。 ②《委托经营管理合约》签订后，公司财会部门主要管理岗位包括总会计师、副总会计师，总会计师由合肥建投委派，副总会计师由力晶科技委派。上述委派安排系双方股东依据《投资参股协议》的约定，保障力晶科技作为小股东对公司财务状况的知情权。 由于上述条款并非为委托经营特别约定事项，《委托经营管理合约》	

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
	终止后，双方股东均继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派相关人员。2020 年 3 月，经双方股东协商一致，不再向公司委派上述岗位人员。	
2	**条款内容：** 其他经营管理团队由甲方指派 **具体执行情况：** 根据《投资参股协议》的约定，合肥建投向发行人委派总会计师、销售副总监、采购副总监，力晶科技向发行人委派副总会计师、审计师，其余经营团队、经理由力晶科技指派。本条款仅重申《投资参股协议》中关于委派经营管理团队的约定，主要目的是如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持，非为委托经营特别约定事项。 《委托经营管理合约》签订后，力晶科技根据《投资参股协议》的约定，向发行人先后委派了审计师、副审计师、副总会计师，并短期派驻了财务、行政及组织人事相关人员，向发行人传授晶圆代工厂运营经验，以及帮助发行人落地、改善相关内控制度。除上述外，公司其他经营管理团队均为发行人员工或合肥建投委派人员。	未实际履行
3	**条款内容：** 乙方财务实行总会计师与副总会计师会签及核决制度 **具体执行情况：** 为满足合肥建投作为国有企业对下级控股企业的管理要求，同时保障力晶科技作为小股东对公司财务状况的知情权，双方在《投资参股协议》中约定由合肥建投委派总会计师，力晶科技委派副总会计师。本条为落实双方合资安排的具体措施，非为委托经营特别约定事项。 《委托经营管理合约》签订后，合肥建投委派的总会计师和力晶科技委派的副总会计师共同执行会签及核决制度。由于上述条款并非为委托经营特别约定事项，《委托经营管理合约》终止后，双方股东均继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派总会计师、副总会计师，并实行会签及核决制度。 2020 年 3 月，经双方股东协商一致，不再向公司委派上述岗位人员，公司财务决策由负责分管的高级管理人员按照公司章程的约定履行内部决策程序，不再实行总会计师与副总会计师会签及核决制度。	实际履行

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
4	**条款内容：** 乙方采购、销售业务实行总监与副总监会签制度 **具体执行情况：** 合肥建投通过委派采购、销售岗位高级管理人员对下级控股企业采购、销售方面进行监督，该等约定在《投资参股协议》以及后续签订的《合资合同》、《公司章程》中亦有体现。合肥建投委派高管参与管控、监督合资企业运营为国有企业与外资企业合资时的通常约定，非为委托经营特别约定事项。 《委托经营管理合约》签订后，采购总监和销售总监均由公司员工担任，与合肥建投委派的采购副总监和销售副总监共同实行会签制度，力晶科技在采购和销售业务方面均未委派人员。由于上述条款并非为委托经营特别约定事项，《委托经营管理合约》终止后，合肥建投继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派采购副总监、销售副总监并实行会签制度。 2020 年 3 月，经双方股东协商一致，不再向公司委派上述岗位人员，公司采购、销售业务决策由负责分管的高级管理人员按照公司章程的约定履行内部决策程序，不再实行总监与副总监会签制度。	实际履行
5	**条款内容：** 乙方日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托甲方管理 **具体执行情况：** 《委托经营管理合约》签订后，发行人日常经营运作由财会部门、内审部门、销售部门、采购部门、营运部门、行政及组织人事部门、研发部门等具体负责。其中，财会部门、内审部门情况详见前款“乙方审计师、副总会计师由甲方指派”的具体执行情况，其他部门主要管理岗位的人员情况如下： ①公司销售部门负责人为销售总监（总经理兼任），由公司员工担任；销售副总监由合肥建投委派。不存在力晶科技委派人员在公司销售相关岗位任职，或参与公司销售工作的情形。 ②公司采购部门负责人为采购总监，由公司员工担任；采购副总监由合肥建投委派。不存在力晶科技委派人员在公司采购相关岗位任职，或参与公司采购工作的情形。 ③公司营运部门负责人为营运副总经理，主要管理岗位均由公司员工	未实际履行

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
	担任，不存在力晶科技委派人员在公司营运相关岗位任职，或参与公司营运工作的情形。 ④公司行政及组织人事部门负责人为行政副总经理，力晶科技曾于 2017 年 8 月至 2018 年 5 月期间，短期向发行人委派行政副总经理，在帮助发行人落地、改善相关制度后即返回力晶科技，后续该岗位由公司员工或合肥建投委派人员任职。除上述情况外，不存在力晶科技委派人员在公司行政及组织人事相关岗位任职，或参与公司行政及组织人事工作的情形。 ⑤公司研发部门负责人为研发副总经理，主要管理岗位均由公司员工担任，不存在力晶科技委派人员在公司研发相关岗位任职，或参与公司研发工作的情形。	

在公司设立并开始经营后，自 2016 年起发行人自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，已具备公司运营的各方面能力，不存在要求力晶科技派驻专属团队协助公司营运的需求和必要性。除双方股东依据《公司章程》《合资合同》的约定委派人员外，发行人其他高级管理人员均由公司员工担任。发行人的日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，未将日常经营运作委托力晶科技管理。因此，上表中所述《委托经营管理合约》部分约定未实际履行。

（2）第一条第二款“经营管理模式”的具体执行情况

本条款主要目的系约定委托经营管理模式，明确双方权利义务，督促力晶科技协助发行人在设立初期加快吸纳晶圆代工行业人才、建立运营团队，并以其在晶圆代工领域的成功经验为发行人提供咨询。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** 甲方将透过移转与授权技术、移转经营经验与经营管理系统、业务支持互补、移转或派驻经营团队、训练当地之干部与人才等方式，达成乙方付托之经营管理任务	部分履行
	具体执行情况： 《委托经营管理合约》签订后，力晶科技与发行人签订《90nm 项目技术协议》，向发行人移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件。此外，力晶科技在公司建厂初期，协助公司招聘了一批中国	

	台湾地区具有晶圆制造行业相关经验的人才，委派部分管理人员协助公司结合晶圆制造行业经验及中国大陆特点，完成财务、内部控制及稽核等制度的落地。 《委托经营管理合约》签订后，力晶科技未同发行人进行业务互补支持，详见本补充法律意见书第 12.4 题“订单互补支持”的相关回复	
2	**条款内容：** 甲方除遴选适当人员至乙方各组织，以兼职、派驻或全职身份按相关组织核决权限执行业务外，乙方董事会下应设立经营管理委员会，由甲方之高管及合肥建投委派至乙方，依第一条第一款所列之全部人员担任委员会成员，具体协助董事会指导并督促乙方所有经理人与经营团队	实际履行
	具体执行情况： 2018 年 12 月，发行人实际设立经营管理委员会，通过经营管理委员会为公司董事会提供咨询。《委托经营管理合约》终止时，发行人同步解散了经营管理委员会	

上表中所述《委托经营管理合约》中关于“业务支持互补”的约定未实际履行。双方设置“业务支持互补”约定，主要目的系表达双方的友好合作关系及长期合作愿景，同时，如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持。《委托经营管理合约》签订后，发行人日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派的高管为主导，在公司经营团队的努力及合肥国资方的积极协调下，公司在产品验证、业务拓展方面进展顺利，建立了独立的业务开拓能力。同时，随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。因此“业务支持互补”的约定未实际履行。

（3）第二条第一款“技术移转”的具体执行情况

主要目的系重申并督促力晶科技履行《技术移转协议》项下的技术移转相关义务，使力晶科技用于出资的制程技术能尽快在发行人处落地、量产。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** 甲方应按照技术移转协议，于乙方建置完成可进行驱动 IC 代工业务之相关技术，确保乙方能够完全掌握该技术，并可在无须另行依赖其他技术的前提下，完整地生产出本项目所涉全部合格产品。	实际履行
	具体执行情况： 2015 年 10 月，发行人、合肥建投与力晶科技签订《技术移转协议》，系与《委托经营管理合约》同期签署。力晶科技以专利技术使用权出资的相关情况，详见本补充法律意见书第 2 题之“（一）专利技术使用权出资的背景及具体情况，是否存在期限即将届满的专利，相关专利技术使用权作价 20 亿元的评估定价依据，是否存在利益输送，增资后力晶科技能否继续使用或授予其他方使用”的相关回复。	

（4）第二条第二款“经营经验导入与经营管理系统建立”的具体执行情况

本条款主要目的系重申并督促力晶科技履行《技术移转协议》项下的技术转移相关义务，加快力晶科技协助发行人落地相应的晶圆代工厂运营管理制度。具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** （一）甲方应将现行于甲方实行，具备效率与竞争力之经营管理经验导入乙方，由乙方人员建置吸收并且在乙方推行，成为乙方的企业文化或 SOP。	实际履行
	具体执行情况： 力晶科技为发行人提供了晶圆代工厂运营管理制度作为参考，并短期委派人员结合中国大陆实际情况，帮助发行人落地、改善相关制度的运作。	
2	**条款内容：** （二）甲方应将现行于甲方量产，具备竞争力之量产全部参数导入乙方机台，并训练乙方生产与技术人员，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。	实际履行
	具体执行情况： 力晶科技依据《技术移转协议》向发行人转移相关制程技术，并组	

	织了相关培训，训练发行人生产及技术人员。	
3	**条款内容：** （三）甲方应将现行于甲方运作，具备竞争力之全部经营管理系统，包含但不限于生产管理软件、派工作业、自动化控制生产系统、会计系统、人事系统、签核流程等，导入乙方之计算机系统内，并训练乙方管理人员进行操作与问题解决能力，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。	实际履行
	具体执行情况： 力晶科技向发行人提供了相关经营管理系统作为参考，并结合中国大陆实际情况，组织了相关培训，训练发行人管理人员，帮助落地、改善相关生产、会计、人事管理系统及签核流程等。	

（5）第二条第三款“业务能力建立与订单互补支持”的具体执行情况

本条款主要目的系为了配合技术移转完成时产品验证，督促力晶科技协助发行人在设立初期快速形成业务能力，具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** 针对技术授权之制程技术及代工业务，甲方应协助建立乙方之业务能力，让乙方业务人员运用大陆之优势，开拓并争取业务订单，以达成国产化之目标	发行人设立初期，阶段性部分履行
	具体执行情况： 发行人建设初期，在技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与发行人客户奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成。除上述两家客户外，发行人其他客户均为独立开发。具体情况详见本补充法律意见书第 12.4 题 “订单互补支持”的相关回复。	
2	**条款内容：** 当甲方之业务量需求超过甲方产能，且乙方之产能仍可支持时，甲方应移转订单到乙方进行生产。当乙方之业务量超过乙方产能，且甲方产能仍可支持时，乙方应移转订单到甲方。针对代工移转订	未实际履行

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
	价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利	
	具体执行情况： 未实际履行	

在公司设立并开始经营后，自 2016 年起发行人自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，在产品验证、业务拓展方面进展顺利。除双方股东依据《公司章程》《合资合同》的约定委派人员外，发行人其他高级管理人员均由公司员工担任。发行人的日常经营运作仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，且随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，具备了自主开展业务经营及开拓客户的能力，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。

因此，在发行人设立初期，力晶科技协助发行人完成产品验证后，双方未再履行“协助建立乙方之业务能力”的约定，“订单互补支持”的相关约定未实际履行。

（6）第二条第四款“派驻或经营团队建立”的具体执行情况

本条款主要目的系督促力晶科技协助发行人在设立初期加快吸纳晶圆代工行业人才、建立运营团队。

根据《委托经营管理合约》，力晶科技应派驻并建立发行人所需之经营管理团队，类型包括兼职人员、派驻人员及全职人员。《委托经营管理合约》签订后，力晶科技向公司派驻的各类型人员情况如下：

① 兼职人员

序号	姓名	所在部门	职务	任职期间	具体负责工作
1	张天桂	会计部	部经理	2016 年 8 月至 2017 年 7 月	结合中国大陆实际情况，帮助公司落地、改善相关制度的运作
2	庄惠雯		课长	2016 年 7 月至 2017 年 10 月	
3	任芬圣	财务部	部经理	2016 年 7 月至 2017 年 3 月	
4	刘荫	总经理室	行政副总经理	2017 年 8 月至 2018 年 5 月	

序号	姓名	所在部门	职务	任职期间	具体负责工作
5	陈美华	稽核室	审计师	2016 年 7 月至 2018 年 5 月	帮助公司完善内部控制，提高公司内部审计工作质量及能力
6	潘炯升		审计师/处长	2017 年 12 月至 2018 年 12 月	
7	林士然		副审计师	2019 年 1 月至 2020 年 3 月	
8	陈央珠	财务副总经理室	副总会计师	2016 年 6 月至 2016 年 12 月	参与公司财务事项审批流程，对公司财务情况进行了解
9	邱垂源			2017 年 1 月至 2019 年 3 月	
10	李泇谕			2018 年 12 月至 2020 年 3 月	

上述兼职人员所在岗位分为短期兼职岗位和长期兼职岗位两类。：（1）张天桂、庄惠雯、任芬圣、刘荫所在岗位为短期兼职岗位，帮助公司落地、改善相关制度后即返回力晶科技，后续该等岗位由公司自行招聘的员工任职；（2）陈美华、潘炯升、陈央珠、林士然、邱垂源、李泇谕所在岗位为长期兼职岗位，该等岗位人员系力晶科技根据《投资参股协议》向公司委派。力晶科技向公司派驻委派审计师、副总会计师岗位人员，一方面该等人员能结合晶圆制造行业的行业特点，帮助公司提高内部控制和稽核能力，传授晶圆制造行业财务核算经验，另一方面力晶科技可通过该等人员对公司财务状况和内部控制进行实现监督，防止控股股东滥用控股地位。其中，林士然、李泇谕已于 2020 年 3 月与力晶科技解除劳动关系，成为公司员工并与公司签订劳动合同；其他人员离职后返回力晶工作。

② 派驻人员

派驻人员系指由晶合集成雇佣并约定一定期间期满后即结束与公司聘雇关系的相关人员，派驻期间其薪资由晶合集成负担。公司未向力晶科技雇佣派驻人员。

③ 全职人员

全职人员系指由晶合集成雇用且正式任职于公司的人员。公司作为新设立的晶圆代工厂，存在招聘中国台湾地区具有晶圆代工行业工作经验人才的迫切需求，因此双方在《委托经营管理合约》中约定了全职人员相关条款。实际操作层面，力晶科技在入股晶合集成后，向其内部员工告知在中国大陆合资成立公司的信息，部分员工考虑

到新设公司有更好的薪酬待遇以及晋升空间，报名来中国大陆工作，加入发行人并与发行人签订了劳动合同，合同中不存在返回力晶科技及其关联方工作的相关条款。该等员工自力晶科技离职后，与力晶科技或其关联方不存在劳动关系、雇佣关系或其他管控关系。

除上述“全职人员”外同时，公司也通过自行在中国台湾地区相关招聘网站上刊登了招聘信息等方式，自行招聘台籍员工。2016 年 11 月前，相关台籍员工由力晶科技人员负责代为面试，面试合格后与晶合集成签订劳动合同；2016 年 11 月后，台籍员工由公司人资部门自行面试。

从长期稳定发展的角度，公司更倾向于选择愿意长期在公司工作的员工。因此，公司未向力晶科技雇佣一定期间期满后即结束与公司聘雇关系的派驻人员，亦未在自愿加入发行人的台籍员工的劳动合同中约定返回力晶科技及其关联方工作的相关条款。

（7）第二条第五款“训练全职或当地之经营人才与员工”的具体执行情况

本条款的主要目的系督促力晶科技协助发行人在设立初期完善人才队伍，提升经营团队在晶圆制造行业的经验及能力，具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** （一）甲方应从各方面促使乙方尽速建立全职或当地之经营人才及员工，以达成经营效率目标。 **具体执行情况：** 根据《委托经营管理合约》，力晶科技在发行人设立初期协助发行人招募了一批具有晶圆制造行业经验的员工，并应发行人需求，组织了相关培训，训练发行人生产及技术人员。	实际履行

（8）第三条关于公司独立性相关条款的具体执行情况

本条款的主要目的系强调公司与力晶科技之间应在制度、资产、财务等各方面相互独立，避免力晶科技干预公司经营，具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：** 一、甲乙双方同意并了解，甲方与乙方皆为独立之公司，各自执行业	实际履行

	务皆须满足各自之法令、公司内稽内控或审计制度、会计制度、组织签核权限等，不能因为人员重复而有混淆。相关精神与原则甲方与乙方须落实倡导，让相关人员得以遵守。 二、乙方所需之各项系统与设备，包含软硬件或劳务服务，若由乙方专用且须支付费用向第三方购买时，由乙方发包采购付款并列为乙方资产。 三、乙方所需有形资产（软硬件系统或设备），若需向甲方购买，则乙方可经过董事会核准后向甲方采购，并列为乙方资产。若乙方所需为甲方之无形资产，甲方应于移转技术验证完成之前无偿移转该无形资产予乙方。 四、本项委托经营乙方除因特别需求并经董事会批准之外，无需向甲方支付本协议约定外的其他任何费用。	
	具体执行情况： 一、公司与力晶科技拥有各自独立的内部管理体系，力晶科技未将公司视为在中国大陆的子厂，公司与力晶科技之间不存在管理上的上下级关系，双方均独立运营。 二、公司购买的各项系统与设备，均由公司支付费用，并列为公司资产，不存在与力晶科技共用或混同的情形。 三、公司购买设备、软硬件系统时，均由公司按照内部流程决策，并列为公司资产，不存在与力晶科技共用或混同的情形。 四、公司未向力晶科技支付委托经营相关费用。	

（9）第四条“委托经营管理目标”的具体执行情况

双方约定经营目标，主要系因 2015 年时晶圆代工行业发展势态良好，出于合作初期对于公司能够尽快投产的良好预期，按照公司满产后的产能进行了估算，约定了经营目标。同时，双方在合作初期即明确公司系独立运营的主体，以及未来将在中国大陆上市的目标，力晶科技在《委托经营管理合约》项下的主要作用为协助公司建立独立的运营能力，而非将公司作为力晶科技下属子厂进行管理，在协助公司建立运营能力的同时要求力晶科技需确保公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性。本条款的具体执行情况如下：

序号	条款内容及具体执行情况	履行情况
1	**条款内容：**	未实际履

	一、争取乙方于建厂完成后 12 个月内开始获利，并保持持续盈利能力。 二、争取乙方于建厂完成后第 13 至 24 个月期间净利润不低于 3 亿元，第 25-36 个月期间净利润不低于 4 亿元，第 27 至 48 个月期间净利润不低于 5 亿元，委托经营期内乙方税前内部收益率不低于 10%。	行
	具体执行情况： 公司于 2017 年 10 月正式量产（建厂完成）。报告期内，公司年产能分别为 7.49 万片、18.21 万片和 26.62 万片，截至报告期末，发行人尚未达成满产，尚未形成盈利。	
2	**条款内容：** 三、争取于建厂完成后的 5 个会计年度内达成乙方于中国大陆资本市场 IPO 需满足的除委托经营事项外的其他基本条件，同时乙方应立即启动中国大陆资本市场 IPO 申报程序。	实际履行
	具体执行情况： 公司于 2020 年下旬启动上市计划，于 2020 年 11 月完成股份改制，于 2021 年 3 月召开股东大会，审议通过本次发行上市相关议案，并于 2021 年 5 月向上交所提交了上市申请。	
3	**条款内容：** 四、甲方承诺为乙方聘雇的大陆员工提供必要培训，并保证建厂完成后 5 年内乙方具备独立经营能力，包括但不限于： 资产完整。乙方应具有开展生产经营所必备的完整资产，包括使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，乙方拥有健全的技术研发、应用能力。 人员独立。乙方高级管理人员、经营团队、技术团队等均独立于甲方，为其自行聘雇的全职人员。乙方的劳动、人事及工资管理均完全独立。 财务独立。乙方设置独立的财务部门，具有独立的财务核算体系、健全的财务会计管理制度，能够独立核算，独立进行财务决策，已发独立纳税。 机构独立。乙方的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，甲方及其职能部门与乙方及其职能部门之间不存在上下级关系。 业务独立。乙方应独立于甲方，具有完整的业务体系和直接面向市场	实际履行

	独立经营的能力，具备独立的产、供、销系统，甲、乙双方之间无法避免的关联交易必须遵循市场公正、公平的原则。乙方委托甲方进行产品销售或原材料采购的金额，占其主营业务收入或外购原材料总额的比例均不应超过 30%。	
	具体执行情况： 发行人已具备独立经营能力，且资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，详见本问询函回复“问题 12.6 请发行人结合上述委托经营管理、委派管理人员、与力晶科技之间的技术出资及转让、订单互补支持、社保缴纳等相关事项，说明发行人是否符合《注册管理办法》第十条和第十二条的规定”之“发行人符合《注册管理办法》第十二条规定的相关条件”。	

第四条第一款、第二款未实际履行的原因主要系：①2015 年双方合作初期，基于对公司建设进度的预期以及力晶科技能够为公司提供业务支持的前提，确定的盈利目标；②公司设立并开始经营后，在较短时间内建立了经营团队，已具备公司运营的各方面能力，出于独立经营的考虑，公司未要求力晶科技提供业务方面的支持，通过自身经营团队开展业务。综上，公司根据业务需求及自身运营能力逐步提升产能，从量产至满产的过程比 2015 年时各方预期的时间长，导致公司实际盈利情况与 2015 年时各方预期情况存在差异。

（10）《委托经营管理合约》其他条款的具体执行情况

《委托经营管理合约》其他条款不涉及“委托经营”相关的权利义务，均系合同常规条款，双方在《委托经营管理合约》履行过程中未发生纠纷。

（11）《投资参股协议》《公司章程》《合资合同》相关条款的具体执行情况

本条款主要目的系重申由力晶科技协助公司建立独立运营能力的安排，促进双方合作，降低投资风险。同时，股东双方按照国有企业与外资企业合资时的通常约定，明确了双方委派高管参与管控、监督合资企业运营。

2016 年 2 月力晶科技入股后，公司变更为中外合资经营企业，合肥建投、力晶科技分别向公司委派了高级管理人员，但公司运营未由力晶科技委派经营管理团队主导，具体情况详见本条前款 “第一条 第一款‘委托经营管理范围’的具体执行情况”。

4、除《委托经营管理合约》及终止协议外，是否还存在其他对委托经营管理的约

定

根据合肥建投、力晶科技出具的《确认函》，除《委托经营管理合约》及终止协议外，公司与合肥建投及公司与力晶科技之间不存在其他对委托经营管理的约定。

（二）合约自 2019 年 12 月 25 日起终止但于 2020 年 1 月 2 日签订终止协议的原因，终止合约是否附带相应条件及期限

根据力晶科技出具的确认函并经本所律师访谈发行人董事会秘书，2019 年末，由于公司各部门、人员配置已相对完善，业务能力及经营管理系统建立等各方面均稳步推进，《委托经营管理合约》中约定的“技术移转”“经营经验导入与经营管理系统建立”“派驻或经营团队建立”等内容均已完成，仅经营管理委员会仍在实行；而经营管理委员会作为董事会幕僚机构，仅为公司提供经营咨询与支持。而力晶科技进行业务重组后，转型为控股型公司，为公司提供咨询的能力和意愿均减弱，具体详见本补充法律意见书第 12.2 题之“（三）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系”的相关回复。

基于上述因素，双方于 2019 年 12 月经协商就终止《委托经营管理合约》事宜达成一致，确定于 2019 年 12 月 25 日终止《委托经营管理合约》，终止合约未附带相应条件及期限。由于中国大陆与中国台湾地区之间文件邮寄需要一定时间，因此最终协议签署落款日期为 2020 年 1 月 2 日。

2021 年 6 月，发行人、力晶科技分别出具确认函，确认签订《委托经营管理合约之终止协议》系双方真实意思表示，原协议自 2019 年 12 月 25 日起即完全终止，终止合约未附带相应条件及期限。

（三）各方当事人对于委托经营管理解除是否存在纠纷或潜在纠纷

2021 年 6 月，发行人、力晶科技分别出具确认函，确认签订《委托经营管理合约之终止协议》系双方真实意思表示，双方对于委托经营管理解除不存在纠纷或潜在纠纷。

（四）详细说明《委托经营管理合约》终止前后对发行人经营模式、客户、供应商、技术、日常经营管理等方面的变动及影响，并梳理完善招股说明书相关信息披露情况

1、经营模式

经核查，发行人自 2017 年 10 月正式量产以来，经营模式一直为晶圆代工模式，《委托经营管理合约》终止前后，发行人的生产模式、采购模式、研发模式、营销模式、销售模式等未发生变化。《委托经营管理合约》终止前后，发行人的经营模式具体详见《招股说明书（申报稿）》“第六节业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“（四）主要经营模式”。

2、客户、供应商

报告期内，发行人主要客户、供应商均为境内外知名半导体行业设计公司、相关领域境内外知名公司，均系发行人独立开发、谈判、维护，发行人已与主要客户、供应商建立了长期稳定的合作关系，并与部分主要客户、供应商签署了长期合作协议，不存在因为终止《委托经营管理合约》而造成客户流失或影响发行人采购的情形，《委托经营管理合约》终止未影响发行人与上述客户、供应商之间的业务合作，对于发行人客户、供应商稳定性与业务持续性方面没有影响。

3、技术

自设立以来，发行人的主营业务始终为 12 英寸半导体晶圆代工服务，目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸半导体晶圆代工平台的量产，已具备 DDIC 等工艺平台的量产能力。报告期内，公司研发团队均系公司员工，相关研发人员利用公司自有资源独立进行研发工作，力晶科技人员未参与公司技术研发。《委托经营管理合约》终止前后，发行人新产品、项目均在正常研发过程中，《委托经营管理合约》终止对于发行人技术方面没有影响。

4、日常经营管理

《委托经营管理合约》签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技，发行人的经营运作仍以发行人自身员工或合肥建投委派高管为主导。《委托经营管理合约》终止前后，发行人日常经营管理方面未发生重大变化，《委托经营管理合约》终止对于发行人日常经营管理没有影响。

（五）报告期内力晶科技如何全力支持公司经营管理，使公司在业务、技术、财务等方面达到 IPO 申报条件

经核查，使发行人达到 IPO 申报条件系合肥国资方与力晶科技的共同目标之一，题述条款系双方在《合作框架协议》《投资参股协议》等相关协议中对该目标进行了

明确。报告期内，力晶科技主要通过在股东大会、董事会决策层面支持发行人经营管理，在业务、技术、财务方面向发行人提供的主要支持如下：

1、业务方面

发行人建设初期，在技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与发行人客户奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成。具体情况详见本补充法律意见书第 12.4 题“订单互补支持”的相关回复。除上述情况外，发行人的其他客户、供应商均由发行人独立开发、谈判、维护，不存在力晶科技或其委派人员参与发行人日常业务经营的情况。

2、技术方面

报告期内，力晶科技与发行人签署《90nm 项目技术协议》，力晶科技将相关技术数据及文件转让予发行人；力晶科技同发行人签署前述协议有利于发行人完成产品更新换代，在当时拥有的 90M 技术平台上进行技术升级改造，具体情况详见本补充法律意见书第 11 题“关于技术来源和先进性”的相关回复。除上述情况外，报告期内，力晶科技不存在其他对公司技术方面的支持。

3、财务方面

报告期内，力晶科技除按照《投资参股协议》向发行人履行出资义务外，未向公司提供任何资金或担保等财务方面的支持。

4、人员方面

报告期内，力晶科技基于《委托经营管理合约》《合资合同》《投资参股协议》的约定，向公司委派管理人员，以帮助发行人落地、改善相关制度的运作，具体详见本补充法律意见书第 12.2 题“委派管理人员”的相关回复。

5、经营管理委员会相关情况

2018 年下旬，基于《委托经营管理合约》的约定，公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，力晶科技向其指派人员，为公司提供经营咨询与支持。具体详见本补充法律意见书第 12.2 题之“（三）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及

实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系”。

八、《问询函》第 12.2 题：委派管理人员

根据申报材料：（1）按照委托经营协议，存在力晶科技、合肥建投委派部分管理人员的情形，委派人员所在岗位主要是财务和内审部门。2020 年 4 月起，公司各部门已无股东委派高管。（2）2018 年 12 月，发行人依据《委托经营管理合约》组建了经营管理委员会。

请发行人说明：（1）委托经营管理合约终止前后合肥建投和力晶科技委派管理人员的具体情况及其主要考虑；（2）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况；（3）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系；（4）结合发行人经营管理团队的构成与变化、委托经营管理的具体事项及运作情况，说明委托经营管理终止前后发行人是否具备独立的经营管理层，是否拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营是否与力晶科技分开且独立运作，发行人的人员、财务、机构是否独立于力晶科技。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师就发行人财务是否独立于力晶科技进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）委托经营管理合约终止前后合肥建投和力晶科技委派管理人员的具体情况及其主要考虑

根据发行人自设立以来历次董事会会议记录、力晶科技及合肥建投向发行人委派人员的名单、发行人组织机构图及审批权限表以及发行人出具的说明，委托经营管理合约终止前后，合肥建投和力晶科技委派管理人员包括力晶科技按照《委托经营管理合约》短期委派的管理人员，以及双方股东按照《公司章程》《合资合同》《投资参股协议》长期委派的管理人员。具体情况如下：

（1）合肥建投向发行人委派人员的具体情况

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
1	总会计师	朱才伟（高管）	2016 年 3 月至 2020 年 3 月	负责公司财务、会计政策的制定，管理公司财务、会计各项工作
2	财会处处长	王兴亚	2016 年 8 月至 2020 年 3 月	负责公司财务、会计各项工作的执行
3	采购副总监	赵鑫森（高管）	2016 年 4 月至 2017 年 8 月	协助采购总监管理公司采购各项工作
4		周义亮（高管）	2017 年 8 月至 2019 年 5 月	
5		王继武（高管）	2019 年 5 月至 2020 年 4 月	
6	销售副总监	周义亮（高管）	2016 年 4 月至 2020 年 3 月	负责管理维护客户，制定销售战略；新客户新产品导入，维持现有业务及拓展新业务
7	行政副总经理	朱晓娟（高管）	2019 年 10 月至 2020 年 3 月	负责公司整体行政管理和组织人事管理工作
8	审计师	朱晓娟（高管）	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	负责公司内部审计工作
9		杨幼玲（高管）	2019 年 12 月至 2020 年 4 月	
10	敬业促进委员会委员长	朱晓娟（高管）	2017 年 8 月至 2019 年 12 月	规范员工行为、鼓励敬业服务
11		杨幼玲（高管）	2019 年 12 月至 2020 年 11 月	
		杨幼玲	2020 年 11 月至 2021 年 3 月	

上述人员主要系合肥建投根据《投资参股协议》《公司章程》《合资合同》等约定向公司委派高管人员，以便于合肥建投作为控股股东对公司的财务、采购、销售、行政、内审、敬业监督等方面进行监督与管理。

（2）力晶科技向公司委派人员的具体情况

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
1	会计部部经理	张天桂	2016 年 8 月至 2017 年 7 月	结合中国大陆实际情况，帮助公司落地、改善相关制度的运作
2	会计部课长	庄惠雯	2016 年 7 月至	

序号	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
			2017 年 10 月	
3	财务部部经理	任芬圣	2016 年 7 月至 2017 年 3 月	
4	行政副总经理	刘荫（高管）	2017 年 8 月至 2018 年 5 月	
5	审计师	陈美华（高管）	2016 年 7 月至 2018 年 5 月	帮助公司完善内部控制，提高公司内部审计工作质量及能力；负责公司内部审计工作
6	审计师/处长	潘炯升（高管）	2017 年 12 月至 2018 年 12 月	
7	副审计师	林士然	2019 年 1 月至 2020 年 3 月	
8	副总会计师	陈央珠（高管）	2016 年 6 月至 2016 年 12 月	参与公司财务事项审批流程，对公司财务情况进行了解
9		邱垂源（高管）	2017 年 1 月至 2019 年 3 月	
10		李泇谕（高管）	2018 年 12 月至 2020 年 3 月	

上述委派人员中：（1）张天桂、庄惠雯、任芬圣、刘荫 4 人系力晶科技根据《委托经营管理合约》在短期内向公司短期委派的管理人员，其中，除刘荫外均非公司高级管理人员，主要考虑为帮助公司结合行业特点，落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等；（2）其余人员均系力晶科技根据《合资合同》《投资参股协议》长期委派的管理人员，主要考虑为通过参与公司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。

（二）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属

情况

1、委托经营管理期间经营决策的具体过程

根据发行人历次董事会会议记录、部分日常经营性会议的会议记录以及发行人出具的说明，《委托经营管理合约》终止前，公司日常经营计划由高级管理人员负责制定及执行，涉及董事会审批的事项，在提交董事会审批后执行。《委托经营管理合约》终止前，发行人经营决策相关的主要会议如下：

会议名称	召开频率	主要决策内容	与会人员	决策机制
董事会	根据需要择期召开	根据《公司章程》需董事会决策事项	董事、总经理，以及需列席汇报议题的相关人员	董事表决
办公会	每周	就日常经营事项讨论、决策	总经理及其他高级管理人员，以及需列席说明或参与讨论的部门主管	与会高级管理人员表决
策略会议	根据需要择期召开	讨论并制定公司发展战略规划、产能规划、产品策略等	总经理、总会计师，分管业务、营运、采购、研发等部门的高级管理人员，企业规划室处长，营销业务处长、部经理等	总经理主导、决定
定价会议	每季度	就产品定价进行讨论、决策	总经理、总会计师、分管业务部门的高级管理人员，企业规划室处长，营销业务处长、部主管等	总经理主导、决定

公司董事会由公司董事进行表决，经营管理委员会委员均不参与表决。办公会由与会高级管理人员进行表决，力晶科技指派的经营管理委员会委员均不参加。策略会议、定价会议由总经理主导，和与会高级管理人员、相关部门主管进行讨论后作出决定，力晶科技委派人员与指派的经营管理委员会委员均不参加。

2、委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议、合肥建投及力晶科技向发行人委派高管的相关函件以及发行人出具的说明，报告期初至股改前，发行人经营管理团队人员的变化情况如下：

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
1	/	总经理	2018 年 1 月-2020 年 3 月	黎湘鄂	发行人员工	发行人
			2020 年 3 月-2020 年 12 月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
2	运营	副总经理	2018 年 1 月-2020 年 3 月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	邱显寰	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 12 月-2020 年 4 月	邱显寰	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 11 月	未设置		
			2020 年 12 月	李庆民	发行人员工	发行人
3	采购	总监/副总经理	2018 年 1 月-2020 年 11 月	盛惟健	发行人员工	发行人
			2020 年 11 月-2020 年 12 月	未设置		
		协理	2020 年 11 月-2020 年 12 月	简瑞荣	发行人员工	发行人
		副总监	2018 年 1 月-2019 年 5 月	周义亮	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 5 月-2020 年 3 月	王继武	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 3 月-2020 年 12 月	未设置		
4	销售	总监/副总经理	2018 年 1 月-2019 年 10 月	黎湘鄂	发行人员工	发行人
			2019 年 10 月-2020 年 4 月	未设置		
			2020 年 4 月-2020 年 6 月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020 年 6 月-2020 年 12 月	未设置		
		协理	2019 年 10 月-2020 年 4 月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	周义亮	发行人员工	发行人
		副总监	2018 年 1 月-2020 年 3 月	周义亮	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	未设置		

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
5	研发	副总经理	2018 年 1 月-2019 年 3 月	陈耿川	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	詹奕鹏	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 3 月-2020 年 3 月	詹奕鹏	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	未设置		
6	财务	总会计师/财务负责人	2018 年 1 月-2020 年 3 月	朱才伟	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月至 2020 年 12 月	朱才伟	发行人员工	发行人
		副总会计师/协理	2018 年 1 月-2019 年 3 月	邱垂源	力晶科技委派	力晶科技
			2019 年 3 月-2020 年 3 月	李泇谕	力晶科技委派	力晶科技
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	李泇谕	发行人员工	发行人
7	内审	审计师	2018 年 1 月-2018 年 5 月	陈美华	力晶科技委派	力晶科技
			2018 年 5 月-2018 年 12 月	潘炯升	力晶科技委派	力晶科技
			2019 年 1 月-2019 年 12 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 12 月-2020 年 4 月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月-2020 年 11 月	未设置		
8	行政	副总经理	2018 年 1 月-2018 年 5 月	刘荫	力晶科技委派	力晶科技
			2018 年 5 月-2019 年 10 月	未聘任，由采购总监盛惟健代管		
			2019 年 10 月-2020 年 3 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月-2020 年 12 月	朱晓娟	发行人员工	发行人
9	证券	董事会秘书	2020 年 4 月-2020 年 12 月	朱才伟	发行人员工	发行人
10	敬业监督	敬业促进委员会委员长	2018 年 1 月-2019 年 11 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 12 月-2020 年 11 月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020 年 11 月-2020 年 12 月	不再为高级管理人员职位		

综上，报告期内，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。

（三）经营管理委员会的具体人员构成、运作情况及实际发挥的作用，与发行人董事会、股东（大）会之间的关系

1、经营管理委员会的具体人员构成

（1）经营管理委员会的构成及选拔机制

根据发行人历次历次董事会会议、经营管理委员会会议记录以及发行人出具的说明等，2015 年 10 月《委托经营管理合约》签订后，公司逐步组建了自身的经营团队及相应职能部门，暂未组建经营管理委员会。2018 年下旬，合肥建投希望力晶科技作为股东发挥其经验优势，为公司提供经营咨询与支持。2018 年 12 月，经公司董事会决议，公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，并制定了《晶合经营管理委员会执行规章》。经营管理委员会由发行人、力晶科技及合肥建投三方的指派人员共同组成，发行人、力晶科技根据所需交流事项自相应部门指派人员担任委员，并各自指派一名执行秘书。合肥建投指派其向发行人委派的高级管理人员担任观察员。委员、执行秘书、观察员根据会议召开的需求，邀请其他应邀参会人员、会务人员参加会议。经营管理委员会会议中，由力晶科技指派人员与发行人对应业务部门人员就发行人经营情况、行业发展情况等事宜定期进行交流、探讨，为董事会提供合理建议。

（2）经营管理委员会各类型人员的具体职责

经营管理委员会委员主要负责对所需交流事项提供意见及建议，并就需向董事会汇报的事项形成具体建议；执行秘书主要负责联络召开会议、撰写会议记录及协助执行经营管理委员会各项工作；会务人员主要负责协助执行秘书协调会务相关工作；观察员主要负责监督经营管理委员会运作情况；其他应邀参会人员负责就具体交流事项向委员汇报。

（3）经营管理委员会各类型人员的变动情况

经营管理委员会存续期间，经营管理委员会委员、执行秘书、观察员未发生变化，会务人员及应邀参加会议的人员根据实际需求在会议召开前由委员确定。经营管理委员会存续期间，共召开会议 12 次，各方指派人员主要情况如下：

①发行人指派人员

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	委员	蔡辉嘉	10	营运副总经理	与力晶科技委员就营运方面信息进行交流
2	委员	盛惟健	11	采购总监	与力晶科技委员就采购方面信息进行交流
3	副执行秘书	黎翠绫	12	企业规划处处长	组织、参与会议及制作会议记录，与力晶科技委员就企业规划方面信息进行交流

在经营管理委员会存续期间，上述人员均为发行人员工。除上述人员外，晶合集成还会根据交流讨论需要，不定期邀请公司其他员工出席经营管理委员会会议，具体情况如下：

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	应邀参会	林熙钦	2	市场/销售处处长	与力晶科技指派人员就市场信息进行交流
2	应邀参会	苏贤钧	1	客户工程服务部 部经理	
3	应邀参会	张志宏	8	市场/销售处处长	
4	应邀参会	李庆民	6	技术开发处处长	与力晶科技指派人员就技术开发趋势及进程等信息进行交流
5	应邀参会	吴佳特	4	先进整合处副处长	
6	应邀参会	林滔天	8	逻辑二部代部经理	
7	应邀参会	许宗能	2	先进整合前端组 部经理	
8	应邀参会	简瑞荣	11	采购处处长	与力晶科技指派人员就采购及成本控制方面的经验和信息进行交流

9	应邀参会	吕庆麟	2	营运企划处处长	与力晶科技指派人员就营运经验及信息进行交流
10	应邀参会	张伟墐	9	N1 厂长室副厂长	
11	应邀参会	吴文达	10	资安室部经理	与力晶科技指派人员就信息安全方面的经验及信息进行交流
12	应邀参会	颜仲稚	1	资安室技术副理	
13	应邀参会	王兴亚	4	财会处处长	与力晶科技指派人员就财务规划、损益 平衡达成的目标设定等财务经验及信息进行交流
14	应邀参会	王云直	1	会计部部经理	
15	应邀参会	江英和	1	人力资源部部经理	与力晶科技指派人员就人资管理方面的经验及信息进行交流

②力晶科技指派人员

序号	身份	姓名	出席次数	当时在力晶科技担任的职务	主要职责
1	委员、主席	刘志能	12	副总经理	负责主持会议，提供企业规划与生产管理方面建议，以及向董事会汇报经管会的建议及分析
2	委员	陈章鉴	11	副总经理	提供采购方面的意见及建议
3	委员	刘坚松	8	资深处长	提供信息安全方面的意见及建议
4	委员	吴元雄	6	副总经理	提供市场讯息及行业方面的意见及建议
5	委员	刘月纯	1	资深处长	提供人力资源方面的意见及建议
6	执行秘书	林士然	12	资深处长	组织、参与会议，制作会议记录
7	会务人员	张文献	12	项目经理	协调会务相关工作
8	会务人员	林佳瑄	1	技术经理	

除上述人员外，力晶科技指派的经营管理委员会还会根据交流、讨论需要，不定期邀请力晶科技其他员工出席经营管理委员会会议，具体情况如下：

序号	身份	姓名	出席次数	当时在力晶科技担任的职务	主要职责
1	应邀参会	谢明霖	12	副总经理	力晶科技委派的监事，提供经营管理委员会运作方面的建议
2	应邀参会	王其国	2	总经理暨营运长	力晶科技委派的董事，提供公司营运方面的经验、信息及建议
3	应邀参会	许晫豪	4	副处长	与公司指派人员就市场及行业信息进行交流
4	应邀参会	戴景松	9	资深部经理	与公司指派人员就采购及成本控制方面的经验及信息进行交流
5	应邀参会	庄铭钧	3	部经理	
6	应邀参会	李清郎	1	部经理	
7	应邀参会	李仲熙	8	副处长	
8	应邀参会	柯亨安	8	副处长	与公司就企业规划方面的经验及信息进行交流
9	应邀参会	张秀忠	4	技术经理	
10	应邀参会	林世国	4	部经理	与公司就信息安全方面的经验及信息进行交流
11	应邀参会	王修彦	1	资深部经理	
12	应邀参会	邱垂源	3	资深处长	力晶科技委派副总会计师，与公司就财务规划、损益 平衡达成的目标设定等财务经验及信息进行交流
13	应邀参会	李泇谕	12	项目经理	

③合肥建投指派人员

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	观察员	朱才伟	11	总会计师	参与会议，了解、监督经营管理委员会运作情况
2	观察员	周义亮	10	销售副总监兼采购副总监/销售副总监	参与会议，了解、监督经营管理委员会运作情况

除上述人员外，合肥建投指派的经营管理委员会还会根据交流、讨论需要，不定

期邀请合肥建投其他员工出席经营管理委员会会议，具体情况如下：

序号	身份	姓名	出席次数	当时在晶合集成担任的职务	主要职责
1	应邀参会	王继武	3	采购副总监	参与会议，协助观察员了解、监督经营管理委员会运作情况

2、经营管理委员会的运作情况及实际发挥的作用

（1）运作情况

①内部决策机制

经营管理委员会召开会议时，由经管会委员或应邀参会人员向经营管理委员会主席、其他委员、观察员报告各专题项目。经营管理委员会讨论事项以达成共识结论为目标，若重大事项未能达成共识或结论，由经营管理委员会主席决定采取表决产生结论，经三分之二以上委员同意通过。在经营管理委员会实际运行过程中，未发生无法达成共识需表决产生结论的情形。

②向董事会提供建议的方式

拟向董事会汇报的事项在经营管理委员会主席与委员充分讨论后, 由执行秘书进行汇总整理，在就近一次董事会会议上进行汇报。

③运作情况

经营管理委员会存续期间，共召开会议 12 次，自 2019 年 1 月至 12 月每月召开一次，主要讨论事项包括当月市场、行业、采购整体状况，产能及生产营运状况，现金损益平衡达成情况，新技术开发整体进度，及信息安全等方面经验交流。2019 年 12 月，基于：（1）公司当时各部门、人员已相对完善，业务及营运等各方面均稳步推进，公司对力晶科技咨询服务的需求下降；（2）力晶科技进行重组后，将主要人员、业务、资产均注入力积电，力晶科技转型为控股型公司，为公司提供咨询的能力和意愿均减弱，公司与力晶科技协商后决定于 2019 年 12 月 25 日终止《委托经营管理合约》，并同时解散了经营管理委员会。

（2）实际发挥的作用

经营管理委员会讨论事项主要为发行人经营总体状况及趋势。经营管理委员会召

开时，由发行人参会人员与力晶科技参会人员就相关议题进行交流、分析，经营管理委员会主要根据其行业经验对发行人的经营状况及趋势是否合理、是否存在风险或可优化之处进行分析，为公司董事会提供合理建议。经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权。

经营管理委员会讨论议题均由发行人员工起草，相关议题中涉及生产经营的具体数据、产品结构、客户信息、价格信息等商业秘密时，发行人均会将相关信息隐去或简化处理，避免发行人经营中的商业秘密通过经营管理委员会泄露。

3、经营管理委员会与发行人董事会、股东（大）会之间的关系

根据《公司章程》《委托经营管理合约》的约定及相关执行情况，经营管理委员会存续期间，公司的最高决策机构为董事会，公司的重大决策由合肥国资方、力晶科技委派的董事在会议上经充分讨论后表决形成，经营管理委员会仅为董事会提供建议。

《委托经营管理合约》经营管理委员会存续期间召开的董事会会议中，有 4 次董事会会议涉及听取或讨论经营管理委员会提出的建议，其中：（1）第一届董事会第 21 次会议、第 22 次会议中，董事会听取了经营管理委员会形成的研究成果及建议事项，相关事项为报告事项，不涉及董事会讨论审议。（2）第一届董事会第 23 次会议、第 24 次会议中，经合肥建投委派董事提议，将经营管理委员会提出的建议作为讨论事项向董事会提出，由全体董事进行审议。具体情况如下：

届次	序号	经营管理委员会研究成果及建议事项	审议结果
第 21 次董事会	1	协助拟定三年 LTBP 及未来财务预估；协助评估现金损益平衡可能性及相关对策；协助分析单位成本、采购单价较高的差异原因与对策；90nm 延伸技术方面公司的需求；讨论信息大门防护措施	不涉及审议事项
第 22 次董事会	1	评估现金损益平衡可行性；建议 20K 及 25K 机台准备先期指标；原物料及机台采购价格对比分析及对策；辅导信息机制、商业秘密专案执行	不涉及审议事项
第 23 次董事会	1	建议对 2020 年营运计划进行检视及追踪，尽速达成现金损益平衡目标	无异议通过
	2	建议建立新产品 tape out 至量产时间、成功率的追踪机制及相关指标，以确保新产品如期贡献订单	
	3	建议季目标订定与预算落差达订单 30%、产出 20%	

届次	序号	经营管理委员会研究成果及建议事项	审议结果
		时，需在公司季会前向股东汇报	
	4	建议经管会进一步发挥功能协助经营团队	
第 24 次董事会	1	建议 3 万片机台要进行投资时，根据先期指标达成状况业务拓展与价格策略，需经董事会同意后，取得预算并进行机台投资	事项 1、2 无异议通过，事项 3 参考业界做法后续讨论
	2	建议针对 2020BP 定期检讨追踪及优化投片配置	
	3	建议制定 2020 年绩效目标执行，经营团队（高管）奖惩方式	

综上，经营管理委员会存续期间，发行人最高权力机构为董事会，经营管理委员会为董事会提供经营相关建议，经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权；经营管理委员会与发行人股东（大）会不存在关系。

（四）结合发行人经营管理团队的构成与变化、委托经营管理的具体事项及运作情况，说明委托经营管理终止前后发行人是否具备独立的经营管理层，是否拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营是否与力晶科技分开且独立运作，发行人的人员、财务、机构是否独立于力晶科技

结合发行人经营管理团队的构成与变化、委托经营管理的具体事项及运作情况，分析如下：

（一）报告期内，发行人曾存在合肥建投、力晶科技向发行人委派部分高级管理人员的情形，该等人员系双方股东依据《投资参股协议》等向公司委派，非为委托经营特别约定事项。《委托经营管理合约》终止后，双方股东均继续依照《投资参股协议》、《合资合同》、《公司章程》向公司委派相关人员。截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任并在公司专职工作。

因此，截至报告期末，发行人具备独立的经营管理人员。

（二）经营管理委员会存续期间，发行人最高权力机构为董事会，经营管理委员会为董事会提供经营相关建议，经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对

公司经营管理事项进行决策的职权；经营管理委员会与发行人股东（大）会不存在关系。

因此，委托经营管理终止前后，发行人具备独立的经营管理机构，发行人拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营与力晶科技分开且独立运作。

综上，委托经营管理合约终止前后，发行人具备独立的经营管理机构，发行人拥有并独立行使经营管理权和决策权，生产经营与力晶科技分开且独立运作，发行人的财务、机构均独立于力晶科技。截至报告期末，发行人具备独立的经营管理层，发行人的人员独立于力晶科技。

九、 《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施

根据申报材料：（1）发行人及其子公司无自有房产及土地使用权。目前主要办公场所及全部生产场所为向合肥建投全资子公司合肥蓝科租赁，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁。环保设施由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。（2）2017 年公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》租入厂房及配套厂务设备；2021 年 4 月，公司与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》对晶合二厂及配套设施认定为经营性租赁，同期公司与合肥蓝科签订《收购意向协议》，公司承诺在该项目交付之日起 5 年内完成收购。（3）以融资租赁方式进行核算，报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元。

请发行人说明：（1）厂房租赁合约签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排；（2）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性；（3）所租赁房产及相应土地使用权是否存在瑕疵，是否履行完备的登记审批程序，相关事项存在的法律风险；（4）按照企业会计准则说明认定为融资租赁的原因，融资租赁金额的计算过程，对经营业绩的影响，收购厂房的资金来源；补充提

供公司与合肥蓝科、力晶科技签订的租用协议。

请保荐机构、发行人律师对事项（1）-（3）和申报会计师对事项（2）和（4）进行核查并发表明确意见。请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示。

回复：

（一）厂房租赁合约签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

1、厂房租赁合约签订的具体考虑

2015 年 4 月 27 日，合肥市政府与力晶科技签署《合作框架协议》，双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区 12 英寸晶圆制造基地项目。根据《合作框架协议》约定，合肥市政府负责提供土地与厂房建设资金，由项目公司主导兴建。合肥市政府同意以租赁方式供项目公司使用该土地及厂房，租赁期限为全产能量产后 20 年，租期届满后，若项目营运顺利，再以相同条件续租 10 年。

2015 年 10 月，合肥蓝科、力晶科技与发行人签署《合肥 12 吋晶圆制造基地项目厂房建设与租用协议》，合肥蓝科根据前述《合作框架协议》，负责建成 12 英寸晶圆制造厂所需的厂房、无尘室、厂务设施及配套设施，并租赁给发行人使用。2017 年 6 月，合肥蓝科与晶合集成签署《电子器件厂房设施租赁合同》，合肥蓝科已按照要求将电子器件厂房基础设施建设完毕，合肥蓝科作为产权人，同意将电子器件厂房设施及土地租赁给晶合集成，租赁期间自 2017 年 6 月 28 日起至 2037 年 6 月 27 日。

上述合肥蓝科建造并向发行人出租的厂房包括发行人生产经营所使用的主体厂房，以及仓库、废水处理站、综合动力站、大宗气体站等配套房屋。其中，主体厂房面积为 173,982.92 平方米，约一半面积已建设洁净室等配套厂务设施，用于发行人目前已投产的“12 英寸晶圆制造基地项目”（晶合一厂）；另一半主体厂房建成后尚未建设洁净室等配套厂务设施，目前尚未投入使用，未来将用于本次募集资金拟投资的“12 英寸晶圆制造二厂项目”（晶合二厂）。

2021 年 4 月，发行人与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，合

肥蓝科将在前述尚未投入使用的预留厂房内建设洁净室及配套厂务供应系统，并在原有主体厂房的基础上进行少量扩建，以及增加部分配套设施，租赁给发行人使用。

合肥蓝科将相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一。公司晶合二厂厂务及配套设施建设时，由于相关土地、厂房均属于合肥蓝科，因此继续由合肥蓝科负责建设。公司主营业务为晶圆代工，公司业务对于厂房专业化要求较高，合肥蓝科向公司出租的厂房系按照公司晶圆代工项目的实际需求定制化建造，相关厂房及配套设施建造成本较高，公司无法直接租赁其他厂房从事生产经营，合肥蓝科按照公司需求定制化建造该等厂房后亦很难再直接向其他方出租。因此，公司长期向合肥蓝科租赁相关厂房具有必要性及合理性。

2、协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

根据前述协议约定，相关土地使用权及相关厂房的所有权归合肥蓝科所有。

根据《电子器件厂房设施租赁合同》，晶合一厂的租赁期间自 2017 年 6 月 28 日起至 2037 年 6 月 27 日；租赁期限届满后，如晶合集成无重大营运问题，自动按原条件续约至 2049 年 6 月 27 日。

根据《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》及《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》，晶合二厂的租赁期限为自实际交付之日起 10 年，租赁期满后，乙方有优先承租权，展延租赁期限由双方另行协商；并且，发行人承诺在交付之日起五年内收购晶合二厂相关厂务及配套设施（不含土建结构部分），土建结构部分将由晶合集成继续租赁。根据合肥蓝科出具的承诺函，租赁期届满后，若晶合集成无重大营运问题且晶合集成需继续承租上述租赁物业中土建结构部分，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给晶合集成。

（二）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性

1、发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况

发行人根据《电子器件厂房设施租赁合同》向合肥蓝科租赁的厂房及配套厂务设备已建设完毕，具体情况如下：

类型	主要内容	使用情况
房屋及建筑物	包括发行人目前生产经营使用的主体厂房以及废水处理站、仓库、综合动力站、大宗气体站等建筑物	主体厂房中，一半用于目前已用于生产经营的晶圆制造一厂项目，另一半目前尚未投入使用，未来将用于本次募集资金拟投资的“12 英寸晶圆制造二厂项目”
厂务设备	包括厂房洁净室系统、水处理系统、气体系统、消防系统等设施	已投入使用
其他	厨房设备	已投入使用

发行人根据《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》向合肥蓝科租赁的厂房及配套设施尚在建设过程中，具体情况如下：

类型	主要内容	使用情况
新增建筑物	L40 区域新增结构楼板及一层建筑物，建筑面积约 2,800 ㎡，洁净室面积约 2,500 ㎡，增设洁净室及配套厂务供应系统	尚未投入使用
二厂洁净室与厂务设施	在现有已建成的二厂厂房中，建成可容载 4 万片/月产能的 12 英寸晶圆洁净室及相关厂务设施	尚未投入使用
配套设施	在现有一厂厂区西侧，建造建筑面积 500 ㎡的一层丙类化学品仓库及相关消防与机电设施	尚未投入使用

2、发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系

报告期内，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
固定资产	**963,849.07**	**776,607.78**	**830,304.51**	**720,936.40**	**578,867.97**	**527,573.26**
其中：房屋	189,450.20	164,395.89	189,080.29	171,257.26	186,889.85	176,227.65

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
及建筑物						
其中：机器设备	765,356.07	608,864.61	634,166.05	546,355.03	386,293.86	347,523.32
其中：运输工具	274.08	0.21	274.08	50.12	274.08	118.64
其中：电子设备及其他	8,768.72	3,347.06	6,784.09	3,273.99	5,410.18	3,703.65
融资租入固定资产	**187,056.39**	**161,990.00**	**187,056.39**	**169,151.82**	**187,056.39**	**176,313.65**
其中：房屋及建筑物	186,787.95	161,909.47	186,787.95	169,017.60	186,787.95	176,125.74
其中：电子设备及其他	268.44	80.53	268.44	134.22	268.44	187.91
融资租入固定资产占固定资产的比例	**19.41%**	**20.86%**	**22.53%**	**23.46%**	**32.31%**	**33.42%**
其中：房屋及建筑物	98.59%	98.49%	98.79%	98.69%	99.95%	99.94%
其中：电子设备及其他	3.06%	2.41%	3.96%	4.10%	4.96%	5.07%

上述租赁厂房及配套厂务设备等计入固定资产的房屋及建筑物、电子设备及其他，不存在租入的在建工程，由于配套厂务设备与厂房密不可分，故作为房屋及建筑物核算。

报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。报告期内，上述租赁获得的厂房及配套厂务设备原值占

发行人固定资产原值的比例分别为 32.31%、22.53%和 19.41%，占发行人固定资产中房屋及建筑物原值的比例分别为 99.95%、98.79%、98.59%，发行人房屋及建筑物主要通过上述租赁方式获得。

3、租用协议到期后固定资产的安置方式

（1）发行人一厂相关厂房及配套厂务租用协议到期后固定资产的安置方式

根据《电子器件厂房设施租赁合同》以及合肥蓝科出具的承诺函，若发行人项目营运顺利，相关物业的租赁期限至 2049 年 6 月 27 日，相关厂房及配套的租赁期限已基本覆盖发行人生产项目厂房正常使用寿命周期，租用协议到期后，相关固定资产已折旧完毕。同时，合肥蓝科承诺，在晶合集成如约履行合同的情况下：（A）未经晶合集成同意，合肥蓝科不向其他单位或个人出租或处置上述租赁物业；（B）租赁期届满后，若晶合集成无重大营运问题且晶合集成需继续承租上述租赁物业，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给晶合集成。发行人一厂相关租用协议到期后，可视运营情况继续向合肥蓝科租赁相关厂房，固定资产的安置不存在重大风险。

（2）发行人二厂相关厂房及配套厂务租用协议到期后固定资产的安置方式

根据《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》《晶合二厂厂务及配套项目收购意向协议》以及合肥蓝科出具的承诺函，相关租赁物交付起 5 年内，发行人将收购租赁物中的配套设施（不含土建结构部分）；租赁期限届满后，若发行人无重大营运问题且需要继续租赁协议约定租赁物中的土建结构部分，合肥蓝科承诺将按照市场公允价格租赁给发行人。发行人二厂相关租用协议到期后，可视运营情况继续向合肥蓝科租赁相关厂房，固定资产的安置不存在重大风险。

4、租赁厂房的业务合理性

合肥蓝科将相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一。公司业务对于厂房专业化要求较高，合肥蓝科向公司出租的厂房系按照公司晶圆代工项目的实际需求定制化建造，相关厂房及配套设施建造成本较高。发行人主要固定资产晶圆代工业务使用的相关机器设备均安装于向合肥蓝科租赁的相关厂房中，与厂务设施及配套设施协同发挥作用，公司无法直接租赁其他厂房从事生产经营。因此，发行人向合肥蓝科租赁相关厂房具有业务合理性。

（三）所租赁房产及相应土地使用权是否存在瑕疵，是否履行完备的登记审批程

序，相关事项存在的法律风险

1、所租赁房产及相应土地使用权是否存在瑕疵

发行人向合肥蓝科租赁房产及相应土地使用权均已取得不动产权证，具体情况如下：

序号	权利人	座落地址	不动产权证号	土地用途	宗地面积（m^2）	房屋建筑面积（m^2）
1	合肥蓝科	新站区东方大道1888号1号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339433号	工业用地	246,407.29	173,982.92
2	合肥蓝科	新站区东方大道1888号2号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339464号	工业用地		5,664.48
3	合肥蓝科	新站区东方大道1888号3号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11340116号	工业用地		5,332.85
4	合肥蓝科	新站区东方大道1888号4号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11340109号	工业用地		26,776.98
5	合肥蓝科	新站区东方大道1888号5号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11340112号	工业用地		974.53
6	合肥蓝科	新站区东方大道1888号6号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11340106号	工业用地		587.25
7	合肥蓝科	新站区东方大道1888号7号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11340103号	工业用地		241.21

序号	权利人	座落地址	不动产权证号	土地用途	宗地面积（m^2）	房屋建筑面积（m^2）
8	合肥蓝科	新站区东方大道1888号8号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11340101号	工业用地		339.81
9	合肥蓝科	新站区东方大道1888号9号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339462号	工业用地		600.6
10	合肥蓝科	新站区东方大道1888号10号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339485号	工业用地		529.26
11	合肥蓝科	新站区东方大道1888号13号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339439号	工业用地		105.31
12	合肥蓝科	新站区东方大道1888号14号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339442号	工业用地		106.69
13	合肥蓝科	新站区东方大道1888号15号建筑	皖（2020）合肥市不动产权第11339448号	工业用地		28.72
合计				**-**	**246,407.29**	**215,270.61**

因此，发行人向合肥蓝科所租赁房产及相应土地使用权不存在瑕疵。

（2）是否履行完备的登记审批程序，相关事项存在的法律风险

合肥蓝科向发行人出租的上述房屋已取得《合肥市房屋租赁备案证书》（备案证书号：2103090AY002），发行人已履行完备的登记及租赁备案程序。发行人向合肥蓝科租赁房屋相关事项不存在法律风险。

（四）请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，充分论证上

述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示

1、发行人向合肥蓝科租赁厂房的具体用途、对发行人的重要程度，以及是否能够确保发行人长期使用

发行人向合肥蓝科租赁厂房的具体用途如下：

序号	物业名称	房屋建筑面积（m^2）	具体用途
1	1 号建筑	173,982.92	用于晶圆加工生产、研发以及公司员工办公
2	2 号建筑	5,664.48	仓库
3	3 号建筑	5,332.85	废水处理站
4	4 号建筑	26,776.98	综合动力站
5	5 号建筑	974.53	大宗气体站
6	6 号建筑	587.25	特气供应间
7	7 号建筑	241.21	硅烷供应间
8	8 号建筑	339.81	化学品库
9	9 号建筑	600.6	化学品库
10	10 号建筑	529.26	化学品供应间
11	13 号建筑	105.31	门卫
12	14 号建筑	106.69	门卫
13	15 号建筑	28.72	门卫

发行人向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房作为发行人目前主要生产经营地点，用途涵盖公司生产、研发、办公，重要性较高，鉴于：

（1）根据发行人与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》，发行人向合肥蓝科租赁的厂房设施及土地的租赁期限至 2049 年 6 月 27 日。

（2）根据合肥蓝科出具的《关于厂房设施租赁的承诺函》，在发行人如约履行合同的情况下：（A）未经发行人同意，合肥蓝科不向其他单位或个人出租或处置上述租赁物业；（B）租赁期届满后，若发行人无重大营运问题且发行人需继续承租上述租赁物业，合肥蓝科承诺按照市场公允价格租赁给发行人。

综上，发行人能够长期使用上述厂房、土地，不会对发行人正常生产经营造成重大不利影响。

2、发行人向关联方租赁物业的背景及未投入发行人的原因

根据合肥市政府与力晶科技签订的《合作框架协议》，双方共同合作实施合肥新站综合开发试验区 12 英寸晶圆制造基地项目，项目厂房建设所需资金约 20.4 亿元由合肥市政府提供，项目选址位于合肥新站区综合保税区内。合肥市政府负责提供土地与厂房建设资金，并以租赁方式供项目公司使用该土地及厂房。

合肥蓝科系合肥市国资委下属国资管理经营平台，亦系合肥建投的全资子公司，《合作框架协议》签订时，合肥综合保税区的整体基础设施的建设由合肥蓝科负责，相关土地均在合肥蓝科名下，合肥蓝科对合肥综合保税区整体办理了建设用地规划许可，因此由合肥蓝科负责落实合肥市政府招商引资相关政策，根据项目实际需要建设了相关厂房并出租给公司使用。相关厂房以租赁方式提供给公司使用系合肥市政府与力晶科技合作初始确定的招商引资政策之一，因此未投入公司。

3、租赁费用的公允性

（1）厂房及一厂配套设施的租赁费用

根据《合作框架协议》、《审计报告》以及发行人相关董事会及股东大会会议文件，发行人向合肥蓝科租赁土地、厂房及配套厂务设施的租金系按照合肥蓝科相关土地、厂房及配套设施实际建设成本以 30 年折旧年限计算的年折旧金额收取，相关租赁价格较为优惠，系因合肥市政府招商引资政策，根据《审计报告》，公司已按照相应会计准则进行处理，具体为：公司按照最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，长期应付款的入账价值与最低租赁付款额现值的差额，确认为未确认融资费用，在租赁期内采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。融资租入资

产按照竣工决算金额入账，公司对于竣工决算金额与最低租赁付款额现值的差额，确认为政府补助，计入递延收益，在租赁期内进行分摊，计入其他收益。

2021 年 3 月，公司董事会、股东大会已对上述关联租赁予以确认，独立董事发表了独立意见，上述关联交易已按照公司章程履行了相应的决策程序。

综上，公司厂房及一厂配套设施的租赁价格较为优惠，属于合肥市政府招商引资政策之一，公司厂房及一厂配套设施的租赁价格具备合理性。

（2）二厂配套设施的租赁费用的公允性

根据发行人相关董事会、股东大会会议文件以及上市公司委托建设方代建项目的相关公告，并与合肥蓝科总经理进行了访谈，公司拟租赁的二厂相关配套设施的租金按项目总投资额（暂定人民币 15 亿元，最终按照竣工决算价格调整）以 10 年回收建造成本加年投资回报率 6%的收益计算收取，该等租金价格系双方经商业谈判协商确定，双方协商在项目建造成本的基础上按照 6%的年化收益计算回报率，主要考虑了以下因素：

①合肥蓝科的融资成本。公司二厂项目由合肥蓝科出资建设，项目投资成本及收益分 10 年逐步收回，因此合肥蓝科需考虑其沉淀资金的融资成本。根据访谈了解，合肥蓝科目前融资成本约为 4.2%左右，6%的收益率首先要覆盖其融资成本。

②合肥蓝科在覆盖成本的基础上获得合理的收益。二厂相关配套设施项目的投资回报率系双方通过商业谈判协商确定，合肥蓝科在覆盖其融资成本的基础上，取得年化收益率 1.8%左右的投资收益。参考上市公司公开披露信息，其委托建设方代建项目支付的代建费费率一般在 2%-3%，但大部分项目的投资总额低于合肥蓝科上述项目，因此费率略高于合肥蓝科（1.8%）。

综上，公司二厂配套设施的租赁费用具备公允性。

4、发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套设施今后的处置方案

发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套设施今后的处置方案，详见本补充法律意见书第 12.3 题之“（二）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建

设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性”的相关回复。

5、总体结论

综上所述，发行人持续、稳定的通过上述租赁房产开展生产经营活动，未出现因合肥蓝科等相关出租方单方面原因，导致发行人不能继续租赁生产经营场所、无法从事生产、研发等经营活动的情形，未因租赁房产而对生产经营产生不利影响。合肥蓝科已出具确认函，确认租赁期限内发行人可持续租赁相关物业，合肥蓝科不会向第三方出租或处置相关物业，且租赁期满后如发行人有租赁需求亦可继续租赁使用。综上所述，发行人租赁合肥蓝科物业能够长期使用，租赁合肥蓝科物业用于生产经营对发行人的资产完整和独立性不构成重大不利影响。

十、《问询函》第 12.4 题：订单互补支持

根据提交的委托经营管理协议，存在关于订单互补支持的约定：当力晶科技之业务量需求超过力晶科技产能，且发行人之产能仍可支持时，力晶科技应移转订单到发行人进行生产。当发行人之业务量超过发行人产能，且力晶科技产能仍可支持时，发行人应移转订单到力晶科技。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利。

请发行人说明：（1）上述订单互补支持约定的原因及实际执行情况；（2）报告期内发行人通过力晶科技及其关联方开拓的客户、独立开拓的客户及相应占比，是否属于共用销售渠道，在订单互补支持的情况下发行人业务是否独立；（3）报告期内从力晶科技转让订单对应的销售模式、客户、金额及占比，销售价格的公允性，委托经营协议终止前后发行人与主要客户的合作方式具体变化，对发行人生产经营的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项（1）和（2），申报会计师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）上述订单互补支持约定的原因及实际执行情况

根据发行人、力晶科技书面确认并经访谈发行人主要客户、供应商，签订《委托经营管理合约》的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力。《委托经营管理合约》中约定订单互补支持，主要系出于表达双方合作的友好关系及合作愿景。

在公司设立并开始经营后，自 2016 年起发行人自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，在产品验证、业务拓展方面进展顺利。随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，具备了自主开展业务经营及开拓客户的能力，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。报告期内，双方未实际履行订单互补支持相关条款。

（二）报告期内发行人通过力晶科技及其关联方开拓的客户、独立开拓的客户及相应占比，是否属于共用销售渠道，在订单互补支持的情况下发行人业务是否独立

根据《技术移转协议》、力晶科技出具的《确认函》，并经本所律师实地走访及访谈了发行人报告期内的主要客户、供应商，2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术（即 0.15um 大尺寸驱动 IC 及 90nm/0.11um 小尺寸驱动 IC 制程技术）作价 20 亿元出资晶合有限，拟投入的三项制程技术包含专利技术、技术文件及数据以及运用该等技术过程中形成的技术经验等内容。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于 2018 年 3 月 31 日已完成技转。根据双方约定，上述技术移转完成的标志之一即需要完成产品验证。

在上述技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与发行人客户奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成。因此，奇景光电和奕力科技不属于报告期内发行人通过力晶科技及其关联方开拓的客户，不属于共用销售渠道，不存在订单互补支持的情形，发行人业务独立。

报告期内，除上述情况外，发行人的其他客户亦均由发行人独立开拓，不存在共用销售渠道或订单互补支持的情形，发行人业务独立。

十一、《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况

报告期各期未在境内缴纳社会保险、住房公积金的人数为 300 多人，占员工总人数比例 20%以上。

请发行人说明：台湾籍员工的数量、职位分布、劳动合同关系、薪酬支付与社保缴纳主体，与力晶科技是否相独立。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

根据发行人提供的员工名单及工资表、中国台湾籍员工劳动合同、社保缴纳凭证、中国台湾劳务公司代缴劳健保的相关协议并经本所律师与代缴公司确认，报告期内，发行人中国台湾籍员工均与发行人或其子公司签订了劳动合同，由发行人或其子公司承担薪酬，其中主要为制造、研发人员，具体情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
台籍员工数量	264	299	296
其中：			
研发人员	59	64	44
制造人员	157	182	200
销售人员	15	11	9
管理人员	33	42	44

报告期内，除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司（以下简称“怡东人事”）为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

根据怡东人事及力晶科技出具的书面确认，怡东人事主要在中国台湾地区从事人力派遣、人力管理顾问等业务，与力晶科技之间不存在关联关系，为发行人独立采购。

怡东人事的基本情况如下：

<table>
<tr><td>公司名称</td><td>怡东人事顾问股份有限公司</td></tr>
<tr><td>公司统一编号</td><td>70523522</td></tr>
<tr><td>公司所在地</td><td>台北市松山区复兴北路 101 号 9 楼</td></tr>
<tr><td>注册日期</td><td>2000 年 6 月 5 日</td></tr>
<tr><td>代表公司负责人</td><td>刘东奇</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td>管理顾问业；其他顾问服务业；资讯软体服务业；资料处理服务业；电子资讯供应服务业；一般广告服务业；人力派遣业；其他工商服务业；产业育成业；国际贸易业；仓储业；理货包装业；就业服务业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务</td></tr>
<tr><td>股份总数</td><td>47,000 股</td></tr>
<tr><td>资本总额</td><td>47,000,000 新台币元</td></tr>
<tr><td>实收资本总额</td><td>47,000,000 新台币元</td></tr>
<tr><td>股东情况</td><td>怡东控股股份有限公司持股 100%，怡东控股股份有限公司的股权结构如下：
<table>
<tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>持股数量（股）</th><th>持股比例</th></tr>
<tr><td>1</td><td>刘东奇</td><td>4,746,800</td><td>47.47%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>刘少杰</td><td>444,700</td><td>4.45%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>刘少淳</td><td>176,600</td><td>1.77%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>洪彣欣</td><td>4,631,900</td><td>46.32%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>10,000,000</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>董事情况</td><td>刘东奇、刘少杰、刘少淳</td></tr>
</table>

综上，本所认为，发行人中国台湾籍员工的劳动合同关系、薪酬支付与社保缴纳主体，均与力晶科技相独立。

十二、《问询函》第 12.6 题

请发行人结合上述委托经营管理、委派管理人员、与力晶科技之间的技术出资及转让、订单互补支持、社保缴纳等相关事项，说明发行人是否符合《注册管理办法》第十条和第十二条的规定。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师说明对委托经营管理是否影响发行人独立性的结论所履行的核查程序，依据是否充分。

回复：

（一）核查程序

针对委托经营管理是否影响发行人独立性，发行人律师执行了以下核查程序：

1、取得并核查了《委托经营管理合约》，并就《委托经营管理合约》签订及履行的情况与发行人相关人员进行了访谈；

2、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况，并就相关人员的具体工作内容与发行人行政部门人员进行了访谈；

3、访谈了发行人相关管理人员，就发行人设立以来运营情况、股东发挥的作用等事项进行了解；

4、取得并核查了发行人报告期内历次高级管理人员变动相关的会议文件及股东委派文件；

5、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单，并抽取部分台籍员工的劳动合同进行核查；

6、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等；

7、取得并核查了发行人自设立以来历次股东大会、董事会及其专门委员会、监事会会议文件等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委派人员的参与情况进行了核查；

8、取得并核查了发行人经营管理委员会相关工作制度、会议文件，并就经营管理委员会的运作情况与发行人员工进行访谈；

9、取得并核查了发行人员工花名册，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查；

10、访谈了发行人主要客户、供应商，并就主要客户、供应商的开发情况访谈了发行人相关人员，取得发行人员工开发客户过程中的相关支持性证据；

11、取得了发行人、力晶科技分别出具的确认函。

（二）核查意见

经核查，发行人律师认为：

1、发行人符合《注册管理办法》第十条和第十二条的规定；

2、委托经营管理不影响发行人的独立性，该结论依据充分。

十三、《问询函》第 13 题：关于关联交易

根据申报材料：（1）合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务。发行人向合肥建投支付咨询服务费用已于 2020 年 3 月 31 日终止，向力晶科技支付的咨询服务费已于 2020 年 6 月 30 日终止。（2）报告期各期，发行人向智成电子采购服务费分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元。

请发行人说明：（1）发行人向合肥建投和力晶科技采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途；（2）委托经营管理协议终止前后提供的咨询服务以及相关人员的差异，咨询服务费于 2020 年 3 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日方才终止的原因；（3）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性；（4）上述关联交易的会计处理及是否符合企业会计准则的要求。

请保荐机构、发行人律师对上述事项（1）-（3）和申报会计师对上述事项（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）发行人向合肥建投和力晶科技采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途

1、发行人向合肥建投采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途

根据发行人与合肥建投签署的三份《咨询服务合约书》，双方约定的咨询服务期间分别为 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。基于合肥建投熟悉大陆地区政策、法规及作业习惯，发行人委托合肥建投提供企业管理、财务、会计及采购、销售、敬业等相关咨询服务。根据约定，报告期内，合肥建投向发行人提供的咨询服务范围，包括企业管理、财务、会计、采购、销售、敬业等业务相关的制度建立、日常作业咨询、人员训练等专业服务。

报告期内，合肥建投通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供上述咨询服务，发行人向合肥建投支付咨询服务费用。咨询服务费定价系以发行人同等职级岗位的平均薪酬为依据确定，定价合理、公允。

关于上述咨询服务费，发行人与合肥建投未就其用途进行约定，合肥建投在收取上述咨询服务费后，可就其用途自行作出安排。

2、发行人向力晶科技采购相关咨询服务的原因、具体内容和相关方收取服务费的具体用途

根据发行人与力晶科技签署的三份《咨询服务合约书》，双方约定的咨询服务期间分别为 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。基于力晶科技拥有丰富的半导体领域营运管理经验，发行人委托力晶科技提供半导体产业财务、会计及审计等相关咨询服务。根据约定，报告期内，力晶科技向发行人提供的咨询服务范围如下：

年度	约定的咨询服务内容

年度	约定的咨询服务内容
2018 年度、2019 年度	（1）半导体营运稽核相关业务，包括内控内稽制度建立、日常稽核作业、流程及人员训练等； （2）半导体营运财务风险管控、财务日常作业流程、资金管控作业及人员训练等； （3）半导体营运会计政策及制度审定、会计作业流程建立、会计作业系统导入及维护、人员训练等。
2020 年度	（1）半导体营运相关业务，包括企业管理、内外部关系协调、行业经验分享等； （2）半导体营运财务风险管控、财务日常作业流程、资金管控作业及人员训练等； （3）半导体营运会计政策及制度审定、会计作业流程建立、会计作业系统导入及维护、人员训练等。

报告期内，力晶科技通过向发行人委派部分管理人员的方式向发行人提供上述咨询服务，发行人向力晶科技支付咨询服务费用。咨询服务费定价系参考同行业可比公司的高管薪酬，以发行人同等职级的平均工资为依据确定，定价合理、公允。

报告期各期，发行人向力晶科技采购上述咨询服务确认的咨询服务费涉及岗位如下：

单位：万元

力晶科技委派人员任职岗位	发行人确认的咨询服务费[1]		
	2020 年度[4]	**2019 年度**	**2018 年度**
董事长[2]	117.92	-	-
审计师/副审计师[3]	17.40	90.19	113.21
副总会计师	17.40	88.87	84.91
合计	**152.72**	**179.06**	**198.11**

注 1：以上金额为不含增值税金额。

注 2：上述“董事长”岗位对应咨询服务费系发行人就 2020 年 1-6 月期间王其国和蔡国智任职公司董事长而确认的服务费。

注 3：报告期内，力晶科技于 2018 年度向发行人委派审计师；于 2019 年度和 2020 年度向发行人委派副审计师，不再委派审计师。

注 4：2020 年度发行人向力晶科技采购上述咨询服务确认的咨询服务费系基于 2020 年实际服务天数计算。

关于上述咨询服务费，发行人与力晶科技未就其用途进行约定，力晶科技在收取上述咨询服务费后，可就其用途自行作出安排。

（二）委托经营管理协议终止前后提供的咨询服务以及相关人员的差异，咨询服务费于 2020 年 3 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日方才终止的原因

1、委托经营管理协议终止前后提供的咨询服务以及相关人员的差异

2020 年 1 月 2 日，发行人与力晶科技签署《委托经营管理合约之终止协议》，双方同意委托经营管理协议自 2019 年 12 月 25 日起即终止。

委托经营管理协议终止前后（即 2019 年 12 月 25 日前后），合肥建投和力晶科技向发行人提供的咨询服务以及相关人员的差异如下：

（1）委托经营管理协议终止前，根据双方 2019 年度签署的《咨询服务合约书》，力晶科技提供的咨询服务内容涵盖“半导体营运稽核相关业务，包括内控内稽制度建立、日常稽核作业、流程及人员训练等”。委托经营管理协议终止后，根据双方 2020 年度签署的《咨询服务合约书》，力晶科技提供的咨询服务内容不再涵盖前述内容，并新增“半导体营运相关业务，包括企业管理、内外部关系协调、行业经验分享等”。

（2）2019 年 12 月 17 日，合肥建投委派杨幼玲担任发行人审计师、敬业促进委员会委员长，原委派人员朱晓娟不再担任审计师、敬业促进委员会委员长。

除上述差异外，委托经营管理协议终止前后，合肥建投和力晶科技向发行人提供的咨询服务以及相关人员未发生其他变化。

2、咨询服务费于 2020 年 3 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日方才终止的原因

根据发行人与合肥建投 2020 年度签署的《咨询服务合约书》，双方约定咨询服务期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日；根据发行人与力晶科技 2020 年度签署的《咨询服务合约书》，双方约定咨询服务期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。上述合约到期终止后，各方未再续签咨询服务合约，咨询服务费相应终止。

发行人与合肥建投、力晶科技签署的《咨询服务合约书》对应的人员委派事项，

系依据合肥建投、合肥芯屏、力晶科技于 2016 年 1 月 20 日签订的《关于合肥晶合集成电路有限公司之合资合同》作出，独立于委托经营管理协议的安排，因此，合肥建投、力晶科技向发行人提供咨询服务的行为及发行人支付咨询服务费的行为并不与委托经营管理协议同步终止。

（三）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性

1、发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性

根据发行人与智成电子于 2017 年 5 月 1 日签订的《产品开发、技术授权暨维护合约书》、于 2019 年 3 月 4 日签订的《智成权利金合同》以及于 2020 年 3 月 31 日签订的《智成权利金合同》，智成电子同意以其所有的 110nm 逻辑制程所需之 Standard Cell Library 授权发行人，并配合发行人的制程特性，维护发行人向智成电子授权取得之产品技术，以使其符合发行人代工客户需求，并达到效率提升、错误侦错并协助发行人推展逻辑制程代工业务。报告期各期，针对上述 IP 授权交易，发行人分别确认费用 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元。

发行人对外部授权 IP 的选择，主要受代工产品工艺技术要求驱动，未来，发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。因此，发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

2、发行人与智成电子的上述交易相关定价公允性

根据发行人与智成电子签署的 IP 授权协议以及发行人与无关联第三方 IP 供应商签订的授权协议，报告期内，发行人与智成电子就上述授权 IP 约定的价款包括前期开发费用和权利金，其中权利金为交易价款的主要组成部分。报告期内，发行人与智成电子约定的授权 IP 权利金为单片晶圆净销售额的 1%。截至 2021 年 4 月 25 日，除智成电子授权 IP 外，发行人正在使用的其他授权 IP 权利金计提比例（按每片晶圆支付固定金额的除外）主要区间为晶圆销售金额或净额的 0.5%-1.5%。因此，发行人与智成电子的上述交易价格仍处于发行人确定的合理价格区间范围内。

对于与智成电子的上述 IP 授权交易，发行人遵循市场化交易原则，与智成电子协商确定 IP 授权价格，采购价格具备公允性。

2021 年 2 月 9 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司 2018 年度至 2020 年度期间关联交易的议案》；发行人全体独立董事就报告期内的关联交易事项发表了独立意见，认为包括上述 IP 授权交易在内的关联交易，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021 年 3 月 16 日，发行人召开股东大会，审议通过了关于公司报告期内的关联交易的议案，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

综上，发行人与智成电子的上述 IP 授权交易，交易相关定价具有公允性。

十四、《问询函》第 14 题：关于存在累计未弥补亏损

招股说明书披露，公司在有限责任公司整体变更为股份有限公司时，截至股改基准日 2020 年 9 月 30 日存在累计未弥补亏损。公司在报告期尚未盈利或最近一期存在累计未弥补亏损。营业收入从 2018 年 2 亿元增长到 2020 年 15 亿元，各期扣非归母净利润在-12 亿元左右。

请发行人按照《问答（一）》第 2 条和第 13 条的要求进行相关信息披露。

请发行人说明营业收入持续上升，扣非归母净利润基本维持不变的原因。

请保荐机构、申报会计师和发行人律师分别按照《问答（一）》的要求进行核查并发表明确意见，申报会计师对说明事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）按照《问答（一）》第 2 条要求进行的核查

1、核查程序

（1）逐条对照《问答（一）》第 2 条关于尚未盈利或最近一期存在累计未弥补亏损情形的信息披露要求，对本次发行招股说明书披露内容的完整性进行了核查；

（2）了解发行人的销售、采购及生产模式等业务，实地查看经营场所，了解发行人发展战略、经营策略及未来市场布局情况，访谈公司管理层，了解尚未盈利的影响趋势风险因素等情况；

（3）获取发行人的销售预测，分析相关假设的数据基础及相关预测的合理性。

2、核查意见

经核查，本所认为：

（1）发行人已按照《问答（一）》第 2 条的要求，在招股说明书中就其尚未盈利及最近一期存在累计未弥补亏损情形进行了完整披露，符合上交所关于信息披露的相关规定。

（2）发行人尚未实现盈利，但具备获得持续经营性现金流的能力、能够持续拓展业务领域和核心客户、具有人才吸引力并保持核心研发团队的稳定性、研发投入金额逐年增加、相关战略性投入符合公司的发展要求，发行人具有持续经营的能力，报告期内尚未盈利对公司持续经营能力不会产生重大不利影响。

（二）按照《问答（一）》第 13 条要求进行的核查

1、关于信息披露要求的核查

（1）核查程序

本所律师逐条对照《问答（一）》第 13 条关于整体变更时存在累计未弥补亏损情形的信息披露要求，对本次发行招股说明书披露内容的完整性进行了核查。

（2）核查意见

经核查，本所认为，发行人已按照《问答（一）》第 13 条的要求，在招股说明书中就其整体变更时存在累计未弥补亏损情形进行了完整披露，符合上交所关于信息披露的相关规定。

2、关于要求核查事项的核查

（1）核查程序

①查阅发行人整体变更时的有限公司董事会、股份公司创立大会决议；

②查阅发行人整体变更时的审计报告、资产评估报告及国资委备案文件、发起人协议、国资委批复文件、验资报告等文件；

③对发行人整体改制是否存在侵害债权人合法权益的情形进行分析，并查阅中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等，确认是否存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷；

④查阅发行人整体变更已完成工商登记注册相关文件；

⑤对发行人整体变更相关事项是否符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定进行分析。

（2）核查意见

经核查，本所认为：

①发行人整体变更相关事项已经有限公司董事会、股份公司创立大会表决通过，相关程序合法合规

②改制中不存在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷

2020 年 10 月 21 日，晶合有限召开董事会，同意公司整体变更为股份公司的方案，整体变更后的注册资本为 1,504,601,368 元，未高于晶合有限经审计的净资产额 7,353,140,545.50 元，同时，公司的一切资产及债权、债务，由依法变更后的股份公司继承，不存在通过自身资产的调整或者企业间资产转移等行为侵害债权人合法权益的情形。

经查询中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在改制中侵害债权人合法权益而导致的纠纷。

③发行人整体变更已完成工商登记注册和税务登记相关程序

就整体变更为股份有限公司事宜，发行人已于 2020 年 11 月 25 日取得合肥市市场监督管理局向发行人核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100343821433Q）。

根据《国家税务总局关于落实“三证合一”登记制度改革的通知》（税总函[2015]482 号）的相关规定，2015 年 10 月 1 日后新设企业领取由工商行政管理部门核发加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照后，无需再次进行税务登记，不再领取税务登记证。

④发行人整体变更相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定

a.发起人符合法定人数

根据发行人创立大会文件及全体发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，发行人发起设立时的发起人共计 30 人，其中有半数以上的发起人在中国境内有住所，符合《公司法》第七十八条的规定。

b.筹办事项符合法律规定

根据全体发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，发起人授权晶合有限董事会办理将有限公司整体变更为股份公司的相关事宜，并于前述协议中明确了各发起人的权利义务，符合《公司法》第七十九条的规定。

c.全体发起人认购的股本总额符合法律规定

根据发行人整体变更时制定的公司章程、发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》，全体发起人认购股本总额为 1,504,601,368 元。容诚于 2020 年 11 月 20 日出具容诚验字[2020]230Z0263 号的《验资报告》，根据该《验资报告》，发行人设立时注册资本已足额缴纳，符合《公司法》第八十条、第八十三条的规定。

发行人整体变更折合的实收股本总额为 1,504,601,368 元，不高于晶合有限净资产额，符合《公司法》第九十五条的规定。

d.发起设立时的公司章程符合法律规定

发行人发起设立时的公司章程包括了《公司法》所要求的股份有限公司章程的必备条款，符合《公司法》第七十六条第（四）项、第八十一条的规定。

e.符合股份有限公司要求的组织机构、公司住所

根据发行人取得的统一社会信用代码为 91340100343821433Q 的营业执照、全体发起人签署的《合肥晶合集成电路股份有限公司发起人协议》及发起设立时的公司章程，发行人公司名称为“合肥晶合集成电路股份有限公司”，同时其建立了股东大会、董事会、监事会等符合股份有限公司要求的组织机构，公司住所为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，符合《公司法》第七十六条第（五）项和第（六）项的规定。

十五、《问询函》第 22 题：关于信息披露豁免

发行人申请豁免披露的信息主要包括前五大客户及前五大供应商名称，应收账款及应付账款等往来款前五大交易对手方名称。在招股书前五大客户和前五大原材料供应商情况中以第一名、第二名、第三名等进行替代。

请发行人说明：（1）严格按照《审核问答》第 16 条要求说明信息披露豁免的原因和依据，豁免披露后的信息是否对投资者决策判断构成重大障碍，豁免披露的信息是否尚未泄漏；（2）如果确有理由豁免披露，请修改信息披露替代方案，同一客户或供应商应有同一明确代称。

请保荐机构、申报会计师和发行人律师应审慎认定信息披露豁免事项，并按照《审核问答》要求出具核查报告。

回复：

发行人、保荐机构、发行人律师、申报会计师已依据《审核问答》第 16 条要求，重新提交《合肥晶合集成电路股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的信息披露豁免申请》《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股

份有限公司信息豁免披露申请的核查意见》《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司信息豁免披露的专项核查报告》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）<关于合肥晶合集成电路股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之申请文件信息披露豁免相关事宜的专项核查意见>》。

十六、《问询函》第 24 题：关于募投项目

招股说明书披露：（1）本次募集资金将全部投入合肥晶合集成电路股份有限公司 12 英寸晶圆制造二厂项目。本项目利用一厂建设工程项目所建设的 12 英寸集成电路芯片制造二厂厂房主体，建设一条产能为 4 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线，主要产品包括电源管理芯片（PMIC）、显示驱动整合芯片（DDIC）、CMOS 图像传感芯片（CIS），另外，将建设一条微生产线用于 OLED 显示驱动与逻辑工艺技术开发试产。（2）发行人本次募集资金拟投资的“12 英寸晶圆制造二厂项目”目前处于立项阶段，尚需在开工建设前办理环评相关手续。

请发行人说明：（1）募投项目所实现的制程节点情况；结合发行人相关产品的市场需求及竞争状况、技术水平等，分析发行人募投项目未来的市场空间和产能消化能力；（2）4 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线与用于 OLED 显示驱动与逻辑工艺技术开发试产的微生产线之间的关系，新增固定资产折旧摊销额预计对公司未来业绩的影响；（3）募投项目未办理环评相关手续的原因，目前进展情况，是否存在无法获得审批的风险。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

募投项目未办理环评相关手续的原因，目前进展情况，是否存在无法获得审批的风险

目前，发行人就本次募投项目正在向相关部门申请备案，备案完成后将向环保主管部门申请办理环评相关审批手续。

合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局已于 2021 年 1 月 13 日在合肥市主持召开了《合肥晶合集成电路股份有公司 12 吋晶圆制造二厂项目环境影响报告表》技术评审会，与会专家及代表经评议出具技术评审意见，认为：报告表编制较规范，基本符合相关要求，评价结论基本可信，经修改完善后可上报审批。

根据环境影响评价相关法律、法规的规定，“12 英寸晶圆制造二厂项目”后续环评审批具体的办理安排包括：公司修改完善环境影响报告表，向环保主管部门提交建设项目环境影响报告表审批申请文件；环保主管部门对环境影响报告表进行审查，出具审批意见并将相关信息进行公示。此外，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局于 2021 年 6 月 11 日出具《关于 12 吋晶圆制造二厂项目相关环评事项的说明》，“本局认为，待晶合集成完成项目发改委备案程序后，该项目环评可上报审批。”

综上，本所认为，发行人就募投项目取得环评批复不存在实质性障碍。

十七、《问询函》第 25 题：关于股东核查情况

请发行人和有关中介机构按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》、《监管规则适用指引——发行类第 2 号》、《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等要求，对相关事项进行核查和披露，并出具专项核查报告。

回复：

根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》《关于股东信息核查中“最终持有人”的理解与适用》的要求，本所已对相关事项进行核查和披露，并出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司证监会系统离职人员入股的专项说明》，详见本次申报文件之“7-8-9”。

（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

苏 峥

刘东亚

单位负责人：

王 玲

二〇二一年七月十三日

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（二）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于上交所于 2021 年 8 月 6 日下发《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2021]488 号）（以下简称“《问询函》”）,本所现根据《问询函》的要求，就其中所涉及的法律问题进行核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》不可分割的组成部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法律意见的引言、前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

在本补充法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、验资报告及境外法律意见等某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会及上交所有关规定的要求，出具本补充法律意见如下：

目录

一、 《问询函》第 1 题：关于委托经营管理 210

二、 《问询函》第 2 题：关于订单互补 221

三、 《问询函》第 3 题：关于人员 229

四、 《问询函》第 5 题：关于实际控制人认定 233

五、 《问询函》第 6 题：关于力晶科技从事同类业务 247

六、 《问询函》第 7 题：关于无形资产和技术 251

七、 《问询函》第 9 题：关于其他 255

一、《问询函》第 1 题：关于委托经营管理

根据问询回复：2015 年 10 月 19 日，力晶科技与公司签订《委托经营管理合约》，主要目的系促进双方合作以及配合技术导入，帮助公司尽快建立独立的营运能力；同时，如发行人出现经营、发展状况不及预期时，合肥国资方也能够约束力晶科技向公司投入更多精力与支持，降低投资风险。

尽管《委托经营管理合约》的合同名称包含“委托经营”，但签订《委托经营管理合约》的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力，协议中并未约定委托经营的期限、委托经营的费用以及相关违约责任等在常规委托经营模式下的约定事项。在实际履行过程中，双方仅根据公司发展的需求履行了部分条款，公司与力晶科技之间相互独立，力晶科技未将公司视为在大陆的子厂，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

请发行人说明：（1）发行人与力晶科技之间签订委托经营管理合约但仅部分履行，与委托经营协议中约定的力晶科技应将公司视为其工厂之延伸的目标实际执行不一致的合理性，是否与实际情况相符；（2）在发行人未将日常经营运作委托力晶科技管理，未执行订单互补支持等条款的情况下，发行人短期内能够满足独立性要求的合理性。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。请保荐机构、申报会计师和发行人律师说明对委托经营管理合约实际执行情况所履行的核查手段、获取的核查证据，对认定委托经营管理合约签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技的依据是否充分发表明确意见。

回复：

（一）发行人与力晶科技之间签订委托经营管理合约但仅部分履行，与委托经营协议中约定的力晶科技应将公司视为其工厂之延伸的目标实际执行不一致的合理性，是否与实际情况相符

《委托经营管理合约》第四条约定：“甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸，全力支持乙方之经营管理，使乙方迅速获利、扩充产能并且达成 IPO 之目标”，其中，“甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸”系表达力晶科技合作态度、强调力晶科技应对

发行人投入大力支持，帮助发行人尽快实现“迅速获利、扩充产能并且达成 IPO 之目标”。约定该条款的目的系为了促进双方合作，约束力晶科技向发行人投入更多精力，以及降低投资风险，并非将公司“视为其工厂之延伸”作为委托经营管理的目标。

《委托经营管理合约》签订于 2015 年 10 月，签署时合肥国资方与力晶科技之间尚未正式展开合作，相关条款系双方充分考虑未来合作过程中可能遇到的问题和风险而设定。在公司设立并开始经营后，自 2016 年起自行聘用员工，在较短时间内建立了经营团队，并拥有了生产经营必需的相关技术和业务渠道，具备了公司运营的各方面能力，因此，双方仅根据公司发展的需求履行了部分条款。《委托经营管理合约》终止前，公司的重大决策由公司董事会独立进行决策，公司日常运营仍以发行人自身员工和合肥国资方委派高管为主导，公司日常运营中管理、业务、财务等方面均由发行人独立决策，与力晶科技独立，公司的客户、供应商的谈判、关系维护、协议签订等均由公司独立完成，公司内部审批流程除力晶科技委派高级管理人员参与外，不存在力晶科技其他人员参与的情形。《委托经营管理合约》履行过程中，公司与力晶科技之间相互独立，力晶科技未将公司视为在大陆的子厂，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：“一、为落实国家关于集成电路产业发展的规划，我市于 2015 年引进力晶科技股份有限公司（以下简称力晶科技）合作建设合肥晶合 12 英寸晶圆制造基地项目，着力提升自主可控的芯片制造能力。

二、2015 年 4 月，我市与力晶科技签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》（以下简称《合作框架协议》），后晶合集成按照协议约定与力晶科技签订《委托经营管理合约》。主要目的系促进双方合作关系，配合晶合集成建厂以及初期技术导入，如晶合集成出现经营、发展状况不及预期时，也能够约束力晶科技向晶合集成投入更多精力与支持，降低投资风险，并非将晶合集成经营管理权交予力晶科技。”

综上，“将乙方视为甲方工厂之延伸”并非委托经营管理的目标，双方根据公司发展的需求履行了部分条款与委托经营协议中“将乙方视为甲方工厂之延伸”的约定不一致存在合理性，且与实际情况相符。

（二）在发行人未将日常经营运作委托力晶科技管理，未执行订单互补支持等条款的情况下，发行人短期内能够满足独立性要求的合理性

1、公司员工及经营团队建立顺利

2015 年 10 月《委托经营管理合约》签订后，公司逐步组建了自身的经营团队及相应职能部门。截至 2017 年末，公司已组建了采购、销售、生产、财务等各项公司运营所需的职能部门，员工人数达 1,000 余人，其中台籍员工约 240 余人，约 110 余人为曾在力晶科技任职。较多员工具备集成电路上下游行业的从业经验，除部分管理岗位由双方股东委派的高级管理人员兼任外，公司已拥有日常运营所需的人员，具备了独立营运的基础，不存在将日常营运委托给力晶科技的需求和必要性。

2、厂房等基础设施建设顺利

2015 年 10 月，合肥建投与力晶科技签订《投资参股协议》后，合肥蓝科即开工建设晶合一厂相关基础设施，并于 2016 年 11 月完成主体厂房的建设，2017 年 7 月完成洁净室及相关配套厂务设施的建设，并于 2017 年 10 月实现正式量产。

发行人设立、建设厂房及配套厂务设施、搬入机台设备、试生产并最终实现量产的过程中，各阶段在经营团队的提前规划下衔接紧凑，使发行人能够在较短时间内实现正式量产，具备了独立经营、开拓业务的能力。

3、技术移转进展顺利

2015 年 10 月，合肥建投、发行人与力晶科技签署《技术移转协议》，约定了力晶科技三项制程技术移转的步骤及实施细节。力晶科技基于《技术移转协议》后续向发行人先后移转了三项制程技术所需全部专利、其他技术文件及数据、技术经验等完整的工艺平台制程技术包。技术移转完成后，发行人具备了独立运营的技术基础。

4、客户开拓及产品验证顺利

在技术移转的过程中，力晶科技负责将奇景光电和奕力科技推荐给发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证。相关技术移转成后，发行人与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，并完成试产、风险量产、量产等工作。除上述情况外，发行人其余主要客户均为发行人自主联系、独立开发。发行人在正式量产后，逐步与多家行业内知名企业建立合作，在显示驱动芯片代工领域建立了自己的客户基础，具备了独立运营的业务拓展能力。

综上所述，发行人员工及经营团队建立、厂房等基础设施建设、技术移转、客户开拓及产品验证等方面均进展顺利。因此，发行人在未将日常经营运作委托予力晶科技管理、未执行订单互补支持等条款的情况下，短期内建立起独立运营能力，具备合理性。

（三）请保荐机构、申报会计师和发行人律师说明对委托经营管理合约实际执行情况所履行的核查手段、获取的核查证据，对认定委托经营管理合约签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技的依据是否充分发表明确意见

对委托经营管理合约实际执行情况，本所律师履行了以下核查手段、获取了以下核查证据：

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
1	**条款内容：** 乙方审计师、副总会计师由甲方指派	实际履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了发行人历次聘任审计师、副总会计师的相关董事会决议； 2、取得并核查了力晶科技出具的确认函。	
2	**条款内容：** 其他经营管理团队由甲方指派	未实际履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得发行人历次高级管理人员变动相关的会议文件； 2、取得并核查了《委托经营管理合约》，并就《委托经营管理合约》签订及履行的情况与发行人相关人员进行了访谈； 3、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况； 4、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单； 5、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等； 6、取得并核查了发行人自设立以来历次董事会会议、经营管理委员会会议记录等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委	

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	派人员的参与情况进行了核查； 7、取得并核查了发行人员工花名册，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查； 8、取得发行人经营管理层各项会议的文件和说明； 9、取得了力晶科技就委托经营管理相关事项出具的确认函。	
3	**条款内容：** 乙方财务实行总会计师与副总会计师会签及核决制度	实际履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了发行人历次聘任总会计师、副总会计师的相关董事会决议； 2、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等。	
4	**条款内容：** 乙方采购、销售业务实行总监与副总监会签制度	实际履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得发行人历次高级管理人员变动相关的会议文件； 2、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等。	
5	**条款内容：** 乙方日常经营运作，包含业务、生产营运、组织人事、技术等皆委托甲方管理	未实际履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了《委托经营管理合约》，并就《委托经营管理合约》签订及履行的情况与发行人相关人员进行了访谈； 2、访谈力晶科技副总经理等相关人员，了解《委托经营管理合约》签订的背景、具体条款的履行情况、部分条款未履行的原因、约定“甲方应将乙方视为甲方工厂之延伸”的原因及实际执行等； 3、访谈合肥建投总经理等相关人员，了解《委托经营管理合约》签订的背景、具体条款的履行情况、部分条款未履行的原因以及《委托经营管理合约》的解除等相关情况； 4、取得并核查了《委托经营管理合约》存续期间，力晶科技与合肥建投之间沟通的相关会议纪要； 5、取得了发行人、力晶科技、合肥建投分别出具的与《委托经营管理合	

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	约》签订、履行、解除情况相关的确认函； 6、取得并核查了发行人自设立以来历次董事会会议、经营管理委员会会议记录等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委派人员的参与情况进行了核查； 7、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等，抽取部分公司内部审批流程文件，核查了力晶科技相关人员的参与情况； 8、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况； 9、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单及离职证明； 10、取得并核查了发行人员工花名册、工资表以及缴纳社保、公积金的明细，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查； 11、对报告期内发行人主要客户进行实地走访/视频访谈，询问客户在与发行人的合作过程中，是否存在从力晶科技转移订单至发行人的情形，以及力晶科技及力积电是否影响发行人的销售和采购，是否存在非公平竞争、利益输送等情形；就报告期内发行人主要客户与发行人的合作情况、初次接洽情况、与力晶科技的关联关系以及历史合作情况等进行询问并形成书面访谈记录，获取客户确认的与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系确认函、交易真实性的承诺函； 12、就发行人客户、供应商的开发过程及订单互补的履行情况与发行人相关员工进行了访谈，了解公司销售业务的流程、客户获取方式、订单签订流程，并取得了力晶科技出具的确认函； 13、取得发行人与主要客户谈判、确定合作以及后续客户关系维护等过程的电子邮件等支持性证据； 14、获取报告期内发行人开发客户时与客户的沟通记录，检查发行人的主要客户订单下达方式及相关记录，查阅了发行人与主要客户签署的框架合同、订单、产能预约合同等，核查其是否与力晶科技之间有关系； 15、获取发行人销售人员与发行人签订的劳动合同，核查其是否与力晶科技之间有关系； 16、对报告期内主要客户收入进行核查，获取并核对客户报告期内收入明细对应的销售订单、销售出库单、销售发票、出口报关单、签收单、客户回款对应银行回单，核实销售订单的来源以及销售过程中是否存在力晶科技的参与； 17、分析了发行人主要客户数量、客户收入金额分布、产能预约订单等	

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	资料，访谈了公司管理层及销售相关人员，了解发行人业务发展中与力晶科技及其关联方的关系； 18、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来力晶科技历年公开披露的年报，并就其中与晶合集成相关事宜的披露情况进行了核查。	
6	**条款内容：** 甲方将透过移转与授权技术、移转经营经验与经营管理系统、业务支持互补、移转或派驻经营团队、训练当地之干部与人才等方式，达成乙方付托之经营管理任务 **核查手段、获取的核查证据：** 1、核查并取得了发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充协议、确认函，《90nm 项目技术协议》及其补充协议、确认函，并与发行人相关人员访谈了解相关协议的履行情况。 2、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单及离职证明； 3、取得并核查了发行人员工花名册、工资表以及缴纳社保、公积金的明细； 4、抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查； 5、对报告期内发行人主要客户进行实地走访/视频访谈，询问客户在与发行人的合作过程中，是否存在从力晶科技转移订单至发行人的情形，以及力晶科技及力积电是否影响发行人的销售和采购，是否存在非公平竞争、利益输送等情形；就报告期内发行人主要客户与发行人的合作情况、初次接洽情况、与力晶科技的关联关系以及历史合作情况等进行询问并形成书面访谈记录，获取客户确认的与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系确认函、交易真实性的承诺函； 6、就发行人客户、供应商的开发过程及订单互补的履行情况与发行人相关员工进行了访谈，了解公司销售业务的流程、客户获取方式、订单签订流程，并取得了力晶科技出具的确认函； 7、取得发行人与主要客户谈判、确定合作以及后续客户关系维护等过程的电子邮件等支持性证据； 8、获取报告期内发行人开发客户时与客户的沟通记录，检查发行人的主要客户订单下达方式及相关记录，查阅了发行人与主要客户签署的框架合同、订单、产能预约合同等，核查其是否与力晶科技之间有关系； 9、获取发行人销售人员与发行人签订的劳动合同，核查其是否与力晶科技之间有关系； 10、对报告期内主要客户收入进行核查，获取并核对客户报告期内收入	部分履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	明细对应的销售订单、销售出库单、销售发票、出口报关单、签收单、客户回款对应银行回单，核实销售订单的来源以及销售过程中是否存在力晶科技的参与； 11、分析了发行人主要客户数量、客户收入金额分布、产能预约订单等资料，访谈了公司管理层及销售相关人员，了解发行人业务发展中与力晶科技及其关联方的关系； 12、取得并核查了发行人、合肥建投与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充协议、发行人与力晶科技就《技术移转协议》履行情况签署的确认函以及相关附录、发行人与力晶科技签订的《专利转让协议》等协议文件； 13、取得并核查了力晶科技派驻发行人处进行技术移转支持团队的人员安排，以及发行人委派员工前往力晶科技进行培训的人员安排；并取得了发行人员工前往力晶科技培训的差旅费用签核表； 14、查看了发行人关于技转文件的电子数据库；抽样核查了力晶科技技转的技术文件资料及附件。	
7	**条款内容：** 甲方除遴选适当人员至乙方各组织，以兼职、派驻或全职身份按相关组织核决权限执行业务外，乙方董事会下应设立经营管理委员会，由甲方之高管及合肥建投委派至乙方，依第一条第一款所列之全部人员担任委员会成员，具体协助董事会指导并督促乙方所有经理人与经营团队 **核查手段、获取的核查证据：** 1、取得发行人经营管理委员会相关工作制度、会议文件，并向发行人了解经营管理委员会的运作情况； 2、取得并核查了发行人自设立以来历次董事会会议、经营管理委员会会议记录等资料，抽取发行人日常经营性会议的会议记录，就力晶科技委派人员的参与情况进行了核查； 3、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等，抽取部分公司内部审批流程文件，核查了力晶科技相关人员的参与情况； 4、取得了力晶科技就委托经营管理相关事项出具的确认函。	实际履行
8	**条款内容：** 甲方应按照技术移转协议，于乙方建置完成可进行驱动 IC 代工业务之相关技术，确保乙方能够完全掌握该技术，并可在无须另行依赖其他技术的前提下，完整地生产出本项目所涉全部合格产品。 **核查手段、获取的核查证据：** 1、核查并取得了发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充	实际履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	协议、确认函，《90nm 项目技术协议》及其补充协议、确认函，并与发行人相关人员访谈了解相关协议的履行情况。 2、取得并核查了力晶科技用以出资的 58 项专利清单及相关专利证书，发行人受让的尚在有效期内的 44 项专利的专利变更手续相关文件； 3、取得并核查了安徽华洲资产评估有限公司、同致信德（北京）资产评估有限公司就专利技术使用权出资出具的资产评估报告及复核报告。	
9	**条款内容：** （一）甲方应将现行于甲方实行，具备效率与竞争力之经营管理经验导入乙方，由乙方人员建置吸收并且在乙方推行，成为乙方的企业文化或 SOP。 （二）甲方应将现行于甲方量产，具备竞争力之量产全部参数导入乙方机台，并训练乙方生产与技术人员，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。 （三）甲方应将现行于甲方运作，具备竞争力之全部经营管理系统，包含但不限于生产管理软件、派工作业、自动化控制生产系统、会计系统、人事系统、签核流程等，导入乙方之计算机系统内，并训练乙方管理人员进行操作与问题解决能力，达成和甲方一致或超越之效率与生产力。	实际履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、核查并取得了发行人与力晶科技签订的《技术移转协议》及其补充协议、确认函，并与发行人相关人员访谈了解相关协议的履行情况； 2、取得并核查了发行人组织机构图及审批权限表，并与发行人相关人员访谈了解各部门具体人员设置及运行情况等，抽取部分公司内部审批流程文件，核查了力晶科技相关人员的参与情况； 3、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况。	
10	**条款内容：** 针对技术授权之制程技术及代工业务，甲方应协助建立乙方之业务能力，让乙方业务人员运用大陆之优势，开拓并争取业务订单，以达成国产化之目标。	发行人设立初期，阶段性部分履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得发行人与主要客户谈判、确定合作以及后续客户关系维护等过程的电子邮件等支持性证据； 2、获取报告期内发行人开发客户时与客户的沟通记录，检查发行人的主要客户订单下达方式及相关记录，查阅了发行人与主要客户签署的框	

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	架合同、订单、产能预约合同等，核查其是否与力晶科技之间有关系； 3、获取发行人销售人员与发行人签订的劳动合同，核查其是否与力晶科技之间有关系； 4、对报告期内主要客户收入进行核查，获取并核对客户报告期内收入明细对应的销售订单、销售出库单、销售发票、出口报关单、签收单、客户回款对应银行回单，核实销售订单的来源以及销售过程中是否存在力晶科技的参与； 5、分析了发行人主要客户数量、客户收入金额分布、产能预约订单等资料，访谈了公司管理层及销售相关人员，了解发行人业务发展中与力晶科技及其关联方的关系。	
11	**条款内容：** 当甲方之业务量需求超过甲方产能，且乙方之产能仍可支持时，甲方应移转订单到乙方进行生产。当乙方之业务量超过乙方产能，且甲方产能仍可支持时，乙方应移转订单到甲方。针对代工移转订价，应考虑市场行情、符合法定并且双方互利 **核查手段、获取的核查证据：** 1、获取发行人 2018 年至 2019 年的销售收入明细及对应的销售订单、出库单、商业发票、出口报关单和签收单据，核对相关单据是否与发行人的客户一致； 2、在发行人工作人员的陪同下，直接至银行打印发行人报告期内的银行流水，检查银行流水记载的交易对手名称、交易金额等信息是否与发行人序时账中记载的交易对手名称、交易金额等信息一致； 3、根据银行流水、应收账款及预收账款明细账等，对客户的回款明细执行双向核对，核对客户名称是否与实际交易客户一致，是否存在第三方收款情况； 4、检查发行人报告期内与力晶科技之间的资金往来情况，检查发行人与力晶科技的资金往来是否与双方业务相匹配； 5、取得并核查了发行人与力晶科技及力积电的收入统计表，并将双方向同一客户提供的产品及服务进行了比对； 6、取得并核查了发行人报告期内主要工艺平台（包括 150nm、110nm、90nm）的验证文件，取得了发行人主要客户对上述工艺平台首颗产品的量产同意书，以及邮件回复确认； 7、取得了力晶科技及力积电与发行人重叠的主要客户签订的产能预约合同，核查了其中是否存在与晶合进行订单互补相关的条款； 8、查询了集成电路行业的研究报告和可比公司公开资料中关于不同尺寸的晶圆价格披露内容；	未实际履行

序号	条款内容及核查手段、获取的核查证据	履行情况
	9、访谈了发行人技术部门和业务部门，对价格存在差异的原因进行了了解； 10、访谈了发行人主要客户，了解以下内容： （1）发行人与力晶科技及力积电向同一主要客户销售产品是否具备替代性； （2）发行人未与奇景光电、奕力科技、合肥捷达微、敦泰电子签订框架协议是否符合行业惯例； （3）发行人与主要客户在 2020 年之后签署产能预约合同的原因； （4）发行人与力晶科技及力积电是否存在潜在的利益安排，发行人与客户之间的交易是否有力晶科技及力积电的参与，是否存在利益输送、相互或者单方让渡商业机会、损害合肥晶合利益等情形； （5）主要客户向发行人采购的验证情况、验证步骤以及验证通过的时点。	
12	**条款内容：** 除技术移转协议规范之技术团队外，甲方应派驻并建立乙方所需之经营管理团队，以执行经营管理职务，类型与相关规定如下： （一）兼职人员：兼职人员系指具备甲方员工身分，但必须于乙方挂职以执行乙方业务之人员。此类人员之薪资由甲方负担，在移转技术验证完成之前，若因执行乙方业务时产生之差旅费及各项费用，由乙方支付。乙方可经过乙方董事会核准，支付该兼职人员薪资补贴。 （二）派驻人员：派驻人员系指由乙方雇佣并约定一定期间期满后即结束与乙方聘雇关系之相关人员。派驻人员派驻期间之薪资由乙方负担，派驻期间之相关保险与退休，亦由乙方按照法令予以支付，甲方及乙方可给予相对优惠条件于派驻人员，吸引人员愿意派驻。 （三）全职人员：全职人员系指由乙方雇用且正式任职乙方之人员。乙方于法令许可条件下，可以优惠条件吸引甲方相关团队（包含技术人员）成为乙方之全职人员	发行人设立初期，阶段性部分履行
	核查手段、获取的核查证据： 1、取得并核查了自《委托经营管理合约》签订以来，力晶科技、合肥建投向发行人委派人员的名单，并向发行人相关人员了解委派人员的岗位职责等情况； 2、取得并核查了自力晶科技入股以来发行人全部台籍员工的名单、曾在力晶科技任职员工的名单及离职证明； 3、取得并核查了发行人员工花名册、工资表以及缴纳社保、公积金的明细，抽取部分员工合同，就发行人员工劳动关系情况进行了核查。	

经核查，本所认为，委托经营管理合约签订后，发行人未将经营管理权委托予力晶科技，且认定依据充分。

二、《问询函》第 2 题：关于订单互补

根据反馈回复：（1）报告期内，双方未实际履行订单互补支持相关条款；（2）发行人主要客户和供应商均与力晶科技重叠，奇景光电和奕力科技的工艺平台验证主要来自力晶科技，而后续与该等客户谈判、确定合作、试产、风险量产、量产以及后续客户关系维护等均由发行人独立完成；（3）发行人仅与联咏科技、集创北方签订了诸如采购契约书、晶圆代工合同等类似的框架合同，其余客户的产能预约合同均在 2020 年左右签订；（4）发行人与半导体晶圆代工领域的可比公司在每片晶圆销售平均价格存在较大差异，发行人价格在 4000 至 5000 元，发行人销售价格偏低。

请发行人说明：（1）向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性，主要客户工艺平台验证通过时间和验证通过的依据并提供相关依据，产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因，未签订框架协议是否符合行业惯例；（2）列表说明 2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系，并提供相应合同或订单，报告期内发行人与力晶科技之间的资金往来情况，是否存在从力晶科技回款的情况；（3）奇景光电及奕力科技同为发行人与力晶科技客户的情况下，将相关技术移转至发行人的合理性，是否需要相关客户的重新认证，发行人与力晶科技向奇景光电、奕力科技提供产品或服务是否存在差异，相关客户与发行人签订的订单是否附属于力晶科技与相关客户所签合同，是否存在潜在利益安排；（4）与可比公司晶圆价格存在差异的原因，发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格的差异及原因；（5）结合上述事项说明报告期内双方未实际履行订单互补支持相关条款的依据是否充分。

请保荐机构、申报会计师和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性，主要客户工艺平台验证通过时间和验证通过的依据并提供相关依

据，产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因，未签订框架协议是否符合行业惯例

1、向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性

报告期内，对于双方均提供的半导体晶圆代工服务，主要是 90nm DDIC、110nm DDIC 和 150nm DDIC 半导体晶圆代工服务，由于发行人和力晶科技及力积电各自的设计组件、生产线设备、机台配置与能力、客户要求的产品规格参数存在差异，因而提供的产品及服务的定制化程度较高；从为客户及终端产品所实现的最终效果来看，均为通过高压元件对电压的控制与调整，实现对液晶分子的转向控制，从而达成对液晶面板的显示控制，但双方提供的代工服务存在差异。

根据对主要客户访谈，发行人及力晶科技及力积电向重合客户提供的半导体晶圆代工服务所代工的具体产品存在差异，不具备完全的相互替代性。

综上，虽然双方共同向客户提供 90nm DDIC、110nm DDIC 和 150nm DDIC 半导体晶圆代工服务，但由于各自的设计组件、生产线设备、机台配置与能力、客户要求的产品规格参数存在差异，提供的产品及服务的定制化程度较高，不可完全相互替代。

2、主要客户工艺平台验证通过时间和验证通过的依据并提供相关依据

发行人工艺平台验证包含多个不同的验证：

（1）发行人自身内部验证

“力晶科技负责将与奇景光电、奕力科技涉及技术移转的相关技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人初期产品和工艺平台的验证”，此处验证是指：在发行人的设立及运营初期，发行人自身内部开展对力晶科技出资的三项制程技术对应的工艺平台的验证，以确保技术移转的工艺平台可以向客户提供服务。2017 年 6 月 5 日，公司与力晶科技签订《技术移转协议确认函》，确认发行人已完成对三项制程技术的验证。

（2）客户验证

在发行人获得客户验证的各阶段步骤中，根据投片量、良率提升和工艺条件等指

标不同，划分为小规模试产、风险量产和大批量生产阶段。发行人主要客户对公司向客户提供服务所采用的工艺平台生产的第一颗产品验证情况如下：

序号	主要客户名称	工艺平台	该工艺平台第一颗产品开始试产的时间	该工艺平台第一颗产品开始风险量产的时间	该工艺平台第一颗产品验证通过、开始大批量生产的时间
1	联咏科技股份有限公司	90nm_1.32V/6V/32V(TDDI)	2018/8/17	2018/10/8	2019/5/15
		150nm_1.8V/18V(TV)	2020/9/24	2021/1/8	2021/5/10
		150nm_3.3V/18V(TV)	2017/12/20	2018/4/19	2018/11/12
2	北京集创北方科技股份有限公司及其关联方	N1 LCDDr 90nm-MP 1.32V_6V_32V	2020/3/13	2020/11/10	2021/2/1
		N1 LCDD 0.15um-S 3.3V_18V	2018/10/29	2020/7/29	2020/9/7
		N1 LCDD 110nm-N 1.5V_6V_32V	2018/6/12	2019/4/28	2019/8/9
		N1 LOGIC 110nm-LP 1.5V_5V	2020/2/20	2020/7/13	2021/7/15
3	奇景光电股份有限公司	110nm_1.5V/6V/32V(SDDI)	2017/9/29	2017/10/9	2018/6/4
		150nm_3.3V/13.5V(NB)	2018/4/27	2018/9/26	2020/2/18
4	奕力科技股份有限公司	90nm_1.32V/6V/32V(TDDI)	2021/1/4	2021/3/9	2021/7/13
		110nm_1.5V/6V/32V(SDDI)	2017/9/28	2017/9/28	2018/6/22
		150nm_3.3V/13.5V(NB)	2019/10/28	2020/2/10	2020/9/3
5	合肥捷达微电子有限公司及其关联方	N1 LCDDr 110nm-SUPER 1.5V_6V_32V	2018/9/26	2019/3/22	2019/12/10
		N1 LCDDr 90nm-MP 1.32V_6V_32V	2020/3/6	2020/10/29	2021/4/16
		150nm_1.8V/18V(TV)	2020/4/21	2020/10/29	2021/4/27
6	敦泰电子股份有限公司	N1 LCDDr 110nm 1.5V_6V_32V	2018/1/23	2018/8/9	2019/12/9

注：发行人在 2017 年自力晶科技技术移转和产品验证的过程中，力晶科技负责将与奇景光电、奕力科技涉及技术移转的相关技术文件和数据资料移转至发行人，以此完成发行人对力晶科技技术移转工艺平台的验证。因此，客户对上述两个产品的情况较为了解，从试产到风险量产的所需时间较短。

3、产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因，未签订框架协议是否符合行业惯例

（1）产能预约合同均在 2020 年以后签订的原因

① 近年来晶圆代工产能较为紧缺

根据公开资料，近年来全球晶圆代工产能紧缺，上游芯片设计企业在全球范围内寻求稳定、可靠的晶圆代工产能。特别是 2020 年以来，随着市场对晶圆代工产能需求的上升，提前预约晶圆代工厂产能愈发重要。因此，2020 年以后与客户签订产能预约合同具备合理性。

② 发行人已与主要客户建立了较久的业务往来

发行人设立和发展初期，产能较小，与客户建立合作的时间较短，尚未形成稳定的合作关系。报告期内，发行人产能逐渐扩充，自 2018 年的 74,860 片/年，上升至 2020 年的 266,237 片/年，具备一定的业务规模，与主要客户建立了时间较久的业务往来，获得了客户的认可，建立了较为稳定的业务关系，因此，2020 年以后与客户签订产能预约合同具备合理性。

综上所述，发行人产能预约合同均在 2020 年以后签订具备合理性。

（2）未签订框架协议是否符合行业惯例

报告期内，发行人的主要客户中，发行人与联咏科技、集创北方签订了框架协议，与部分主要客户未签订框架协议。发行人虽与部分主要客户未签订框架协议，但通过持续的订单、产能预约合同建立了稳定、持久的合作关系。根据对未签订框架协议客户的访谈，未签订框架协议符合客户通常的业务模式，符合行业惯例。

（二）列表说明 2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系，并提供相应合同或订单，报告期内发行人与力晶科技之间的资金往来情况，是否存在从力晶科技回款的情况

1、2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系

2018 年和 2019 年主要客户销售收入与客户与发行人签订合同或下达订单的对应关系如下：

客户名称	2018 年收入（万元）	2019 年收入（万元）	2018 年签署的订单数量（份）	2018 年产生收入的对应订单数量（份）	2019 年签署的订单数量（份）	2019 年产生收入的对应订单数量（份）
奇景光电股份有限公司	7,600.76	9,540.79	33	38	46	52
联咏科技股份有限公司	7,533.39	32,558.13	11	9	14	19
奕力科技股份有限公司	6,114.49	3,601.30	35	35	36	27
北京集创北方科技股份有限公司及其关联方	266.44	2,423.88	6	7	11	13
敦泰电子股份有限公司	193.49	非前五大客户	4	4	2	6
合肥捷达微电子有限公司及其关联方	非前五大客户	2,439.84	7	4	10	10

注：敦泰电子股份有限公司 2019 年不为前五大客户，合肥捷达微电子有限公司 2018 年不为前五大客户

2、报告期内发行人与力晶科技之间的资金往来情况，是否存在从力晶科技回款的情况

报告期内，发行人与力晶科技之间的资金往来主要为发行人向力晶科技支付专业服务费、技术费及咨询服务费，以及发行人从力晶科技收到增资款，不存在发行人通过力晶科技回款的情况。

（三）奇景光电及奕力科技同为发行人与力晶科技客户的情况下，将相关技术移转至发行人的合理性，是否需要相关客户的重新认证，发行人与力晶科技向奇景光电、奕力科技提供产品或服务是否存在差异，相关客户与发行人签订的订单是否附属于力晶科技与相关客户所签合同，是否存在潜在利益安排

1、奇景光电及奕力科技同为发行人与力晶科技客户的情况下，将相关技术移转至发行人的合理性，是否需要相关客户的重新认证

与奇景光电及奕力科技相关的技术移转属于力晶科技技术移转的一部分，技术移

转后，需要有客户进行试产、投片，进行产品的开发及验证，以确保技术移转的完成，进而形成发行人的技术文件。该等技术转移属于力晶科技向发行人转移相关技术，而非奇景光电及奕力科技将其技术移转至发行人。

奇景光电及奕力科技向发行人采购，需要对发行人的工艺平台重新认证。根据客户访谈，发行人客户在使用新的晶圆代工厂时，发行人客户的客户亦要求发行人的客户对新供应商的工艺平台进行验证。

2、发行人与力晶科技向奇景光电、奕力科技提供产品或服务是否存在差异，相关客户与发行人签订的订单是否附属于力晶科技与相关客户所签合同，是否存在潜在利益安排

报告期内，发行人与力晶科技及力积电向奇景光电、奕力科技提供设计组件，在客户进行产品设计后进行代工生产，发行人与力晶科技及力积电在产品组件、生产流程、机台设备等方面存在差异。

根据发行人与相关客户签订的有关合同、力晶科技及力积电与相关客户签订的有关合同，以及对奇景光电、奕力科技的客户访谈，相关客户与发行人签订的订单不附属于力晶科技及力积电与相关客户所签合同，不存在潜在利益安排。

（四）与可比公司晶圆价格存在差异的原因，发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格的差异及原因

1、与可比公司晶圆价格存在差异的原因

晶圆价格受制程、晶圆尺寸、工艺平台等影响，价格呈现较大差异，通常来讲，制程越小晶圆价格越高，晶圆尺寸越大晶圆价格越高：

（1）和台积电、联华电子、中芯国际相比，发行人制程节点与之存在差距，价格低于台积电、联华电子、中芯国际具备合理性；

（2）和华润微相比，发行人制程节点更为先进，晶圆尺寸更大，价格高于华润微具备合理性；

（3）和华虹半导体、世界先进相比，发行人与之制程节点相近，但报告期内，发行人处于发展初期，通过采取高性价比策略，快速渗透、拓展市场，价格低于华虹半导体、世界先进具备合理性；随着发行人技术、产品逐渐成熟，客户逐渐稳定，发行

人价格已逐渐上升。

综上所述，发行人与可比公司晶圆价格存在差异具备合理性。

2、发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格的差异及原因

对于相同制程、相同工艺平台的产品，由于客户产品设计、晶圆代工企业生产能力的不同，定制化程度较高，所需要的光罩层数、金属层数存在差异，晶圆代工企业生产的晶圆尺寸亦存在差异，发行人销售产品与力晶科技及力积电销售同类产品单价系多种产品的平均价格，不具备直接可比性，相同类型产品的价格存在差异具有合理性。

通常来讲，假设其他条件不变，光罩层数越多价格越高，金属层数越多价格越高，晶圆尺寸越大价格越高。

对于相同制程、相同工艺平台、且同为 12 英寸的半导体晶圆代工服务，发行人与力晶力积电价格不存在显著异常差异；对于相同制程、相同工艺平台、但晶圆尺寸不同的半导体晶圆代工服务，发行人价格高于力晶科技及力积电，该等差异主要系尺寸差异导致：发行人提供的 12 英寸半导体晶圆比力晶科技及力积电提供的 8 英寸半导体晶圆面积更大，价格差异具备合理性。

因此，发行人向主要客户销售产品的价格与力晶科技销售同类产品价格存在差异具备合理性。

（五）结合上述事项说明报告期内双方未实际履行订单互补支持相关条款的依据是否充分

1、双方签订订单互补条款的背景

双方签署订单互补条款的本意系落实《合作框架协议》项下力晶科技导入建厂经验的责任，约束力晶科技帮助公司建立独立的营运能力。《委托经营管理合约》中约定订单互补支持，主要系出于表达双方合作的友好关系及合作愿景。

实际执行过程中，发行人和力晶科技对各自的客户进行独立开发，提供的产品和服务存在差异，定价策略也不相同，实施订单互补在实际操作上存在难度。随着发行人产能的逐步释放，发行人业务经营状况良好，具备了自主开展业务经营及开拓客户的能力，公司出于独立经营的考虑亦未要求力晶科技提供业务方面的支持。

2、报告期内未执行订单互补的客观依据

（1）发行人与力晶科技及力积电向客户提供的服务存在差异

报告期内，发行人与力晶科技及力积电向同一客户提供的服务存在差异，不可完全相互替代，客户向发行人下达的订单无法直接转移至力晶科技及力积电进行生产，客户向力晶科技及力积电下达的订单亦无法直接转移至发行人进行生产。双方向同一主要客户提供半导体晶圆代工服务的具体差异情况参见本补充法律意见第 2 题之“（一）向主要客户销售的产品类型与力晶科技向同一客户销售产品类型的异同以及是否具备替代性……”的相关回复。

（2）2018 年至 2019 年半导体行业景气度较差，力晶科技业绩逐步下滑，不具备向发行人转移订单的主观动力

根据力晶科技 2018 年、2019 年年报， 2018 年第三季度后，力晶科技业绩增速放缓，并呈下降趋势。2019 年，力晶科技收入及利润大幅下跌，税后利润为-43.7 亿元新台币，为过去七年来首次亏损。

综上，考虑到力晶科技为中国台湾地区公开发行公司，股东及投资者较为关注其业绩表现，在行业景气度下降和自身业绩下滑的背景下，不具备向发行人转移订单的主观动力。

（3）力晶科技确认报告期内未向发行人转移订单

根据力晶科技出具的确认函：

“晶合集成向主要客户销售的产品类型与本公司及关联企业向同一客户销售产品类型存在差异，不可相互替代，订单互补条款并未实际执行。

晶合集成与本公司及关联企业向奇景光电、奕力科技提供产品或服务存在差异，相关客户与晶合集成独立签署订单，不附属于本公司及关联企业与相关客户所签合同，不存在潜在利益安排。”

（4）主要客户对发行人自身晶圆代工工艺平台均进行独立验证

报告期内，发行人的主要客户对发行人提供的晶圆代工服务从试产、风险量产到大批量生产均进行了有效验证，获得了客户的认可，具备独立向客户提供半导体晶圆代工服务的能力，不存在与力晶科技及力积电订单转移的情形。

（5）主要客户订单和合同均直接向发行人下达，不存在从力晶科技回款情形

报告期内，发行人主要客户销售收入来自客户向发行人下达的订单或签署的合同，不存在通过力晶科技转移订单形成收入的情形，亦不存在从力晶科技回款的情形。

（6）发行人与主要客户均独立开展沟通、谈判、下单、维护，不依赖力晶科技和力积电

报告期内，发行人具备独立面向客户开展业务的能力，报告期内，发行人与发行人客户之间的业务关系均由发行人独立谈判、维护，发行人收到的订单均由发行人客户直接向发行人下达，不存在通过订单互补获得力晶科技及力积电相关订单的情形。奇景光电、奕力科技等主要客户的订单不附属于力晶科技及力积电与相关客户所签合同，不存在潜在利益安排。

（7）发行人与力晶科技晶圆价格存在合理差异，系双方独立与各自客户商业谈判的结果所致。若进行订单移转需要对相关产品和服务的价格重新进行商业谈判，不符合客户对于晶圆代工服务高效率、定制化、稳定性强的客观需求。

综上所述，报告期内双方未实际履行订单互补支持相关条款具有客观依据，且相关依据充分。

三、《问询函》第 3 题：关于人员

根据问询回复：（1）合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务，并收取相应的咨询服务费。（2）发行人与合肥建投、力晶科技签署的《咨询服务合约书》对应的人员委派事项，系依据《合资合同》作出，独立于委托经营管理协议的安排，因此，合肥建投、力晶科技向发行人提供咨询服务的行为及发行人支付咨询服务费的行为并不与委托经营管理协议同步终止。（3）委派人员中包括短期委派人员与长期委派人员。

请发行人说明：合肥建投和力晶科技收取相应咨询服务费的原因及合理性；结合《合资合同》《投资参股协议》《委托经营管理合约》等相关约定及安排，清晰说明各约定间的关系以及委派人员的类型及具体构成情况，相关事项对发行人的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）合肥建投和力晶科技收取相应咨询服务费的原因及合理性

合肥建投、力晶科技根据《投资参股协议》《公司章程》《合资合同》的约定长期向公司委派管理人员，该等管理人员为发行人提供了日常运营方面的管理服务，相关人员的劳动关系均在股东处，薪酬亦由股东发放。因此，发行人根据双方股东委派人员的岗位向股东支付咨询服务费，具备合理性，与《委托经营管理合约》无关。

（二）结合《合资合同》《投资参股协议》《委托经营管理合约》等相关约定及安排，清晰说明各约定间的关系以及委派人员的类型及具体构成情况，相关事项对发行人的影响

1、《合资合同》《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间的关系

协议名称	签署主体	签订时间	主要内容
《投资参股协议》	合肥建投、力晶科技	2015 年 10 月	主要约定双方后续投资金额、持股比例、双方股东董事会席位、委派高级管理人员岗位等公司治理层面的权利义务
《委托经营管理合约》	发行人、力晶科技	2015 年 10 月	约定力晶科技需在经营层面对发行人进行支持，帮助发行人建立独立运营能力
《合资合同》	合肥芯屏、合肥建投、力晶科技	2016 年 1 月	由于合资公司设立需要，根据法律法规规定签订

（1）《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间的关系

2015 年 4 月，合肥市人民政府与力晶科技签署了《合作框架协议》。为落实《合作框架协议》，2015 年 10 月，合肥建投与力晶科技签署了《投资参股协议》、公司与力晶科技签署了《委托经营管理合约》。其中，《投资参股协议》主要约定双方后续投资金额、持股比例、双方董事会席位安排、双方委派管理人员岗位等股权投资常规事项；《委托经营管理合约》主要约定力晶科技需在经营层面对发行人进行支持，帮助发行人建立独立运营能力，同时控制投资风险。由于《投资参股协议》《委托经营管理合约》系同期签署的协议，且双方股东委派管理人员事项，与力晶科技需在经

营层面对发行人进行支持、帮助公司建立营运能力之间存在关联，因此《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间在长期委派管理人员部分存在内容上的重复，并非《委托经营管理合约》项下的特别安排。

（2）《合资合同》与《投资参股协议》《委托经营管理合约》之间的关系

2016 年 1 月，力晶科技拟出资入股发行人，力晶科技出资入股后发行人的企业性质将由内资企业变更为中外合资企业。根据当时有效的《中外合资经营企业法》的规定，“合营各方签订的合营协议、合同、章程，应报国家对外经济贸易主管部门（以下称审查批准机关）审查批准”、“合营企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资....上述各项投资应在合营企业的合同和章程中加以规定”、“合营企业设董事会，其人数组成由合营各方协商，在合同、章程中确定”，公司变更为中外合资经营企业需由各方股东签订合资合同。因此，为配合办理力晶科技出资入股的相关变更手续，合肥建投、合肥芯屏与力晶科技签订了《合资合同》，并延续了《投资参股协议》中对委派人员的约定。《合资合同》系履行《投资参股协议》项下力晶科技出资义务的过程中，按照法律法规的相关要求签订，与《委托经营管理合约》不存在关系。

2、合肥建投、力晶科技委派人员的类型及具体构成情况，相关事项对发行人的影响

（1）基于《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》长期委派人员

合肥建投根据约定向公司委派总会计师等管理人员，主要作用为对公司的财务、采购、销售、行政、内审、敬业监督等方面进行监督与管理；力晶科技根据约定向公司委派审计师等管理人员，主要作用为通过参与公司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。上述岗位由双方股东长期委派人员担任，公司根据委派人员的岗位向股东支付咨询服务费。长期委派人员的具体情况如下：

委派方	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
合肥建投	总会计师	朱才伟（高管）	2016 年 3 月至 2020 年 3 月	负责公司财务、会计政策的制定，管理公司财务、会计各项工作
	财会处处长	王兴亚	2016 年 8 月至	负责公司财务、会计各项工作

委派方	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
			2020 年 3 月	的执行
	采购副总监	赵鑫森（高管）	2016 年 4 月至 2017 年 8 月	协助采购总监管理公司采购各项工作
		周义亮（高管）	2017 年 8 月至 2019 年 5 月	
		王继武（高管）	2019 年 5 月至 2020 年 4 月	
	销售副总监	周义亮（高管）	2016 年 4 月至 2020 年 3 月	负责管理维护客户，制定销售战略；新客户新产品导入，维持现有业务及拓展新业务
	行政副总经理	朱晓娟（高管）	2019 年 10 月至 2020 年 3 月	负责公司整体行政管理和组织人事管理工作
	审计师	朱晓娟（高管）	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	负责公司内部审计工作
		杨幼玲（高管）	2019 年 12 月至 2020 年 4 月	
	敬业促进委员会委员长	朱晓娟（高管）	2017 年 8 月至 2019 年 12 月	规范员工行为、鼓励敬业服务
		杨幼玲（高管）	2019 年 12 月至 2020 年 11 月	
		杨幼玲	2020 年 11 月至 2021 年 3 月	
力晶科技	审计师	陈美华（高管）	2016 年 7 月至 2018 年 5 月	帮助公司完善内部控制，提高公司内部审计工作质量及能力；负责公司内部审计工作
	审计师/处长	潘炯升（高管）	2017 年 12 月至 2018 年 12 月	
	副审计师	林士然	2019 年 1 月至 2020 年 3 月	
	副总会计师	陈央珠（高管）	2016 年 6 月至 2016 年 12 月	参与公司财务事项审批流程，对公司财务情况进行了解
		邱垂源（高管）	2017 年 1 月至 2019 年 3 月	
		李洳谕（高管）	2018 年 12 月至 2020 年 3 月	

上述人员在公司财务、采购、销售、行政、内审、敬业监督等方面提供了支持，部分管理人员后续自愿自股东处离职并加入发行人，成为发行人员工，对发行人建立独立的营运能力起到了积极作用。

（2）基于《委托经营管理合约》短期委派人员

力晶科技入股后，为履行《委托经营管理合约》相关义务，在短期内向公司委派了部分管理人员，帮助公司结合行业特点，落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等。短期委派人员完成任务后即返回力晶科技，后续该岗位由公司员工或合肥建投委派人员任职，发行人未就上述短期委派人员或岗位向力晶科技支付费用。短期委派人员的具体情况如下：

委派方	所在岗位	姓名	委派期间	具体负责工作内容
力晶科技	会计部部经理	张天桂	2016 年 8 月至 2017 年 7 月	依据《委托经营管理合约》，帮助公司结合中国大陆实际情况，落地、改善相关制度的运作
	会计部课长	庄惠雯	2016 年 7 月至 2017 年 10 月	
	财务部部经理	任芬圣	2016 年 7 月至 2017 年 3 月	
	行政副总经理	刘荫（高管）	2017 年 8 月至 2018 年 5 月	

上述人员在帮助发行人落地、改善相关制度的运作，提高公司内部控制和稽核能力，传授财务核算经验等方面提供了帮助。

报告期内，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，发行人具备独立的经营管理层，人员与力晶科技相独立，上述人员委派安排未对公司独立性造成重大不利影响。

四、 《问询函》第 5 题：关于实际控制人认定

根据问询回复：（1）2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意，部分事项需要一致批准。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。回复中称合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位；（2）公司董事长提名人为力晶科技；（3）公司高管成员包括行使敬业监督职能的敬业促进委员会委员长，由合肥建投进行委派；（4）回复中列式了报告期内公司高级管理人员的变化情况，但未说明相关人员的提名情况；（5）公司组

建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，其中合肥建投指派人员的职责主要为监督。

请发行人说明：（1）结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式，董事长的提名人为力晶科技的原因，以及在合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分；（2）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况；（3）报告期内公司高级管理人员的提名情况，是否主要由力晶科技进行提名及主导；（4）结合上述情况，以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况，说明公司是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人最近两年实际控制人是否发生变更，是否通过实际控制人认定进而规避同业竞争。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式，董事长的提名人为力晶科技的原因，以及在合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分

1、结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式

公司股改前，根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》，董事长的职责及具体产生方式如下：

相关协议名称	董事长的职责	具体产生方式
《投资参股协议》（甲方：合肥建投，乙方：力晶科技）	董事长行使下列职权： （1）对外行使晶合集成法定代表人职权； （2）召集、主持董事会会议； （3）检查、督促董事会决议的执行； （4）签署董事会重要文档和其	甲乙双方同意由乙方推举乙方入资之后的首任董事长，并由甲方推举乙方入资之后的首任副董事长。董事长与副董事长人选确定后，按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等中国法律法规，报请商务部核准后经晶合集成董事会选

	他应由晶合集成法定代表人签署的文档； （5）在发生不可抗力的紧急情况下，对晶合集成事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后实时向董事会报告； （6）公司章程、董事会授予的其他职权。	举产生。甲方承诺促请晶合集成董事会，通过选举乙方推举之董事长人选成为乙方入资之后的首任董事长。董事长为晶合集成的法定代表人，如董事长不能行使职权，应由副董事长或董事长指定的其它董事代行职权。
《公司章程》（甲方：合肥芯屏，乙方：力晶科技，丙方：合肥建投）		董事会设一名董事长，甲、乙、丙三方同意由乙方委派乙方入资之后的首任董事长，并由甲方及丙方共同委派乙方入资之后的首任副董事长。董事长与副董事长人选确定后,按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等中国法律法规，报请商务部核准产生。董事长为合资公司的法定代表人，如董事长不能行使职权，应由副董事长或董事长指定的其他董事代行职权。首任董事长任期届满后，由甲、乙、丙三方依投资参股协议的精神协商新任董事长人选。
《合资合同》（甲方：合肥芯屏，乙方：力晶科技，丙方：合肥建投）		叁方同意由乙方委派的一名董事担任乙方入资之后的首任董事长，由甲方及丙方共同委派一名董事担任乙方入资之后的首任副董事长。董事长与副董事长人选确定后，按照合资法等中国法律法规，报请商务部核准产生。乙方入资后的首任合资公司董事长由乙方委派。董事长为合资公司的法定代表人，如董事长不能行使职权，应由副董事长或董事长指定的其他董事代行职权。首任董事长任期届满后，由甲、乙、丙三方依投资参股协议的精神协商新任董事长人选。

公司股改后，根据《公司章程》，董事长由全体董事选举产生，未再约定董事长由力晶科技推荐。

2、董事长的提名人为力晶科技的原因

（1）董事长的提名人为力晶科技的原因

力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，由力晶科技推荐具有相关行业经验的人选担任董事长，对于公司在行业内的形象、知名度以及与产业链上下游合作伙伴沟通方面有一定帮助。因此，发行人股改前，经双方协商，董事长人选由力晶科技推荐，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。发行人股改时，公司董事长未进行更换。

（2）董事长的提名人为力晶科技不会对合肥国资方对发行人的控制力造成重大不利影响

根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》，公司股改前，最高权力机构为董事会，公司董事长的主要职责包括担任公司法定代表人、对外代表公司，以及召集、主持董事会会议等。在董事会会议上，董事长除负责主持董事会会议外，与其他董事拥有的表决权相同，发行人重大事项由董事会集体决策，董事长无法单独决策重大事项。此外，发行人重大事项除由董事会审议外，尚需履行相关国资审批程序。因此，发行人股改前由力晶科技提名董事长不会对合肥国资方对董事会的控制力造成重大不利影响。

2020 年 11 月，公司整体变更为股份有限公司，根据发行人股改后的《公司章程》，董事长由全体董事选举产生，未再约定董事长由力晶科技推荐。发行人现任董事长于 2020 年 4 月由力晶科技推荐并经董事会聘任，发行人在股改时未对主要董事、高级管理人员成员进行重大调整，公司董事长亦未进行更换。股改后，发行人最高权利机构为股东大会，重大事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并履行相关国资审批程序，董事长无法单独决策重大事项。在董事会会议上，董事长除负责主持董事会会议外，与其他董事拥有的表决权相同，亦无法单独决策重大事项。因此，发行人股改后由力晶科技提名的董事担任董事长事宜不会对合肥国资方对发行人的控制力造成重大不利影响。

综上，发行人股改前，董事长的提名人为力晶科技具有合理的原因，发行人股改后，未再约定董事长由力晶科技推荐；由力晶科技提名的董事担任董事长事宜不会对合肥国资方对发行人的控制力造成重大不利影响。

3、合肥建投委派董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导

地位的依据是否充分

（1）董事会席位设置的原因及背景

2015 年 4 月，合肥市人民政府与力晶科技签订《合作框架协议》中即约定，项目设董事 9 席，其中合肥国资方指派 5 席董事，力晶科技指派 4 席董事。该等董事会席位设置的原因主要系在双方合作初期，投资项目的前景不明朗，力晶科技出于降低其在中国大陆投资风险及增强在合资企业重大决策等方面的参与度等考虑，合肥市人民政府出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，经双方友好协商确定，并在《合作框架协议》中对于合资公司的董事会席位进行了明确约定。

（2）首任董事长系双方协商确定，且非力晶科技员工

2016 年 3 月，发行人首届董事会成立，并推选陆祎担任董事长，任期四年。2019 年 12 月前，发行人董事长一直由陆祎担任。陆祎系美籍华人，毕业于中国科学技术大学，后前往美国华盛顿大学、伊利诺伊大学香槟分校、佛罗里达大学深造并取得博士学位，曾在美国 Intel 公司、Anax 半导体公司工作，具备集成电路行业经验。陆祎主要系因其与合肥国资方、力晶科技均具有良好的关系，有利于合资初期股东双方之间的沟通及关系维护；陆祎从未在力晶科技担任任何职务，身份相对独立，更加能够从合资公司利益的角度在董事会中发挥作用。因此，经双方协商，由力晶科技推荐陆祎为公司首任董事长人选，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。

（3）董事会未发生力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形

公司召开董事会会议前，相关议案需提交合肥建投先行内部审议，合肥建投审议通过后再由其委派的董事在董事会会议上进行表决。合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位，报告期内公司历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票。仅在董事会审议合肥建投向发行人提供委托贷款及担保等相关事项时，出现过 1 次合肥国资方全体委派董事投同意票，力晶科技 2 名委派董事弃权、2 名委派董事同意，但仍获得董事会通过的情况。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。

（4）合肥市人民政府出具的确认函

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：“晶合集成自成立以来，均系在合肥国资方的主导下建设、发展，并未将经营管理权交予力晶科技，合肥市国资委一直系晶合集成的实际控制人，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

综上，2019 年 12 月前，合肥建投委派董事虽未达 2/3，但董事会席位设置具备合理的背景，首任董事长虽由力晶科技推荐，但其身份相对独立，董事会执行层面亦未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形，公司董事会实际运营层面由合肥国资方委派董事占实质主导地位依据充分。

（二）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况

1、行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况

（1）敬业促进委员会的成立目的及主要职能

根据发行人《敬业促进委员会组织章程》《敬业规范》，发行人成立敬业促进委员会的主要目的系树立企业风气、规范员工行为、鼓励敬业服务、查处敬业案件等，维护企业良性运行。发行人倡导敬业为荣的观念，要求全体员工诚信从事所涉业务活动，在与业务之上下游利害关系人互动时，恪守敬业规范与诚信原则，不允许任何员工因贪污舞弊、索贿受贿等行为获取不正当利益。

发行人的员工在日常工作中，遇到涉及请托关说、赠受财物、交际应酬及其他涉及个人利益与公司利益冲突的事宜，可通过发行人网站中的“敬业举报系统”进行敬业申报。敬业促进委员会每月会对“敬业举报系统”中的申报案件进行汇总，于每年度末对敬业申报内容进行统计核查。

发行人敬业促进委员会会议由委员长视需要不定期召开，负责处理公司员工申报的敬业案件，并向董事会报告处理结果。

（2）敬业促进委员会委员长的具体职能

根据发行人《敬业促进委员会组织章程》，公司敬业促进委员会委员长的具体职能为：

①敬业促进委员会委员长负责会议的主持与召集；

②敬业促进委员会会议由委员长视需要不定期召开委员会议；

③敬业促进委员会可视审核案件的性质，由敬业促进委员会委员长决定审议的形式为书面或现场召开；

④敬业促进委员会审议结果由敬业促进委员会委员长核准后方得执行，敬业公告提交总经理签发。

（3）敬业促进委员会人员构成

自 2017 年 9 月敬业促进委员会成立至报告期末，公司敬业促进委员会的人员构成及变化情况具体如下：

日期	委员长	委员			
2017.9 至 2018.5	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	陈美华（审计师）	-
2018.5 至 2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	潘炯升（审计师）	-
2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	-
2019.1 至 2019.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2019.12 至 2020.4	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.4 至 2020.8	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.8 至 2020.12	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）

（4）该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置

发行人敬业促进委员会系为规范员工行为、树立企业风气而设立，敬业促进委员会委员长主要职责系主持公司敬业监督工作，并非针对与力晶科技合作进行设置。

（5）报告期内的实际执行情况

报告期内，敬业促进委员会共计召开 11 次会议，均由敬业委员会委员长主持，相关会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
1	2018.6.28	审议一起员工违反公司出勤规定事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予大过 1 次，并追回虚报加班费用及公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
2	2018.7.11	审议一起员工工作能力不足检举事件。各委员依调查结果讨论后，要求该员工所属部门畅通内部沟通管道，以化解工作中存在的问题	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
3	2019.1.10	审议一起员工工作能力不足、二起员工违反公司出勤规定及一起员工违反公司住宿规定检举事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予申诫 1 次、并追回虚报加班费用；违反住宿规定属实者，取消入住公司宿舍权利。以上四起案件公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十一次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
4	2019.4.11	审议一起员工作业疏失及一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者给予申诫 1 次，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十二次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
5	2019.6.19	审议二起员工违反工作纪律及一起员工在外行为影响其他同事。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予扣二个月绩效，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
6	2019.9.5	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
7	2019.10.24	审议一起拖欠供应商货款。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公	处理结果在晶合有限第一届第二十四次董事会

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		告厂内周知	会议中作为报告事项向董事会汇报
8	2019.12.17	审议一起员工违反工作纪律。各委员依调查结果讨论后，未有违反工作纪律之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
9	2020.1.15	审议一起采购品项不符合招标需求。各委员依调查结果讨论后，检举不属实	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
10	2020.8.27	审议一起采购品项指定单一品牌及一起员工泄露供应商报价。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第二届第四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
11	2020.11.5	审议一起员工违反公司住宿补贴规定。各委员依调查结果讨论后，违反住宿补贴规定属实者给予记过 1 次，并追回虚报住宿补贴及取消领取补贴资格，同时公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报

（三）报告期内公司高级管理人员的提名情况，是否主要由力晶科技进行提名及主导

报告期内公司高级管理人员中，除根据《公司章程》由股东双方委派的岗位外，其余高级管理人员的聘任由总经理根据公司发展的需求及行业经验物色公司所需的相关人才并推荐给董事会，由董事会决定是否聘任。

报告期初，发行人的高级管理人员及提名情况如下：

序号	任职起始时间	姓名	职务	提名情况
1	2016.3	黎湘鄂	总经理	经力晶科技推荐、合肥建投审核，董事会同意由初期加入公司的员工中资历、晶圆代工厂营运经验最丰富的员工担任总经理

2	2016.3	蔡辉嘉	副总经理	根据公司经营需要，由总经理推荐，董事会聘任
3	2017.10	盛惟健	采购总监	
4	2017.12	陈耿川	研发副总经理	
5	2016.3	朱才伟	总会计师	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由合肥建投委派，董事会聘任
6	2016.3	周义亮	销售副总监兼采购副总监	
7	2017.1	邱垂源	副总会计师	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由力晶科技委派，董事会聘任
8	2016.7	陈美华	审计师	
9	2017.8	刘荫	行政副总经理	根据《委托经营管理合约》的约定，由力晶科技委派，董事会聘任

报告期内，发行人新增高级管理人员的提名情况如下：

序号	任职起始时间	姓名	职务	提名情况
1	2019.3	詹奕鹏	研发协理	根据公司经营需要，由总经理推荐，董事会聘任
2	2019.10	孙志明	业务协理	
3	2019.12	蔡嘉辉	执行副总经理	
4	2019.12	邱显寰	营运协理	
5	2020.4	朱才伟	董事会秘书	
6	2020.4	邱显寰	营运副总经理	
7	2020.4	孙志明	业务副总经理	
8	2020.4	詹奕鹏	研发副总经理	
9	2020.11	简瑞荣	采购协理	
10	2020.12	李庆民	营运副总经理室公司协理	
11	2020.3	蔡嘉辉	总经理	经股东双方协商、合肥建投审核，董事会聘任
12	2018.1	朱晓娟	审计师、敬业委员会委员长	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由合肥建投委派，董事会聘任
13	2019.5	王继武	采购副总监	

序号	任职起始时间	姓名	职务	提名情况
14	2019.10	朱晓娟	行政副总	
15	2019.12	杨幼玲	审计师、敬业委员会委员长	
16	2018.5	潘炯升	审计师	根据《投资参股协议》《合资合同》《公司章程》的约定，由力晶科技委派，董事会聘任
17	2019.3	李洳谕	副总会计师	

综上，报告期内，发行人新增的高级管理人员中，除 2020 年 3 月前审计师、副总会计师由力晶科技委派外，其他高级管理人员均非力晶科技提名，不存在主要由力晶科技进行提名及主导的情形。

（四）结合上述情况，以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况，说明公司是否实质为力晶科技控制或 合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人最近两年实际控制人是否发生变更，是否通过实际控制人认定进而规避同业竞争

1、前述情况以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况对于发行人实际控制人认定的影响

（1）发行人董事会席位设置及首任董事长由力晶科技推荐

①公司成立初期，为控制公司经营决策风险，重大事项由绝对多数董事通过有利于公司稳健运营，因此当时有效的《公司章程》约定，公司部分重大事项需全体董事或 2/3 以上董事投赞成票方能通过。发行人 2019 年 12 月前的董事会席位设置，系力晶科技出于降低其在中国大陆投资风险及增强在合资企业重大决策等方面的参与度等考虑，合肥国资方出于招商引资需要及保护小股东利益考虑，经双方友好协商确定，具有合理的背景。

②公司董事长的主要职责包括担任公司法定代表人、对外代表公司，以及召集、主持董事会会议等，力晶科技系国际知名的晶圆制造企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，由力晶科技推荐具有相关行业经验的人选担任董事长，对于公司在行业内的形象、知名度以及与产业链上下游合作伙伴沟通方面有一定帮助，因此，经双方

协商，由力晶科技推荐公司董事长人选，并在合肥国资方对其背景审核后，提交董事会审议通过。

③发行人首任董事长系由双方协商确定且非力晶科技员工，身份相对独立；报告期内公司历次董事会会议上均未发生因力晶科技委派董事单方面反对或弃权而无法形成决策的情形。

综上，基于上述情况，发行人 2019 年 12 月前董事会席位设置及首任董事长由力晶科技推荐的情形未对合肥市国资委的实际控制人的地位造成重大不利影响。

（2）曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、发行人曾设置经营管理委员会

①发行人虽曾与力晶科技签署《委托经营管理合约》，在实际履行过程中，双方仅履行了《委托经营管理合约》中的部分条款，公司未将经营管理权委托予力晶科技。

②发行人的晶圆代工业务和技术在制程节点、代工晶圆尺寸、金属制程、技术路线、产品特性等方面与力晶科技和力积电存在一定差异，发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠具备合理性，不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争和利益输送，亦不存在对发行人利益造成重大损害的情形及风险。

③经营管理委员会存续期间，发行人最高权力机构为董事会，经营管理委员会为董事会提供经营相关建议，经营管理委员会不属于公司运营管理机构，不具有对公司经营管理事项进行决策的职权。

综上，基于上述情况，发行人曾与力晶科技签署《委托经营管理合约》、第二大股东从事同类型业务、发行人曾设置经营管理委员会的情形对合肥市国资委的实际控制人地位无实质影响。

2、不存在力晶科技单方控制发行人的情形

（1）力晶科技在公司最高权力机构中未占主导地位

公司股改前，最高权力机构为董事会，力晶科技持有公司的股权比例均在 50%以下，委派的董事人数未达半数。自 2016 年 3 月公司设立董事会至股改前，公司共计召

开 33 次董事会，历次董事会会议上力晶科技委派董事均未对相关审议事项投反对票。仅在董事会审议合肥建投向发行人提供委托贷款及担保等相关事项时，出现过 1 次合肥国资方全体委派董事投同意票，力晶科技 2 名委派董事弃权、2 名委派董事同意，但仍获得董事会通过的情况。未发生因力晶科技委派董事单方面反对而无法形成决策的情形。

公司股改后，最高权力机构为股东大会，力晶科技持有公司的股份比例为 27.44%，提名的董事人数未达半数。

（2）力晶科技委派高级管理人员数量较少且主要起监督作用

自 2016 年 3 月至 2020 年期间，力晶科技向发行人委派高级管理人员包括行政副总经理、审计师、财务副总经理，其中，行政副总经理仅在公司短期任职，在帮助公司结合行业特点，落地、改善相关制度的运作后即返回；审计师、财务副总经理为力晶科技长期委派岗位，主要作用为通过参与公司财务事项审批及内部审计流程，对公司财务状况实施监督，防止控股股东滥用控股地位。

综上所述，力晶科技在公司最高权力机构中未占主导地位，力晶科技委派高级管理人员数量较少且主要起监督作用，不存在力晶科技单方控制发行人的情形。

3、不存在合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形

根据合肥建投、力晶科技出具的确认函，力晶科技与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥国资方之间从未签订一致行动协议，亦不存在与发行人控制权相关的约定或类似安排，不存在合肥市国资委与力晶科技共同控制发行人的情形。

4、各方对于公司控制权的确认

（1）合肥市人民政府关于公司控制权的确认

2021 年 8 月，合肥市人民政府出具确认函：

“一、为落实国家关于集成电路产业发展的规划，我市于 2015 年引进力晶科技股份有限公司（以下简称力晶科技）合作建设合肥晶合 12 英寸晶圆制造基地项目，着力提升自主可控的芯片制造能力。

二、2015 年 4 月，我市与力晶科技签署《12 吋晶圆制造基地项目合作框架协议书》（以下简称《合作框架协议》），后晶合集成按照协议约定与力晶科技签订《委托经营管理合约》。主要目的系促进双方合作关系，配合晶合集成建厂以及初期技术导入，如晶合集成出现经营、发展状况不及预期时，也能够约束力晶科技向晶合集成投入更多精力与支持，降低投资风险，并非将晶合集成经营管理权交予力晶科技。

三、除《合作框架协议》外，我市与力晶科技之间未签署其他与晶合集成相关的协议，不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排。

四、晶合集成自成立以来，均系在合肥国资方的主导下建设、发展，并未将经营管理权交予力晶科技，合肥市国资委一直系晶合集成的实际控制人，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

（2）合肥建投关于公司控制权的确认

2021 年 3 月及 8 月，合肥建投出具确认函：

“自晶合集成成立以来，本公司一直系晶合集成的直接或间接控股股东，且不存在与力晶科技股份有限公司共同控制晶合集成的情形。”

“本公司及下属合肥芯屏从未与力晶科技签订一致行动协议，本企业与力晶科技之间不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排，不存在晶合集成实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制的情形。”

（3）力晶科技关于公司控制权的确认

2021 年 3 月及 8 月，力晶科技出具确认函：

“自入股晶合集成以来，本企业充分认可合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）方的控股股东地位，对晶合集成重大决策战略方针、企业发展方向、经营决策、重大投资等具有决定性影响力，认可并尊重合肥市国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）作为晶合集成实际控制人的地位，本企业自入股以来未以任何形式谋求对晶合集成的控制权，亦不存在与合肥市国资委共同控制晶合集成的情形。

2019 年 12 月前，根据晶合集成的公司章程及合资合同，晶合集成的董事会由 9 名董事组成，其中本企业有权委派 4 名董事，且晶合集成的重大事项需经 2/3 以上出席会议董事投赞成票方可通过。该等董事会席位设置系出于保护本企业在中国大陆投资安全性考虑而与合肥国资委、合肥建投方协商确定，自本企业入股晶合集成以来，不存在通过委派的董事阻碍或影响合肥建投方、合肥市国资委对于晶合集成的控制权的情形。”

“本企业认可并尊重合肥市国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）作为晶合集成实际控制人的地位，且从未与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥建投或合肥芯屏中的一方或多方签订一致行动协议，本企业与合肥市人民政府、合肥市国资委、合肥建投或合肥芯屏之间不存在关于晶合集成控制权的任何协议或安排，不存在晶合集成实质为本企业控制或合肥市国资委与本企业共同控制的情形。”

5、结论意见

综上，发行人自设立以来一直由合肥市国资委实际控制，不存在力晶科技实质控制发行人或合肥市国资委与力晶科技共同控制发行人的情形，发行人最近两年实际控制人未发生变更，不存在通过实际控制人认定进而规避同业竞争的情形。

五、 《问询函》第 6 题：关于力晶科技从事同类业务

根据申报材料：力晶科技及其关联企业力积电从事晶圆代工业务，与发行人主营业务属于同一类型业务。

请发行人披露力晶科技与公司从事同类型业务的情况以及对发行人的影响，并就发行人与第二大股东力晶科技间存在同类业务的情况作重大事项提示和风险提示。

请发行人说明：（1）结合对与力晶科技之间重叠客户、供应商的销售与采购金额占比较高的情况，充分分析是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、是否会导致利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险；（2）公司与力晶科技从事同类型业务的情况下是否对发行人相关

产品及业务拓展造成不利影响，双方未来的发展规划。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）结合对与力晶科技之间重叠客户、供应商的销售与采购金额占比较高的情况，充分分析是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、是否会导致利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

1、发行人具备独立、完善的公司治理结构

力晶科技与发行人独立开展经营，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事影响导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。

为防范非公平竞争、利益输送或相互或者单方让渡商业机会，发行人制定了《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等，在《公司章程（上市后适用）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度中对公司重大投资、交易、资金往来的审议和决策程序等进行了规定，并制定了研发、采购、生产、销售、人力资源管理、财务管理等业务及财务相关的管理制度，对公司各类业务审批、执行、管理等事项进行了规定，从而避免利益输送及利益冲突，保持公司独立性，保障公司及股东的利益。

2、发行人与力晶科技及力积电的服务存在差异

发行人与力晶科技在技术方面存在差异，双方提供的晶圆代工服务存在差异，不具备完全的互相替代性。

3、全球晶圆代工市场规模巨大，客户、供应商重叠具备合理性

全球晶圆代工市场规模巨大，发行人与力晶科技及力积电均具有较大发展空间，同一客户在多个晶圆代工厂同时下单、同一供应商同时向多个晶圆代工企业供货等情形具备合理性，发行人与力晶科技及力积电供应商重叠具备合理性。

4、发行人前五大客户及前五大供应商与发行人不存在关联关系

发行人前五大客户中，集创北方为发行人股东，持有发行人 8,801,412 股，持股比例 0.58%。发行人的前五大客户和供应商均为行业知名企业，与发行人、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在配合发行人进行利益输送的情形。

5、发行人独立向客户提供服务，没有力晶科技及力积电参与

根据对发行人主要客户的访谈，发行人主要客户向发行人、力晶科技及力积电的采购决策均由客户独立作出，向发行人采购和向力晶科技及力积电采购互不影响。发行人和发行人客户之间的晶圆投产、价格确定均由发行人客户与发行人独立进行，并由客户对发行人的工艺平台进行验证。客户向发行人采购的过程中没有力晶科技及力积电的参与，发行人与力晶科技及力积电之间不存在非公平竞争，不存在通过发行人客户进行利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形。

6、发行人独立向供应商采购，没有力晶科技及力积电参与

报告期内，发行人的供应商均由发行人独立开发、谈判、维护。发行人的主要原材料和设备采购均由发行人独立决策、独立执行。力晶科技及力积电不参与发行人采购的任何环节，发行人与力晶科技及力积电之间不存在非公平竞争，不存在通过发行人供应商进行利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形。

7、力晶科技已签署相关承诺函

力晶科技已于 2021 年 3 月签署关于独立性与同业竞争的《承诺函》，并承诺：

“2018 年 1 月至今，本公司及本公司下属企业与晶合集成存在部分客户、供应商重叠，该等重叠的客户、供应商均系双方独立开发、谈判、维护，不存在非公平竞争、通过重叠客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。”

力晶科技已于 2021 年 8 月签署《确认函》，并承诺：

“晶合集成与本公司及力积电等本公司关联企业之间存在部分客户重叠的情形，但双方之间对于销售均独立作出决策，本公司及力积电等本公司关联企业从未干预或

影响晶合集成的销售决策过程，从未干预或影响晶合集成的客户向晶合集成采购的决策过程，亦不存在晶合集成通过本公司及力积电等本公司关联企业进行销售的情形。”

“晶合集成与本公司及力积电等本公司关联企业之间存在部分供应商重叠的情形，但双方之间对于采购均独立作出决策，本公司从未干预或影响晶合集成的采购决策过程，亦不存在晶合集成通过本公司进行采购的情形。”

“晶合集成与本公司及力积电等本公司关联企业间不存在非公平竞争、不存在利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，本公司不存在损害晶合集成利益的情形。”

综上所述，发行人与力晶科技及力积电之间的客户重叠、供应商重叠具备合理性，不会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、不会导致利益输送、相互或者单方让渡商业机会情形，不存在损害发行人利益的情形及风险。

（二）公司与力晶科技从事同类型业务的情况下是否对发行人相关产品及业务拓展造成不利影响，双方未来的发展规划

芯片设计企业通过向多个晶圆代工厂下单，分散供应商，降低供货风险，保证产品的多样性，任一晶圆代工企业（包括力晶科技及力积电）无法通过其在客户中的供货地位，来影响客户的采购决策，发行人与力晶科技从事同类型业务不会影响发行人客户和业务拓展。

在未来发展规划方面，发行人与力晶科技及力积电存在一定差异，具体情况如下：

主体	未来发展规划
发行人	目前正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的研发，并已投入大量资源，积极从事 MCU、CIS、PMIC、Mini LED 等晶圆代工工艺平台的研发工作。同时，拟将募集资金运用于后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目、微控制器芯片工艺平台研发项目、40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目、28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目。
力晶科技及力积电	1、逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台： BSI CMOS 影像感测平台、25nm 逻辑平台、40nm 内存整合芯片平台、3D 整合芯片技术平台、第三代半导体功率组件平台等晶圆代工平台等； 2、内存产品晶圆代工平台：提供 30/25nm 及其以下制程的 DRAM 代工平台及 28nm NAND Flash 代工产品，并开发 48nm NOR Flash 代工产品等。

发行人正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的研发，拟将募集资金运用于后照式 CMOS 图像传感器、微控制器等特色工艺平台的研发，及 40nm 以下制程的研发。力积电未来计划开发的下一代新产品及服务主要涉及逻辑及特殊应用产品晶圆代工平台和内存产品晶圆代工平台，与发行人在工艺平台、制程节点上存在较大差异。

综上所述，发行人与力晶科技及力积电从事同类型业务的情况下不会对发行人相关产品及业务拓展造成不利影响。发行人与力晶科技及力积电的未来发展方向在工艺平台、制程节点方面存在差异。

六、 《问询函》第 7 题：关于无形资产和技术

根据问询回复：（1）2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年，截至问询函回复出具之日，上述发明专利权中 14 项已到期，但 2018 年和 2019 年末，发行人对无形资产进行了减值测试未发现减值迹象；（2）2018 年导入 90nmM+技术平台；（3）报告期内，发行人向智成电子采购 IP 授权交易分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元，智成电子系力晶科技控制公司。未来发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

请发行人说明：（1）结合力晶科技转让技术的相关情况，说明相关技术文件及力晶科技相关技术经验等内容转移至发行人的具体实施过程，相关技术转让后短期内独立获取客户的原因；（2）专利到期对于专利作价、专利技术保护和相关技术使用的影响，2018 年和 2019 年专利到期事项未对 2018 年和 2019 年末无形资产减值产生影响的合理性；（3）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）结合力晶科技转让技术的相关情况，说明相关技术文件及力晶科技相关技术经验等内容转移至发行人的具体实施过程，相关技术转让后短期内独立获取客户的原因

1、相关技术文件及力晶科技相关技术经验等内容转移至发行人的具体实施过程

2015 年 10 月，晶合集成与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技将 150nm、110nm、90nm 驱动 IC 技术移转予发行人，其中包括工艺平台数据、技术文件、相关专利文件等材料。相关技术文件及相关技术经验由力晶科技转移至发行人的具体实施过程如下：

（1）技术整备、导入及验证

力晶科技于发行人建厂期间对涉及移转的技术进行整备，确保技术文件完整，以便向发行人移转。在发行人建厂完成后，力晶科技将整理好的移转技术数据全部交由发行人，其中包括工艺平台参数、制程技术流程、配套 IP 技术数据等。针对移转的 150nm、110nm、90nm 的三项制程技术，发行人自身内部开展验证，以确保技术移转的工艺平台可以向客户提供服务。2017 年 6 月 5 日，公司与力晶科技签订《技术移转协议确认函》，确认发行人已完成对三项制程技术的验证。

（2）技术转移团队建置及人才培育

力晶科技组建一支技术移转团队，负责进行技术移转与发行人员工培训事宜，确保相关技术的顺利实施。该团队中包括黄光工程部、蚀刻工程部、薄膜工程部、扩散工程部、制造部、自动化工程部、厂务部、分析技术部等专业技术人员，协助发行人进行技术移转工作。

发行人亦将部分员工委派至力晶科技进行培训，使发行人能更好的进行技术承接，培训结束后受训人员返回发行人处进行工作。

（3）技术移转完成

在承接以上技术、专利文件且各项技术指标达成产品验证及其他技术移转条件后，力晶科技技术移转完成。根据发行人与力晶科技的《技术移转完成证明书》，力晶科技于 2018 年 3 月 31 日已完成技转。

2、相关技术移转后短期内独立获取客户的原因

在技术移转的过程中，为协助发行人完成初期产品和工艺平台的技术移转验证工作，力晶科技负责将与奇景光电和奕力科技涉及技术移转的相关 PDK（制造工艺设计包）、制程资料等技术文件和数据资料移转至发行人。相关技术移转完成后，发行人与奇景光电、奕力科技独立沟通、谈判签署相关合同订单，随后完成试产、风险量产、量产等工作，并与奇景光电和奕力科技建立了稳定的合作关系，具备合理性。

除上述情况外，发行人其余主要客户均为发行人自主联系、独立开发，双方通过邮件、电话等沟通确认需求，正式订单主要通过邮件等方式进行下达。发行人销售团队于 2016 年 12 月开始接触联咏科技，至 2017 年 8 月签订正式订单；于 2017 年 4 月开始接触集创北方，至 2017 年 12 月签订正式订单；于 2017 年 6 月开始接触合肥捷达微电子有限公司、天钰科技股份有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司，至 2018 年 6 月签订正式订单。发行人获取该等客户均经历了完整的前期接洽、沟通讨论、工程开发、产品验证、订单签署过程，具备合理性。

综上，在技术移转完成后，发行人获取主要客户均经历了完整的前期接洽、沟通讨论、工程开发、产品验证、订单签署等过程，具备合理性。

（二）专利到期对于专利作价、专利技术保护和相关技术使用的影响，2018 年和 2019 年专利到期事项未对 2018 年和 2019 年末无形资产减值产生影响的合理性

1、专利到期对于专利作价、专利技术保护和相关技术使用的影响

发行人 2015 年 10 月与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年。2015 年《技术移转协议》签署时，相关标的专利尚未到期，但作价时已考虑部分专利即将到期的影响。虽然部分标的专利即将到期，但其仍具有相当的使用价值，专利到期并不影响发行人对相关专利技术的使用。

此外，发行人高度重视产品研发与技术创新，报告期内研发费用呈持续上升趋势，并在新技术、新产品研发的过程中持续申请新的专利以加强技术保护，部分专利到期对发行人专利保护影响相对有限。前述专利到期不会对标的公司生产经营产生重大不利影响。

2、2018 年和 2019 年专利到期事项对 2018 年和 2019 年末无形资产减值的影响

发行人报告期内发生减值的无形资产系发行人无形资产中核算的专利权及非专利技术，包括发行人自力晶科技移转并计入无形资产的 58 项专利权和 1 项非专利技术（90nm M+驱动 IC 制程），广泛应用于公司生产制造过程的各个环节及工艺流程，共同对产品发挥作用。

由于难以对单项专利的可收回金额进行估计，因此发行人以资产组为基础确定可收回金额。公司以 2018 年末及 2019 年末为基准日对上述专利权及非专利技术构成的资产组采用收益法进行减值测试过程中，已考虑专利到期因素的影响。经测算前述基准日资产组的可收回金额高于账面价值，因此未计提减值准备。

为确保减值测试准确性，发行人委托安徽安建资产评估有限责任公司及同致信德（北京）资产评估有限公司分别对 2018 年及 2019 年减值测试进行了评估，同时同致信德（北京）资产评估有限公司对安徽安建资产评估有限责任公司出具的 2018 年减值测试评估报告进行了复核，相关评估结果显示评估基准日无需计提减值准备。

（三）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

1、发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用

根据智成电子公开资料，智成电子成立于 2001 年，为客户提供 IP、IC、Module 等产品设计服务方案，是一家拥有专业晶片研发技术的公司。

发行人向智成电子采购 IP 授权的内容为 110nm 标准单元库。标准单元库是集成电路芯片后端设计过程中的基础部分，运用智成电子预先设计好的优化的单元库进行自动逻辑综合和版图布局布线，以提升被授权人的客户引入效率。采用标准单元库 IP 授权系晶圆代工行业特征，具有行业普遍性，IP 授权商在晶圆代工企业对通用的逻辑单元库和布局布线进行事先设计及验证，并以标准单元库的形式向晶圆代工企业授权并提供客户直接在设计时使用，以减少晶圆代工企业客户重复工作，缩短客户引入的时间。如不进行标准单元库 IP 采购，将降低客户引入的效率，但不会对晶圆代工企业的生产工艺造成实质影响。

除了向智成电子采购标准单元库 IP 授权以外，发行人亦向寅通科技股份有限公司 、

円星科技股份有限公司采购标准单元库 IP 授权服务。随着发行人工艺平台种类进一步增加，制程水平不断提高，未来将与更多 IP 授权商进行合作，以避免单个授权商因不可抗力等原因无法继续提供 IP 授权时可能对发行人带来的不利影响。前述 3 家 IP 授权商提供的标准单元库在进行部分调整后即可实现相互替代，发行人对智成电子提供的 110nm 标准单元库 IP 授权不存在依赖。

2、发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

发行人对于 IP 供应商的选择，需要综合考虑供应商的资质、品牌、IP 在业界被采用的量产记录、客户口碑和 IP 质量，以及性价比等多个维度。发行人向智成电子采购 IP 服务具有商业合理性，系根据自身业务需要独立完成相关 IP 授权采购。上述采购流程系发行人综合判断 IP 供应商服务能力、品牌质量、性价比等因素后独立作出，符合发行人内部采购制度，与力晶科技的研发和技术体系无关。

报告期内，发行人对技术进行持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，并形成了稳定的研发人员团队，团队成员均与发行人直接签署劳动合同。同时，发行人不断将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 71 件，不依赖于力晶科技的研发团队、科研成果及专利和非专利技术，具有独立研发能力。

综上，智成电子提供的 110nm 标准单元库 IP 授权主要用于提升发行人客户引入效率，但不会对晶圆代工企业的生产工艺造成实质影响。发行人对智成电子提供的 110nm 标准单元库 IP 授权不存在依赖。发行人在研发机制、研发团队、专利申请各方面均具备独立性，不依赖于力晶科技的研发和技术体系。

七、 《问询函》第 9.2 题

报告期内，报告期内除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

请结合相关法律法规规定说明上述代缴社保相关情形是否符合相关法律法规规定以及对公司的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）发行人通过第三方劳务公司为台籍员工在中国台湾地区缴纳劳健保的原因

发行人的主营业务为 12 英寸半导体晶圆代工服务，中国台湾地区在晶圆代工行业较为领先，相关人才较为充裕，公司作为快速发展阶段的晶圆代工厂，存在招聘中国台湾地区具有晶圆代工行业工作经验人才的需求。考虑到中国台湾籍员工有在中国台湾地区缴纳劳健保的需求，且其在中国大陆地区缴纳社会保险的意愿不强，因此，发行人通过第三方劳务公司为中国台湾籍员工在中国台湾地区缴纳劳健保，同时，中国台湾籍员工在与公司签订的相关劳动合同中承诺放弃在中国大陆缴纳社会保险。此外，公司还为中国台湾籍员工在购买了商业保险作为补充。

（二）中国大陆对于社会保险相关法律、法规规定

根据《中华人民共和国社会保险法》第四条规定：“中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费”，第五十八条规定：“用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记”，第八十四条规定：“用人单位不办理社会保险登记的，由社会保险行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。”

根据《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法》第二条规定：“在内地（大陆）依法注册或者登记的企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体经济组织等用人单位（以下统称用人单位）依法聘用、招用的港澳台居民，应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，由用人单位和本人按照规定缴纳社会保险费。”

（三）中国台湾地区对于缴纳劳健保的相关法规规定

1、劳工保险

根据台湾律师出具的法律意见，中国台湾地区《劳工保险条例》规定，被保险人受派遣出国考察、研习或提供服务者，可以继续参加劳工保险（以下简称“劳保”）；被

保险人受派遣出国考察、研习或提供服务的情形下，是否可以继续参加劳保，应依个案事实认定雇佣关系判断。如投保单位故意为不合《劳工保险条例》之人员办理参加保险手续，台湾行政院劳动部劳工保险局可以取消被保险人之加保资格，违法加保期间之年资无法并计，已缴之劳保保险费亦不退还，且得依法追还已领取之保险给付。

第三方劳务公司怡东人事与发行人中国台湾籍员工之间并不存在实质雇佣关系，不符合《劳工保险条例》，台湾行政院劳动部劳工保险局可以取消台籍员工加入劳保的资格，违法参加劳保期间之年资无法并计，已缴之劳保保险费亦不退还，且劳保局可以依法追还台籍员工已领取之保险给付。

2、全民健康保险

根据台湾律师出具的法律意见，中国台湾地区《全民健康保险法》规定，具有中国台湾籍、符合最近 2 年内曾有参加台湾全民健康保险（以下简称“健保”）纪录且在中国台湾地区设有户籍，或参加健保前 6 个月继续在中国台湾地区设有户籍，或参加健保时已在台湾地区设有户籍之公职或受雇者，应参加健保。发行人中国台湾籍员工符合前述要件者，不论是否具有与第三方劳务公司的雇佣关系，均可以参加健保；于受雇时，以健保法第一类被保险人下受雇者身分加保，于无职业时，以眷属身分或第六类被保险人下无职业一般家户户长或家户代表加保健保。

第三方劳务公司怡东人事为台籍员工以健保法第一类被保险人下受雇者身分加保，但因怡东人事与台籍员工并非实质雇佣关系，台籍员工属于无职业的类别，应以第六类被保险人下无职业一般家户户长或家户代表加保健保。怡东人事为台籍员工参加健保的方式不符合健保法的规定，但健保法并未就前述不合法加保订有相关处罚。

综上，公司作为实际用人单位通过第三方劳务公司怡东人事为台籍员工缴纳劳保、健保的行为不完全符合中国台湾地区《劳工保险条例》和《全民健康保险法》的相关规定，但是上述法规并未对实际用人单位需要承担的相应法律责任和处罚进行规定。

（四）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜对于发行人经营成果的影响

根据发行人测算，报告期内，发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保、未在中国大陆缴纳社会保险对发行人经营成果的影响如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保的金额（a）	468.88	555.63	560.10
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额（b）	1,460.51	1,423.38	413.61
差额（b-a）	991.63	867.75	-146.49
营业总成本（c）	123,918.17	169,998.65	255,660.04
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额占营业总成本的比例（b/c）	**1.18%**	**0.84%**	**0.16%**
差额占营业总成本的比例 [(b-a)/c]	**0.80%**	**0.51%**	**-0.06%**

注：2020 年度，国家在疫情期间推出了社保减免政策，因此，发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额大幅降低。

发行人报告期内应当为中国台湾籍员工在中国大陆缴纳社会保险的金额与发行人为中国台湾籍员工缴纳劳健保的金额的差额占发行人营业总成本的比例分别为 0.80%、0.51%、-0.06%，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

（五）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜未曾受到行政处罚

发行人通过第三方劳务公司为中国台湾籍员工代缴劳健保的行为未完全符合《中华人民共和国社会保险法》《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法》中“为其员工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记”的相关规定，但发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保的方式，已实质履行为中国台湾籍员工实际缴纳社会保险费的义务。

根据本所律师对合肥市新站区劳动局仲裁监察处的访谈，发行人目前社保的缴纳方式符合要求，2018 年 1 月 1 日至今无举报、投诉的情形。

根据合肥市人力资源和社会保障局出具的证明：未发现发行人劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门行政处罚的不良记录。

（六）不会对本次发行上市造成重大不利影响

发行人委托第三方劳务公司代缴台籍员工劳健保的行为是基于自身业务经营及台

籍员工意愿产生，虽未完全符合《中华人民共和国社会保险法》及相关规定，但已实际履行了为其台籍员工缴纳社会保险的义务，保障了台籍员工享有的社会保险权利，具有合理性。发行人作为实际用人单位通过第三方劳务公司怡东人事为台籍员工缴纳劳保、健保的行为不完全符合中国台湾地区《劳工保险条例》和《全民健康保险法》的相关规定，但是上述法规并未对实际用人单位需要承担的相应法律责任和处罚进行规定。此外，发行人不存在因未为员工缴纳社会保险而受到行政处罚的情形。因此，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

综上，发行人委托第三方劳务公司为中国台湾籍员工代缴劳健保不会对本次发行上市造成重大不利影响。

八、 《问询函》第 9.3 题

公司于 2017 年在日本设立子公司，员工主要来源于 Synaptics 公司，日本晶合所取得的知识产权权益归属于晶合集成。2017 年前后 Synaptics 公司拟进行业务转型，晶合集成获得吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队的机会。

请发行人说明：相关人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

发行人日本子公司吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队，截至 2020 年 12 月 31 日，日本晶合共有 14 名员工，其中 9 名曾任职于 Synaptics 日本子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，日本晶合员工作为发明人、在发行人任职期间自主研发并取得的授权专利共计 3 项，具体情况如下：

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
1	晶合集成	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
2	晶合集成	小嶋英充	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	日本
3	晶合集成	小嶋英充	发明专利	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	日本

日本晶合全体员工均已出具确认函：“本人从原单位离职后加入日本晶合，不存在违反原单位竞业禁止及保密义务或其他约定的情形，亦不存在任何同原单位纠纷或潜在纠纷。”

根据日本律师出具的法律意见书，日本晶合与其他第三方无专利诉讼案件，日本员工与原单位之间不存在诉讼案件。

综上所述，日本子公司相关人员不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果不涉及其原任职单位的技术成果，不存在纠纷或潜在纠纷。

九、 《问询函》第 9.5 题

请发行人和有关中介机构按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等要求，对相关事项进行核查和披露，并出具专项核查报告。

答：

本所已根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》对股东事项进行了核查，更新《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东信息披露专项核查报告》，具体详见本次申报文件之“7-8-7 发行人律师关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东信息披露的专项核查报告”。

（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

苏 峥

刘东亚

单位负责人：

王 玲

2021 年 8 月 31 日

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（三）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）和《北京市

金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 12 日出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司审计报告》（容诚审字[2021]第 230Z3811 号）（以下简称《三年及一期审计报告》）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度，2021 年 1 月至 6 月期间（以下简称最近一期）财务报表进行审计，并出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（以下简称《2021 年半年度内控报告》）。本所现根据《三年及一期审计报告》《2021 年半年度内控报告》及发行人招股说明书和其他相关申报文件的修改和变动，就其中所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》不可分割的一部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，出具补充法律意见如下：

目录

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新 266

一、 本次发行上市的批准和授权 266

二、 发行人本次发行上市的主体资格 266

三、 本次发行上市的实质条件 266

四、 发行人的独立性及其变化情况 269

五、 发起人和股东的变化情况 270

六、 发行人的股本及其演变 273

七、 发行人的业务 273

八、 关联交易及同业竞争及其变化情况 275

九、 发行人的主要财产及其变化情况 295

十、 发行人的重大债权债务变化情况 301

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并 307

十二、 发行人公司章程的制定与修改 307

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 307

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 308

十五、 发行人的税务及其变化情况 309

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况 310

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况 312

十八、 发行人募集资金的运用 313

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况 314

二十、 发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价 315

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见 315

第二部分 财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日后《问询函》中涉及的相关问题回复内容的更新 316

一、 《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定 316

二、 《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务 317

三、 《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性 318

四、 《问询函》第 12.2 题：委派管理人员 320

五、 《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施 324

六、 《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况 326

七、 《问询函》第 24 题：关于募投项目 327

八、 《第二轮问询函》第 5 题：关于实际控制人认定 328

九、 《第二轮问询函》第 7 题：关于无形资产和技术 332

十、 《第二轮问询函》第 9.2 题 333

十一、 《第二轮问询函》第 9.3 题 335

附件一：发行人及其子公司拥有的知识产权 339

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新

一、 本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的董事会和股东大会的会议文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人于 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会对本次发行上市的批准和授权仍在有效期内，该次股东大会通过的与发行人本次发行上市有关的各项议案仍然有效。

发行人本次发行尚需上交所科创板股票上市委员会的审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人工商档案资料、《营业执照》《企业信用报告》、合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具《证明》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），截至本补充法律意见书出具日，发行人仍为合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一）本次发行上市符合《公司法》《证券法》的相关条件

1、 根据发行人本次发行上市相关股东大会决议及发行人书面说明，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、 发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3、 根据《三年及一期审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4、 根据《三年及一期审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5、 根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司之机构股东有关事项的调查函》及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本补充法律意见书第一部分“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会以及相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《三年及一期审计报告》《2021 年半年度内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《三年及一期审计报告》；根据《2020 年半年度内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《三年及一期审计报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）如本补充法律意见书第一部分“四、发行人的独立性及其变化情况”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本补充法律意见书第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化情况”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“五、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，截至本补充法律意见书出具日，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本补充法律意见书第一部分“九、发行人的主要财产及其变化情况”“十、发行人的重大债权债务变化情况”及“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司之机构股东有关事项的调查函》及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿

赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

（3）如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的《董事、监事、高级管理人员调查表》，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

(三) 本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（申报稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（申报稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《三年及一期审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的独立性及其变化情况

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资

料、发行人高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》，并经本所律师审阅发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《三年及一期审计报告》《2020 年半年度内控报告》等书面材料，以及发行人的确认，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人业务、资产、人员、机构及财务独立性情况未发生变化，发行人资产完整且仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、 发起人和股东的变化情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的股东变化情况如下：

1、 中小企业基金

根据中小企业基金的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），中小企业基金的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 6 月 30 日，中小企业基金的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司	普通合伙人	4,500.00	1.00
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.00	24.44
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	109,500.00	24.33
4	安信证券股份有限公司	有限合伙人	25,000.00	5.56
5	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	45,000.00	10.00
6	新余市华邦投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	56,000.00	12.44
7	万科企业股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
8	山证创新投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
9	深圳市创东方富盛投资企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	4.44

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
10	舟山保泰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	2.22
11	山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	2.22
合计		**—**	**450,000.00**	**100.00**

2、 海通创新

根据海通创新的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，海通创新已增资并于 2021 年 6 月 16 日完成工商变更登记，变更后的注册资本为 930,000 万元人民币，股东仍为海通证券股份有限公司。

3、 中金浦成

根据中金浦成的营业执照，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中金浦成已增资并于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 11 月 15 日进行了两次增资，变更后的注册资本为 600,000 万元人民币，股东仍为中国国际金融股份有限公司。

4、 惠友豪创

根据惠友豪创的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），中小企业基金的合伙人结构发生变更，杨庆将持有的惠友豪创 1,000 万元出资额转让给刘君，已于 2021 年 9 月 1 日完成工商变更手续。前述变更完成后，惠友豪创的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.00001
2	杨庆	有限合伙人	49,000.00	40.83
3	周祥书	有限合伙人	12,000.00	10.00
4	杨林	有限合伙人	10,000.00	8.33

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
5	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,800.00	7.33
6	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,200.00	6.00
7	孙义强	有限合伙人	5,000.00	4.17
8	刘晨露	有限合伙人	5,000.00	4.17
9	深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
10	深圳市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
11	深圳市创欣诚创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17
12	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.17
13	苏州锦天前程投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	0.83
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83
15	刘君	有限合伙人	1,000.00	0.83
合计		**-**	**120,000.01**	**100.00**

5、 集创北方

根据集创北方的股东名册，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），集创北方于 2021 年 12 月 16 日完成增资的工商变更登记，变更后的总股数为 43,106.52 万股。

根据发行人的股东名册、发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，除上述变化外，发行人的股东未发生其他变化。本所律师认为，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 发行人的股本及其演变

根据发行人提供的股东名册、本所律师对发行人股东的补充问卷调查、发行人的工商档案、《公司章程》及发行人确认，并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的股份结构未发生变化。

根据发行人股东的补充问卷调查确认、发行人说明，并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），截至本补充法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

七、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的经营方式和经营范围未发生变化。

发行人境内子公司情况详见本补充法律意见书之“0 发行人的主要财产及其变化情况”之“0 发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据《三年及一期审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发行人境外子公司的具体情况详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）发行人的主营业务

根据《招股说明书（申报稿）》《三年及一期审计报告》，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。发行人的主营业务未发生变化。

（四）主要业务资质和许可

经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人持有的辐射安全许可证、高新技术企业证书办理了更名手续，证书中的企业名称/单位名称由晶合有限变更为晶合集成，除上述变化外，发行人及其控股子公司与其主营业务相关的主要业务资质和许可未发生变化。

（五）发行人的持续经营能力

根据发行人最新的《营业执照》《三年及一期审计报告》及发行人确认，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

（六）发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人正在从事的合作研发项目具体情况如下：

序号	合作方	合作内容	研发成果归属	合作期间	保密措施
1	合肥海图微电子有限公司	高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发	项目执行过程中产生的知识产权，与制程技术、PDK 相关的知识产权归属于晶合集成，与产品设计相关的知识产权归属于海图微电子，后续基于项目所开发、修改、增进、改良、衍生或更新的相关设计及技术成果的知识产权和相应权益为各自独有	2020/10/1-2023/9/30	已签署保密协议
2	杰华特微电子（杭	150nm 高压/超高压	杰华特享有优先在发行人工艺线上联合开发 BCD 产	2020/11/01-2027/06/29	已签署保密协议

序号	合作方	合作内容	研发成果归属	合作期间	保密措施
	州）有限公司	电源管理芯片技术平台	品，杰华特拥有项目工艺技术的独家使用权，发行人对杰华特在本项目的器件结构、工艺流程及子流程等工艺技术严格保密，在独家使用权期间不得将此揭露、应用于其他方，不得对外直接、间接变相公开、转让		
3	思特威（上海）电子科技有限公司	90 纳米 CMOS 后照度图像传感器平台（90BSI）	双方合作期间涉及的各类知识产权，如果属于一方独立开发或拥有的，则该部分知识产权始终为一方所专有，另一方如需使用该部分知识产权应当事先征得一方的书面同意或授权	2020/3/20-2025/3/19	已签署保密协议
4	合作方一	150nm BCD 电源管理芯片技术平台	双方合作期间合作开发的技术和相关的信息参数仅适用于双方合作的项目，任何其他第三方使用需要经合作方一同意	2021/3/18-2024/3/17	签署保密协议

八、 关联交易及同业竞争及其变化情况

（一）关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的主要关联方如下：

1、 发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥建投的具体情况，详见律师工作报告“六、发起人和股东”之“（五）发行人的控股股东及实际控制人”。

2、 发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业

发行人控股股东合肥建投直接或间接控制的其他企业为发行人的关联方。截至2021 年 6 月 30 日，除发行人及其控股子公司以外，发行人控股股东直接或间接控制的其他主要企业如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥芯屏	2016 年 1 月 18 日	合肥市包河区武汉路 229 号	投资管理、资产管理；投资咨询。
2	合肥蓝科	2008 年 11 月 5 日	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。
3	合肥燃气	1995 年 11 月 13 日	合肥市蜀山区合作化南路 466 号	燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；能源项

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。
4	合肥供水	1994 年 7 月 21 日	安徽省合肥市屯溪路 70 号	自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
5	百大购物	2012 年 6 月 27 日	安徽省合肥市蜀山区望江西路 218 号	预包装食品批发兼零售（在许可证有效期内经营）；保健食品销售（李宝赢堂牌参茸酒）（在许可证有效期内经营）；日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、五金交电、化工产品（除危险品）、文体用品、办公用品、金银珠宝玉器、家具、皮革制品、钟表眼镜、照相器材、工艺品、儿童游乐设施、通讯设备、家电、电子产品、计算机软硬件及配件、劳保用品、建材、装饰材料、儿童用品销售；卷烟零售；合肥通卡代收代付（在协议范围内经营）；物业服务；企业管理咨询；房屋租赁。
6	百大合家福	2000 年 6 月 15 日	安徽省合肥市沿河路 118 号	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售；酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务（现场制售：面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）；农产品收购；日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售；家具、文体用品、五金车件、化工产品（除危险品）、建筑材料、劳保用品、汽车（除小轿车）及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定和禁止企业经营商品除外）；医疗器械销售（除国家限制项目）、音像制品、图书；儿童娱乐服务；彩扩服务；房屋租赁、场地出租（涉及许可在许可证有效期内经营）；停车场服务项目；特殊医学用途配方食品销售；网络表演；为本超市销售产品提供配送服务。
7	合肥市建设投资有限公司	1992 年 4 月 15 日	合肥市滨湖新区武汉路 229 号	项目投资、股权投资、资产重组及并购（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁。
8	合肥市交通投资控股有	2004 年 2 月 11 日	安徽省合肥市梅山路 77 号	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务；城乡交通基础设施及相关

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	限公司			产业的投资与运营；营运授权范围内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务；实业投资；旅游项目的投资开发。
9	合肥城建投资控股有限公司	2001 年 12 月 6 日	合肥市滨湖区武汉路 229 号	城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易，房屋租赁。
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	1996 年 7 月 29 日	安徽省合肥市长江中路 150 号	预包装食品、酒、乳制品销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输，土产品、纺织品、服装、工艺美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务，黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务。
11	合肥丰乐种业股份有限公司	1997 年 4 月 16 日	合肥市蜀山区创业大道 4 号	农作物种子、种苗生产、销售；大米、芝麻、棉花生产、销售；肥料销售；农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售；粮食作物、油料作物种植、储藏、运输、销售；农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；农业高新技术开发及成果转让；农业技术咨询、技术服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。
12	合肥科融高科技产业投资有限公司	2009 年 11 月 10 日	安徽省合肥市滨湖新区武汉路 229 号	高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理。
13	合肥市轨道交通集团有限公司	2009 年 6 月 2 日	安徽省合肥市阜阳路 17 号	城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售；轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告。
14	合肥金太阳能源科技股	2010 年 12 月 30 日	安徽省合肥市高新区黄山路 630	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
	份有限公司		号	一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。
15	合肥文旅博览集团有限公司	2002 年 4 月 30 日	安徽省合肥市政务文化新区习友路 988 号	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产经营管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。
16	合肥市水务环境建设投资有限公司	2000 年 8 月 8 日	安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼	水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。
17	合肥通航控股有限公司	2015 年 10 月 19 日	合肥市包河区徽州大道 1 号骆岗机场	机场运营、资产管理、设备维修、物业管理、企业管理、投资咨询、企业策划、航空投资、计算机系统集成、数据处理。
18	建投资本	2016 年 1 月 11 日	合肥市包河区武汉路 229 号	投资管理、资产管理。
19	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	2013 年 1 月 9 日	安徽省合肥市包河区包河大道 398 号建投综合办公区 A 座 8-9 楼	农业、文化旅游产业项目投资及运营管理；农村基础设施建设及人居环境建设；乡村旅游开发；特色小镇开发及田园综合体开发；农产品生产种植与销售；城市基础设施建设；土地整治；土地储备业务。
20	安徽环巢湖生态发展有限公司	2004 年 10 月 18 日	安徽省巢湖市巢庐路（原东庵林场）	生态产业投资与建设，休闲旅游产业、文化旅游产业的投资与运营，旅游景区的开发、建设、运营，旅行社、旅游交通服务，文化演艺与婚庆、展览服务，旅游商品开发与销售，酒店管理，物业管理，会议、培训服务，旅游策划与管理咨询，文化体育运动的组织与服务。
21	合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司	2015 年 2 月 15 日	合肥市蜀山区合作化南路 466 号燃气大厦 22-24 层	各类工程建设活动；电气安装服务；供电业务；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试。以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车租赁；信息系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；充电桩销售；电气设备修理；专用设备修理；停车场服务。
22	合肥市综合管廊投资运营有限公司	2016 年 12 月 23 日	合肥市包河区武汉路 229 号建投大厦	各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务。市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。
23	合肥融科项目投资有限公司	2010 年 11 月 11 日	合肥市新站区大禹路与东方大道交口西北角合肥综合保税区进口商品展示中心大楼 12-14 层	项目投资。
24	合肥市引江济淮投资有限公司	2017 年 8 月 30 日	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路 118 号	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
				管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。
25	合肥市建庐建设投资有限公司	2017 年 12 月 21 日	合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 15 层	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。
26	安徽中安智通科技股份有限公司	2015 年 12 月 16 日	合肥市包河区常青街道姚公社居委南屏路 555 号	城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售；城市交通项目投资；交通设施和器材的研发、设计、制作、安装及维护维修；机械式立体停车设备、智能车位引导等自动化控制系统及系统集成的研发设计、生产制造销售、技术服务；停车场相关设计施工、技术服务、管理服务；软件开发；广告发布、传媒灯箱、信息咨询服务；住房及商用房租赁；物业管理。
27	合肥市住房租赁发展股份有限公司（以下简称合肥租赁）	2020 年 5 月 18 日	安徽省合肥市蜀山区长江西路 460 号合房租赁办公区	住房租赁，商业房产运营，房地产开发、咨询、代理、经纪，房屋建筑工程施工，室内外装饰工程设计施工，酒店管理，物业管理，停车场（库）运营，户外广告、道路绿化及工程施工咨询，家具及家用电器用品出租服务，计算机和网络技术服务，互联网信息服务。

此外，过去 12 个月内发行人控股股东直接或间接控制的其他企业亦为发行人的关联方。

3、 发行人的控股子公司

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人在中国境内拥有 2 家控股子公司，在中国境外拥有 1 家控股子公司。上述公司的具体情况，详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

4、 发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人现任董事、监事、高级管理人员以及过去 12 个月内曾经担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方，上述人员的具体情况，详见律师工作报告“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”及本补充法律意见第一部分之“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、 发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	智慧记忆科技股份有限公司	蔡国智担任董事
2	Xsense Technology Corporation	蔡国智担任董事
3	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、黄颢担任董事兼副总经理
4	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事
5	建投资本	黄颢担任董事
6	合肥德轩投资管理有限公司	黄颢担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
7	合肥京东方显示技术有限公司	黄颢担任董事长
8	合肥市信实产业投资基金（有限合伙）	黄颢担任执行事务合伙人委派代表
9	合肥奕斯伟封测控股有限公司	黄颢担任董事
10	合肥颀中封测技术有限公司	黄颢担任董事
11	合肥维信诺科技有限公司	黄颢担任董事
12	蔚来控股有限公司	黄颢担任董事
13	启迪新基建产业（合肥）集团有限公司	黄颢担任董事
14	合肥德电新能源汽车股份有限公司	黄颢担任董事
15	合肥神州数码信创控股有限公司	黄颢担任董事
16	智丰科技股份有限公司	郑素芬担任总经理
17	新相科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
18	顺立投资股份有限公司	郑素芬担任董事
19	瑞相科技股份有限公司	郑素芬担任董事
20	晶相光电股份有限公司	郑素芬担任董事
21	力相光学股份有限公司	郑素芬担任董事
22	宏丽数位创意股份有限公司	郑素芬担任董事
23	智合精准医学科技股份有限公司	郑素芬担任董事
24	智成电子	郑素芬担任董事
25	景睿科技股份有限公司	郑素芬担任董事
26	力晶微元科技股份有限公司	郑素芬担任董事长
27	智仁科技开发股份有限公司	郑素芬担任董事
28	英达投资股份有限公司	胡竞英担任董事长且控制
29	疯狂秀股份有限公司	胡竞英担任董事
30	中兴农林开发股份有限公司	胡竞英担任董事
31	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	胡竞英担任董事
32	合润生活国际有限公司	胡竞英担任董事
33	益宠生医股份有限公司	胡竞英担任董事

此外，过去 12 个月内发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者除独立董事外的前述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

6、 直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至 2021 年 6 月 30 日，除合肥建投以外，直接持有发行人 5%以上股份的股东为合肥芯屏、力晶科技、美的创新。

美的集团直接持有美的创新 70%的股权，并通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司间接持有美的创新 30%的股权，亦系发行人的关联方。

7、 直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织

截至 2021 年 6 月 30 日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织包括：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	力信投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
2	世仁投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
3	富硕投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
4	智典国际股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
5	世成科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
6	智仁科技开发股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
7	智慧记忆体科技股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
8	Deutron Japan Corp.	力晶科技直接或间接控制
9	智翔投资股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
10	智成电子	力晶科技直接或间接控制
11	力相光学股份有限公司	力晶科技直接或间接控制
12	广东美云智数科技有限公司	美的创新直接或间接控制
13	深圳数智场景定位科技有限公司	美的创新直接或间接控制

序号	关联方名称	关联关系说明
14	上海美仁半导体有限公司	美的创新直接或间接控制

此外，过去 12 个月内直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

8、 直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

（1）直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2021 年 6 月 30 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李宏卓	合肥建投董事长
2	陈小蓓	合肥建投董事
3	陆勤航	合肥建投董事兼总经理
4	黄颢	合肥建投董事兼副总经理
5	倪敬东	合肥建投董事
6	吴子能	合肥建投董事
7	杨雪蕾	合肥建投董事
8	黄跃明	合肥建投监事
9	杨国庆	合肥建投监事
10	范红金	合肥建投监事
11	田胜彬	合肥建投监事
12	朱庆	合肥建投监事
13	罗文萍	合肥建投高级管理人员

过去 12 个月内曾经担任合肥建投董事、监事、高级管理人员的人员构成发行人关联方。

（2）前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织

前述关联自然人中，陆勤航、黄灏亦系发行人董事。除陆勤航、黄灏外，其他关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥维信诺科技有限公司	李宏卓担任董事长
2	建投资本	李宏卓担任董事长，陈小蓓、罗文萍担任董事
3	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
4	合肥芯屏	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
5	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
6	合肥市乡村振兴产业投资合伙企业（有限合伙）	李宏卓担任执行事务合伙人委派代表
7	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
8	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
9	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事
11	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事
12	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
13	合肥市水务环境建设投资有限公司	吴子能担任董事长
14	合肥市铭城建设发展有限公司	吴子能担任董事长
15	合肥市环巢湖建设发展有限公司	吴子能担任董事长
16	合肥泽众城市智能科技有限公司	吴子能担任副董事长
17	安徽庐铜铁路有限公司	吴子能担任副董事长
18	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	吴子能担任副董事长
19	合肥新桥国际机场有限公司	吴子能担任副董事长
20	合肥龙和投资咨询有限公司	黄跃明担任董事兼总经理

序号	关联方名称	关联关系说明
21	合肥科融高科技产业投资有限公司	黄跃明担任执行董事兼总经理
22	合肥二号线轨道交通有限公司	田胜彬担任董事
23	合肥市建庐建设投资有限公司	田胜彬担任董事长
24	合肥建翔投资有限公司	田胜彬担任董事
25	合肥市建设投资有限公司	罗文萍担任执行董事兼总经理
26	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	杨雪蕾担任执行董事

除此之外，前述关联自然人过去 12 个月内曾经担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

9、 其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、 关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、 注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

（二）关联交易

根据《三年及一期审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：

1、 向关联方采购商品及接受服务

报告期内，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	
		金额	占比
合肥燃气	采购燃气	236.11	0.21%
合肥供水	采购厂区用水	235.92	0.21%
智成电子	采购服务	243.81	0.21%
合肥租赁	房屋租赁	71.40	0.06%
关联采购合计		**787.23**	**0.69%**

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、 向关联方销售商品及提供服务

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人未向关联方销售商品及提供服务。

3、 关联租赁

发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人作为承租方向合肥蓝科租入资产所支付的租金金额为 3,588.01 万元。

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则进行会计处理，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

4、 关联担保情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
合肥建投	华泰资产	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行合肥分行	57,580.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行合肥分行	16,806.00	借款发放日	2028/1/7	否	是
		50,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	中国银行北城支行	68,397.66	借款发放日	2028/1/15	否	是
		25,000.00	2021/3/19	2027/10/10	否	是

2017 年 12 月 14 日，合肥建投与中国银行北城支行签署了《最高额保证合同》，约定合肥建投为公司与中国银行北城支行签署的《授信额度协议》项下 70,000 万元授信提供连带责任保证担保，保证期间为《授信额度协议》生效之日至主债权期限届满之日起两年。

2017 年 12 月 28 日，合肥建投与平安银行合肥分行签署了《最高额保证担保合同》，合肥建投为公司与平安银行合肥分行签署的《综合授信额度合同》项下 110,000 万元的债务提供最高额连带责任保证担保，担保期限至主合同项下债务完全清偿。

2017 年 12 月 29 日，合肥建投与兴业银行合肥分行签署了《最高额保证合同》，合肥建投为公司与兴业银行合肥分行在保证额度有效期内最高本金限额 70,000 万元的

债务提供连带责任保证担保，保证额度有效期自 2017 年 12 月 29 日至 2028 年 1 月 5 日止。

2018 年 8 月 20 日，合肥建投与华泰资产签署了《华泰－合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划保证担保合同》，合肥建投为公司与华泰资产签署的《华泰－合肥晶合集成电路基础设施债权投资计划投资合同》项下本金 300,000 万元的债务提供连带责任保证担保，担保期间自同生效之日起至全部债务期限届满之日起两年。

2021 年 3 月 17 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与平安银行合肥分行签署了《最高额保证担保合同》，为本公司与平安银行合肥分行签署的《综合授信额度合同》提供 85,000.00 万元连带责任保证担保，保证期间为《最高额保证担保合同》生效日至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后两年。

2021 年 3 月 17 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司与中国银行北城支行签署了《保证合同》，为本公司与中国银行北城支行签署的《固定资产借款合同》提供 25,000.00 万元提供连带责任保证担保，保证期间为《固定资产借款合同》之主债权的清偿期届满之日起三年。

根据公司与合肥建投签订的反担保合同及补充协议，公司就合肥建投为公司上述借款的担保以公司所有的晶合一期 5 万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分提供反担保。

5、 关联方资金拆借

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人未发生与关联方资金拆借的情形。

6、 关键管理人员薪酬

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额为 741.14 万元。

7、 关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 6 月 30 日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	邱显寰	3.10	-
其他应收款	詹奕鹏	2.01	-
其他应收款	简瑞荣	0.18	-
其他应收款	李泇谕	1.15	
其他应收款	合肥燃气	40.00	-
其他应收款	智成电子	0.06	0.003
预付款项	合肥租赁	71.40	-

（2）应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 6 月 30 日
其他应付款	蔡辉嘉	0.43
其他应付款	周义亮	1.17
其他应付款	合肥蓝科	216.05
其他应付款	合肥租赁	11.90
应付账款	合肥燃气	14.62
应付账款	智成電子	241.28
租赁负债	合肥蓝科	184,856.98

根据《三年及一期审计报告》、发行人相关会议资料、发行人的书面说明，并经本所律师核查，上述报告期内发生的发行人关联方与发行人所发生的关联交易，交易价格及条件均符合公允原则，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（三）同业竞争

截至本补充法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，

合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

（四）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

九、 发行人的主要财产及其变化情况

（一）土地使用权和房屋所有权变化情况

1、自有物业

截至本补充法律意见书出具日期间，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 3 处，面积合计约 215,654.47 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	215,270.61	2017 年 6 月 28 日至 2037 年 6 月 27 日	生产办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份有限公司	上海市张江高科技园区盛夏路 608 号 2 幢 5 层 502 室	141.15	2019 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日	办公
3	日本晶合	マ ス タ	東京都立川市喀町一丁目 13 番 11 号	242.71	2016 年 11 月 1 日至	办公

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限	用途
		一・プロパティーズ株式会社			2021 年 4 月 30 日	
4	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

（二）在建工程

根据《三年及一期审计报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人书面说明，截至本补充法律意见出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人在建工程的账面余额为 132,959.17 万元。

（三）商标、专利等无形资产变化情况

1、注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家知识产权局出具的《商标初步审定公告》，并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 108 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 17 项，在中国境外注册的商标 91 项，该等商标的具体情况详见本补充法律意见书附件。

2、注册专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查

册结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（http://pss-system.cnipa.gov.cn），并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 163 项已授权专利，在中国境外共拥有 55 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本补充法律意见附件。

3、互联网域名

截至 2021 年 6 月 30 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（http://beian.miit.gov.cn），发行人及其子公司合法拥有 1 项注册域名。该等域名的具体情况如下：

序号	注册域名	注册所有权人	注册日期	到期日期
1	nexchip.com.cn	晶合集成	2015 年 9 月 16 日	2023 年 9 月 16 日

4、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

截至 2021 年 6 月 30 日，公司正在使用的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
1	美商矽成积体电路股份有限公司	110纳米嵌入式闪存技术	开发服务费用	2019年1月31日-2025年1月30日
2	円星科技股份有限公司	90纳米编译器IP	开发服务费及权利金	2019年1月25日-2022年1月24日
		150纳米标准单元库	开发服务费及权利金	2019年1月25日-2022年1月24日
		150纳米标准单元库	开发服务费及权利金	2019年10月16日-2022年10月15日
		90纳米编译器IP	开发服务费及权利金	2020年4月1日-2023年3月31日
		90纳米编译器IP	开发服务费及权利金	2019年10月16日-2022年10月15日

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
3	力旺电子股份有限公司	单次可编程IP	设计服务费及权利金等	2019年1月25日-2024年1月24日
		单次可编程（反熔丝）IP	设计服务费及权利金等	2018年7月15日-2021年7月14日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2019年1月25日-2024年1月24日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2020年8月18日-2025年8月17日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年3月3日-2026年3月2日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2020年10月12日-2025年10月11日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年3月2日-2026年3月1日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年5月10日-2026年5月9日
		单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年6月18日-2026年6月17日
4	智成电子	110纳米标准单元库	量产权利金	2020年1月1日-2022年12月31日
5	寅通科技股份有限公司	80纳米集成电路IP	技术开发费及量产权利金	2019年3月8日-2024年3月7日
		90纳米集成电路IP	技术开发费及量产权利金	2019年4月1日-2024年3月31日
		集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年4月1日-2024年3月31日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年7月18日-2024年7月17日

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
		55纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2019年10月25日-2024年10月24日
		集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年2月28日-2023年2月27日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年5月22日-2023年5月21日
		90纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2018年6月11日-2023年6月10日
		55纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2020年4月15日-2025年4月14日
		110纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2020年9月1日-2025年8月31日
		90纳米集成电路IP	开发及授权服务费及量产权利金	2021年6月15日-2026年6月14日
6	亿而得微电子股份有限公司	多次可编程电路模块	产品开发费用、权利金	2019年7月19日-2024年7月18日
		集成电路模块	产品开发费用、权利金	2017年11月1日-2023年10月31日
7	成都锐成芯微科技股份有限公司	110纳米低功耗嵌入式存储工艺平台模拟IP	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日
		110纳米多次可编程电路 90纳米多晶硅熔丝IP 150纳米多晶硅熔丝IP	技术秘密使用费，并根据实际发生金额结算、支付版税费用	2020年4月1日-2030年3月31日
		110纳米多次可编程电路	支付版税费用	2021年5月10日-

序号	许可方	授权许可内容	合同定价依据	有效期限
				2030 年 5 月 9 日
8	珠海创飞芯科技有限公司	110单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用	2021 年 6 月 1 日起至达成新协议前永久有效

（四）主要生产经营设备

根据《三年及一期审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至 2020 年 6 月 30 日，机器设备的账面价值为 971,757.33 万元、电子设备及其他的账面价值为 7,331.34 万元、运输工具的账面价值为 0.21 万元。

（五）发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人子公司北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合的基本情况未发生变化。发行人新增一家境内控股子公司合肥新晶集成电路有限公司（以下简称新晶集成），具体情况如下：

发行人持有新晶集成 100%股权，新晶集成为发行人全资子公司。根据合肥市新站区市场监督管理局 2021 年 9 月 6 日向新晶集成核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA8N4PFB89），新晶集成的基本情况如下表所示：

公司名称	合肥新晶集成电路有限公司
住所	合肥市新站区综合保税区内西淝河路 88 号
法定代表人	周义亮
注册资本	400,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售

	（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：2021 年 12 月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新晶集成增资扩股案的议案》，新晶集成拟引入外部投资人筹集资本金。截至本补充法律意见出具日，发行人正在与投资人谈判沟通，尚未签署增资协议。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、不动产登记簿、经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司主要财产存在权利受限的情况未发生重大改变。

十、 发行人的重大债权债务变化情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的重大债权债务变化情况如下：

（一）重大合同的变化情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间新增的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、 销售合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大的客户签署的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最高的订单情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	集创北方	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	71,935.55 万元产能预约金	正在履行
2	晶合集成	敦泰电子	2021/05/23-2023/12/31	110nm、90nm、	1,990.50 万	正在履行

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
		股份有限公司		55nm 晶圆代工产能预约	美元产能预约金	
3	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	11,847.79 万元产能预约金	正在履行
4	晶合集成	天钰科技股份有限公司	2021/05/12-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	3,171.12 万美元产能预约金	正在履行
5	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2021/5-2023/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工	7,834 万美元产能预约金	正在履行
6	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/04/01-2023/03/31	晶圆代工服务及晶圆产品	/	正在履行
7	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/05/21-2021/12/31	90nm TDDI、90nm 其他、150nm LDDI	606 万美元产能预约金	正在履行
8	晶合集成	联咏科技股份有限公司	2021/06/02-2023/12/31	150nm、90nm 产能	14,860.80 万美元产能预约金	正在履行
9	晶合集成	奇景光电股份有限公司	2021/05/23-2023/12/31	150nm、110nm 晶圆代工	2,520 万美元产能预约金	正在履行

2、 采购合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商签署的正在履行的正在履行的或已经履行完毕的合同或各期金额最高的采购订单情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2021/06/01	2022、2023 年硅晶圆产能	2,772 万美元预付款	正在履行
2	晶合集成	环球晶圆股份有限公司	2021/06/07	2022 至 2024 年 12 吋磊晶硅晶圆产能	550.80 万美元预付款	正在履行
3	晶合集成	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2021/05/25	零部件	33.58 万美元	已履行
4	晶合集成	Wah Lee Industrial Corp.	2021/01/26	化学品	70.49 万美元	已履行
5	晶合集成	Rohm and Haas Electronic Materials CMPAsica Inc.	2021/06/24	化学品	349.07 万美元	正在履行
6	晶合集成	Siltronic Singapore Pte.Ltd	2021/03/16	硅晶圆	270 万美元	已履行

3、 借款合同

根据发行人提供的相关文件及说明，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行及已履行完毕的授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合有限	平安银行合肥分行	2017/04/11	50 亿元授信	2017/04/11-2027/04/10	正在履行	合肥建投为 50 亿授信中的 11 亿元提供担保
2	晶合有限	平安银行合肥分行	2018/02/24	11 亿元借款	120 个月	正在履行	
3	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/03/19	5 亿元借款	2021/04/01-2027/10/10	正在履行	合肥建投提供最高额为 8.5 亿元的担保
4	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/06/09	3.5 亿元借款	2021/06/15-2027/10/10	正在履行	
5	晶合有限	兴业银行合肥分行	2017/05/18	5 亿元授信	2017/05/18-2018/05/17	已履行	合肥建投提供最高额为 7 亿元的担保
6	晶合有限	兴业银行合肥分行	2020/11/17	11.68 亿元授信	至 2021/03/04	已履行	
7	晶合有限	兴业银行合肥分行	2018/01/08	7 亿元借款	2018/01/08-2028/01/07	正在履行	
8	晶合集成	兴业银行合肥分行	2021/04/01	5 亿元授信	2021/04/01-2021/10/29	已履行	
9	晶合集成	兴业银行合肥分行	2020/10/30	3 亿元授信	2020/10/30-2021/10/29	已履行	-
10	晶合有限	中国银行北城支行	2017/11/14	7 亿元授信	生效之日起至 2018/09/21	已履行	合肥建投提供担保
11	晶合有限	中国银行北城支行	2017/11/14	7 亿元借款	实际提款日起 120 个月	正在履行	
12	晶合集成	中国银行北城支行	2021/03/17	2.5 亿元借款	实际提款日起 80 个月	正在履行	

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
13	晶合有限	中国银行北城支行（受合肥建投委托提供贷款）	2018/04/28	8.05 亿借款	提款日起 6 个月	已履行	-
14	晶合有限	华泰资产管理有限公司	2018/08/20	不超过 30 亿投资本金	10 年	正在履行	合肥建投提供担保
15	晶合集成	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2021/03/22	2 亿元授信	2021/03/23-2024/03/22	正在履行	-
16	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	2021/02/10	2 亿元授信	2021/02/10-2022/01/05	正在履行	-
17	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2021/06/09	3 亿元授信	2021/06/09-2022/06/08	正在履行	-

4、 对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

除本节之“（一）重大合同”之“1、销售合同”已披露的合同外，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人签订的产能预约金金额前五大的合同如下：

（1）2021 年 6 月 1 日，发行人同成都爱旗科技有限公司签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为成都爱旗科技有限公司预留 150nm 产能，合同期限为 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（2）2021 年 6 月 10 日，发行人同客户一签订《2022-2023 150nm BCDAE(MTK M153)合同》，约定发行人为客户一预留并投入 150nm BCDAE(MTK M153)晶圆 2022 年及 2023 年产能，合同期限为 2021 年 6 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。

（3）2021 年 5 月 26 日，发行人同思特威签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为思特威预留相关晶圆代工产能，合同期限为 2021 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。

（4）2021 年 5 月 31 日，发行人同客户二签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为客户二预留 110nm 产能，合同期限为 2021 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）2021 年 5 月 12 日，发行人同客户三签订《2022-2023 产能预约合同》，约定发行人为客户三预留 150nm 产能，合同期限为 2021 年 5 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）合同主体及合同的履行

上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三）侵权之债

根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《三年及一期审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本补充法律意见第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化”及“十、发行人的重大债权债务变化情况”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（五）发行人的其他应收、应付款

根据《三年及一期审计报告》并经本所律师核查，本期间内，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人无重大资产收购、出售或拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记资料、股东大会会议文件及发行人说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，《公司章程》及《发行人章程》未进行修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人确认，并经本所律师核查发行人会议资料，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间：

（一）发行人的组织结构没有发生变化；

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则内容没有发生变化；

（三）发行人共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，未召开监事会会议，主

要情况如下：

1、根据发行人提供的股东大会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 2 次股东大会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 27 日
2	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 20 日

2、根据发行人提供的董事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 5 次董事会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	第一届董事会第五次会议	2021 年 5 月 26 日
2	第一届董事会第六次会议	2021 年 8 月 12 日
3	第一届董事会第七次会议	2021 年 10 月 11 日
4	第一届董事会第八次会议	2021 年 11 月 30 日
5	第一届董事会第九次会议	2021 年 12 月 28 日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员范围未发生变化。经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）发行人董事、监事及高级管理人员变化情况

根据发行人提供的股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员变化如下：

2021 年 11 月 30 日，发行人召开第一届董事会第八次会议，聘任周义亮为公司副总经理。

2021 年 11 月 26 日，合肥建投向晶合集成发出《关于调整晶合公司董事人选的函》，推荐陈小蓓担任公司董事，接任黄颢的董事职务。2021 年 12 月 20 日，晶合集成召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意选举陈小蓓为公司董事。

除上述情况，发行人董事、监事及高级管理人员未发生其他变化。

十五、 发行人的税务及其变化情况

（一）税务登记及税种、税率

根据更新的《三年及一期审计报告》《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，最近一期，发行人及境内下属企业执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

本所律师认为，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《三年及一期审计报告》《2020 年半年度主要税种纳税情况专项说明》及发行人的说明，最近一期，发行人享有的税收优惠无重大变化。

（三）财政补贴

根据《三年及一期审计报告》及发行人的说明，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，发行人及其境内控股子公司获得的与资产相关的政府补助为 3,504.14 万元，与收益相关的政府补助为 837.76 万元。

（四）税务合规证明

2021 年 7 月 16 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经征管系统查询，该纳税人自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日一直正常申报纳税，未发生违法违章等行为被税务机关处罚的情形。”

2021 年 7 月 14 日，国家税务总局南京市秦淮区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“经税收管理系统查询，你单位 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间暂未发现该企业存在逾期申报等违法违规记录。”

2021 年 7 月 13 日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 7 月 13 日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚，该单位企业所得税征收方式为查账征收。”

2021 年 7 月 16 日，国家税务总局上海市浦东新区税务局向上海晶合出具《税务证明》，“在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，能按税法的规定按期办理纳税申报，暂未发现有欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法规的情形。”

（五）税务处罚

最近一期，发行人及其子公司无新增税务处罚情况。

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

（一）环境保护

1、根据发行人说明及其提供的文件，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见

书出具日期间，发行人及其子公司环境污染的具体环节、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力未发生变动。

2、根据发行人说明及其提供的文件并经本所律师核查，发行人原募集资金投资项目已获得了有关环境保护主管部门关于该等项目环境影响报告书的审查批复，同意建设该等项目，具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥新晶集成电路有限公司 12 吋晶圆制造项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12064 号）。

除上述情况外，《法律意见书》“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”披露的“环评批复及环保验收情况”内容未发生变动。

3、根据发行人说明并经本所律师核查，发行人募集资金投资项目已获得了有关环境保护主管部门关于该等项目环境影响报告书的审查批复，同意建设该等项目，具体情况如下：

2021 年 9 月 15 日，合肥市生态环境局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12048 号）。

4、2021 年 7 月 12 日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自 2021 年 1 月 1 日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

5、根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，最近一期，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项，

不涉及安全生产相关事项。发行人安全生产合规情况如下：

2021 年 7 月 6 日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自 2021 年 1 月 1 日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的统计资料及社会保险及住房公积金缴纳凭证，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其境内子公司员工共 2,051 人，已为其中 1,573 人缴纳社会保险，已为其中 1,669 人缴纳住房公积金。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾籍员工按照台湾地区法规缴纳了劳健保；（3）在境内任职的外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾籍、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

2021 年 7 月 13 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 13 未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2021 年 7 月 13 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自 2016 年 7 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

十八、 发行人募集资金的运用

2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》，公司拟公开发行 A 股普通股股票，实际募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	晶合集成	3.5
1.3	40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
合计		**-**	**95.0**

发行人“合肥晶合集成电路先进工艺研发项目”的实施地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，位于发行人厂区范围内，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁，合肥蓝科已取得相关房屋的不动产权证，具体情况如律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（一）土地使用权及房屋所有权”所述。

发行人“合肥晶合集成电路先进工艺研发项目”已由合肥新站高新技术产业开发区经贸局于 2021 年 8 月 20 日完成项目备案（项目代码：2108-340163-04-05-220549）。

发行人“合肥晶合集成电路先进工艺研发项目”已于 2021 年 9 月 15 日取得合肥市生态环境局出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12048 号）。

本所认为，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、行政法规和规章的规定。

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）、中国检察网（http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国法院失信被执

行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）、中国检察网（http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）等网站，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十、 发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》及其摘要，并特别审阅了其中引用《法律意见书》及本补充法律意见书的相关内容。本所认为，发行人《招股说明书（申报稿）》引用的《法律意见书》及本补充法律意见书相关内容与《法律意见书》及本补充法律意见书无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》及其摘要中引用《法律意见书》及本补充法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用《法律意见书》及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，发行人自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间内所发生的变化，不会对《法律意见书》中本所律师发表的结论意见构成影响，本所律师发表的结论意见依然有效。

第二部分 财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日后《问询函》中涉及的相关问题回复内容的更新

一、 《问询函》第 1 题：关于实际控制人认定

根据申报材料：（1）发行人控股股东为合肥建投，直接持有发行人 31.14%的股份，并通过合肥芯屏控制发行人 21.85%的股份，合计控制发行人 52.99%的股份，系发行人的控股股东。发行人实际控制人为合肥市国资委，直接持有合肥建投 100%的股权。（2）2015 年 10 月，公司与第二大股东力晶科技签订《委托经营管理合约》，约定公司委托力晶科技进行经营管理。根据保荐工作报告，2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。（3）目前，公司董事长蔡国智的提名人为力晶科技。

请发行人披露合肥建投能够控制合肥芯屏的原因。

请发行人说明：……（3）力晶科技是否将发行人并入合并报表；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（四）力晶科技是否将发行人并入合并报表

根据力晶科技公开披露的 2016 年至 2021 年 1-6 月的年度报告、半年度报告及审计报告，自 2016 年 2 月力晶科技入股公司至今，力晶科技均未将公司纳入合并报表范围，仅作为参股投资企业列示。

二、 《问询函》第 4 题：关于第二大股东力晶科技从事同类型业务

根据保荐工作报告，力晶科技及其关联企业力积电从事晶圆代工业务，与发行人主营业务属于同一类型业务。在定位方面，双方均定位于晶圆代工领域；主要产品方面，发行人晶圆代工服务主要为制程为 90nm-150nm 的 12 英寸晶圆代工，力晶科技及力积电晶圆代工服务主要为制程为 65nm 及以上的 12 英寸、8 英寸晶圆代工；工艺平台方面，发行人主要工艺平台为 DDIC 晶圆代工，力晶科技及力积电主要工艺平台为 DDIC、PMIC、分离式元件、Flash、影像感测 IC、记忆体整合芯片。同时，发行人与力晶科技及力积电主要客户、供应商存在重叠的情形。

请发行人：……（2）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况；（3）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）报告期内力晶科技及其关联企业晶圆代工业务的收入规模及毛利情况

4、2021 年 1-6 月

2021 年 1-6 月，力积电具备晶圆代工产能，力晶科技不具备晶圆代工产能，其晶圆代工业务收入规模及毛利情况如下：

单位：千新台币

项目	力晶科技	力积电
营业收入	-	28,573,900
其中：晶圆代工	-	28,554,693
包装元件	-	19,207

营业成本	-	18,082,416
毛利	-	10,491,484
毛利率*	-	36.72%

注：力积电未单独披露晶圆代工营业成本，但除晶圆代工外营收规模较小，晶圆代工毛利率与整体毛利率相近，数据出自力晶科技、力积电 2021 年半年报。

（三）发行人与力晶科技及力积电的主要客户、供应商重叠的具体情况和原因，是否会导致发行人与力晶科技及其关联企业之间的非公平竞争、利益输送等情形，是否存在损害发行人利益的情形及风险

1、发行人与力晶科技及力积电的主要客户重叠情况和原因

（1）具体情况

报告期内，发行人前五大客户占发行人营业收入的比重分别为 99.74%、94.70%、89.80%和 78.31%，发行人前五大客户占力晶科技及力积电营业收入比重分别为 15.61%、14.22%、14.63%和 14.27%，2020 年度，联咏科技、集创北方、合肥捷达微电子有限公司及其关联方在力晶科技及力积电的收入占比中均不足 1.5%，其客户重要性在力晶科技及力积电较低。

2、发行人与力晶科技及力积电的主要供应商重叠情况和原因

（1）具体情况

根据发行人取得的报告期内力晶科技及力积电采购占比达 90%以上的原材料供应商明细表（采购占比由大到小排序，合计占比达 90%以上），报告期内，2018 年至 2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人与力晶科技及力积电的主要原材料供应商存在重叠较高的情形，发行人在报告期内向重叠原材料供应商采购的金额分别为 2.37 亿元、2.94 亿元、5.40 亿元和 4.00 亿元，占发行人向原材料供应商采购总额的比重分别为 83.30%、88.99%、85.34%和 82.37%。

三、 《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性

根据申报材料：（1）招股说明书对核心技术情况披露较为简单。公司取得力晶科技相关技术后，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了现有技术平台。（2）核心技

术人员多为中国台湾籍且具有力晶科技任职背景，部分曾有中芯国际、联华电子等工作经历。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，发行人发明专利数量 2018 年为 0 项，2019 年为 2 项，2020 年为 71 项。（4）2015 年 10 月，《技术移转协议》约定力晶科技提供驱动 IC 代工所需之制程技术予公司，用以出资的转移技术作价 20 亿元。（5）2020 年 9 月，力晶科技将用于出资的 58 项专利技术使用权中尚在有效期的 44 项无偿转让给晶合有限。（6）2018 年 4 月、2021 年 4 月，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》及《补充协议》，约定力晶科技向公司移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，公司需合计支付 500 万美元。

请发行人详细披露核心技术的形成过程，力晶科技在发行人技术发展过程中的作用，现有技术平台和技术先进性的具体表征。

请发行人说明：（1）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。请发行人律师说明对核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷事项的核查情况及核查结论。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（一）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响

2、对公司业务及生产经营的影响

报告期内，2018 年至 2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人晶圆代工业务收入分别为 21,765.95 万元、53,336.01 万元、151,186.11 万元及 160,194.97 万元，实现了稳健增长。

四、 《问询函》第 12.2 题：委派管理人员

根据申报材料：（1）按照委托经营协议，存在力晶科技、合肥建投委派部分管理人员的情形，委派人员所在岗位主要是财务和内审部门。2020 年 4 月起，公司各部门已无股东委派高管。（2）2018 年 12 月，发行人依据《委托经营管理合约》组建了经营管理委员会。

请发行人说明：……（2）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师就发行人财务是否独立于力晶科技进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

2、委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议、合肥建投及力晶科技向发行人委派高管的相关函件以及发行人出具的说明，报告期初至股改前，发行人经营管理团队人员的变化情况如下：

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
1	/	总经理	2018 年 1 月-	黎湘鄂	发行人员工	发行人

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020 年 3 月			
			2020 年 3 月-报告期末	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
2	运营	副总经理	2018 年 1 月-2020 年 3 月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 12 月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 11 月	未设置		
			2020 年 12 月-报告期末	李庆民	发行人员工	发行人
3	采购	总监/副总经理	2018 年 1 月-2020 年 11 月	盛惟健	发行人员工	发行人
			2020 年 11 月-报告期末	未设置		
		协理	2020 年 11 月-报告期末	简瑞荣	发行人员工	发行人
		副总监	2018 年 1 月-2019 年 5 月	周义亮	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 5 月-2020 年 3 月	王继武	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 3 月-报告期末	未设置		
4	销售	总监/副总经理	2018 年 1 月-2019 年 10 月	黎湘鄂	发行人员工	发行人

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2019 年 10 月-2020 年 4 月	未设置		
			2020 年 4 月-2020 年 6 月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020 年 6 月-报告期末	未设置		
		协理	2019 年 10 月-2020 年 4 月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	周义亮	发行人员工	发行人
		副总监	2018 年 1 月-2020 年 3 月	周义亮	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	未设置		
5	研发	副总经理	2018 年 1 月-2019 年 3 月	陈耿川	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	詹奕鹏	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 3 月-2020 年 3 月	詹奕鹏	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	未设置		
6	财务	总会计师/财务负责人	2018 年 1 月-2020 年 3 月	朱才伟	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月至报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
		副总会计师/协	2018 年 1 月-	邱垂源	力晶科技委派	力晶科技

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
		理	2019 年 3 月			
			2019 年 3 月-2020 年 3 月	李洳谕	力晶科技委派	力晶科技
			2020 年 4 月-报告期末	李洳谕	发行人员工	发行人
7	内审	审计师	2018 年 1 月-2018 年 5 月	陈美华	力晶科技委派	力晶科技
			2018 年 5 月-2018 年 12 月	潘炯升	力晶科技委派	力晶科技
			2019 年 1 月-2019 年 12 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 12 月-2020 年 4 月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月-报告期末	未设置		
8	行政	副总经理	2018 年 1 月-2018 年 5 月	刘荫	力晶科技委派	力晶科技
			2018 年 5 月-2019 年 10 月	未聘任，由采购总监盛惟健代管		
			2019 年 10 月-2020 年 3 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月-报告期末	朱晓娟	发行人员工	发行人
9	证券	董事会秘书	2020 年 4 月-报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
10	敬业监督	敬业促进委员会委员长	2018 年 1 月-2019 年 11 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2019 年 12 月-2020 年 11 月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 11 月-报告期末	不再为高级管理人员职位		

综上，报告期内，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。

五、 《问询函》第 12.3 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施

根据申报材料：（1）发行人及其子公司无自有房产及土地使用权。目前主要办公场所及全部生产场所为向合肥建投全资子公司合肥蓝科租赁，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁。环保设施由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。（2）2017 年公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》租入厂房及配套厂务设备；2021 年 4 月，公司与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》对晶合二厂及配套设施认定为经营性租赁，同期公司与合肥蓝科签订《收购意向协议》，公司承诺在该项目交付之日起 5 年内完成收购。（3）以融资租赁方式进行核算，报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元。

请发行人说明：（1）厂房租赁合约签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排；（2）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性；……。

请保荐机构、发行人律师对事项（1）-（3）和申报会计师对事项（2）和（4）进行核查并发表明确意见。请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，

充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（一）厂房租赁合约签订的具体考虑，协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

2、协议对厂房及相关土地的权属安排的具体约定及未来的具体安排

2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第一届第六次董事会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》。2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。募投项目变更后，拟使用 31 亿募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，以保证发行人的独立性及资产的完整性。

（二）发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备的内容，各厂房的建设进度和使用情况，发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系，租用协议到期后固定资产的安置方式，结合上述情况具体说明租赁厂房的业务合理性

2、发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系

报告期内，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	
	账面原值	账面价值
固定资产	1,192,519.62	981,761.60
其中：房屋及建筑物	2,914.92	2,672.79
其中：机器设备	1,175,720.18	971,757.33
其中：运输工具	274.08	0.14
其中：电子设备及其他	13,610.44	7,331.34

项目	2021 年 6 月 30 日	
	账面原值	账面价值
融资租入固定资产	187,056.39	158,409.08
其中：房屋及建筑物	186,787.95	158,355.40
其中：电子设备及其他	268.44	53.69
融资租入固定资产占固定资产的比例	15.69%	16.14%
其中：房屋及建筑物	98.46%	98.34%
其中：电子设备及其他	1.93%	0.73%

注：发行人自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，将融资租入固定资产调整计入使用权资产。为保证 2018 年至 2021 年 1-6 月数据可比，上表 2021 年 1-6 月“融资租入固定资产占固定资产的比例”计算方式为融资租入固定资产金额/（固定资产金额+融资租入固定资产金额）

上述租赁厂房及配套厂务设备等计入固定资产的房屋及建筑物、电子设备及其他，不存在租入的在建工程，由于配套厂务设备与厂房密不可分，故作为房屋及建筑物核算。

报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元、161,990.00 万元和 158,409.08 万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。报告期内，上述租赁获得的厂房及配套厂务设备原值占发行人固定资产原值的比例分别为 32.31%、22.53%、19.41%和 15.69%，占发行人固定资产中房屋及建筑物原值的比例分别为 99.95%、98.79%、98.59%和 98.46%，发行人房屋及建筑物主要通过上述租赁方式获得。

六、 《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况

报告期各期末在境内缴纳社会保险、住房公积金的人数为 300 多人，占员工总人数比例 20%以上。

请发行人说明：台湾籍员工的数量、职位分布、劳动合同关系、薪酬支付与社保缴纳主体，与力晶科技是否相独立。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

根据发行人提供的员工名单及工资表、中国台湾籍员工劳动合同、社保缴纳凭证、中国台湾劳务公司代缴劳健保的相关协议并经本所律师与代缴公司确认，报告期内，发行人中国台湾籍员工均与发行人或其子公司签订了劳动合同，由发行人或其子公司承担薪酬，其中主要为制造、研发人员，具体情况如下：

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
台籍员工数量	288	264	299	296
其中：				
研发人员	72	59	64	43
制造人员	165	157	182	200
销售人员	16	15	11	9
管理人员	35	33	42	44

七、 《问询函》第 24 题：关于募投项目

招股说明书披露：（1）本次募集资金将全部投入合肥晶合集成电路股份有限公司 12 英寸晶圆制造二厂项目。本项目利用一厂建设工程项目所建设的 12 英寸集成电路芯片制造二厂厂房主体，建设一条产能为 4 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线，主要产品包括电源管理芯片（PMIC）、显示驱动整合芯片（DDIC）、CMOS 图像传感芯片（CIS），另外，将建设一条微生产线用于 OLED 显示驱动与逻辑工艺技术开发试产。（2）发行人本次募集资金拟投资的“12 英寸晶圆制造二厂项目”目前处于立项阶段，尚需在开工建设前办理环评相关手续。

请发行人说明：（1）募投项目所实现的制程节点情况；结合发行人相关产品的市场需求及竞争状况、技术水平等，分析发行人募投项目未来的市场空间和产能消化能力；（2）4 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线与用于 OLED 显示驱动与逻辑工艺技术开发试产的微生产线之间的关系，新增固定资产折旧摊销额预计对公司未来业绩的影响；（3）募投项目未办理环评相关手续的原因，目前进展情况，是否存在无法获得审批的风险。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对上述事项（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

2021 年 11 月 4 日，合肥新晶集成电路有限公司 12 吋晶圆制造项目已由合肥新站高新技术产业开发区经贸局完成项目备案（项目代码：2111-340163-04-01-543967）。2021 年 11 月 29 日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥新晶集成电路有限公司 12 吋晶圆制造项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12064 号）。

八、 《第二轮问询函》第 5 题：关于实际控制人认定

根据问询回复：（1）2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意，部分事项需要一致批准。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。回复中称合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位；（2）公司董事长提名人为力晶科技；（3）公司高管成员包括行使敬业监督职能的敬业促进委员会委员长，由合肥建投进行委派；（4）回复中列式了报告期内公司高级管理人员的变化情况，但未说明相关人员的提名情况；（5）公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，其中合肥建投指派人员的职责主要为监督。

请发行人说明：（1）结合《合资合同》《公司章程》等相关协议约定，说明董事长的职责及具体产生方式，董事长的提名人为力晶科技的原因，以及在合肥建投委派

董事未达 2/3 情况下合肥国资方委派董事在董事会中占实质主导地位的依据是否充分；（2）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况；（3）报告期内公司高级管理人员的提名情况，是否主要由力晶科技进行提名及主导；（4）结合上述情况，以及曾签署委托经营管理合约、第二大股东从事同类型业务、经营管理委员会等情况，说明公司是否实质为力晶科技控制或合肥市国资委与力晶科技共同控制，发行人最近两年实际控制人是否发生变更，是否通过实际控制人认定进而规避同业竞争。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况

1、行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况

（3）敬业促进委员会人员构成

自 2017 年 9 月敬业促进委员会成立至报告期末，公司敬业促进委员会的人员构成及变化情况具体如下：

日期	委员长	委员			
2017.9 至 2018.5	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	陈美华（审计师）	-
2018.5 至 2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	潘炯升（审计师）	-
2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务	江英和（人力资	林士然（副	-

		室副处长）	源部部经理）	审计师）	
2019.1 至 2019.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2019.12 至 2020.4	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.4 至 2020.8	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.8 至 2021.3	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）
2021.3 至报告期末	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）

（5）报告期内的实际执行情况

报告期内，敬业促进委员会共计召开 14 次会议，均由敬业委员会委员长主持，相关会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
1	2018.6.28	审议一起员工违反公司出勤规定事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予大过 1 次，并追回虚报加班费用及公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
2	2018.7.11	审议一起员工工作能力不足检举事件。各委员依调查结果讨论后，要求该员工所属部门畅通内部沟通管道，以化解工作中存在的问题	处理结果在晶合有限第一届第十七次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
3	2019.1.10	审议一起员工工作能力不足、二起员工违反公司出勤规定及一起员工违反公司住宿规定检举事件。各委员依调	处理结果在晶合有限第一届第二十一次董事会会议中作为报告事项向

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予申诫 1 次、并追回虚报加班费用；违反住宿规定属实者，取消入住公司宿舍权利。以上四起案件公告厂内周知	董事会汇报
4	2019.4.11	审议一起员工作业疏失及一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者给予申诫 1 次，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十二次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
5	2019.6.19	审议二起员工违反工作纪律及一起员工在外行为影响其他同事。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予扣二个月绩效，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
6	2019.9.5	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
7	2019.10.24	审议一起拖欠供应商货款。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
8	2019.12.17	审议一起员工违反工作纪律。各委员依调查结果讨论后，未有违反工作纪律之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
9	2020.1.15	审议一起采购品项不符合招标需求。各委员依调查结果讨论后，检举不属	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		实	会议中作为报告事项向董事会汇报
10	2020.8.27	审议一起采购品项指定单一品牌及一起员工泄露供应商报价。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第二届第四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
11	2020.11.5	审议一起员工违反公司住宿补贴规定。各委员依调查结果讨论后，违反住宿补贴规定属实者给予记过 1 次，并追回虚报住宿补贴及取消领取补贴资格，同时公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
12	2021.1.22	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
13	2021.3.18	审议二起员工违反公司工作纪律。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予解雇，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第五次会议中作为报告事项向董事会汇报
14	2021.5.19	审议二起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者分别给予申诫 1 次和记过 1 次，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第六次会议中作为报告事项向董事会汇报

九、《第二轮问询函》第 7 题：关于无形资产和技术

根据问询回复：（1）2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016

年至 2025 年，截至问询函回复出具日，上述发明专利权中 14 项已到期，但 2018 年和 2019 年末，发行人对无形资产进行了减值测试未发现减值迹象；（2）2018 年导入 90nmM+技术平台；（3）报告期内，发行人向智成电子采购 IP 授权交易分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元，智成电子系力晶科技控制公司。未来发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

请发行人说明：……（3）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（三）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

报告期内，发行人对技术进行持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，并形成了稳定的研发人员团队，团队成员均与发行人直接签署劳动合同。同时，发行人不断将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 71 件，不依赖于力晶科技的研发团队、科研成果及专利和非专利技术，具有独立研发能力。

十、 《第二轮问询函》第 9.2 题

报告期内，报告期内除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

请结合相关法律法规规定说明上述代缴社保相关情形是否符合相关法律法规规定以及对公司的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（四）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜对于发行人经营成果的影响

根据发行人测算，报告期内，发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保、未在中国大陆缴纳社会保险对发行人经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月
发行人为中国台湾籍员工实际缴纳劳健保的金额（a）	468.88	555.63	560.10	**307.08**
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额（b）	1,460.51	1,423.38	413.61	**620.57**
差额（b-a）	991.63	867.75	-146.49	**313.49**
营业总成本（c）	123,918.17	169,998.65	255,660.04	**152,679.28**
发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额占营业总成本的比例（b/c）	**1.18%**	**0.84%**	**0.16%**	**0.41%**
差额占营业总成本的比例 [(b-a)/c]	**0.80%**	**0.51%**	**-0.06%**	**0.21%**

注：2020 年度，国家在疫情期间推出了社保减免政策，因此，发行人应为中国台湾籍员工缴纳社会保险的金额大幅降低。

发行人报告期内应当为中国台湾籍员工在中国大陆缴纳社会保险的金额与发行人为中国台湾籍员工缴纳劳健保的金额的差额占发行人营业总成本的比例分别为 0.80%、0.51%、-0.06%、0.21%，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

十一、 《第二轮问询函》第 9.3 题

公司于 2017 年在日本设立子公司，员工主要来源于 Synaptics 公司，日本晶合所取得的知识产权权益归属于晶合集成。2017 年前后 Synaptics 公司拟进行业务转型，晶合集成获得吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队的机会。

请发行人说明：相关人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

发行人日本子公司吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队，截至 2021 年 6 月 30 日，日本晶合共有 15 名员工，其中 9 名曾任职于 Synaptics 日本子公司。

截至 2021 年 6 月 30 日，日本晶合员工作为发明人、在发行人任职期间自主研发并取得的授权专利共计 12 项，具体情况如下：

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
1	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	中国
2	发行	小嶋英充	发明	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	日

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
	人		专利				本
3	发行人	小嶋英充	发明专利	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	日本
4	发行人	川村昌靖；夏目秀隆；藤井康博；熊谷裕弘	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	日本
5	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	日本
6	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	高耐庄半導体素子及びその製造方法	特许第 6892889 号	2019/04/15	日本
7	北京晶芯成	夏目秀隆；田矢真敏；藤井康博；中野纪夫	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159567.5	2020/10/27	中国
8	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
9	北京晶芯成	大田裕之	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	中国
10	北京晶芯成	藤井康博；李波；陈信全	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	中国
11	北京晶芯成	田矢真敏；石田浩；中野纪夫	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	中国
12	北京晶芯成	小嶋英充；藤井康博	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	中国

日本晶合全体员工均已出具确认函：“本人从原单位离职后加入日本晶合，不存在违反原单位竞业禁止及保密义务或其他约定的情形，亦不存在任何同原单位纠纷或潜在纠纷。”

根据日本律师出具的法律意见书，日本晶合与其他第三方无专利诉讼案件，日本员工与原单位之间不存在诉讼案件。

综上所述，日本子公司相关人员不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果不涉及其原任职单位的技术成果，不存在纠纷或潜在纠纷。

（本页以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

苏 峥

刘东亚

单位负责人：

王 玲

二〇二一 年十二月二十九日

附件一：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	Nexchip	26296999A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
2	晶合集成	Nexchip	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
3	晶合集成	Nexchip	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
4	晶合集成	Nexchip	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
5	晶合集成	晶合	26295138A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
6	晶合集成	晶合	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
7	晶合集成	晶合	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
8	晶合集成	晶合	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
9	晶合集成	晶合集成	26296982A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
11	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
12	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
13	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得
14	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
15	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
16	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
17	晶合集成		36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得

2、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	01919639	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	01923633	25	2018/07/01-2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	01920983	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	01912745	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	01919637	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
22	晶合集成	晶合	01909401	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	01920981	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
24	晶合集成	晶合	01912743	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01-2028/05/31	原始取得	中国台湾
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11-2028/09/10	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
49	晶合有限	Nexchip	018074417	9	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	018074417	35	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	018074417	40	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
52	晶合有限		018073971	9	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限		018073971	35	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限		018073971	40	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
55	晶合有限		018073976	9	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		018073976	35	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		018073976	40	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限		4216333	35	2019/06/25-2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限		4216334	40	2019/06/25-2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限		401605036	35	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限		401605037	40	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成		401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23-2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	Nexchip	40201926832S	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	Nexchip	40201926831T	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	Nexchip	40201926806V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限		40201925814T	35	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成		40201925815S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成		40201926869W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		40201926842V	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		40201926838P	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		40201926847Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
83	晶合集成	Nexchip	TM2019044357	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
84	晶合集成	Nexchip	TM2019044362	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	Nexchip	TM2019044364	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	Nexchip	TM2019045346	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	Nexchip	TM2019045348	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	Nexchip	TM2019045350	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM2019045352	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM2019045355	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM2019045357	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

3、境内专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL201810796277.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL201810897300.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL201810920343.8	2018/08/14	原始取得
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL201810980356.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体管及其制造方	ZL201811237197.5	2018/10/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			法			
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811345719.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811354139.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201910048694.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL201910104747.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	原始取得
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL201910611966.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL201911268173.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL201911303991.X	2019/12/17	原始取得
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL201911326563.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶	ZL202010043997.4	2020/01/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			体管的形成方法			
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202010099798.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数据校正模型的方法	ZL202010219356.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火方法	ZL202010372489.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010454977.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL201820995525.7	2018/06/25	原始取得
29	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装置	ZL201821163226.3	2018/07/23	原始取得
30	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的安装位检测装置	ZL201821130870.0	2018/07/17	原始取得
31	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的定位装置	ZL201821147988.4	2018/07/19	原始取得
32	晶合集成	实用新型	一种气体供应装置	ZL201821192419.1	2018/07/24	原始取得
33	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL201821719617.9	2018/10/22	原始取得
34	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL201821753440.4	2018/10/26	原始取得
35	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL201821957502.3	2018/11/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
36	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL201822002991.3	2018/11/30	原始取得
37	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的不间断储水装置及半导体设备	ZL201920706945.3	2019/05/17	原始取得
38	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL201921016248.1	2019/07/02	原始取得
39	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL201921235650.9	2019/08/01	原始取得
40	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL201921439572.4	2019/09/02	原始取得
41	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL201921604162.0	2019/09/25	原始取得
42	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL201921654723.8	2019/09/30	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL202020368355.7	2020/03/23	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL202020257664.7	2020/03/04	原始取得
45	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除装置	ZL201922312082.4	2019/12/20	原始取得
46	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL202020331150.1	2020/03/16	原始取得
47	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519501.1	2020/04/10	原始取得
48	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519503.0	2020/04/10	原始取得
49	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL202020333222.6	2020/03/17	原始取得
50	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL202020247738.9	2020/03/02	原始取得
51	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL202020404622.1	2020/03/24	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体结构	ZL202020778398.2	2020/05/12	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			及其应用的半导体器件			
53	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL202020252537.8	2020/03/04	原始取得
54	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL202020604243.7	2020/04/21	原始取得
55	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL202020832666.4	2020/05/15	原始取得
56	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL202021137450.2	2020/06/18	原始取得
57	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL202021166959.X	2020/06/22	原始取得
58	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL202021248626.1	2020/06/30	原始取得
59	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL202021282186.1	2020/07/02	原始取得
60	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL202021283661.7	2020/07/03	原始取得
61	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL202021581370.6	2020/08/03	原始取得
62	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL202021618739.6	2020/08/06	原始取得
63	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置和化学机械研磨设备	ZL202021645116.8	2020/08/10	原始取得
64	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202021645079.0	2020/08/10	原始取得
65	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL202021794843.0	2020/08/25	原始取得
66	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL202021873549.9	2020/09/01	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
67	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL202021935217.9	2020/09/03	原始取得
68	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL202022409723.0	2020/10/23	原始取得
69	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL202022619232.9	2020/11/12	原始取得
70	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202010983155.7	2020/09/18	原始取得
71	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011001446.8	2020/09/22	原始取得
72	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL202010998495.7	2020/09/22	原始取得
73	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202011012426.0	2020/09/24	原始取得
74	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL202011021046.3	2020/09/25	原始取得
75	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011019411.7	2020/09/25	原始取得
76	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011039422.1	2020/09/28	原始取得
77	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成方法	ZL202011059138.0	2020/09/30	原始取得
78	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成方法	ZL202011054620.5	2020/09/30	原始取得
79	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011054657.8	2020/09/30	原始取得
80	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方法及其	ZL202011069600.5	2020/10/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			形成的浅沟槽隔离结构			
81	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和表面处理装置	ZL202011069584.X	2020/10/09	原始取得
82	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011069193.8	2020/10/09	原始取得
83	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011073751.8	2020/10/10	原始取得
84	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL202011084965.5	2020/10/12	原始取得
85	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL202011081316.X	2020/10/12	原始取得
86	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL202011106814.5	2020/10/16	原始取得
87	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106813.0	2020/10/16	原始取得
88	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011106699.1	2020/10/16	原始取得
89	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106690.0	2020/10/16	原始取得
90	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106407.4	2020/10/16	原始取得
91	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106406.X	2020/10/16	原始取得
92	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测试结构	ZL202011114851.0	2020/10/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
93	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835.1	2020/10/19	原始取得
94	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387.5	2020/10/19	原始取得
95	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL202011122506.1	2020/10/20	原始取得
96	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	原始取得
97	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL202011121614.7	2020/10/20	原始取得
98	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136464.7	2020/10/22	原始取得
99	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136463.2	2020/10/22	原始取得
100	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	原始取得
101	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL202011135589.8	2020/10/22	原始取得
102	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011135359.1	2020/10/22	原始取得
103	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011160229.3	2020/10/27	原始取得
104	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159567.5	2020/10/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
105	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL202011159566.0	2020/10/27	原始取得
106	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制作方法、DAC 器件及其制作方法	ZL202011159556.7	2020/10/27	原始取得
107	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL202011159377.3	2020/10/27	原始取得
108	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011176040.3	2020/10/29	原始取得
109	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011184712.5	2020/10/30	原始取得
110	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL202011207288.1	2020/11/03	原始取得
111	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011207284.3	2020/11/03	原始取得
112	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011206497.4	2020/11/03	原始取得
113	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制作方法	ZL202011206496.X	2020/11/03	原始取得
114	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213725.0	2020/11/04	原始取得
115	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213310.3	2020/11/04	原始取得
116	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213304.8	2020/11/04	原始取得
117	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制	ZL202011235571.5	2020/11/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			造方法			
118	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位置的监测装置及监测方法	ZL202011235545.2	2020/11/09	原始取得
119	北京晶芯成	发明专利	气体置换装置及光阻烘烤设备	ZL202011243682.0	2020/11/10	原始取得
120	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及其形成方法、半导体器件的测试方法	ZL202011243675.0	2020/11/10	原始取得
121	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及半导体钝化层的质量测试方法	ZL202011242883.9	2020/11/10	原始取得
122	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011251097.5	2020/11/11	原始取得
123	北京晶芯成	发明专利	一种洁净室过滤装置	ZL202011249788.1	2020/11/11	原始取得
124	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011275119.1	2020/11/16	原始取得
125	北京晶芯成	发明专利	一种自动调整半导体设备平衡性的装置及方法	ZL202011283036.7	2020/11/17	原始取得
126	北京晶芯成	发明专利	一种半导体设备的报警方法	ZL202011283029.7	2020/11/17	原始取得
127	北京晶芯成	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	原始取得
128	北京晶芯成	发明专利	一种光学邻近校正模型的建模方	ZL202011359576.9	2020/11/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			法及建模系统			
129	北京晶芯成	发明专利	半导体生产过程中的参数监控方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011367625.3	2020/11/30	原始取得
130	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析方法及良率分析系统	ZL202011384551.4	2020/12/02	原始取得
131	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法及系统	ZL202011419830.X	2020/12/08	原始取得
132	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011424911.9	2020/12/09	原始取得
133	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011565146.2	2020/12/25	原始取得
134	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL202011579234.8	2020/12/28	原始取得
135	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	原始取得
136	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL202110010268.3	2021/01/06	原始取得
137	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL202110010266.4	2021/01/06	原始取得
138	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL202110051576.0	2021/01/15	原始取得
139	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL202110248935.1	2021/03/08	原始取得
140	北京晶芯	发明专利	静态随机存储器	ZL202110252700.X	2021/03/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
	成		的制备方法			
141	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研磨方法及其分析系统	ZL202110281539.9	2021/03/16	原始取得
142	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方法	ZL202110306176.X	2021/03/23	原始取得
143	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL202010931740.2	2020/09/08	原始取得
144	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL202010938526.X	2020/09/09	原始取得
145	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法及检测系统	ZL202010937768.7	2020/09/09	原始取得
146	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件制造方法	ZL202010938519.X	2020/09/09	原始取得
147	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL202010998512.7	2020/09/22	原始取得
148	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011005773.0	2020/09/23	原始取得
149	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构制备方法	ZL202011012959.9	2020/09/24	原始取得
150	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制作方法	ZL202011013439.X	2020/09/24	原始取得
151	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202010937769.1	2020/09/09	原始取得
152	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011021798.X	2020/09/25	原始取得
153	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离	ZL202011019947.9	2020/09/25	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			结构的制造方法			
154	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制造方法	ZL202011019302.5	2020/09/25	原始取得
155	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备方法	ZL202011037143.1	2020/09/28	原始取得
156	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防护线路	ZL202011099926.2	2020/10/15	原始取得
157	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011093528.X	2020/10/14	原始取得
158	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图案的修正方法与修正系统	ZL202011095237.4	2020/10/14	原始取得
159	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其制造方法	ZL202011093599.X	2020/10/14	原始取得
160	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构及测量方法	ZL202011093598.5	2020/10/14	原始取得
161	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的仿真方法及仿真系统	ZL202011135351.5	2020/10/22	原始取得
162	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的检测方法	ZL202011189007.4	2020/10/30	原始取得
163	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取方法以及辅助图形显影情况的检测方法	ZL202011185018.5	2020/10/30	原始取得

4、境外专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having reduced interconnect-line parasitic capacitance	US 6,531,776 B2	2001/08/29	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method for forming stepped contact hole for semiconductor devices	US 6,444,574 B1	2001/09/06	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	US 6,583,055 B1	2002/01/25	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国
9	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			by utilizing alternate phase shift principle				
11	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国
12	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor substrate	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国
20	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
23	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
24	晶合有限	发明专利	Method for	US 8,822,303	2012/09/15	继受	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			manufacturing semiconductor device	B2		取得	
25	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	METHOD OF FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,490,647 B1	2018/08/31	原始取得	美国
27	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
28	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
29	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus	US10,916,417B2	2020/06/16	原始取得	美国
31	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B2	2020/05/21	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B2	2019/06/27	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION	US10,950,601B2	2019/04/15	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			STRUCTURE				
34	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B2	2018/12/17	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF FABRICATING SAME	US11,024,722B1	2020/03/25	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US10,916,664B2	2020/09/19	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
38	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
39	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
40	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	2005/02/16	继受取得	中国台湾
41	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
42	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
46	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体的故障检测方法	I301982	2006/09/28	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
49	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方	I464831	2012/06/27	继受	中国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			法			取得	台湾
50	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	原始取得	日本
52	晶合集成	发明专利	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	原始取得	日本
53	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	原始取得	日本
54	晶合集成	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	原始取得	日本
55	晶合集成	发明专利	高耐庄半導体素子及びその製造方法	特许第 6892889 号	2019/04/15	原始取得	日本

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（五）

致：合肥晶合集成电路股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）、《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）和《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（四）》（以下简称《补充法律意见书（四）》）。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 15 日出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司审计报告》（容诚审字[2022]第 230Z0100 号）（以下简称《2019-2021 年度审计报告》）对公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度（以下简称报告期）财务报表进行审计，并出具了《合肥晶合集成电路股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0082 号）（以下简称《2021 年度内控报告》）。本所现根据《2019-2021 年度审计报告》《2021 年度内控报告》及发行人招股说明书和其他相关申报文件的修改和变动，就其中所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》不可分割的一部分；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》中对相关用语的释义、缩写适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书特别说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市制作的《招股说明书（注册稿）》中自行引用或按照中国证监会、上交所的审核要

求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，出具补充法律意见如下：

目录

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新 370
一、 本次发行上市的批准和授权 370
二、 发行人本次发行上市的主体资格 370
三、 本次发行上市的实质条件 370
四、 发行人的独立性及其变化情况 374
五、 发起人和股东的变化情况 374
六、 发行人的股本及其演变 386
七、 发行人的业务 386
八、 关联交易及同业竞争及其变化情况 387
九、 发行人的主要财产及其变化情况 396
十、 发行人的重大债权债务变化情况 400
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并 405
十二、 发行人公司章程的制定与修改 405
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 405
十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 406
十五、 发行人的税务及其变化情况 407
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况 408
十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况 410
十八、 发行人募集资金的运用 411
十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况 411
二十、 发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价 413
二十一、 本次发行上市的总体结论性意见 413
第二部分 财务数据更新至 2021 年 12 月 31 日后《问询函》中涉及的相关问题回复内容的更新 414
附件一：发行人及其子公司拥有的知识产权 433

第一部分 发行人本次发行上市相关情况的更新

一、 本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的董事会和股东大会的会议文件并经本所律师核查，2022 年 3 月，发行人分别召开第一届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》等相关议案，具体内容如下：

2021 年 3 月 16 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》。根据股东大会审议，本次发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。根据公司本次 A 股股票发行并上市事宜的进展，经董事会研究，拟决定将本次 A 股股票发行并上市方案的有效期延长至：本次议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。原发行上市方案其它内容不变。

本所认为，发行人本次发行上市已获得的批准及授权仍然有效；发行人本次发行尚需上交所科创板股票上市委员会的审核，并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人工商档案资料、《营业执照》《企业信用报告》、合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局出具的证明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），截至本补充法律意见书出具日，发行人仍为合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一）本次发行上市符合《公司法》《证券法》的相关条件

1、根据发行人本次发行上市相关股东大会决议及发行人书面说明，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3、根据《2019-2021 年度审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人及其境内子公司相关主管部门出具的证明及发行人书面说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，不存在因违法经营而被相关主管部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4、根据《2019-2021 年度审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5、根据发行人及其子公司所在地公安机关出具的证明、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

1、如本补充法律意见书第一部分“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会以及相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《2019-2021 年度审计报告》《2021 年度内控报告》和发行人书面说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露

规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2019-2021 年度审计报告》；根据《2021 年度内控报告》和发行人书面说明，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具标准无保留意见的《2019-2021 年度审计报告》，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（1）如本补充法律意见书第一部分“四、发行人的独立性及其变化情况”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本补充法律意见书第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化情况”所述，发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化；如本补充法律意见书第一部分“五、发起人和股东”所述，发行人的股权权属清晰，截至本补充法律意见书出具日，控股股东和受控股股东支配的股东持有的发行人股份权属清晰，最近两年控制权稳定、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本补充法律意见书第一部分“九、发行人的主要财产及其变化情况”“十、发行人的重大债权债务变化情况”及“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策：

（1）如本补充法律意见书第一部分“七、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件和发行人书面说明，经本所律师核查，发行人生产经

营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（2）如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人及其子公司所在地相关政府部门出具的证明文件、发行人控股股东填写的调查表及发行人书面说明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

（3）如本补充法律意见书第一部分“十八、诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况”所述，根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

(三)本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书（注册稿）》，本次发行上市后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书（注册稿）》和本次发行上市相关股东大会决议，发行人股本总额超过 4 亿元，本次发行完成后，发行人公开发行的股份数将达到本次发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据《2019-2021 年度审计报告》、保荐机构出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司预计市值的分析报告》及发行人书面说明，发行人申请本次发行上市，预计市值不低于 30 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元，符合《上市规则》第

2.1.2 条第（四）项规定的市值和财务指标标准及第 2.1.1 条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的独立性及其变化情况

根据发行人提供的业务合同台账、订单台账及重大业务合同、订单等相关文件资料、发行人高级管理人员填写的调查表，并经本所律师审阅发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《2019-2021 年度审计报告》《2021 年度内控报告》等书面材料，以及发行人的确认，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人业务、资产、人员、机构及财务独立性情况未发生变化，发行人资产完整且仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

五、 发起人和股东的变化情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的股东变化情况如下：

1、 惠友豪创

根据惠友豪创的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日日，惠友豪创的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	杨庆	有限合伙人	49000	40.8333%
2	周祥书	有限合伙人	12000	10.0000%
3	杨林	有限合伙人	10000	8.3333%
4	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8800	7.3333%
5	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7200	6.0000%
6	刘晨露	有限合伙人	5000	4.1667%
7	孙义强	有限合伙人	5000	4.1667%
8	深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.1667%
9	深圳市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.1667%

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
10	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5000	4.1667%
11	深圳市创欣诚创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.1667%
12	苏州锦天前程投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1000	0.8333%
13	刘军	有限合伙人	1000	0.8333%
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1000	0.8333%
15	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0%
合计		**-**	**120,000.01**	**100.00%**

深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业（有限合伙）已将其持有惠友豪创的全部出资额转让给王赫，并于 2022 年 1 月 26 日办理完成工商变更。

2、 海通创新

根据海通创新的工商档案，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，海通创新已增资并于 2021 年 12 月 2 日完成工商变更登记，变更后的注册资本为 1,150,000 万元人民币，股东仍为海通证券股份有限公司。

3、 集创北方

根据集创北方的股东名册并经本所律师核查，集创北方的股东结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，集创北方的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	张晋芳	76,687,466	17.7899%
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	41,152,542	9.5467%
3	北京永昌寰宇投资有限公司	28,332,633	6.5727%
4	北京永昌环宇投资中心（有限合伙）	17,158,980	3.9806%
5	北京集智非凡科技中心（有限合伙）	17,888,483	4.1498%
6	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	16,098,932	3.7347%
7	天津海松股权投资合伙企业（有限合伙）	14,809,938	3.4357%
8	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	13,048,091	3.0269%
9	宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限	12,823,803	2.9749%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
	合伙）		
10	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	10,780,579	2.5009%
11	珠海科技创业投资有限公司	10,089,921	2.3407%
12	珠海大横琴创新发展有限公司	10,089,921	2.3407%
13	厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,464,197	1.7316%
14	北京集创寰宇科技中心（有限合伙）	7,394,492	1.7154%
15	维沃移动通信有限公司	6,856,452	1.5906%
16	深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	6,509,036	1.5100%
17	集创芯恒（珠海）科技中心（有限合伙）	5,305,339	1.2308%
18	苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）	5,120,775	1.1879%
19	上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	4,997,900	1.1594%
20	厦门南囿秋风投资合伙企业（有限合伙）	4,847,171	1.1245%
21	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	4,491,908	1.0420%
22	天津海松飞跃股权投资合伙企业（有限合伙）	4,388,130	1.0180%
23	北京欧铼德芯科技中心（有限合伙）	4,080,033	0.9465%
24	哈勃科技创业投资有限公司	4,035,971	0.9363%
25	苏州芯动能显示科技创业投资合伙企业（有限合伙）	3,428,226	0.7953%
26	厦门源峰磐松股权投资合伙企业（有限合伙）	3,428,226	0.7953%
27	思凯（珠海横琴）科技有限公司	3,291,097	0.7635%
28	北京芯动能投资基金（有限合伙）	3,078,990	0.7143%
29	北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）	2,832,861	0.6572%
30	苏州元禾厚望睿芯创业投资合伙企业（有限合伙）	2,742,581	0.6362%
31	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	2,742,581	0.6362%
32	井冈山晨睿股权投资合伙企业（有限合伙）	2,742,581	0.6362%
33	天津海河集睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,742,581	0.6362%
34	集创芯通（珠海）科技中心（有限合伙）	2,615,758	0.6068%
35	集创芯弘（珠海）科技中心（有限合伙）	2,480,200	0.5754%
36	北京晋睿博远科技有限公司	2,400,000	0.5568%
37	欧铼德弘（珠海）科技中心（有限合伙）	2,231,117	0.5176%
38	湖南湘江祥鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	2,216,183	0.5141%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
39	北京丝路华创贰号股权投资中心（有限合伙）	2,125,500	0.4931%
40	厦门新鼎啃哥玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0.4640%
41	无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,796,763	0.4168%
42	集创芯领（珠海）科技中心（有限合伙）	1,665,400	0.3863%
43	嘉兴鼎峰佳创创业投资合伙企业（有限合伙）	1,464,533	0.3397%
44	北京集成电路设计与封测股权投资中信（有限合伙）	1,416,632	0.3286%
45	北京欧铼德芯诚科技中心（有限合伙）	1,383,063	0.3208%
46	辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
47	嘉兴创领隆顺股权投资合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
48	苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
49	三亚星睿壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
50	广德远涧创芯股权投资合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
51	中国互联网投资基金（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
52	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
53	中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	1,371,290	0.3181%
54	深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）	1,332,036	0.3090%
55	欧铼德鑫（珠海）科技中心（有限合伙）	1,252,847	0.2906%
56	北京丝路云和投资中心（有限合伙）	1,227,141	0.2847%
57	集芯领睿（珠海）科技中心（有限合伙）	1,200,962	0.2786%
58	湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）	1,192,806	0.2767%
59	集创芯盛（珠海）科技中心（有限合伙）	1,184,207	0.2747%
60	共青城哲灵丰升投资管理合伙企业（有限合伙）	1,167,896	0.2709%
61	北京汇智合盛电子科技有限公司	1,111,300	0.2578%
62	SK 海力士（无锡）投资有限公司	1,097,032	0.2545%
63	江苏聿泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	1,097,032	0.2545%
64	集创芯美（珠海）科技中心（有限合伙）	1,012,088	0.2348%
65	集创芯兴（珠海）科技中心（有限合伙）	973,433	0.2258%
66	陕西葆晟控股有限公司	934,977	0.2169%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
67	新疆 TCL 股权投资有限合伙	898,382	0.2084%
68	集创芯卓（珠海）科技中心（有限合伙）	852,813	0.1978%
69	芜湖纪源灿辉创业投资合伙企业（有限合伙）	822,774	0.1909%
70	珠海景祥恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	822,774	0.1909%
71	德芯非凡（珠海）科技中心（有限合伙）	814,470	0.1873%
72	珠海景祥宏利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	807,194	0.1873%
73	集芯卓宇（珠海）科技中心（有限合伙）	709,800	0.1647%
74	苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）	708,655	0.1644%
75	欧铼德盛（珠海）科技中心（有限合伙）	691,773	0.1605%
76	平潭宝盛股权投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
77	北京屹唐中艺投资中心（有限合伙）	685,645	0.1591%
78	嘉兴智徽股权投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
79	南京又东华兴创业投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
80	北京兴投优选创业投资基金（有限合伙）	685,645	0.1591%
81	珠海华金尚盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
82	共青城合盛犇犇股权投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
83	无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
84	北京中璟三号股权投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
85	曲水泉禾企业管理有限责任公司	685,645	0.1591%
86	银河芯动能壹号股权投资基金（烟台）合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
87	苏州工业园区中鑫致远投资中心（有限合伙）	685,645	0.1591%
88	珠海鲸芯一号集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	685,645	0.1591%
89	北京芯创科技一期创业投资中心（有限合伙）	650,904	0.1510%
90	宁波瀚澜企业管理合伙企业（有限合伙）	650,904	0.1510%
91	湖南湘江盛世光保股权投资合伙企业（有限合伙）	617,080	0.1432%
92	烟台德泰新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	575,942	0.1336%
93	苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙）	525,506	0.1219%
94	刘宏辉	484,072	0.1123%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
95	天铭京福（台州）创业投资合伙企业（有限合伙）	274,258	0.0636%
96	北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙）	212,828	0.0494%
合计		**431,065,156**	**100%**

4、 合肥晶炯

根据合肥晶炯的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶炯的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶炯的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例	在发行人处任职情况
1	蔡国智	有限合伙人	575	25.5091%	董事长
2	蔡辉嘉	有限合伙人	510	22.6254%	总经理
3	邱显寰	有限合伙人	380	16.8582%	副总经理
4	李泇谕	有限合伙人	200	8.8727%	协理
5	黄晋德	有限合伙人	148	6.5658%	业务一处技术处长
6	林士然	有限合伙人	100	4.4364%	深圳办公室主任
7	王建智	有限合伙人	40	1.7745%	先进整合后端组经理
8	许嘉哲	有限合伙人	36	1.5971%	产品工程处技术副理
9	吴建宏	有限合伙人	30	1.3309%	微影开发部副理
10	古哲安	有限合伙人	20	0.8873%	制程一课副理
11	田俊鹏	有限合伙人	16	0.7098%	系统课副理
12	黄浩玮	有限合伙人	16	0.7098%	先进整合一组技术副理
13	林政纬	有限合伙人	16	0.7098%	制程二课副理
14	吴家頫	有限合伙人	16	0.7098%	制程二课副理
15	蔡汉郅	有限合伙人	12	0.5324%	设备自动化课副理
16	邱一峯	有限合伙人	12	0.5324%	空调课技术副理
17	郑子锋	有限合伙人	12	0.5324%	设备一课技术副理
18	苏耕乐	有限合伙人	12	0.5324%	逻辑一课技术副理
19	毛泽民	有限合伙人	12	0.5324%	业务二课技术副理
20	沈俊明	有限合伙人	12	0.5324%	制程一课技术副理
21	柯孟志	有限合伙人	10	0.4436%	制造部技术副理
22	陈思皓	有限合伙人	10	0.4436%	缺陷改善课副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例	在发行人处任职情况
23	简瑞荣	有限合伙人	10	0.4436%	协理
24	陈依柏	有限合伙人	8	0.3549%	故障分析课主任工程师
25	王振择	有限合伙人	8	0.3549%	制造二课主任工程师
26	张正一	有限合伙人	7.9	0.3505%	量测技术部经理
27	张琳琳	有限合伙人	5	0.2218%	故障分析课主任工程师
28	江冬冬	有限合伙人	5	0.2218%	扩散生产科生产线主任
29	李晗飞	有限合伙人	5	0.2218%	制造二课主任工程师
30	翟伟	有限合伙人	5	0.2218%	设备三课主任工程师
31	张振华	有限合伙人	5	0.2218%	设备一课主任工程师
32	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0089%	/
合计			**2,254.1**	**100%**	-

5、 合肥晶本

根据合肥晶本的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶本的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶本的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	张润生	有限合伙人	12	2.6019%	制程一课技术副理
2	计豪	有限合伙人	12	2.6019%	营运系统课技术副理
3	王厚有	有限合伙人	12	2.6019%	制程一课副理
4	邢志同	有限合伙人	12	2.6019%	设备二课副理
5	凌军	有限合伙人	12	2.6019%	制造信息课技术副理
6	刘秀梅	有限合伙人	12	2.6019%	光学模型组技术副理
7	李强	有限合伙人	12	2.6019%	制程供应课技术副理
8	彭萍	有限合伙人	12	2.6019%	制程一课技术副理
9	詹霄飞	有限合伙人	12	2.6019%	逻辑二课副理
10	杨排	有限合伙人	12	2.6019%	营运系统课技术副理
11	顾炜	有限合伙人	12	2.6019%	大客户课技术副理
12	祝进专	有限合伙人	10	2.1683%	逻辑一课副理
13	王梦慧	有限合伙人	10	2.1683%	制程开发课代副理
14	严俊生	有限合伙人	10	2.1683%	保安课代副理
15	涂程林	有限合伙人	10	2.1683%	制程一课副理

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
16	汪高生	有限合伙人	10	2.1683%	网络系统课副理
17	刘波	有限合伙人	10	2.1683%	洁净及化学分析课副理
18	邵迎亚	有限合伙人	10	2.1683%	整合一课代副理
19	徐东东	有限合伙人	10	2.1683%	大数据分析课副理
20	童佳佳	有限合伙人	10	2.1683%	环保课代副理
21	金良民	有限合伙人	10	2.1683%	行政系统课副理
22	蔡永霞	有限合伙人	10	2.1683%	品质体系稽核课副理
23	李倩娣	有限合伙人	10	2.1683%	平台课副理
24	简瑞荣	有限合伙人	10	2.1683%	协理
25	封瑞	有限合伙人	10	2.1683%	工业工程二课主任工程师
26	张海英	有限合伙人	8	1.7346%	网络系统课主任工程师
27	王冰	有限合伙人	8	1.7346%	客户工程二部代部经理
28	唐昌玉	有限合伙人	8	1.7346%	工业工程一课副理
29	冯维	有限合伙人	8	1.7346%	物管部副理
30	李青	有限合伙人	8	1.7346%	资源课主任工程师
31	张倩倩	有限合伙人	8	1.7346%	行政系统课主任工程师
32	巫瑶瑶	有限合伙人	8	1.7346%	生产管理课主任工程师
33	未东洋	有限合伙人	8	1.7346%	经营与营运系统部主任工程师
34	高亮	有限合伙人	8	1.7346%	系统课副理
35	徐国宝	有限合伙人	8	1.7346%	营运系统课主任工程师
36	田春	有限合伙人	8	1.7346%	资安室主任工程师
37	胡旺能	有限合伙人	8	1.7346%	制造部主任工程师
38	张兴才	有限合伙人	8	1.7346%	厂务课副理
39	檀翠琴	有限合伙人	8	1.7346%	经营系统课技术副理
40	刘伟	有限合伙人	8	1.7346%	网络系统课主任工程师
41	黄风	有限合伙人	8	1.7346%	制造一课主任工程师
42	夏海峰	有限合伙人	8	1.7346%	应急管理课主任工程师
43	丁超	有限合伙人	8	1.7346%	制造二课技术副理
44	周静	有限合伙人	8	1.7346%	经营系统课主任工程师
45	黄玉	有限合伙人	8	1.7346%	制造二课主任工程师
46	郑兴华	有限合伙人	8	1.7346%	营运系统课主任工程师
47	唐鹤飞	有限合伙人	8	1.7346%	网络系统课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
48	葛礼玉	有限合伙人	8	1.7346%	平台服务课主任工程师
49	黎翠绫	有限合伙人	5	1.0841%	企业规划室资深处长
50	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0434%	/
合计			**461.2**	**100%**	-

6、 合肥晶辽

根据合肥晶辽的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶辽的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶辽的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	许凯迪	有限合伙人	12	4.0789%	自动化系统课技术副理
2	王曼真	有限合伙人	12	4.0789%	制程三课副理
3	钟尚仁	有限合伙人	12	4.0789%	气体化学课技术副理
4	林胜雄	有限合伙人	12	4.0789%	制程供应课副理
5	刘志铭	有限合伙人	12	4.0789%	系统整合课副理
6	陈宏玮	有限合伙人	12	4.0789%	制程一课副理
7	曾凯慧	有限合伙人	12	4.0789%	解析设备课副理
8	翁文杰	有限合伙人	12	4.0789%	制程二课技术副理
9	曾盟善	有限合伙人	12	4.0789%	制程二课技术副理
10	蔡煇堂	有限合伙人	12	4.0789%	layout课副理
11	黄晋德	有限合伙人	12	4.0789%	业务一处资深处长
12	吴德刚	有限合伙人	10	3.3990%	工业工程二课副理
13	林宗晔	有限合伙人	10	3.3990%	设备信息课副理
14	何瑞凤	有限合伙人	10	3.3990%	基准情报一课代副理
15	蔡孟孺	有限合伙人	10	3.3990%	客户工程一部副理
16	简瑞荣	有限合伙人	10	3.3990%	协理
17	黄绍铭	有限合伙人	8	2.7192%	制程一课技术副理
18	丘卓册	有限合伙人	8	2.7192%	空调课主任工程师
19	黄任逢	有限合伙人	8	2.7192%	设备一课主任工程师
20	林宏展	有限合伙人	8	2.7192%	设备一课主任工程师
21	张建烜	有限合伙人	8	2.7192%	空调课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
22	刘铭哲	有限合伙人	8	2.7192%	设备二课技术副理
23	林子荏	有限合伙人	8	2.7192%	制程一课技术副理
24	张家玮	有限合伙人	8	2.7192%	逻辑一课主任工程师
25	江承达	有限合伙人	8	2.7192%	量测制程课主任工程师
26	蔡志宏	有限合伙人	8	2.7192%	安环体系课副理
27	刘凯文	有限合伙人	8	2.7192%	制程二课技术副理
28	蔡明洋	有限合伙人	8	2.7192%	制程一课技术副理
29	汤志英	有限合伙人	8	2.7192%	电力课主任工程师
30	张伟墐	有限合伙人	8	2.7192%	N1厂厂长
31	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0680%	/
合计			**294.2**	**100%**	-

曾凯慧、林胜雄已将其持有合肥晶辽的全部出资份额转让给蔡信裕、王曼真，并于 2022 年 3 月 5 日办理完成工商变更。

7、 合肥晶妥

根据合肥晶妥的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶妥的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶妥的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	黄晋德	有限合伙人	15	6.2448%	业务一处资深处长
2	崔洁	有限合伙人	5	2.0816%	平台服务课主任工程师
3	柯焱	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
4	张东杰	有限合伙人	5	2.0816%	设备信息课主任工程师
5	彭涛	有限合伙人	5	2.0816%	工业工程二课主任工程师
6	孙航海	有限合伙人	5	2.0816%	设备信息课主任工程师
7	张静	有限合伙人	5	2.0816%	先进整合一组主任工程师
8	储挺进	有限合伙人	5	2.0816%	Methodology 课主任工程师
9	葛键	有限合伙人	5	2.0816%	流程整合组主任工程师
10	孟娟	有限合伙人	5	2.0816%	技术一课主任工程师
11	王丽雅	有限合伙人	5	2.0816%	失效分析课代副理
12	目晶晶	有限合伙人	5	2.0816%	可靠性工程课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
13	张国庆	有限合伙人	5	2.0816%	设备一课主任工程师
14	丁璇璇	有限合伙人	5	2.0816%	行政与网络系统部主任工程师
15	俞佩佩	有限合伙人	5	2.0816%	失效分析课主任工程师
16	王云龙	有限合伙人	5	2.0816%	消防管理课主任工程师
17	黎翠绫	有限合伙人	5	2.0816%	企业规划室资深处长
18	许飞	有限合伙人	5	2.0816%	制程开发课主任工程师
19	周芹芹	有限合伙人	5	2.0816%	营运系统课主任工程师
20	马忠祥	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑一课代副理
21	刘利娟	有限合伙人	5	2.0816%	制程品质工程课主任工程师
22	颜传奇	有限合伙人	5	2.0816%	安环体系课主任工程师
23	叶秀平	有限合伙人	5	2.0816%	总经理室主任管理师
24	葛祥福	有限合伙人	5	2.0816%	制程品质工程课主任工程师
25	宋明明	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑三课主任工程师
26	谢烈翔	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑三课主任工程师
27	吴俊	有限合伙人	5	2.0816%	行政系统课主任工程师
28	徐恩杰	有限合伙人	5	2.0816%	网络系统课主任工程师
29	陈国彬	有限合伙人	5	2.0816%	制程品质工程课主任工程师
30	马成	有限合伙人	5	2.0816%	经营管理组主任工程师
31	郝利兰	有限合伙人	5	2.0816%	洗净工程部主任工程师
32	谭倩倩	有限合伙人	5	2.0816%	经营与营运系统部主任工程师
33	操梦雅	有限合伙人	5	2.0816%	先进整合一组主任工程师
34	李磊	有限合伙人	5	2.0816%	风险控制部主任工程师
35	曹文强	有限合伙人	5	2.0816%	经营系统课主任工程师
36	侯丹丹	有限合伙人	5	2.0816%	制成品质工程课主任工程师
37	高创	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
38	李波	有限合伙人	5	2.0816%	逻辑二课代副理
39	韩小琴	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
40	吕玉波	有限合伙人	5	2.0816%	供应商管理科主任工程师
41	王博	有限合伙人	5	2.0816%	出货品质保证课主任工程师
42	程洋	有限合伙人	5	2.0816%	核心技术一部代副理
43	马婷	有限合伙人	5	2.0816%	元件二课代副理
44	郑鹏	有限合伙人	5	2.0816%	设备一课主任工程师

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
45	张永仓	有限合伙人	5	2.0816%	制程一课主任工程师
46	王琳	有限合伙人	5	2.0816%	安环体系课主任工程师
47	合肥晶策	普通合伙人	0.2	0.0833%	/
合计			**240.2**	**100%**	**-**

8、 合肥晶雄

根据合肥晶雄的合伙协议及工商档案并经本所律师核查，合肥晶雄的合伙人结构发生变更。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥晶雄的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人处任职情况
1	黄南翔	有限合伙人	35.999936	23.9680%	生管物管部代经理
2	陈文璟	有限合伙人	20.0000312	13.3156%	制程整合部副理
3	李维泽	有限合伙人	11.9999286	7.9893%	制程一课技术副理
4	简瑞荣	有限合伙人	10.0000156	6.6578%	协理
5	陈欣蕙	有限合伙人	7.9999524	5.3262%	元件一课技术副理
6	蔡君正	有限合伙人	7.9999524	5.3262%	先进整合前端组技术副理
7	陈佳局	有限合伙人	6.0000394	3.9947%	经营系统课副理
8	萧凯彰	有限合伙人	6.0000394	3.9947%	水处理课副理
9	赖韦伶	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	制程整合技术处主任工程师
10	姚怡雯	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	核心技术二部主任工程师
11	陈俊雄	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	统计设备管制课代副理
12	葛年翔	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	制程二课主任工程师
13	沈丞伟	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	设备二课主任工程师
14	郑淙徽	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	量测设备课主任工程师
15	林岳煌	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	扩散生产课主任工程师
16	李奇威	有限合伙人	5.0000078	3.3289%	薄膜生产课生产线主任
17	黄晋德	有限合伙人	2.9999446	1.9973%	业务一处资深处长
18	郭千琦	有限合伙人	1.0000316	0.6658%	模型器件组技术副理
19	合肥晶策	普通合伙人	0.2000664	0.1332%	/
合计			150.2	10%	-

根据发行人的股东名册、发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意

见书出具日，除上述变化外，发行人的股东未发生其他变化。本所律师认为，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、 发行人的股本及其演变

根据发行人提供的股东名册、本所律师对发行人股东的补充问卷调查、发行人的工商档案、《公司章程》及发行人确认，并经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的股份结构未发生变化。

根据发行人股东的补充问卷调查确认、发行人说明，并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），截至本补充法律意见书出具日，发行人股东所持发行人的股份未设置质押。

七、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

根据发行人持有的《营业执照》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的经营方式和经营范围未发生变化。

发行人境内子公司情况详见本补充法律意见书之“0 发行人的主要财产及其变化情况”之“0 发行人的子公司”。

根据发行人及其子公司所在地工商、税务等相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规的规定，已经取得经营所需的相关业务资质及许可。

（二）境外业务

根据《2019-2021 年度审计报告》、发行人提供的工商资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人拥有 1 家境外子公司（日本晶合），主要从事集成电路设计服务及技术开发。发行人境外子公司的具体情况详见律师工作报告“十、发行人的主要财产”之“（五）发行人的子公司”。

（三）发行人的主营业务

根据《招股说明书（注册稿）》《2019-2021 年度审计报告》，截至本补充法律意见书出具日，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务。发行人的主营业务未发生变化。

（四）主要业务资质和许可

经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人新取得的主要经营资质证书情况如下：

资质名称	持证主体	证书/登记编号	授予单位/登记机关	有效期限
辐射安全许可证	新晶集成	皖环辐证[A0813]	安徽省生态环境厅、合肥市生态环境局	2022 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 3 日
排污许可证	发行人	91340100343821433Q001W	合肥市生态环境局	2022 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 3 日
排污许可证	新晶集成	91340100MA8N4PFB89001V	合肥市生态环境局	2022 年 2 月 11 日至 2027 年 2 月 10 日

（五）发行人的持续经营能力

根据发行人最新的《营业执照》《2019-2021 年度审计报告》及发行人确认，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

（六）发行人合作研发的相关情况

根据发行人与相关合作方签订的协议和发行人书面说明，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人正在从事的合作研发项目情况未发生变化。

八、 关联交易及同业竞争及其变化情况

（一）关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并经本所律师核查，2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人的主要关联方变化如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的控股股东仍为合肥建投，实际控制人仍为合肥市国资委，未发生变化。

2、发行人的控股股东直接或间接控制的其他企业的变化情况

发行人控股股东合肥建投直接或间接控制的其他企业为发行人的关联方。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人控股股东新增加的直接或间接控制的其他主要企业情况如下：

序号	企业名称	成立时间	注册地址	经营范围
1	合肥建新投资有限公司	2020 年 2 月 20 日	合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢 604、605 室	项目投资。

3、发行人的控股子公司的变化情况

2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人新设一家控股子公司新晶集成。截至 2021 年 12 月 31 日，新晶集成的基本情况如下表所示：

公司名称	合肥新晶集成电路有限公司
住所	合肥市新站区综合保税区内西淝河路 88 号
法定代表人	周义亮
注册资本	400,000 万元

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的变化情况

2021 年 11 月 26 日，合肥建投向晶合集成发出《关于调整晶合公司董事人选的函》，推荐陈小蓓担任公司董事，接任黄颢的董事职务。2021 年 12 月，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司更换董事的议案》，同意选举陈小蓓为公司董事。此外，与上述人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织的变化情况

由于陈小蓓于 2021 年 12 月被选举为发行人董事，陈小蓓及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织为发行人新增关联方，截至 2021 年 12 月 31 日，该等法人或其他组织情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥建投	陆勤航担任董事兼总经理、陈小蓓担任董事兼副总经理兼董事会秘书
2	启迪控股股份有限公司	陆勤航担任董事
3	合肥建投资本管理有限公司	陈小蓓担任董事
4	安徽省合肥联合发电有限公司	陈小蓓担任董事
5	合肥通航控股有限公司	陈小蓓担任董事
6	合肥市大数据资产运营有限公司	陈小蓓担任董事
7	合肥高特佳创业投资有限责任公司	陈小蓓担任董事
8	合肥丰乐种业股份有限公司	陈小蓓担任董事
9	合肥中科微电子创新中心有限公司	陈小蓓担任董事
10	合肥百货大楼集团股份有限公司	陈小蓓担任董事

序号	关联方名称	关联关系说明
11	合肥京东方显示技术有限公司	陈小蓓担任董事长
12	合肥维信诺科技有限公司	陈小蓓担任董事
13	蔚来控股有限公司	陈小蓓担任董事
14	合肥德轩投资管理有限公司	陈小蓓担任董事

6、直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织的变化情况

截至 2021 年 12 月 31 日，直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织未发生变化。

7、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织的变化情况

截至 2021 年 12 月 31 日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织增加 2 家，相关情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	杭州矗元企业管理合伙企业（有限合伙）	力晶科技直接或间接控制
2	宏丽数位创意股份有限公司	力晶科技直接或间接控制

8、直接控制上市公司的法人的董事、监事、高级管理人员及其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的变化情况

（1）直接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员的变化情况

直接控制发行人的法人为合肥建投，截至 2021 年 12 月 31 日，合肥建投的董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	黄颢	原担任合肥建投董事兼副总经理，已不再担任任何职务
2	陈小蓓	原担任合肥建投董事，现兼任副总经理、董事会秘书
3	吴子能	原担任合肥建投董事，现兼任副总经理

序号	关联方姓名	关联关系说明
4	杨雪蕾	原担任合肥建投董事，现兼副总经理
5	田胜彬	原担任合肥建投监事，现兼副总经理

（2）前述关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织的变化情况

前述关联自然人中，陈小蓓亦系发行人董事；吴子能、杨雪蕾原系发行人的关联自然人，截至 2021 年 12 月 31 日，其控制或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织范围未发生变化；田胜彬担任董事、高级管理人员的法人或其他组织新增 2 家，相关情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	合肥市住房租赁发展股份有限公司	田胜彬担任董事
2	合肥市综合管廊投资运营有限公司	田胜彬担任董事

9、其他关联方

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括其他根据《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定认定的关联方。

10、关联方信息披露

根据发行人的书面说明，并经本所律师核查，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会的相关规定认定并披露关联方。

11、注销或转让重要关联方

根据发行人控股股东填写的调查表和发行人的书面说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在注销或转让的子公司，亦不存在与发行人存在关联交易的关联方注销或转让的情形。

（二）关联交易

根据《2019-2021 年度审计报告》和发行人书面说明，并经本所律师核查，2021

年度，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：

1、 向关联方采购商品及接受服务

2021 年度，发行人向关联方采购商品及接受服务的相关情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	
		金额	占当期营业成本的比例
合肥燃气	采购燃气	596.20	0.20%
合肥供水	采购厂区用水	633.39	0.21%
智成电子	采购服务	784.48	0.26%
合肥租赁	房屋租赁	142.80	0.05%
关联采购合计		**2,156.87**	**0.72%**

2021 年度，发行人向合肥供水、合肥燃气采购厂区用水、燃气的价格与合肥供水、合肥燃气向第三方销售的价格一致；发行人向智成电子采购服务为授权许可知识产权（IP），双方定价模式与发行人与其他同类供应商的定价模式一致，且价格处于同类供应商报价范围区间内。

综上，本所认为，发行人与关联方之间的上述关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2、 向关联方销售商品及提供服务

2021 年度，发行人向关联方销售商品及提供服务的相关情况如下：

关联方	关联交易内容	2021 年度	
		金额	占当期营业收入的比例
晶相光电	销售商品	6.23	0.00%

3、 关联租赁

发行人因经营需要向关联方合肥蓝科租赁土地、厂房及厂务设施，均位于安徽省合肥市瑶海区综合保税区内西淝河路 88 号，为发行人的注册地及主要办公场所。

发行人于 2021 年 1 月 1 日实施新租赁准则，按照新租赁准则相关要求，发行人将上述租入的土地、厂房及配套厂务设备调整计入使用权资产，相关负债调整计入租赁负债，发行人 2021 年度与土地、厂房及配套厂务设备相关的租赁负债增减变动情况列示如下：

单位：万元

关联方	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
合肥蓝科	-	188,444.99	188,444.99	174,353.91	16,349.88	346,449.02

本所认为，合肥蓝科系依据合肥市人民政府相关政策向公司出租厂房，租赁价格虽低于市场价格，但公司已按照相应会计准则进行会计处理，该等关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

4、 关联担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
合肥建投	华泰资产	130,000.00	2018/9/28	2028/9/27	否	是
		30,000.00	2018/10/30	2028/10/29	否	是
		42,000.00	2018/11/8	2028/11/7	否	是
		90,000.00	2019/7/18	2029/7/17	否	是
		8,000.00	2019/8/29	2029/8/28	否	是
	平安银行合肥分行	78,740.00	借款发放日	2027/10/10	否	是
	兴业银行合肥分行	16,806.00	借款发放日	2028/1/7	否	是
		47,000.00	借款发放日	2027/10/10	否	是

担保方	出借人	借款余额（含一年内到期的长期借款）	借款日期	到期日	担保是否已经履行完毕	是否提供反担保
	中国银行北城支行	67,397.69	借款发放日	2028/1/15	否	是
		23,170.73	2021/3/19	2027/10/10	否	是

截至 2021 年 12 月 31 日，根据发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订的《反担保合同》及《反担保合同补充协议》，发行人已就合肥市建设投资控股（集团）有限公司为发行人上述借款的担保提供反担保。

2021 年 7 月 1 日，发行人与合肥市建设投资控股（集团）有限公司签订《动产浮动抵押合同》，约定合肥市建设投资控股（集团）有限公司对于发行人所有的晶合一期 5 万片月产能所对应的机器设备及原物料中海关监管期限已届满的部分有权变卖处分和优先受偿，对于抵押人其余在海关监管期限内的机器设备及原物料，在海关监管期限届满后合肥市建设投资控股（集团）有限公司自动享有前述权利。

2021 年 8 月 5 日，合肥市建设投资控股（集团）有限公司对本公司所有的海关监管期限届满的部分机器设备办理了抵押登记，已办理抵押登记的机器设备于 2021 年 12 月 31 日的账面原值、累计折旧及账面价值如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	330,178.75	132,341.26	197,837.49

5、 关联方资金拆借

2021 年度，发行人未发生与关联方资金拆借的情形。

6、 关键管理人员薪酬

2021 年度，发行人向关键管理人员支付薪酬，关联交易金额为 2,168.94 万元。

7、 关联方往来余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	李泇谕	1.16	-
其他应收款	合肥燃气	40.00	-
其他应收款	智成电子	0.06	0.003
其他应收款	合肥租赁	21.90	-

（2）应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 12 月 31 日
其他应付款	蔡辉嘉	0.51
其他应付款	周义亮	0.10
其他应付款	简瑞荣	0.38
其他应付款	邱显寰	0.34
其他应付款	蔡国智	0.17
其他应付款	合肥蓝科	129.91
其他应付款	晶相光电	1,821.97
应付账款	合肥燃气	57.90
应付账款	智成電子	583.47
应付账款	合肥供水	13.36
租赁负债	合肥蓝科	346,449.02

注：上表中晶相光电他应付款系晶相光电缴纳的产能保证金；合肥蓝科租赁负债系发行人向合肥蓝科租赁厂房及配套厂务设备形成，具体情况详见本补充法律意见书之“0 关联交易及同业竞争及其变化情况”之“0 关联交易”之“3、关联租赁”。

根据《2019-2021 年度审计报告》、发行人相关会议资料、发行人的书面说明，并经本所律师核查，上述报告期内发生的发行人关联方与发行人所发生的关联交易，交易价格及条件均符合公允原则，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（三）同业竞争

截至本补充法律意见书出具日，发行人从事 12 英寸晶圆代工业务。根据合肥建投提供的对外投资企业清单并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站等方式进行核查，合肥建投除投资发行人外，未控制其他从事晶圆代工业务的公司，合肥建投及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

（四）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人已在《招股说明书（注册稿）》中对有关减少和规范关联交易的措施及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

九、 发行人的主要财产及其变化情况

（一）土地使用权和房屋所有权变化情况

1、自有物业

截至本补充法律意见书出具日期间，发行人无自有物业。

2、租赁物业

经发行人确认并经本所律师核查发行人及其子公司的租赁协议及租赁物业产权证明，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司承租用于办公、生产经营的房产共计 4 处，面积合计约 215,785.43 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限	用途
1	晶合集成	合肥蓝科	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号	215,270.61	2017 年 6 月 28 日至 2037 年 6 月 27 日	生产办公
2	上海晶合	上海莘泽创业投资管理股份	上海市浦东新区区盛夏路 608 号 3 幢 5 层 502 室	141.15	2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	办公

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限	用途
		有限公司				
3	日本晶合	マスター・プロパティーズ株式会社	東京都立川市喀町一丁目 13 番 11 号	242.71	2021 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日	办公
4	晶合集成	深圳市唐庄实业有限公司	深圳市福田区深南西路车公庙工业区	130.96	2021 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日	办公

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人不存在租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产的情形。

（二）在建工程

根据《2019-2021 年度审计报告》《招股说明书（注册稿）》以及发行人书面说明，截至本补充法律意见出具日，发行人的在建工程主要为公司新购置待安装机台设备。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人在建工程的账面余额为 332,905.83 万元。

（三）商标、专利等无形资产变化情况

1、注册商标

根据发行人提供的《商标注册证》、商标注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册商标相关事宜的确认函》、国家知识产权局出具的《商标初步审定公告》，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 113 项注册商标，其中，在中国境内注册的商标 22 项，在中国境外注册的商标 91 项，该等商标的具体情况详见本补充法律意见书附件。

2、注册专利

根据发行人提供的专利证书等相关文件、专利注册代理机构出具的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于中国境外注册专利相关事宜的确认函》、国家知识产权局查册结果并查询国家知识产权局综合服务平台专利检索及分析系统（http://pss-system.cnipa.gov.cn），并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司在中国境内共拥有 198 项已授权专利，在中国境外共拥有 58 项已授权专利。该等专利注册的具体情况详见本补充法律意见附件。

3、集成电路布图设计

根据发行人提供的《集成电路布图设计登记证书》、国家知识产权局网站的查询结果，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合法拥有集成电路布图设计专有权 1 项，具体情况如下：

序号	权利人	设计名称	申请号	申请日
1	晶合集成	90FCIS_1.32V_3.3V ESD sample layout	21560372.9	2021/08/20

4、互联网域名

截至 2021 年 12 月 31 日，根据发行人提供的域名证书，并经本所律师核查工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（http://beian.miit.gov.cn），发行人及其子公司拥有的域名情况没有发生变化。

5、发行人使用的授权许可知识产权（IP）

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司新取得的授权许可知识产权（IP）情况如下：

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
1	力旺电子股份有限公司	单次可编程（反熔丝）技术	设计服务费及权利金等	2021年8月10日-2026年8月9日
		单次可编程（反熔	设计服务费及	2021年8月10日-

序号	合同相对方	授权内容	合同金额或定价依据	有效期限
		丝）技术	权利金等	2026年8月9日
2	智成电子	110纳米标准单元库	量产权利金	2021年7月1日-2022年12月31日
3	珠海创飞芯科技有限公司	90单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用	2021年8月2日起至达成新协议前永久有效
		110单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用	2021年6月1日-2026年5月31日
		90单次可编程（反熔丝）技术	授权产品的使用提成费用	2021年8月2日-2026年8月1日
4	IMEC VZW	28纳米集成电路IP	分期支付使用费	2021年12月23日-2023年6月23日

（四）主要生产经营设备

根据《审计报告》、重大生产经营设备的购置合同、履行凭证及发行人说明，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。截至2021年12月31日，机器设备的账面价值为1,618,943.07万元、电子设备及其他的账面价值为11,002.59万元、运输工具的账面价值为0.07万元。

（五）发行人的子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人拥有北京晶芯成、南京晶驱、日本晶合、新晶集成4家控股子公司，其中新晶集成的情况发生变化，具体情况如下：

2021年12月20日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新晶集成增资扩股案的议案》，新晶集成拟引入外部投资人筹集资本金。

2021年12月31日，合肥市国资委出具《关于同意对合肥新晶集成电路有限公司增资扩股的批复》（合国资产权[2021]124号），同意采用非公开交易方式引入合作方

对新晶集成合计增资 60 亿元。增资后，发行人持有新晶集成 52.02%股权，合作方持有 47.98%的股权，新晶集成仍为发行人控股子公司。

发行人及新晶集成已与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议》；合肥建投及新晶集成已与前述投资人签订《增资协议之补充协议》；前述增资协议对应的 49 亿元认购款已实际缴纳，尚待与其他投资人完成增资协议的签署并完成剩余 11 亿元认购款的缴纳及本次增资的工商变更。

（六）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人提供的相关债权合同、担保合同、不动产登记簿、经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司主要财产存在权利受限的情况未发生重大改变。

十、 发行人的重大债权债务变化情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的重大债权债务变化情况如下：

（一）重大合同的变化情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人新增的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同如下：

1、 销售合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大的客户新签署的重大销售合同情况如下：

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	集创北方	2021/12/25-	150nm、110nm、	102,669.11	正在履行

序号	供应主体	客户	有效期/订单日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
			2026/12/31	90nm、55nm、40nm 等晶圆代工产能预约	万元产能预约金	
2	晶合集成	敦泰电子股份有限公司	2021/10/25-2026/12/31	150nm、110nm、55nm 晶圆代工产能预约	1,385.10 万美元	正在履行
3	晶合集成	深圳天德钰科技股份有限公司	2021/12/30-2026/12/31	110nm、90nm、55nm、40nm 晶圆代工产能预约	50,890.04 万元产能预约金	正在履行
4	晶合集成	奕力科技股份有限公司	2021/10/01-2022/12/31	110nm 晶圆代工预约	/	正在履行
5	晶合集成	奇景光电股份有限公司	2021/11/01-2026/12/31	150nm、110nm、90nm、55nm 晶圆代工产能预约	3,821.85 万美元	正在履行

2、 采购合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司与报告期各期前五大原材料供应商新签署的重大采购合同情况如下：

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
1	晶合集成	Applied Materials South East Asia Pte. Ltd	2021/11/25	零部件	75.84 万美元	正在履行

序号	采购主体	供应商	签订日期	合同标的	合同金额	目前履行情况
2	晶合集成	Wah Lee Industrial Corp.	2021/07/14	化学品	103.60 万美元	正在履行

3、 借款合同

根据发行人提供的相关文件及说明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司新签订的重大授信、借款及担保合同如下：

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
1	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/11/01	50 亿元授信	2021/11/01-2022/10/31	正在履行	合肥建投为 50 亿授信中的 11 亿元提供担保
2	晶合集成	平安银行合肥分行	2021/12/21	3,000 万美元借款	2021/12/21-2022/03/20	已履行	-
3	晶合集成	兴业银行合肥分行	2021/12/15	19 亿元授信	2021/12/15-2022/12/09	正在履行	合肥建投提供最高额为 7 亿元的担保
4	晶合集成	兴业银行合肥分行	2021/10/11	6 亿元授信	2021/10/11-2021/10/29	已履行	-
5	晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支	2021/12/30	10 亿元授信	2021/12/30-2022/10/15	正在履行	-

序号	借款人/额度申请人	贷款人/额度授予人	签订日期	合同金额	贷款/授信期限	目前履行情况	担保情况
		行					
6	晶合集成	招商银行股份有限公司合肥分行	2021/08/16	10 亿元授信	2021/08/16-2022/08/15	正在履行	-
7	晶合集成	中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	2021/12/21	1.54 亿元借款	首次提款日起 3 个月	正在履行	-
8	晶合集成	中信银行股份有限公司合肥分行	2021/12	1,700 万美元	2021/12-2022/03	已履行	-

4、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同

（1）产能预约金合同

除本节之“（一）重大合同”之“1、销售合同”已披露的合同外，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人与主要客户新签订的产能预约金合同如下：

①2021 年 11 月 8 日，发行人同客户一签订《产能预约合同》，约定发行人为客户一预留 2024 至 2026 年 150nm 晶圆代工产能，合同期限为 2021 年 11 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。

②2021 年 11 月 16 日，发行人同 Sitronix Technology Corporation（矽创电子股份有限公司）签订《产能预约合同》，约定发行人为 Sitronix Technology Corporation

（矽创电子股份有限公司）预留 2024 年-2026 年 110nm、90nm、55nm、40nm 晶圆代工产能。

③2021 年 10 月 25 日，发行人同客户三签订《2024-2026 产能预约合同》，约定发行人为客户三预留 2024-2026 年 150nm、110nm、55nm 晶圆代工产能，合同期限为 2021 年 10 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。

（2）新晶集成增资相关合同

2021 年 12 月 30 日，发行人及新晶集成与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议》，约定外部投资者拟以货币方式合计出资 60 亿元认购新晶集成新增注册资本 368,890.26 万元，增资完成后，发行人持有新晶集成 52.02%的股权。其中：北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）出资 20 亿元，中国东方资产管理股份有限公司出资 4 亿元，建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）出资 15 亿元，农银金融资产投资有限公司出资 10 亿元。截至本招股说明书签署日，前述增资协议对应的 49 亿元认购款已实际缴纳，尚待与其他投资人完成增资协议的签署并完成剩余 11 亿元认购款的缴纳及本次增资的工商变更。

同日，合肥建投及新晶集成已与北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司签订《增资协议之补充协议》，约定交割日后 1.5 年起至满 3 年止，若投资者所持新晶集成股权未能转换为上市公司股票，合肥建投有权自行或指定第三方（第三方不含发行人及其控股子公司）向投资者发出收购通知，以现金方式受让外部投资者持有新晶集成的全部股权。

（二）合同主体及合同的履行

上述适用中国法律的重大合同内容和形式不违反中国法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其子公司作为上述适用中国法律的重大合同的主体，继续履行该等合同不存在实质性法律障碍。

（三）侵权之债

根据发行人说明、相关工商行政管理部门、人事劳动社会保障部门、税务部门等出具的证明，经本所律师在发行人及其子公司相关主管部门政府网站核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人及其子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《2019-2021 年度审计报告》并经本所律师核查，截至报告期末，除本补充法律意见第一部分“八、关联交易及同业竞争及其变化”及“十、发行人的重大债权债务变化情况”所述之外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（五）发行人的其他应收、应付款

根据《2019-2021 年度审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营及投资活动发生，合法有效。

十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所律师核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人无重大资产收购、出售或拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的《公司章程》、工商登记资料、股东大会会议文件及发行人说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，《公司章程》及《发行人章程》未进行修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人确认，并经本所律师核查发行人会议资料，自《补充法律意见书

（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间：

（一）发行人的组织结构没有发生变化；

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则内容没有发生变化；

（三）发行人共召开了 1 次股东大会、1 次董事会会议，未召开监事会会议，主要情况如下：

1、根据发行人提供的股东大会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 1 次股东大会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 16 日

2、根据发行人提供的董事会会议决议、会议记录、会议通知等相关文件，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人共召开了 1 次董事会，其主要情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间
2	第一届董事会第十次会议	2022 年 3 月 15 日

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十四、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员范围未发生变化。经本所律师核查，发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）发行人董事、监事及高级管理人员变化情况

根据发行人提供的股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事、监事、高级管理人员 未发生变化。

十五、 发行人的税务及其变化情况

（一）税务登记及税种、税率

根据《2019-2021 年度审计报告》《主要税种纳税情况说明的专项审核报告》及发行人书面确认，并经本所律师核查，2021 年度，发行人及境内下属企业执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米

本所律师认为，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《2019-2021 年度审计报告》《主要税种纳税情况专项说明》及发行人的说明，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人享有的税收优惠无重大变化。

（三）财政补贴

根据《2019-2021 年度审计报告》及发行人的说明，2021 年度，发行人及其境内控股子公司获得的计入当期损益的政府补助金额为 18,975.01 万元。

（四）税务合规证明

2022 年 1 月 28 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局向晶合集成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日一直正常申报纳税，未发生违法违章等行为被税务机关处罚的情形。”

2022 年 1 月 13 日，国家税务总局南京市秦淮区税务局向南京晶驱出具《涉税信息查询结果告知书》，“经税收管理系统查询，你单位 2020 年 08 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日期间，未发现违法违规记录。”

2022 年 1 月 19 日，国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所（办税服务厅）向北京晶芯成出具《涉税信息查询结果告知书》，“经查询，晶芯成（北京）科技有限公司为我局登记户，该单位于 2021 年 06 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日在我局无缴纳税款。根据税务核心系统记载，该企业在此期间未接受过行政处罚，该单位企业所得税征收方式为查账征收。”

2022 年 1 月 28 日，国家税务总局合肥新站高新技术产业开发区税务局出具《涉水信息查询结果告知书》，“经金三征管系统查询，该纳税人自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日一直正常申报纳税，未发生违法违章等行为被税务机关处罚的情形。”

（五）税务处罚

自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人及其子公司无新增税务处罚情况。

十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

（一）环境保护

1、根据发行人说明及其提供的文件，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人新增主要环境污染物的处理设施及处理能力情况如下：

处理设备名称	数量（套）	主要用途	处理能力	运行情况
污水处理站-含氟废水处理系统	1	处理含氟废水	960 吨/天	正常

污水处理站-研磨废水处理系统	1	处理研磨废水	480 吨/天	正常
污水处理站-有机废水处理系统	1	处理有机废水	480 吨/天	正常
污水处理站-含氨废水处理系统	1	处理含氨废水	720 吨/天	正常

2、根据发行人说明及其提供的文件并经本所律师核查，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人新增建设项目已获得了有关环境保护主管部门关于该等项目环境影响报告书的审查批复，同意建设该等项目，具体情况如下：

（1）2021 年 9 月 15 日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥晶合集成电路有限公司合肥晶合集成电路先进工艺研发项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12048 号）。

（2）2021 年 11 月 29 日，合肥市生态环境局出具了《关于合肥新晶集成电路有限公司 12 吋晶圆制造项目环境影响报告表的批复》（环建审[2021]12064 号）。

3、环保合规证明

2022 年 1 月 12 日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向发行人出具《证明》，“该公司自 2021 年 6 月 30 日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

2022 年 1 月 12 日，合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局向新晶集成出具《证明》，“该公司自 2021 年 6 月 30 日以来，未发生过环境污染事故，也未因环境违法行为受到环保行政处罚或立案调查。”

4、根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（二）产品质量和技术监督标准

根据发行人确认及本所律师通过网络公开信息检索等方式核查，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人不存在因违反有关产品

质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

（三）安全生产

根据发行人书面说明，自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，北京晶芯成、南京晶驱无实际经营，日本晶合不从事生产，不涉及安全生产相关事项，不涉及安全生产相关事项。发行人及新晶集成安全生产合规情况如下：

2022 年 1 月 12 日，合肥市新站高新技术产业开发区应急管理局出具《关于合肥晶合集成电路股份有限公司安全生产有关情况的证明》，“自 2021 年 6 月 30 日至今，我局未发现合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥新站高新技术产业开发区发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局安全生产行政处罚。”

2022 年 2 月 23 日，安徽省应急管理厅出具《拟上市（挂牌）企业安全生产相关情况证明》，“合肥新晶集成电路有限公司自 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 2 月 15 日，在合肥市辖区内未发生亡人生产安全事故。”

根据上述安全生产监督管理部门出具的证明、发行人书面确认并经本所律师核查，发行人及其子公司的生产经营符合安全生产监督管理要求，最近三年未发生过安全生产事故，未受过安全生产方面的行政处罚。

十七、 发行人的劳动与社会保障及其变化情况

1、劳动合同

根据发行人提供的《劳动合同》模板，并经本所律师抽样核查发行人与员工签署的《劳动合同》，该等劳动合同的内容、形式符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求。

2、社会保险缴纳情况

根据发行人提供的统计资料及社会保险及住房公积金缴纳凭证，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司员工共 2,720 人，已为其中 2,186 人缴纳社会保险，已为其中 2,277 人缴纳住房公积金。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为（1）存在个别当月社会保险扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳社会保险；（2）在境内任职的中国台湾员工按照中国台湾地区相关规定缴纳了劳健保；（3）在境内任职的中国香港员

工、外籍员工未缴纳社会保险；（4）境外子公司员工遵循当地法律相关规定缴纳社会保险。

发行人及其子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）存在个别当月住房公积金扣缴日后新入职的员工，入职后次月才能缴纳住房公积金；（2）在境内任职的中国台湾员工、中国香港员工、外籍员工未缴纳住房公积金；（3）境外子公司员工遵循当地法律相关规定无需缴纳住房公积金。

2022 年 3 月 7 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，晶合集成依法足额缴纳各项社会保险费，自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2022 年 3 月 7 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：晶合集成自 2016 年 7 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。

2022 年 3 月 7 日，合肥市人力资源和社会保障局出具证明：经核实，新晶集成依法足额缴纳各项社会保险费，自 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 3 月 7 日未发现劳动用工违法行为，无人力资源社会保障行政部门处罚的不良记录。

2022 年 3 月 7 日，合肥市住房公积金管理中心出具证明：新晶集成自 2021 年 12 月在我中心开户缴存职工住房公积金，该公司住房公积金缴存正常，未发现违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚.

十八、 发行人募集资金的运用

自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人本次发行上市募集资金投资项目的项目备案文件及环评备案文件未发生变化。

十九、 诉讼、仲裁及行政处罚及其变化情况

（一）发行人及其下属公司

经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）、

国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）、中国检察网（http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），访谈发行人董事、监事和高级管理人员并根据发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司机构股东调查表》、持有发行人 5%以上股份的主要股东出具的承诺函、境外法律意见书，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）、信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）、中国检察网（http://www.12309.gov.cnajxxgk.jcy.gov.cn/12309/index.shtml）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在对晶合集成产生影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司董事、监事、高级管理人员调查表》、核心技术人员填写的《合肥晶合集成电路股份有限公司核心技术人员调查表》，中国证监会安徽监管局诚信信息查询结果，并经本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn/）等网站，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十、 发行人《招股说明书（注册稿）》法律风险的评价

经审阅发行人《招股说明书（注册稿）》所引用的《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》及本补充法律意见书相关内容部分，金杜认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人《招股说明书（注册稿）》及其摘要引用相关内容与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》及本补充法律意见书不存在矛盾之处。金杜确认，《招股说明书（注册稿）》及其摘要不致因引用《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、 本次发行上市的总体结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，发行人自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日期间内所发生的变化，不会对《补充法律意见书（三）》中本所律师发表的结论意见构成影响，本所律师发表的结论意见依然有效。

第二部分 财务数据更新至 2021 年 12 月 31 日后《问询函》中涉及的相关问题回复内容的更新

一、 《问询函》第 11 题：关于技术来源和先进性

根据申报材料：（1）招股说明书对核心技术情况披露较为简单。公司取得力晶科技相关技术后，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了现有技术平台。（2）核心技术人员多为中国台湾籍且具有力晶科技任职背景，部分曾有中芯国际、联华电子等工作经历。（3）截至 2020 年 12 月 31 日，发行人发明专利数量 2018 年为 0 项，2019 年为 2 项，2020 年为 71 项。（4）2015 年 10 月，《技术移转协议》约定力晶科技提供驱动 IC 代工所需之制程技术予公司，用以出资的转移技术作价 20 亿元。（5）2020 年 9 月，力晶科技将用于出资的 58 项专利技术使用权中尚在有效期的 44 项无偿转让给晶合有限。（6）2018 年 4 月、2021 年 4 月，发行人同力晶科技签订了《90nm 项目技术协议》及《补充协议》，约定力晶科技向公司移转 90nm M+驱动 IC 制程技术相关技术数据及文件，公司需合计支付 500 万美元。

请发行人详细披露核心技术的形成过程，力晶科技在发行人技术发展过程中的作用，现有技术平台和技术先进性的具体表征。

请发行人说明：（1）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业务及生产经营的影响；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。请发行人律师说明对核心技术人员是否存在违反竞业禁止、保密协议的情形，是否使用原任职单位技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷事项的核查情况及核查结论。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（一）自身研发团队取得力晶科技技术后改进优化所取得的技术成果，对公司业

务及生产经营的影响

2、对公司业务及生产经营的影响

报告期内，发行人晶圆代工业务收入分别为 53,336.01 万元、151,186.11 万元及 542,084.44 万元，实现了稳健增长。

二、 《问询函》第 12.2 题：委派管理人员

根据申报材料：（1）按照委托经营协议，存在力晶科技、合肥建投委派部分管理人员的情形，委派人员所在岗位主要是财务和内审部门。2020 年 4 月起，公司各部门已无股东委派高管。（2）2018 年 12 月，发行人依据《委托经营管理合约》组建了经营管理委员会。

请发行人说明：……（2）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，请申报会计师就发行人财务是否独立于力晶科技进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（二）委托经营管理期间经营决策的具体过程，列表说明委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

2、委托经营管理期间及委托经营管理终止后发行人经营管理团队的变化，相关变动人员的来源及劳动关系隶属情况

根据发行人自设立以来历次董事会会议、合肥建投及力晶科技向发行人委派高管

的相关函件以及发行人出具的说明，2018 年初至报告期末，发行人经营管理团队人员的变化情况如下：

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
1	/	总经理	2018 年 1 月-2020 年 3 月	黎湘鄂	发行人员工	发行人
			2020 年 3 月-报告期末	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
2	运营	副总经理	2018 年 1 月-2020 年 3 月	蔡辉嘉	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 12 月-报告期末	邱显寰	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2020 年 11 月	未设置		
			2020 年 12 月-报告期末	李庆民	发行人员工	发行人
3	采购	总监/副总经理	2018 年 1 月-2020 年 11 月	盛惟健	发行人员工	发行人
			2020 年 11 月-报告期末	未设置		
		协理	2020 年 11 月-报告期末	简瑞荣	发行人员工	发行人
		副总监	2018 年 1 月-2019 年 5 月	周义亮	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 5 月-2020 年 3 月	王继武	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 3 月-报	未设置		

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			告期末			
4	销售	总监/副总经理	2018 年 1 月-2019 年 10 月	黎湘鄂	发行人员工	发行人
			2019 年 10 月-2020 年 4 月	未设置		
			2020 年 4 月-2020 年 6 月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020 年 6 月-2021 年 11 月	未设置		
			2021 年 11 月-报告期末	周义亮	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 10 月-2020 年 4 月	孙志明	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-2021 年 11 月	周义亮	发行人员工	发行人
			2021 年 11 月-报告期末	未设置		
		副总监	2018 年 1 月-2020 年 3 月	周义亮	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	未设置		
5	研发	副总经理	2018 年 1 月-2019 年 3 月	陈耿川	发行人员工	发行人
			2020 年 4 月-报告期末	詹奕鹏	发行人员工	发行人
		协理	2019 年 3 月-2020 年 3 月	詹奕鹏	发行人员工	发行人

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020 年 4 月-报告期末	未设置		
6	财务	总会计师/财务负责人	2018 年 1 月-2020 年 3 月	朱才伟	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月至报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
		副总会计师/协理	2018 年 1 月-2019 年 3 月	邱垂源	力晶科技委派	力晶科技
			2019 年 3 月-2020 年 3 月	李洳谕	力晶科技委派	力晶科技
			2020 年 4 月-报告期末	李洳谕	发行人员工	发行人
7	内审	审计师	2018 年 1 月-2018 年 5 月	陈美华	力晶科技委派	力晶科技
			2018 年 5 月-2018 年 12 月	潘炯升	力晶科技委派	力晶科技
			2019 年 1 月-2019 年 12 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 12 月-2020 年 4 月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 4 月-报告期末	未设置		
8	行政	副总经理	2018 年 1 月-2018 年 5 月	刘荫	力晶科技委派	力晶科技
			2018 年 5 月-2019 年 10 月	未聘任，由采购总监盛惟健代管		
			2019 年 10 月-	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投

序号	部门	职位	任职时间	姓名	变动人员的来源	劳动关系隶属
			2020 年 3 月			
			2020 年 4 月-报告期末	朱晓娟	发行人员工	发行人
9	证券	董事会秘书	2020 年 4 月-报告期末	朱才伟	发行人员工	发行人
10	敬业监督	敬业促进委员会委员长	2018 年 1 月-2019 年 11 月	朱晓娟	合肥建投委派	合肥建投
			2019 年 12 月-2020 年 11 月	杨幼玲	合肥建投委派	合肥建投
			2020 年 11 月-报告期末	不再为高级管理人员职位		

综上，2018 年初至报告期末，发行人经营管理团队主要来源于发行人员工；截至报告期末，发行人高级管理人员均由公司聘任，不涉及股东委派的情形。关于独立性。

三、 《问询函》第 12.2 题：向控股股东子公司租赁厂房及设施

根据申报材料：（1）发行人及其子公司无自有房产及土地使用权。目前主要办公场所及全部生产场所为向合肥建投全资子公司合肥蓝科租赁，募投项目实施相关厂房系向合肥蓝科租赁。环保设施由合肥蓝科与厂房一同建设并出租给发行人使用。（2）2017 年公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》租入厂房及配套厂务设备；2021 年 4 月，公司与合肥蓝科签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》对晶合二厂及配套设施认定为经营性租赁，同期公司与合肥蓝科签订《收购意向协议》，公司承诺在该项目交付之日起 5 年内完成收购。（3）以融资租赁方式进行核算，报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 176,313.65 万元、169,151.82 万元和 161,990.00 万元。

请发行人说明：……（2）发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系……。

请保荐机构、发行人律师对事项（1）-（3）和申报会计师对事项（2）和（4）进行核查并发表明确意见。请保荐机构和发行人律师根据《问答（二）》第 7 条的规定，充分论证上述情况是否对发行人资产完整和独立性构成重大不利影响，督促发行人做好信息披露和风险揭示。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

2、发行人大额固定资产、在建工程与上述厂房的关系

报告期内，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
固定资产	**1,912,854.87**	**1,632,598.75**	**963,849.07**	**776,607.78**	**830,304.51**	**720,936.40**
其中：房屋及建筑物	2,964.35	2,653.02	189,450.20	164,395.89	189,080.29	171,257.26
其中：机器设备	1,890,601.76	1,618,943.07	765,356.07	608,864.61	634,166.05	546,355.03
其中：运输工具	274.08	0.07	274.08	0.21	274.08	50.12
其中：电子设备及其他	19,014.68	11,002.59	8,768.72	3,347.06	6,784.09	3,273.99
融资租入固定资产	**325,766.54**	**291,688.85**	**187,056.39**	**161,990.00**	**187,056.39**	**169,151.82**
其中：房屋及建筑物	325,498.10	291,662.00	186,787.95	161,909.47	186,787.95	169,017.60
其中：电子设备及其他	268.44	26.84	268.44	80.53	268.44	134.22
融资租入固定资产占固定资产的比例	**14.55%**	**15.16%**	**19.41%**	**20.86%**	**22.53%**	**23.46%**
其中：房屋及建筑	99.10%	99.10%	98.59%	98.49%	98.79%	98.69%

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
物						
其中：电子设备及其他	1.39%	0.24%	3.06%	2.41%	3.96%	4.10%

注：发行人自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，将融资租入固定资产调整计入使用权资产。为保证 2019 年至 2021 年数据可比，上表 2021 年 “融资租入固定资产占固定资产的比例”计算方式为融资租入固定资产金额/（固定资产金额+融资租入固定资产金额）

上述租赁厂房及配套厂务设备等计入固定资产的房屋及建筑物、电子设备及其他，不存在租入的在建工程，由于配套厂务设备与厂房密不可分，故作为房屋及建筑物核算。

报告期各期末，公司融资租入固定资产账面价值分别为 169,151.82 万元、161,990.00 万元和 291,688.85 万元，主要为根据公司与合肥蓝科、力晶科技签订的《厂房建设与租用协议》及公司与合肥蓝科签订的《电子器件厂房设施租赁合同》和《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》所租入的厂房及配套厂务设备。报告期内，上述租赁获得的厂房及配套厂务设备原值占发行人固定资产原值的比例分别为 22.53%、19.41%和 14.55%，占发行人固定资产中房屋及建筑物原值的比例分别为 98.79%、98.59%和 99.10%，发行人房屋及建筑物主要通过上述租赁方式获得。

四、 《问询函》第 12.5 题：社保缴纳情况

报告期各期末在境内缴纳社会保险、住房公积金的人数为 300 多人，占员工总人数比例 20%以上。

请发行人说明：台湾籍员工的数量、职位分布……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（一）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（一）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

根据发行人提供的员工名单及工资表、中国台湾员工劳动合同、社保缴纳凭证、中国台湾劳务公司代缴劳健保的相关协议并经本所律师与代缴公司确认，报告期内，发行人中国台湾员工均与发行人或其子公司签订了劳动合同，由发行人或其子公司承担薪酬，其中主要为制造、研发人员，具体情况如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
中国台湾员工数量	340	264	299
其中：			
研发人员	117	59	64
制造人员	168	157	182
销售人员	21	15	11
管理人员	34	33	42

注：截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末，发行人中国台湾员工占发行人总员工比例分别为 21.90%、15.85%、12.50%。

五、 《问询函》第 13 题：关于关联交易

根据申报材料：（1）合肥建投和力晶科技通过向发行人委派管理人员的方式向发行人提供企业管理、会计等相关咨询服务。发行人向合肥建投支付咨询服务费用已于 2020 年 3 月 31 日终止，向力晶科技支付的咨询服务费已于 2020 年 6 月 30 日终止。（2）报告期各期，发行人向智成电子采购服务费分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元。

请发行人说明：……（3）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性……。

请保荐机构、发行人律师对上述事项（1）-（3）和申报会计师对上述事项（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

（三）发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性，相关定价公允性

1、发行人向智成电子采购服务费的具体情况，后续是否具有持续性

根据发行人与智成电子于 2017 年 5 月 1 日签订的《产品开发、技术授权暨维护合约书》、于 2019 年 3 月 4 日签订的《智成权利金合同》、于 2020 年 3 月 31 日签订的

《智成权利金合同》以及于 2021 年 7 月 1 日签订的《智成权利金合同》，智成电子同意以其所有的 110nm 逻辑制程所需之 Standard Cell Library 授权发行人，并配合发行人的制程特性，维护发行人向智成电子授权取得之产品技术，以使其符合发行人代工客户需求，并达到效率提升、错误侦错并协助发行人推展逻辑制程代工业务。报告期各期，针对上述 IP 授权交易，发行人分别确认费用 152.95 万元、372.62 万元和 784.48 万元。

发行人对外部授权 IP 的选择，主要受代工产品工艺技术要求驱动，未来，发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。因此，发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

2、发行人与智成电子的上述交易相关定价公允性

根据发行人与智成电子签署的 IP 授权协议以及发行人与无关联第三方 IP 供应商签订的授权协议，报告期内，发行人与智成电子就上述授权 IP 约定的价款包括前期开发费用和权利金，其中权利金为交易价款的主要组成部分。报告期内，发行人与智成电子约定的授权 IP 权利金为单片晶圆净销售额的 1%。截至 2021 年 12 月 31 日，除智成电子授权 IP 外，发行人正在使用的其他授权 IP 权利金计提比例（按每片晶圆支付固定金额的除外）主要区间为晶圆销售金额或净额的 0.5%-1.5%。因此，发行人与智成电子的上述交易价格仍处于发行人确定的合理价格区间范围内。

对于与智成电子的上述 IP 授权交易，发行人遵循市场化交易原则，与智成电子协商确定 IP 授权价格，采购价格具备公允性。

2021 年 2 月 9 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认合肥晶合集成电路股份有限公司 2018 年度至 2020 年度期间关联交易的议案》；发行人全体独立董事就报告期内的关联交易事项发表了独立意见，认为包括上述 IP 授权交易在内的关联交易，交易定价公允、合理，关联交易事项按照一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2021 年 3 月 16 日，发行人召开股东大会，审议通过了关于公司报告期内的关联交易预计的议案，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

综上，发行人与智成电子的上述 IP 授权交易，交易相关定价具有公允性。

六、 《第二轮问询函》第 5 题：关于实际控制人认定

根据问询回复：（1）2019 年 12 月以前，发行人最高权力机构董事会，有 9 名董事。公司章程规定重大经营、财务、人事事项需 2/3 董事同意，部分事项需要一致批准。而合肥建投占 5 席，未达 2/3。回复中称合肥国资方委派董事在发行人董事会中占实质主导地位；（2）公司董事长提名人为力晶科技；（3）公司高管成员包括行使敬业监督职能的敬业促进委员会委员长，由合肥建投进行委派；（4）回复中列式了报告期内公司高级管理人员的变化情况，但未说明相关人员的提名情况；（5）公司组建了经营管理委员会作为董事会幕僚机构，其中合肥建投指派人员的职责主要为监督。

请发行人说明：……（2）行使敬业监督职能高管的具体职能行使情况，该职位是否主要针对与力晶科技合作进行设置，报告期内的实际执行情况；……。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（3）敬业促进委员会人员构成

自 2017 年 9 月敬业促进委员会成立至报告期末，公司敬业促进委员会的人员构成及变化情况具体如下：

日期	委员长	委员			
2017.9 至 2018.5	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	陈美华（审计师）	-
2018.5 至 2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	潘炯升（审计师）	-
2019.1	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	-
2019.1 至 2019.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2019.12 至 2020.4	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	林士然（副审计师）	刘桂云（党委办公室主任）
2020.4 至 2020.8	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	刘桂云（党委办公室主任）

2020.8 至 2021.3	杨幼玲	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）
2021.3 至 2021.6	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源部部经理）	王兴亚（财会处处长）	林士然（总经理特别助理）
2021.6 至 2021.12	朱晓娟	施雪峯（法务室副处长）	江英和（人力资源处代副处长）	王兴亚（财会处处长）	黎翠绫（企业规划室资深处长）

（5）报告期内的实际执行情况

报告期内，敬业促进委员会共计召开 13 次会议，均由敬业委员会委员长主持，相关会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
1	2019.1.10	审议一起员工工作能力不足、二起员工违反公司出勤规定及一起员工违反公司住宿规定检举事件。各委员依调查结果讨论后，违反出勤规定属实者给予申诫 1 次、并追回虚报加班费用；违反住宿规定属实者，取消入住公司宿舍权利。以上四起案件公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十一次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
2	2019.4.11	审议一起员工作业疏失及一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者给予申诫 1 次，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十二次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
3	2019.6.19	审议二起员工违反工作纪律及一起员工在外行为影响其他同事。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予扣二个月绩效，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
4	2019.9.5	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十三次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
5	2019.10.24	审议一起拖欠供应商货款。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第一届第二十四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
6	2019.12.17	审议一起员工违反工作纪律。各委员	处理结果在晶合有限第

序号	召开日期	会议主要内容及处理结果	董事会汇报情况
		依调查结果讨论后，未有违反工作纪律之情况，并公告厂内周知	一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
7	2020.1.15	审议一起采购品项不符合招标需求。各委员依调查结果讨论后，检举不属实	处理结果在晶合有限第一届第二十五次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
8	2020.8.27	审议一起采购品项指定单一品牌及一起员工泄露供应商报价。各委员依调查结果讨论后，检举不属实，并公告厂内周知	处理结果在晶合有限第二届第四次董事会会议中作为报告事项向董事会汇报
9	2020.11.5	审议一起员工违反公司住宿补贴规定。各委员依调查结果讨论后，违反住宿补贴规定属实者给予记过 1 次，并追回虚报住宿补贴及取消领取补贴资格，同时公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
10	2021.1.22	审议一起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第三次会议中作为报告事项向董事会汇报
11	2021.3.18	审议二起员工违反公司工作纪律。各委员依调查结果讨论后，违反工作纪律属实者给予解雇，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第五次会议中作为报告事项向董事会汇报
12	2021.5.19	审议二起员工违反公司敬业规范。各委员依调查结果讨论后，违反敬业规范属实者分别给予申诫 1 次和记过 1 次，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第六次会议中作为报告事项向董事会汇报
13	2021.8.4	审议一起员工违反公司敬业规范及一起员工违反公司纪律。各委员依调查结果讨论后，未有违反敬业规范之情况、违反工作纪律属实者给予记过 1 次，并公告厂内周知	处理结果在发行人第一届董事会第八次会议中作为报告事项向董事会汇报

七、 《第二轮问询函》第 7 题：关于无形资产和技术

根据问询回复：（1）2015 年 10 月，晶合有限与力晶科技、合肥建投签订《技术移转协议》，约定力晶科技以三项制程技术作价 20 亿元出资晶合有限，包括专利技术、

技术文件及数据以及技术经验等内容，所涉及的 58 项专利使用权的到期时间在 2016 年至 2025 年，截至问询函回复出具日，上述发明专利权中 14 项已到期，但 2018 年和 2019 年末，发行人对无形资产进行了减值测试未发现减值迹象；（2）2018 年导入 90nmM+技术平台；（3）报告期内，发行人向智成电子采购 IP 授权交易分别为 177.18 万元、152.95 万元和 372.62 万元，智成电子系力晶科技控制公司。未来发行人不排除基于代工产品工艺技术要求继续向智成电子取得上述 IP 或其他类型 IP 的授权。发行人与智成电子的 IP 授权交易具有持续性。

请发行人说明：……（3）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（三）发行人向智成电子采购 IP 授权交易的原因，在发行人生产经营及技术方面的作用，发行人目前技术与力晶科技之间的关系，是否存在技术依赖

报告期内，发行人对技术进行持续自主研发并创新升级，以满足不同客户针对不同制程节点、不同工艺平台的产品需求，并形成了稳定的研发人员团队，团队成员均与发行人直接签署劳动合同。同时，发行人不断将研发投入所形成的科研成果及核心技术通过申请专利等方式进行保护，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已形成与主营业务收入相关的发明专利共 198 件，不依赖于力晶科技的研发团队、科研成果及专利和非专利技术，具有独立研发能力。

八、 《第二轮问询函》第 9.2 题

报告期内，报告期内除日本子公司员工外，发行人台籍员工通过中国台湾第三方劳务公司怡东人事顾问股份有限公司为其在中国台湾地区缴纳劳健保。

请结合相关法律法规规定说明上述代缴社保相关情形是否符合相关法律法规规定以及对公司的影响。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

（四）发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事宜对于发行人经营成果的影响

根据发行人测算，报告期内，发行人为中国台湾员工实际缴纳劳健保、未在中国大陆缴纳社会保险对发行人经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
发行人为中国台湾员工实际缴纳劳健保的金额（a）	555.63	560.10	689.99
发行人应为中国台湾员工缴纳社会保险的金额（b）	1,423.38	413.61	1,391.02
差额（b-a）	867.75	-146.49	701.03
营业总成本（c）	169,998.65	255,660.04	380,028.97
发行人应为中国台湾员工缴纳社会保险的金额占营业总成本的比例（b/c）	**0.84%**	**0.16%**	**0.37%**
差额占营业总成本的比例 [(b-a)/c]	**0.51%**	**-0.06%**	**0.18%**

注：2020 年度，国家在疫情期间推出了社保减免政策，因此，发行人应为中国台湾员工缴纳社会保险的金额大幅降低。

发行人报告期内应当为中国台湾员工在中国大陆缴纳社会保险的金额与发行人为中国台湾员工缴纳劳健保的金额的差额占发行人营业总成本的比例分别为 0.51%、-0.06%、0.18%，发行人通过第三方劳务公司代缴劳健保事对发行人的经营成果影响较小。

九、 《第二轮问询函》第 9.3 题

公司于 2017 年在日本设立子公司，员工主要来源于 Synaptics 公司，日本晶合所取得的知识产权权益归属于晶合集成。2017 年前后 Synaptics 公司拟进行业务转型，晶合集成获得吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队的机会。

请发行人说明：相关人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，相关研发成果是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

《补充法律意见书（二）》中已就前述问题进行了回复，本补充法律意见现对《补充法律意见书（二）》中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相关补充更新具体如下：

发行人日本子公司吸纳曾于 Synaptics 日本子公司任职的研发团队，截至 2021 年 12 月 31 日，日本晶合共有 19 名员工，其中 9 名曾任职于 Synaptics 日本子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，日本晶合员工作为发明人、在发行人任职期间自主研发并取得的授权专利共计 16 项，具体情况如下：

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
1	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	半导体组件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	中国
2	发行人	川村昌靖；夏目秀隆；藤并康博；熊谷裕弘	发明专利	电容性半导体组件	ZL201910340165.6	2019/04/25	中国
3	发行人	田矢真敏；川村昌靖：	发明专利	电容性半导体组件	ZL202010324914.9	2020/04/23	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
		夏目秀隆；藤井康博					
4	发行人	小嶋英充	发明专利	ラッチ回路	特许第6761074号	2019/05/21	日本
5	发行人	小嶋英充	发明专利	SRAM、半導体集積回路及びLCDドライバ	特许第6801053号	2019/06/19	日本
6	发行人	川村昌靖；夏目秀隆；藤井康博；熊谷裕弘	发明专利	容量性半导体素子	特许第6831067号	2019/04/25	日本
7	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第6826795号	2019/01/09	日本
8	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	高耐庄半導体素子及びその製造方法	特许第6892889号	2019/04/15	日本
9	发行人	田矢真敏；川村昌靖；夏目秀隆	发明专利	容量性半导体素子	特许第6918173号	2020/04/23	日本
10	北京晶芯成	夏目秀隆；田矢真敏；藤井康博；中野纪夫	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159567.5	2020/10/27	中国
11	发行人	田矢真敏；中野纪夫；熊谷裕弘	发明专利	高耐压半导体组件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	中国

序号	权利人	发明人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	国别
12	北京晶芯成	大田裕之	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	中国
13	北京晶芯成	藤井康博；李波；陈信全	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	中国
14	北京晶芯成	田矢真敏；石田浩；中野纪夫	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	中国
15	北京晶芯成	小嶋英充；藤井康博	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	中国
16	北京晶芯成	田矢真敏；石田浩；熊谷裕弘	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202110397617.1	2021/04/14	中国

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（五）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

苏 峥

刘东亚

单位负责人：

王 玲

二〇二二 年 三 月 十一 日

附件：发行人及其子公司拥有的知识产权

1、境内注册商标

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
1	晶合集成	Nexchip	26258933	25	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
2	晶合集成	Nexchip	26283789	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
3	晶合集成	Nexchip	26255490	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
4	晶合集成	晶合	26295138A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
5	晶合集成	晶合	26261189	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
6	晶合集成	晶合	26283543	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
7	晶合集成	晶合	26258453	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
8	晶合集成	晶合集成	26296982A	9	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
9	晶合集成	晶合集成	26257005	25	2018/10/28-2028/10/27	原始取得
10	晶合集成	晶合集成	26279879	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式
11	晶合集成	晶合集成	26258966	40	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
12	晶合集成		26279826	9	2018/12/07-2028/12/06	原始取得
13	晶合集成		43218141	25	2020/10/14-2030/10/13	原始取得
14	晶合集成		26279830	35	2018/09/07-2028/09/06	原始取得
15	晶合集成		26273278	40	2019/12/14-2029/12/13	原始取得
16	晶合集成	Nexchip	36794768	25	2020/08/21-2030/08/20	原始取得
17	晶合集成	晶芯成	54924121	9	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
18	晶合集成	晶芯成	53267990	25	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
19	晶合集成	晶芯成	54895828	35	2021/11/7-2031/11/6	原始取得
20	晶合集成	晶芯成	53268332	40	2021/9/7-2031/9/6	原始取得
21	晶合集成	晶驱	53274613	25	2021/8/28-2031-8/27	原始取得
22	晶合集成	晶驱	53264804	40	2021/8/28-2031/8/27	原始取得

2、境外商标情况

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	Nexchip	6098177	9	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
2	晶合有限	Nexchip	6071853	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
3	晶合有限	Nexchip	6098177	35	2018/11/16-2028/11/15	原始取得	日本
4	晶合有限	Nexchip	6071853	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
5	晶合有限	晶合	6050343	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
6	晶合有限	晶合	6070505	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
7	晶合有限	晶合	6050343	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
8	晶合有限	晶合	6070505	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
9	晶合有限	晶合集成	6050344	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
10	晶合有限	晶合集成	6071852	25	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
11	晶合有限	晶合集成	6050344	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
12	晶合有限	晶合集成	6071852	40	2018/08/17-2028/08/16	原始取得	日本
13	晶合有限		6050345	9	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
14	晶合有限		6070504	25	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
15	晶合有限		6050345	35	2018/06/08-2028/06/07	原始取得	日本
16	晶合有限		6070504	40	2018/08/10-2028/08/09	原始取得	日本
17	晶合有限	Nexchip	01919639	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
18	晶合集成	Nexchip	01923633	25	2018/07/01-2028/06/30	原始取得	中国台湾
19	晶合有限	Nexchip	01920983	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
20	晶合集成	Nexchip	01912745	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
21	晶合有限	晶合	01919637	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
22	晶合集成	晶合	01909401	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
23	晶合有限	晶合	01920981	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
24	晶合集成	晶合	01912743	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
25	晶合有限	晶合集成	01919636	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
26	晶合集成	晶合集成	01909400	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
27	晶合有限	晶合集成	01920980	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
28	晶合集成	晶合集成	01918174	40	2018/06/01-2028/05/31	原始取得	中国台湾
29	晶合有限		01919638	9	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
30	晶合集成		01909402	25	2018/04/16-2028/04/15	原始取得	中国台湾
31	晶合有限		01920982	35	2018/06/16-2028/06/15	原始取得	中国台湾
32	晶合集成		01912744	40	2018/05/01-2028/04/30	原始取得	中国台湾
33	晶合有限	Nexchip	5513533	9	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
34	晶合有限	Nexchip	5513299	25	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
35	晶合有限	Nexchip	5559722	35	2018/09/11-2028/09/10	原始取得	美国
36	晶合有限	Nexchip	5513440	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
37	晶合有限	晶合	5523772	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
38	晶合有限	晶合	5518583	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
39	晶合有限	晶合	5513532	35	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
40	晶合有限	晶合	5518584	40	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
41	晶合有限	晶合集成	5518591	25	2018/07/17-2028/07/16	原始取得	美国
42	晶合有限	晶合集成	5523770	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
43	晶合有限	晶合集成	5523769	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
44	晶合有限	晶合集成	5513586	40	2018/07/10-2028/07/09	原始取得	美国
45	晶合有限		5523767	9	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
46	晶合有限		5523806	25	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
47	晶合有限		5523768	35	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国
48	晶合有限		5523807	40	2018/07/24-2028/07/23	原始取得	美国

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
49	晶合有限	Nexchip	018074417	9	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
50	晶合有限	Nexchip	018074417	35	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
51	晶合有限	Nexchip	018074417	40	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
52	晶合有限	Nexchip	018073971	9	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
53	晶合有限	Nexchip	018073971	35	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
54	晶合有限	Nexchip	018073971	40	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
55	晶合有限		018073976	9	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
56	晶合有限		018073976	35	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
57	晶合有限		018073976	40	2019/05/31-2029/05/31	原始取得	欧盟
58	晶合有限	Nexchip	4196328	35	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
59	晶合有限	Nexchip	4196329	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
60	晶合有限	Nexchip	4216333	35	2019/06/25-2029/06/24	原始取得	印度
61	晶合有限	Nexchip	4216334	40	2019/06/25-2029/06/24	原始取得	印度
62	晶合有限		4196323	9	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
63	晶合有限		4196324	35	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
64	晶合有限		4196325	40	2019/06/03-2029/06/02	原始取得	印度
65	晶合有限	Nexchip	401603379	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
66	晶合有限	Nexchip	401603380	40	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
67	晶合集成	Nexchip	401684625	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
68	晶合有限		401605036	35	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
69	晶合有限		401605037	40	2020/05/12-2030/05/11	原始取得	韩国
70	晶合集成		401684665	9	2021/1/20-2031/1/19	原始取得	韩国
71	晶合有限		401603377	9	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
72	晶合有限		401603378	35	2020/05/07-2030/05/06	原始取得	韩国
73	晶合有限		401599318	40	2020/04/23-2030/04/22	原始取得	韩国
74	晶合有限	Nexchip	40201926832S	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
75	晶合有限	Nexchip	40201926831T	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
76	晶合集成	Nexchip	40201926806V	9	2019/12/11-2029/12/10	原始取得	新加坡
77	晶合有限		40201925814T	35	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
78	晶合集成		40201925815S	40	2019/11/28-2029/11/27	原始取得	新加坡
79	晶合集成		40201926869W	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
80	晶合有限		40201926842V	9	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
81	晶合有限		40201926838P	35	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
82	晶合集成		40201926847Q	40	2019/12/12-2029/12/11	原始取得	新加坡
83	晶合集成		TM2019044357	9	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚

序号	商标权人名称	商标	注册号	分类号	专用期限	取得方式	国家/地区
84	晶合集成	Nexchip	TM20190 44362	35	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
85	晶合集成	Nexchip	TM20190 44364	40	2019/12/2-2029/12/2	原始取得	马来西亚
86	晶合集成	Nexchip	TM20190 45346	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
87	晶合集成	Nexchip	TM20190 45348	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
88	晶合集成	Nexchip	TM20190 45350	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
89	晶合集成		TM20190 45352	9	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
90	晶合集成		TM20190 45355	35	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚
91	晶合集成		TM20190 45357	40	2019/12/9-2029/12/9	原始取得	马来西亚

3、境内专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	晶合集成	发明专利	光学光刻方法	ZL03155531.4	2003/08/28	继受取得
2	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗的半导体元件及其制造方法	ZL200510065580.3	2005/04/18	继受取得
3	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	ZL200510065608.3	2005/04/18	继受取得
4	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	ZL200610005891.5	2006/01/19	继受取得
5	晶合集成	发明专利	导线的制造方法以及缩小导线与图案间距的方法	ZL200510129767.5	2005/12/05	继受取得
6	晶合集成	发明专利	电路结构及用以定义此电路结构的光掩模	ZL200710161775.7	2007/09/26	继受取得
7	晶合集成	发明专利	监控光刻工艺的方法与监控标记	ZL200810093317.9	2008/04/18	继受取得
8	晶合集成	发明专利	分栅式非易失性存储器及其制备方法	ZL201810796277.8	2018/07/19	原始取得
9	晶合集成	发明专利	一种晶元破片分析装置及其晶元破片分析方法	ZL201810897300.2	2018/08/08	原始取得
10	晶合集成	发明专利	一种裂片装置及方法	ZL201810920343.8	2018/08/14	原始取得
11	晶合集成	发明专利	一种半导体结构制造方法	ZL201810980356.4	2018/08/27	原始取得
12	晶合集成	发明专利	MOS 场效应晶体	ZL201811237 19	2018/10/23	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			管及其制造方法	7.5		
13	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811345719.3	2018/11/13	原始取得
14	晶合集成	发明专利	一种非易失性存储器及其制作方法	ZL201811354139.0	2018/11/14	原始取得
15	晶合集成	发明专利	沟槽隔离结构的形成方法	ZL201910048694.9	2019/01/18	原始取得
16	晶合集成	发明专利	一种存储器及其制造方法	ZL201910104747.4	2019/02/01	原始取得
17	晶合集成	发明专利	高耐压半导体元件及其制造方法	ZL201910299871.0	2019/04/15	原始取得
18	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	ZL201910611966.1	2019/07/08	原始取得
19	晶合集成	发明专利	沟槽制作方法及半导体隔离结构制作方法	ZL201911268173.0	2019/12/11	原始取得
20	晶合集成	发明专利	半导体集成器件的阱制备方法和阱注入光罩组	ZL201911303991.X	2019/12/17	原始取得
21	晶合集成	发明专利	一种半导体器件的制造方法及其形成的半导体器件	ZL201911326563.9	2019/12/20	原始取得
22	晶合集成	发明专利	扩散型场效应晶	ZL20201004399	2020/01/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			体管的形成方法	7.4		
23	晶合集成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202010099798.5	2020/02/18	原始取得
24	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	ZL201910103609.4	2019/02/01	原始取得
25	晶合集成	发明专利	一种建立光学数据校正模型的方法	ZL202010219356.X	2020/03/25	原始取得
26	晶合集成	发明专利	一种晶圆的退火方法	ZL202010372489.0	2020/05/06	原始取得
27	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010454977.6	2020/05/26	原始取得
28	晶合集成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202010358483.8	2020/04/29	原始取得
29	晶合集成	发明专利	电容性半导体元件	ZL201910340165.6	2019/04/25	原始取得
30	晶合集成	发明专利	电容性半导体元件	ZL202010324914.9	2020/04/23	原始取得
31	晶合集成	实用新型	一种液位测量仪	ZL201820995525.7	2018/06/25	原始取得
32	晶合集成	实用新型	双灯丝离子源装置	ZL201821163226.3	2018/07/23	原始取得
33	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的安装位检测装置	ZL201821130870.0	2018/07/17	原始取得
34	晶合集成	实用新型	用于半导体设备的定位装置	ZL201821147988.4	2018/07/19	原始取得
35	晶合集成	实用新型	一种气体供应装	ZL201821192419.1	2018/07/24	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			置			
36	晶合集成	实用新型	一种载台及载具	ZL201821719617.9	2018/10/22	原始取得
37	晶合集成	实用新型	一种气体除尘装置及具有该气体除尘装置的气体处理装置	ZL201821753440.4	2018/10/26	原始取得
38	晶合集成	实用新型	掩膜板	ZL201821957502.3	2018/11/23	原始取得
39	晶合集成	实用新型	可感测基片破损的片盒	ZL201822002991.3	2018/11/30	原始取得
40	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的不间断储水装置及半导体设备	ZL201920706945.3	2019/05/17	原始取得
41	晶合集成	实用新型	一种防干扰装置及半导体制程机台	ZL201921016248.1	2019/07/02	原始取得
42	晶合集成	实用新型	流速调节装置	ZL201921235650.9	2019/08/01	原始取得
43	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的组件调整装置	ZL201921439572.4	2019/09/02	原始取得
44	晶合集成	实用新型	一种半导体设备夹持装置	ZL201921604162.0	2019/09/25	原始取得
45	晶合集成	实用新型	半导体检测机台	ZL201921654723.8	2019/09/30	原始取得
46	晶合集成	实用新型	一种光罩	ZL202020368355.7	2020/03/23	原始取得
47	晶合集成	实用新型	一种晶体管结构	ZL202020257664.7	2020/03/04	原始取得
48	晶合集成	实用新型	封装芯片的移除	ZL201922312080	2019/12/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			装置	2.4		
49	晶合集成	实用新型	多次可编程存储器的单元结构	ZL202020331150.1	2020/03/16	原始取得
50	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519501.1	2020/04/10	原始取得
51	晶合集成	实用新型	一种非易失性存储器结构	ZL202020519503.0	2020/04/10	原始取得
52	晶合集成	实用新型	一种半导体器件	ZL202020333222.6	2020/03/17	原始取得
53	晶合集成	实用新型	半导体器件	ZL202020247738.9	2020/03/02	原始取得
54	晶合集成	实用新型	封装结构	ZL202020404622.1	2020/03/24	原始取得
55	晶合集成	实用新型	一种半导体结构及其应用的半导体器件	ZL202020778398.2	2020/05/12	原始取得
56	晶合集成	实用新型	嵌入式焊盘结构	ZL202020252537.8	2020/03/04	原始取得
57	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的腔室及半导体设备	ZL202020604243.7	2020/04/21	原始取得
58	晶合集成	实用新型	量测机台	ZL202020832666.4	2020/05/15	原始取得
59	晶合集成	实用新型	一种转接装置	ZL202021137450.2	2020/06/18	原始取得
60	晶合集成	实用新型	一种半导体的测试装置	ZL202021166959.X	2020/06/22	原始取得
61	晶合集成	实用新型	一种基板表面污染物取样装置	ZL202021248626.1	2020/06/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
62	晶合集成	实用新型	封装芯片的开封装置	ZL202021282186.1	2020/07/02	原始取得
63	晶合集成	实用新型	一种晶圆侦测设备	ZL202021283661.7	2020/07/03	原始取得
64	晶合集成	实用新型	研磨垫中心校准治具	ZL202021581370.6	2020/08/03	原始取得
65	晶合集成	实用新型	流体测量治具	ZL202021618739.6	2020/08/06	原始取得
66	晶合集成	实用新型	研磨后清洗装置和化学机械研磨设备	ZL202021645116.8	2020/08/10	原始取得
67	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202021645079.0	2020/08/10	原始取得
68	晶合集成	实用新型	一种用于化学机械研磨的清洗装置	ZL202021794843.0	2020/08/25	原始取得
69	晶合集成	实用新型	一种半导体设备	ZL202021873549.9	2020/09/01	原始取得
70	晶合集成	实用新型	进样装置	ZL202021935217.9	2020/09/03	原始取得
71	晶合集成	实用新型	晶圆表面金属离子收集装置	ZL202022409723.0	2020/10/23	原始取得
72	晶合集成	实用新型	吹气管、吹气式液位计和硅片清洗装置	ZL202022619232.9	2020/11/12	原始取得
73	晶合集成	实用新型	高度测量装置	ZL202022982757.9	2020/12/07	原始取得
74	晶合集成	实用新型	一种循环水控温装置	ZL202120383318.8	2021/02/20	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
75	晶合集成	实用新型	晶圆定位标示工具	ZL202120350044.2	2021/02/08	原始取得
76	晶合集成	实用新型	电容测试结构	ZL202023278550.X	2020/12/29	原始取得
77	晶合集成	实用新型	一种用于微光显微镜的测试夹具	ZL202022727035.9	2020/11/23	原始取得
78	晶合集成	实用新型	一种更换制程材料的防呆装置及防呆系统	ZL202120139540.3	2021/01/19	原始取得
79	晶合集成	实用新型	一种探针弯折装置	ZL202023000991.3	2020/12/11	原始取得
80	晶合集成	实用新型	一种二次离子质谱的样品装载盒	ZL202120419724.5	2021/02/25	原始取得
81	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的张力自动调控装置	ZL202120256206.6	2021/01/29	原始取得
82	晶合集成	实用新型	变容二极管	ZL202022952129.6	2020/12/08	原始取得
83	晶合集成	实用新型	超纯水取样器	ZL202120367091.8	2021/02/09	原始取得
84	晶合集成	实用新型	缺陷检测装置	ZL202121665116.9	2021/07/21	原始取得
85	晶合集成	实用新型	化学机械研磨装置	ZL202121554906.X	2021/07/08	原始取得
86	晶合集成	实用新型	涂胶机喷头位置测量装置及涂胶机	ZL202121665098.4	2021/07/21	原始取得
87	晶合集成	实用新型	套刻对准标记及掩模板组件	ZL202120925351.9	2021/04/29	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
88	晶合集成	实用新型	一种半导体设备的压力测量装置	ZL202121520685.4	2021/07/05	原始取得
89	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202010983155.7	2020/09/18	原始取得
90	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011001446.8	2020/09/22	原始取得
91	北京晶芯成	发明专利	SRAM 器件及其形成方法	ZL202010998495.7	2020/09/22	原始取得
92	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202011012426.0	2020/09/24	原始取得
93	北京晶芯成	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制作方法	ZL202011021046.3	2020/09/25	原始取得
94	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011019411.7	2020/09/25	原始取得
95	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011039422.1	2020/09/28	原始取得
96	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其形成方法	ZL202011059138.0	2020/09/30	原始取得
97	北京晶芯成	发明专利	一种金属互连结构的形成方法	ZL202011054620.5	2020/09/30	原始取得
98	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011054657.8	2020/09/30	原始取得
99	北京晶芯成	发明专利	浅沟槽隔离结构的制造方法及其形成的浅沟槽隔离结构	ZL202011069600.5	2020/10/09	原始取得
100	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆表面处理方法和表面处	ZL202011069584.X	2020/10/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			理装置			
101	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011069193.8	2020/10/09	原始取得
102	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011073751.8	2020/10/10	原始取得
103	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆背封结构及其制造方法	ZL202011084965.5	2020/10/12	原始取得
104	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法与制造系统	ZL202011081316.X	2020/10/12	原始取得
105	北京晶芯成	发明专利	测试结构及其测试方法	ZL202011106814.5	2020/10/16	原始取得
106	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106813.0	2020/10/16	原始取得
107	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011106699.1	2020/10/16	原始取得
108	北京晶芯成	发明专利	一种沟槽的形成方法	ZL202011106690.0	2020/10/16	原始取得
109	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106407.4	2020/10/16	原始取得
110	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011106406.X	2020/10/16	原始取得
111	北京晶芯成	发明专利	一种介质层缺陷检测的测试结构	ZL202011114851.0	2020/10/19	原始取得
112	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试结构	ZL202011114835.1	2020/10/19	原始取得
113	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆中心的校正方法及系统	ZL202011114387.5	2020/10/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
114	北京晶芯成	发明专利	Nor 闪存结构及其制作方法	ZL202011122506.1	2020/10/20	原始取得
115	北京晶芯成	发明专利	半导体器件	ZL202011122488.7	2020/10/20	原始取得
116	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆电性测试方法及测试设备	ZL202011121614.7	2020/10/20	原始取得
117	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136464.7	2020/10/22	原始取得
118	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法	ZL202011136463.2	2020/10/22	原始取得
119	北京晶芯成	发明专利	一种半导体装置的制备方法	ZL202011136147.5	2020/10/22	原始取得
120	北京晶芯成	发明专利	微透镜阵列的形成方法及点胶装置	ZL202011135589.8	2020/10/22	原始取得
121	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011135359.1	2020/10/22	原始取得
122	北京晶芯成	发明专利	半导体数据分析方法、系统及计算机可读存储介质	ZL202011160229.3	2020/10/27	原始取得
123	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构	ZL202011159567.5	2020/10/27	原始取得
124	北京晶芯成	发明专利	SONOS 存储器及其制造方法	ZL202011159566.0	2020/10/27	原始取得
125	北京晶芯成	发明专利	隔离结构的制作方法、DAC 器件	ZL202011159556.7	2020/10/27	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			及其制作方法			
126	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制备方法	ZL202011159377.3	2020/10/27	原始取得
127	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011176040.3	2020/10/29	原始取得
128	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011184712.5	2020/10/30	原始取得
129	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的结构及其制备方法	ZL202011207288.1	2020/11/03	原始取得
130	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制备方法	ZL202011207284.3	2020/11/03	原始取得
131	北京晶芯成	发明专利	LDMOS 晶体管及其制造方法	ZL202011206497.4	2020/11/03	原始取得
132	北京晶芯成	发明专利	MIM 电容器的制作方法	ZL202011206496.X	2020/11/03	原始取得
133	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213725.0	2020/11/04	原始取得
134	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213310.3	2020/11/04	原始取得
135	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件及其制造方法	ZL202011213304.8	2020/11/04	原始取得
136	北京晶芯成	发明专利	一种静态随机存取存储器及其制造方法	ZL202011235571.5	2020/11/09	原始取得
137	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆清洗位置的监测装置及监测方法	ZL202011235545.2	2020/11/09	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
138	北京晶芯成	发明专利	气体置换装置及光阻烘烤设备	ZL202011243682.0	2020/11/10	原始取得
139	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及其形成方法、半导体器件的测试方法	ZL202011243675.0	2020/11/10	原始取得
140	北京晶芯成	发明专利	半导体测试结构及半导体钝化层的质量测试方法	ZL202011242883.9	2020/11/10	原始取得
141	北京晶芯成	发明专利	一种半导体器件的制造方法	ZL202011251097.5	2020/11/11	原始取得
142	北京晶芯成	发明专利	一种洁净室过滤装置	ZL202011249788.1	2020/11/11	原始取得
143	北京晶芯成	发明专利	半导体隔离结构及其制作方法	ZL202011275119.1	2020/11/16	原始取得
144	北京晶芯成	发明专利	一种自动调整半导体设备平衡性的装置及方法	ZL202011283036.7	2020/11/17	原始取得
145	北京晶芯成	发明专利	一种半导体设备的报警方法	ZL202011283029.7	2020/11/17	原始取得
146	北京晶芯成	发明专利	功率半导体器件及制造方法	ZL202011333530.X	2020/11/25	原始取得
147	北京晶芯成	发明专利	一种光学邻近校正模型的建模方法及建模系统	ZL202011359576.9	2020/11/27	原始取得
148	北京晶芯成	发明专利	半导体生产过程中的参数监控方法、系统及计算	ZL202011367625.3	2020/11/30	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			机可读存储介质			
149	北京晶芯成	发明专利	半导体产品的良率分析方法及良率分析系统	ZL202011384551.4	2020/12/02	原始取得
150	北京晶芯成	发明专利	一种晶圆失效的分析方法及系统	ZL202011419830.X	2020/12/08	原始取得
151	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011424911.9	2020/12/09	原始取得
152	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202011565146.2	2020/12/25	原始取得
153	北京晶芯成	发明专利	一种曝光位置的确定方法及系统	ZL202011579234.8	2020/12/28	原始取得
154	北京晶芯成	发明专利	半导体存储器件	ZL202011572842.6	2020/12/28	原始取得
155	北京晶芯成	发明专利	ESD 保护电路、ESD 保护结构及其制造方法	ZL202110010268.3	2021/01/06	原始取得
156	北京晶芯成	发明专利	半导体器件的形成方法	ZL202110010266.4	2021/01/06	原始取得
157	北京晶芯成	发明专利	化学机械研磨方法	ZL202110051576.0	2021/01/15	原始取得
158	北京晶芯成	发明专利	一种集成半导体器件	ZL202110248935.1	2021/03/08	原始取得
159	北京晶芯成	发明专利	静态随机存储器的制备方法	ZL202110252700.X	2021/03/09	原始取得
160	北京晶芯成	发明专利	一种化学机械研磨方法及其分析系统	ZL202110281539.9	2021/03/16	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
161	北京晶芯成	发明专利	一种半导体元件的制造方法	ZL202110306176.X	2021/03/23	原始取得
162	北京晶芯成	发明专利	半导体器件及其制造方法	ZL202110397617.1	2021/04/14	原始取得
163	北京晶芯成	发明专利	3D 半导体器件及其形成方法	ZL202110574826.9	2021/05/26	原始取得
164	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构的制造方法	ZL202110816834.X	2021/07/20	原始取得
165	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202110575021.6	2021/05/26	原始取得
166	北京晶芯成	发明专利	一种电介质击穿测试电路及其测试方法	ZL202110421520.X	2021/04/20	原始取得
167	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202011106408.9	2020/10/16	原始取得
168	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构的制备方法	ZL202110252703.3	2021/03/09	原始取得
169	北京晶芯成	发明专利	一种 LDMOS 晶体管及其形成方法	ZL202110921916.0	2021/08/12	原始取得
170	北京晶芯成	发明专利	沟槽隔离结构及其制备方法	ZL202110921908.6	2021/08/12	原始取得
171	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111036002.2	2021/09/06	原始取得
172	北京晶芯成	发明专利	一种半导体结构及其制造方法	ZL202111103889.2	2021/09/22	原始取得
173	南京晶驱	发明专利	晶圆裂片方法及其应用	ZL202010931740.2	2020/09/08	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
174	南京晶驱	发明专利	一种检测半导体设备检测感度的方法和检测系统	ZL202010938526.X	2020/09/09	原始取得
175	南京晶驱	发明专利	一种光阻层阻挡能力的检测方法及检测系统	ZL202010937768.7	2020/09/09	原始取得
176	南京晶驱	发明专利	一种半导体器件制造方法	ZL202010938519.X	2020/09/09	原始取得
177	南京晶驱	发明专利	刻蚀方法	ZL202010998512.7	2020/09/22	原始取得
178	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011005773.0	2020/09/23	原始取得
179	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽结构制备方法	ZL202011012959.9	2020/09/24	原始取得
180	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制作方法	ZL202011013439.X	2020/09/24	原始取得
181	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202010937769.1	2020/09/09	原始取得
182	南京晶驱	发明专利	一种半导体结构的制备方法	ZL202011021798.X	2020/09/25	原始取得
183	南京晶驱	发明专利	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	ZL202011019947.9	2020/09/25	原始取得
184	南京晶驱	发明专利	半导体结构的制造方法	ZL202011019302.5	2020/09/25	原始取得
185	南京晶驱	发明专利	电容器及其制备方法	ZL202011037143.1	2020/09/28	原始取得
186	南京晶驱	发明专利	一种静电放电防护线路	ZL202011099926.2	2020/10/15	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
187	南京晶驱	发明专利	半导体器件的制备方法	ZL202011093528.X	2020/10/14	原始取得
188	南京晶驱	发明专利	一种版图边界图案的修正方法与修正系统	ZL202011095237.4	2020/10/14	原始取得
189	南京晶驱	发明专利	MOS 晶体管及其制造方法	ZL202011093599.X	2020/10/14	原始取得
190	南京晶驱	发明专利	电容的测量结构及测量方法	ZL202011093598.5	2020/10/14	原始取得
191	南京晶驱	发明专利	一种光刻图形的仿真方法及仿真系统	ZL202011135351.5	2020/10/22	原始取得
192	南京晶驱	发明专利	图形显影情况的检测方法	ZL202011189007.4	2020/10/30	原始取得
193	南京晶驱	发明专利	光强阈值的获取方法以及辅助图形显影情况的检测方法	ZL202011185018.5	2020/10/30	原始取得
194	南京晶驱	发明专利	辅助图形的添加方法、装置及测试版图	ZL202110492632.4	2021/05/07	原始取得
195	南京晶驱	发明专利	光学临近修正方法、装置及电子设备	ZL202110754593.0	2021/07/05	原始取得
196	南京晶驱	发明专利	光学邻近修正模型的建模方法	ZL202110951888.7	2021/08/19	原始取得
197	南京晶驱	发明专利	预测图形桥联的方法、装置及电	ZL202110951881.5	2021/08/19	原始取得

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			子设备			
198	南京晶驱	发明专利	一种光学临近效应的修正方法及系统	ZL202110816830.1	2021/07/20	原始取得

4、境外专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
1	晶合有限	发明专利	Method of forming stepped contact trench for semiconductor devices	US 6,583,055 B1	2002/01/25	继受取得	美国
2	晶合有限	发明专利	Method for automatically controlling defect - specification in a semiconductor manufacturing process	US 6,807,454 B2	2003/03/17	继受取得	美国
3	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device with formation of a heavily doped region by implantation through an insulation layer	US 6,670,254 B1	2002/10/01	继受取得	美国
4	晶合有限	发明专利	Semiconductor device formed on silicon-on-insulator substrate	US 6,828,633 B2	2003/02/26	继受取得	美国
5	晶合有限	发明专利	Silicon-on-insulator device structure	US 7,019,582 B2	2004/09/29	继受取得	美国
6	晶合有限	发明专利	Method for producing a gate	US 6,699,755 B1	2003/03/24	继受取得	美国
7	晶合有限	发明专利	Half-tone phase shift mask and patterning method using thereof	US 7,461,472 B2	2003/06/16	继受取得	美国
8	晶合有限	发明专利	Method of improving a resolution of contact hole patterns by utilizing alternate phase shift principle	US 7,008,733 B2	2003/09/25	继受取得	美国
9	晶合有限	发明专利	Re-performable spin-on process	US 6,881,590 B2	2003/08/25	继受取得	美国
10	晶合有限	发明专利	Method for fabricating a through hole on a semiconductor	US 6,995,086 B2	2004/06/28	继受取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			substrate				
11	晶合有限	发明专利	Method for forming a titanium nitride layer	US 7,030,015 B2	2004/09/16	继受取得	美国
12	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing semiconductor device	US 7,056,787 B2	2005/01/12	继受取得	美国
13	晶合有限	发明专利	Method of forming contact hole and method of fabricating semiconductor device	US 7,098,124 B2	2005/05/31	继受取得	美国
14	晶合有限	发明专利	Semiconductor device having self-aligned contact	US 7,612,433 B2	2005/09/21	继受取得	美国
15	晶合有限	发明专利	Manufacturing method of semiconductor device having self-aligned contact	US 7,803,692 B2	2009/09/18	继受取得	美国
16	晶合有限	发明专利	Method of fabricating conductive lines with silicide layer	US 7,550,372 B2	2005/08/29	继受取得	美国
17	晶合有限	发明专利	Method for forming buried doped region	US 7,465,632 B2	2005/10/28	继受取得	美国
18	晶合有限	发明专利	Method of manufacturing self-aligned contact openings	US 7,429,527 B2	2007/09/11	继受取得	美国
19	晶合有限	发明专利	Method of fabricating semiconductor device	US 7,268,055 B2	2005/11/07	继受取得	美国
20	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing gate dielectric layer	US 7,273,787 B2	2005/11/18	继受取得	美国
21	晶合有限	发明专利	Method for forming contact window	US 8,722,538 B2	2012/09/12	继受取得	美国
22	晶合有限	发明专利	Method for manufacturing semiconductor device	US 8,822,303 B2	2012/09/15	继受取得	美国
23	晶合有限	发明专利	SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	US10,636,801 B2	2018/11/25	原始取得	美国
24	晶合有限	发明专利	METHOD OF	US10,490,647	2018/08/31	原始	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			FORMING METAL SILICIDE LAYER, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING SAME	B1		取得	
25	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY CELL, ARRAY AND FABRICATION METHOD	US10,726,894 B2	2018/11/25	原始取得	美国
26	晶合有限	发明专利	SILICON ISLAND STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING SAME	US 10,490,441 B1	2018/10/18	原始取得	美国
27	晶合有限	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US 10,854,758 B2	2019/02/18	原始取得	美国
28	晶合集成	发明专利	Pre-processing method, method for forming metal silicide and semiconductor processing apparatus	US10,916,417B2	2020/06/16	原始取得	美国
29	晶合集成	发明专利	METHOD OF FABRICATING MOSFET	US10,957,776B2	2020/05/21	原始取得	美国
30	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	US10,930,545B2	2019/06/27	原始取得	美国
31	晶合集成	发明专利	CURRENT SOURCE USING EMITTER REGION AS BASE REGION ISOLATION STRUCTURE	US10,950,601B2	2019/04/15	原始取得	美国
32	晶合集成	发明专利	MOSFET AND METHOD OF FABRICATING SAME	US10,971,595B2	2018/12/17	原始取得	美国
33	晶合集成	发明专利	DIFFUSED FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND METHOD OF	US11,024,722B1	2020/03/25	原始取得	美国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			FABRICATING SAME				
34	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US10,916,664B2	2020/09/19	原始取得	美国
35	晶合集成	发明专利	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND METHOD OF FORMING SAME	US11,069,559B1	2020/06/22	原始取得	美国
36	晶合集成	发明专利	METHOD FOR FABRICATING SPLIT-GATE NON-VOLATILE MEMORY	US11,088,155B2	2020/03/18	原始取得	美国
37	晶合集成	发明专利	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME	US11,049,947B2	2019/11/07	原始取得	美国
38	晶合集成	发明专利	以交替式相位移原理改善接触洞图案解析度之方法	I313889	2003/07/21	继受取得	中国台湾
39	晶合集成	发明专利	制作通孔的方法	I240988	2004/01/07	继受取得	中国台湾
40	晶合集成	发明专利	浅沟渠隔离结构的制造方法	I234228	2004/05/12	继受取得	中国台湾
41	晶合集成	发明专利	具有自行对准接触窗之半导体元件及其制造方法	I254409	2005/02/16	继受取得	中国台湾
42	晶合集成	发明专利	导线的制造方法	I254365	2005/01/27	继受取得	中国台湾
43	晶合集成	发明专利	自行对准接触窗开口的制作方法	I301997	2005/06/17	继受取得	中国台湾
44	晶合集成	发明专利	半导体元件及其制造方法	I267190	2005/08/29	继受取得	中国台湾
45	晶合集成	发明专利	隔离结构的制造方法	I300968	2006/06/28	继受取得	中国台湾
46	晶合集成	发明专利	光罩复验方法与系统	I305004	2006/07/17	继受取得	中国台湾
47	晶合集成	发明专利	管制规格界限之制定方法	I305838	2006/09/29	继受取得	中国台湾
48	晶合集成	发明专利	分离闸极快闪记忆体	I301982	2006/09/28	继受	中国

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式	国家/地区
			的故障检测方法			取得	台湾
49	晶合集成	发明专利	接触窗的形成方法	I473206	2012/07/03	继受取得	中国台湾
50	晶合集成	发明专利	半导体元件的制造方法	I464831	2012/06/27	继受取得	中国台湾
51	晶合集成	发明专利	分栅式非挥发性记忆体及其制备方法	I720350	2018/10/09	原始取得	中国台湾
52	晶合集成	发明专利	预处理方法、金属硅化物的形成方法以及半导体处理装置	I739473	2020/06/11	原始取得	中国台湾
53	晶合集成	发明专利	ラッチ回路	特许第 6761074 号	2019/05/21	原始取得	日本
54	晶合集成	发明专利	SRAM、半導体集積回路及び LCD ドライバ	特许第 6801053 号	2019/06/19	原始取得	日本
55	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6831067 号	2019/04/25	原始取得	日本
56	晶合集成	发明专利	半導体素子の製造方法	特许第 6826795 号	2019/01/09	原始取得	日本
57	晶合集成	发明专利	高耐圧半導体素子及びその製造方法	特许第 6892889 号	2019/04/15	原始取得	日本
58	晶合集成	发明专利	容量性半導体素子	特许第 6918173 号	2020/04/23	原始取得	日本